

创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

北京君正集成电路股份有限公司

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

(北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A 座 108 室)



首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



(山东省济南市经十路 20518 号)

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
本次拟发行股数	2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	[]元，通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期	[]年[]月[]日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	8,000 万元
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	<p>公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>实际控制人刘强之弟刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>盈富泰克创业投资有限公司、张紧、洗永辉、姜君、许志鹏、晏晓京、赵明漪、鹿良礼、张燕祥、张敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>除前述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张紧、洗永辉、姜君、晏晓京、张燕祥、张敏、刘飞还承诺：在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；离职半年</p>

	后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。
保荐机构（主承销商）	齐鲁证券有限公司
招股说明书签署日期	二〇一〇年[]月[]日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、股份锁定承诺

公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人刘强之弟刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

盈富泰克创业投资有限公司、张紧、洗永辉、姜君、许志鹏、晏晓京、赵明漪、鹿良礼、张燕祥、张敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除前述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张紧、洗永辉、姜君、晏晓京、张燕祥、张敏、刘飞还承诺：在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。

二、滚存利润分配方案

公司于2010年2月24日召开2009年度股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润分配的方案，同意公司首次公开发行股票完成后，本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

1、保持持续创新能力的风险

本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内外领先的32位嵌入式CPU芯片供应商，在自主创新CPU内核、多媒体技术、SoC芯片技术、功耗和电源管理技术、软件平台技术等5大领域形成了15项核心技术。通过持续的技术创新，公司已经在便携消费电子、教育电子应用领域取得了领先的市场优势。在集成电路设计行业，技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。未来如何保持持续的技术创新能力是公司面临的重大风险。

2、核心技术泄密风险

公司处于集成电路设计行业，主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。本公司的核心技术均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

3、核心技术被替代的风险

目前，公司在CPU内核、功耗和电源管理技术、软件平台技术等核心领域的技术均处于国内领先水平或国际先进水平。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，存在公司现有技术被其他新技术替代，从而导致公司丧失竞争优势，对本公司的生产经营造成不利影响的风险。

4、成长性风险

公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的领域。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，在便携消费电子、教育电子应用领域的市场竞争力优势明显，市场占有率稳步提高，具备高成长性。报告期内，公司业绩持续快速增长，2008年和2009年营业收入分别较上年增长了321.54%和32.71%，净利润分别较上年增长了809.13%和51.50%。但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或产业政策等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

5、人力资源风险

集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。根据公司未来的战略规划，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还将进一步增加。如果公司不能建立完善的员工激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

6、募集资金投资项目的市场风险

公司本次募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家产业政策，均具有良好的市场前景。但是，面向便携消费电子、教育电子和移动互联网终端设备应用领域的新一代嵌入式CPU芯片的研发和市场推广，面临着技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定性。如果公司推出的新产品其性能和价格无法满足市场需求，将可能导致募集资金投资项目的效益不能如期实现。

7、募集资金投资项目实施新增折旧、摊销及研发支出导致业绩下滑的风险

受现有资本实力限制，公司目前固定资产规模及年均研发支出相对较小。根

据募集资金可行性研究报告及公司会计政策，募集资金投资项目实施当年及其后四年将分别增加固定资产折旧、摊销及研发支出合计4,295.83万元、5,570.46万元、1,958.96万元、1,958.96万元和1,958.96万元。

尽管公司充分考虑了各种内外部因素对募集资金投资项目效益的影响，并对募集资金投资项目进行了可行性研究，论证结果也显示公司本次募集资金投资项目的总体经济效益良好，足以抵销新增折旧、摊销及研发支出对公司经营业绩带来的压力。但下游电子产品市场环境变化较快，如果公司本次募集资金投资项目研发的新产品无法满足目标市场的需求，无法实现预期效益，新增折旧、摊销及研发支出将对公司未来业绩造成不利影响。

目 录

释 义	13
一、一般释义	13
二、专业术语释义	16
第一节 概 览	19
一、发行人简介	19
二、控股股东及实际控制人简介	20
三、主要财务数据	20
四、本次发行情况	22
五、募集资金用途	23
六、发行人核心竞争优势	24
第二节 本次发行概况	26
一、发行人基本情况	26
二、本次发行的基本情况	26
三、本次发行的有关当事人	27
四、预计发行上市的重要日期	29
第三节 风险因素	30
一、保持持续创新能力的风险	30
二、核心技术泄密风险	30
三、核心技术被替代的风险	31
四、成长性风险	31
五、人力资源风险	31
六、募集资金投资项目的市场风险	32
七、募集资金投资项目实施新增折旧、摊销及研发支出导致业绩下滑的风险	32
八、知识产权风险	32
九、市场风险	33
十、管理风险	33
十一、税收优惠政策变化的风险	33
十二、供应商和客户较为集中的风险	34
十三、净资产收益率下降的风险	35
十四、产业政策变化的风险	35

第四节 发行人基本情况	36
一、发行人改制重组及设立情况	36
二、发行人设立以来的重大资产重组情况	40
三、发行人的组织结构	41
四、发行人控股、参股公司情况	43
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	47
六、发行人股本情况	56
七、员工及其社会保障情况	61
八、实际控制人、股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺	65
第五节 业务和技术	67
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况	67
二、发行人所处行业的基本情况	69
三、发行人在行业中的竞争地位	89
四、发行人主营业务情况	95
五、主要固定资产和无形资产	115
六、公司主要产品核心技术情况	120
七、公司技术储备情况	129
八、技术创新机制	130
九、核心技术人员及研发人员情况	132
十、公司资质、重要科研成果和获奖情况	133
十一、香港子公司经营情况	135
第六节 同业竞争与关联交易	138
一、同业竞争	138
二、关联方及其关联方关系	139
三、关联交易	140
四、规范关联交易的制度安排	142
五、关联交易的执行情况及独立董事意见	143
第七节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员	145
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况	145
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况	149
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员发行前对外投资情况	151
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况	151
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况	152

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系	153
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议	153
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺	154
九、董事、监事、高级管理人员的任职资格	154
十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因	154
第八节 公司治理	156
一、发行人公司治理制度的建立健全及运行情况	156
二、发行人近三年违法违规行为情况	169
三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况	169
四、发行人内部控制情况	169
五、发行人对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况	170
六、发行人投资者权益保护情况	172
第九节 财务会计信息与管理层分析	174
一、财务报表	174
二、审计意见	189
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况	189
四、主要会计政策和会计估计	190
五、税项情况	210
六、主要财务指标	211
七、资产评估情况	213
八、历次验资情况	214
九、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项	216
十、财务状况分析	216
十一、盈利能力分析	231
十二、现金流量分析	245
十三、资本性支出分析	248
十四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析	248
十五、股利分配政策	249
第十节 募集资金运用	252
一、募集资金运用计划	252
二、募集资金项目概述	255
三、固定资产投资和研发支出的必要性	275
四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响	277
第十一节 未来发展与规划	280

一、公司发行当年和未来三年的发展规划及发展目标.....	280
二、本次募集资金运用对发行人未来发展以及增强成长性和自主创新的影响.....	285
三、发展规划和目标的假设条件与面临的主要困难.....	286
四、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系.....	288
五、公司关于公告规划实施和目标实现情况的声明.....	288
第十二节 其他重要事项.....	289
一、重大合同.....	289
二、对外担保事项.....	293
三、重大诉讼或仲裁事项.....	293
第十三节 有关声明.....	294
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	294
二、保荐机构（主承销商）声明.....	296
三、发行人律师声明.....	297
四、审计机构声明.....	298
五、资产评估机构声明.....	299
六、验资机构声明.....	300
第十四节 附件.....	301
一、备查文件.....	301
二、备查地点、时间.....	301
三、信息披露网址.....	302

释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义

北京君正、公司、本公司、股份公司、发行人	指	北京君正集成电路股份有限公司
君正有限	指	北京君正集成电路有限公司，本公司的前身
香港君正集团	指	北京君正集成电路（香港）集团有限公司，本公司的子公司
君正时代	指	深圳君正时代集成电路有限公司，本公司的子公司
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司，本公司的股东之一
ARM	指	ARM Ltd.，一家全球知名的半导体知识产权供应商，主要提供 CPU 内核 IP，不制造和销售实际的半导体芯片
MIPS	指	MIPS Technologies, Inc.，一家全球知名的 CPU 架构及内核供应商，主要提供 CPU 架构及 CPU 内核 IP
Marvell	指	Marvell Technology Group Ltd.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
SiRF	指	SiRF Technology, Inc.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
三星半导体	指	SAMSUNG Semiconductor, Inc.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
高通	指	Qualcomm Corporation，一家全球知名的集成电路设计企业，专注于无线通讯领域的芯片设计

联发科、MTK	指	联发科技股份有限公司，一家全球知名的集成电路设计企业，专注于无线通讯及数码多媒体等领域的芯片设计
德州仪器、TI	指	Texas Instruments, Inc.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
意法半导体、ST	指	STMicroelectronics，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
飞思卡尔	指	Freescale Semiconductor, Inc.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
瑞芯微	指	福州瑞芯微电子有限公司，一家国内的集成电路设计企业，专注于数字音视频、移动多媒体等领域的芯片设计
海思	指	深圳市海思半导体有限公司，一家国内的集成电路设计企业，产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域
凌阳科技	指	凌阳科技股份有限公司，一家台湾地区的集成电路设计企业，专注于便携消费电子、数码家电等领域的芯片设计
安凯技术	指	Anyka Technologies Corporation（安凯技术公司），一家集成电路设计企业，专注于便携消费电子、教育电子等领域的芯片设计
矽创电子	指	矽创电子股份有限公司，一家台湾地区的集成电路设计企业，专注于便携消费电子、教育电子等领域的芯片设计
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司，一家全球知名的晶圆制造企业
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司，我国大陆最大的晶圆制造企业
安靠公司	指	安靠封装测试（上海）有限公司，美国Amkor Technology（简称“安靠科技”）在中国的子公司
通富微电	指	南通富士通微电子股份有限公司，一家封装测试企业
步步高	指	东莞市步步高教育电子产品有限公司

诺亚舟	指	诺亚舟教育控股有限公司
爱国者	指	北京华旗资讯数码科技有限公司
深圳中控	指	深圳市中控生物识别技术有限公司
香港东宏	指	香港东宏电子贸易有限公司
赛迪顾问、CCID	指	赛迪顾问股份有限公司，一家国内信息产业领域的专业咨询公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	齐鲁证券有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
兴华事务所、审计机构、申报会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
近三年一期、报告期	指	2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-6 月
元	指	人民币元
本次发行	指	公司本次向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行有效的章程
《公司章程（草案）》	指	公司 2009 年度股东大会通过的《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》

二、专业术语释义

CPU	指	Central Processing Unit 中央处理器
32 位嵌入式 CPU 芯片、嵌入式 CPU、处理器	指	相对于通用 CPU 而言应用于嵌入式系统的微处理器，其系统通常不表现为计算机形态
IP、IP 核	指	Intellectual Property 的缩写，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
CPU 内核	指	CPU IP Core，以 IP 模块的形式存在的中央处理器，可以被集成到 SoC 芯片中
XBurst	指	由公司自主创新的一种 32 位嵌入式 CPU 技术的统称，包括指令集、CPU 内核
多核技术	指	指在一颗 CPU 芯片中集成两个或多个完整的运算处理内核，比如 CPU 内核
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
SoC	指	System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
SoC 技术	指	完成 SoC 芯片设计整个过程中所涵盖的技术，主要包括系统功能划分及架构设计、软/硬件功能划分和设计等相关技术
视频引擎	指	芯片内部专门用于视频处理的单元模块
DSP	指	Digital Signal Processor 的缩写，即一种数字信号处理运算的微处理器
SIMD	指	Single Instruction Multiple Data 的缩写，即单指令多数据流，可以有效增强多媒体处理效率的扩展指令集
RISC	指	Reduced Instruction Set Computing 的缩写，即精简指令集，其指令集系统相对简单
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件

HDMI	指	High Definition Multimedia Interface 的缩写，即高清晰度多媒体接口，可以高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据，可以保证最高质量的影音信号传送
EDA	指	Electronic Design Automation 的缩写，即电子设计自动化软件工具
EPD	指	Electro-Phoretic Display 的缩写，指电泳显示技术或电泳显示器，俗称电子纸
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
掩膜	指	又称 Mask、光罩、光掩膜，即半导体制造中用于光刻技术的图形“底片”，通常为制造流程中造价最高的部分
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即垂直整合制造模式，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
Turnkey 整体解决方案、整体解决方案	指	交钥匙方案，即完整且可立即使用的方案
PMP	指	Portable Media Player 的缩写，即便携式媒体播放器，一种能够随身携带，具备播放音频、视频，显示图片、文字功能的电子产品
PND	指	Portable Navigation Device 的缩写，即便携式自动导航设备，一种能够随身携带，具备 GPS 定位、导航功能的电子产品
GPS	指	Global Positioning System 的简称，即全球定位系统
MID	指	Mobile Internet Devices 的缩写，移动互联网设备，其尺寸和性能通常介于手机和上网本之间
便携消费电子	指	PMP（MP4/MP5）、PND、掌上游戏机、数码相框等便携消费电子产品

便携教育电子	指	学习机、点读机、电子词典、电子书等便携教育电子产品
移动互联网终端	指	智能手机、平板电脑、上网本、MID 等便携上网设备
便携消费电子 CPU 芯片、便携式消费电子产品用多媒体处理器	指	应用于便携消费电子产品的嵌入式 CPU 芯片
便携教育电子 CPU 芯片、便携式教育电子产品用嵌入式处理器	指	应用于便携教育电子产品的嵌入式 CPU 芯片
移动互联网终端 CPU 芯片、移动互联网终端用应用处理器	指	应用于移动互联网终端的嵌入式 CPU 芯片
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，即集成电路设计技术每 18 个月就更新换代一次
一代拳王	指	集成电路设计行业的一种现象，即当前的市场领导者很难持久地保持领导地位，往往被后来的公司所超越
Wi-Fi、WIFI	指	基于 IEEE 802.11 标准的无线网络技术
μm	指	微米，长度单位，1 微米=0.001 毫米
nm	指	纳米，长度单位，1 纳米=0.001 微米
ISO9001	指	由国际标准化组织发布的“质量管理体系要求”标准

本招股说明书中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

第一节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）公司概况

本公司系由君正有限以截至2009年10月31日经审计账面净资产折股整体改制、变更设立的股份有限公司。2009年12月24日，公司在北京市工商局登记注册，注册登记号为110108008639445，注册资本为6,000万元。公司发起人为：刘强、李杰、盈富泰克、张紧、冼永辉、姜君、刘飞、许志鹏、晏晓京、赵明漪、鹿良礼、张燕祥、张敏。

（二）主营业务

公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。公司产品主要应用于移动便携设备领域，如便携消费电子、便携教育电子、移动互联网终端设备等细分市场。

（三）经营情况

公司自成立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内外领先的32位嵌入式CPU芯片供应商，是掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一。公司拥有很强的自主创新能力、具备高成长性，并形成可持续发展的梯队化产品布局。在便携消费电子、教育电子应用领域的市场竞争力优势明显，市场占有率稳步提高。

1、公司具有很强的自主创新能力

公司现为高新技术企业，在关键技术上自主研发，已在自主创新CPU内核、

多媒体技术、SoC芯片技术、功耗和电源管理技术、软件平台技术等5大领域形成了15项核心技术。2008年，公司产品JZ4740分别被中国半导体行业协会和北京市科学技术委员会评为“第三届（2008年度）中国半导体创新产品和技术”和“北京市自主创新产品”；2009年，公司被科学技术部、中国科学院、北京市人民政府认定为“中关村国家自主创新示范区创新型试点企业”。

2、公司具有高成长性

近年来，公司采用“开放平台、纵横扩展”的市场推广策略，CPU芯片产品先后进入指纹识别、学习机、点读机、电子词典、PMP、电子书、上网本、学生电脑等多个细分领域。目前公司已经成为我国应用领域最广、出货量最大的本土嵌入式CPU芯片提供商。2009年，公司芯片产品荣获工信部软件与集成电路促进中心颁布的“2009年度‘中国芯’最佳市场表现奖”；2010年，公司被中国半导体行业协会评为“2009年中国最具成长性集成电路设计企业”。

报告期内，本公司业绩持续快速增长，2008年和2009年营业收入分别较上年增长了321.54%和32.71%，净利润分别较上年增长了809.13%、51.50%。展望未来，随着公司逐步进入移动互联网终端设备领域，公司将具有更大的成长空间。

二、控股股东及实际控制人简介

发行人控股股东暨实际控制人为刘强和李杰。刘强和李杰为公司创始人，也是一致行动人，合计持有公司股份30,092,633股，占公司发行前总股本的50.15%。有关刘强和李杰的情况详见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

三、主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	184,951,561.97	183,117,670.03	111,980,576.93	27,640,181.68
资产总额	186,529,528.09	185,312,636.78	114,086,048.75	28,610,276.30
流动负债	28,487,344.16	76,130,164.37	41,757,379.32	4,824,388.91
负债总额	30,987,344.16	79,630,164.37	43,257,379.32	4,824,388.91
股东权益	155,542,183.93	105,682,472.41	70,828,669.43	23,785,887.39
其中：归属于母公司 股东权益合计	155,542,183.93	105,682,472.41	70,828,669.43	23,785,887.39

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	112,760,420.16	192,224,959.66	144,842,154.53	34,360,258.98
营业利润	47,548,223.30	77,514,188.42	56,827,530.95	5,845,282.21
利润总额	54,730,184.82	79,520,406.83	56,729,535.95	5,850,532.23
净利润	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
其中：归属于母公司 所有者净利润	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
扣除非经常损益后 归属于母公司所有 者净利润	48,915,336.15	67,791,648.20	46,207,112.14	1,151,990.96

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的 现金流量净额	58,627,372.28	55,467,600.88	47,467,788.41	-1,356,082.13
投资活动产生的 现金流量净额	-621,872.33	-24,257,997.55	-854,364.32	-66,768.24
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,423,832.50	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
现金及现金等价 物净增加额	22,517,838.74	46,158,205.59	45,948,495.56	5,411,598.93

（四）主要财务指标

财务指标	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
流动比率（倍）	6.49	2.41	2.68	5.73
速动比率（倍）	5.70	1.93	1.99	4.30
资产负债率（%，合并）	16.61	42.97	37.92	16.86
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.59	1.76	10.19	3.81
财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率（次）	34.36	255.50	216.98	509.80
存货周转率（次）	1.59	2.40	3.94	5.40
息税折旧摊销前利润（元）	55,416,252.19	79,949,560.24	57,069,348.38	6,146,747.40
归属于母公司股东的净利润（元）	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	48,915,336.15	67,791,648.20	46,207,122.14	1,151,990.96
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.9771	0.9245	0.7911	-0.0251
每股净现金流量（元/股）	0.3753	0.7693	0.7658	0.1003
全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	31.45	64.15	65.24	4.84
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	37.44	67.83	98.26	8.04
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.8153	1.1299	0.8330	0.0350
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.8153	1.1299	0.8330	0.0350

四、本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行股数：2,000万股

4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

6、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股（A股）股东账户且根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）

7、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销

五、募集资金用途

公司拟公开发行2,000万股，所募集资金全部用于主营业务，将进一步提高公司核心竞争力。按项目轻重缓急程度排列，本次募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	投资时间计划		项目备案文件编号
			第一年	第二年	
1	便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	8,721	5,093	3,628	京海淀发改(备)[2010]22号
2	便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	8,165	4,675	3,490	京海淀发改(备)[2010]23号
3	移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	12,387	8,168	4,219	京海淀发改(备)[2010]24号
4	研发中心建设项目	3,388	3,388	-	京海淀发改(备)[2010]25号
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-

若实际募集资金净额与项目总投资之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。

为及时把握市场机遇，募集资金到位之前，公司可先自筹适当资金投入上述项目，待募集资金到位后以募集资金置换先期自筹投入的资金。

六、发行人核心竞争优势

（一）核心技术优势

公司拥有国际领先的自主创新 XBurst CPU 核心技术。XBurst CPU 指令集架构在业界成熟技术的基础上进一步创新，综合了 RISC 指令和 SIMD 指令的优势，兼具计算、多媒体加速和信号处理能力；在 CPU 内核设计上引入创新因素，使得 CPU 能够在极低的功耗下高速发射指令。综合客户应用及公司测试表明，XBurst CPU 内核在相同工艺下，主频约为同类产品的 1.5 倍，面积约为同类产品的 1/2，功耗约为同类产品的 1/4。

CPU 内核设计复杂、技术含量高，大部分芯片厂商购买 CPU 知识产权供应商 ARM、MIPS 的 CPU IP 内核进行芯片设计，只有 Marvell、高通、Broadcom 等少数国际知名企业通过取得指令集架构授权再自主设计内核。本公司的 XBurst CPU 内核自主设计，是世界上少数成功量产的 CPU 内核之一。

CPU 是所有 SoC 芯片的基础，掌握了 CPU 内核技术意味着公司在核心技术上不受制于他人，避免了本行业中因为普遍采用 ARM、MIPS 内核而导致的芯片产品同质化现象。此外，掌握了 CPU 核心技术意味着占据了产业的制高点，公司能够根据市场的变化和趋势，及时推出符合市场需求的创新产品，不断拓展新的应用领域。

（二）产品优势

自主创新的 CPU 技术使公司芯片产品具有突出的优势，具体表现在公司产品的性价比和功耗指标远远领先于同类产品。

高性价比使公司产品在市场上具有非常强的竞争性，使得公司在短短三年之内迅速进入多个市场领域并且取得了较高的占有率。

低功耗优势使公司芯片产品在移动便携设备市场具有天然的优势。与桌面设备不同，移动便携设备采用电池供电，便携性、续航时间成为衡量产品优劣的重要指标。今天，全世界的处理器厂商包括 Intel 都在为降低处理器的功耗努力。公司产品的低功耗优势迎合了产业发展的趋势，成为市场竞争中独特的力量。

（三）开放平台的市场策略优势

公司根据嵌入式 CPU 芯片及目标市场的特点，制订了“开放平台、纵横扩展”的市场推广策略。与国内大量集成电路设计企业仅提供芯片的 Turnkey 整体解决方案不同，公司一方面对市场容量大、产品功能相对专一（如 PMP、智能手机、平板电脑等）的垂直市场提供芯片 Turnkey 整体解决方案，以方便客户快速将终端产品推向市场，及时抓住市场机遇；另一方面，针对其他市场领域开放芯片技术资料、提供操作系统软件平台，以方便客户自行进行二次开发，显著地扩大了公司产品的应用领域。

上述策略有效地支持了公司的市场拓展，使公司的产品既可以快速抢占 PMP 等垂直市场，也可以广泛应用于各种学习机、电子书、指纹识别等横向市场，通过点、面的有机结合，大大增强了公司的市场竞争力，为公司进军不同的应用领域奠定了坚实的基础。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：北京君正集成电路股份有限公司
英文名称：Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
- 2、注册资本：6,000万元
- 3、法定代表人：刘强
- 4、有限公司成立日期：2005年7月15日
股份公司成立日期：2009年12月24日
- 5、住 所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座108室
邮政编码：100193
- 6、联系电话：010-82825005
传 真：010-82825845
- 7、互联网网址：www.ingenic.cn
- 8、电子信箱：investors@ingenic.cn
- 9、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
负责人：张敏
电话号码：010-82825005

二、本次发行的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行股数：2,000万股，占发行后总股本的比例为25%
- 4、每股发行价格：[]元，通过向询价对象询价确定发行价格
- 5、发行市盈率：
[]倍（按照2009年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行前总股本计算）

[]倍（按照2009年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）

6、发行前每股净资产：2.5924（以2010年6月30日经审计的净资产除以发行前股本计算）

发行后每股净资产：[]元（以2010年6月30日经审计的净资产和实际募集资金合计额除以发行后股本计算）

7、发行市净率：[]倍（以每股发行价格除以发行前每股净资产值计算）

[]倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产值计算）

8、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

9、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股（A股）股东账户且根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）

10、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销

11、募集资金总额：[]万元

12、募集资金净额：[]万元

13、发行费用概算：

发行费用主要包括：（1）保荐费[]万元；

（2）承销费[]万元；

（3）审计及验资费[]万元；

（4）律师费用[]万元；

（5）发行手续费用 []万元。

三、本次发行的有关当事人

1、保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：山东省济南市经十路20518号

联系电话：0755-82792736

传 真：0755-82792736

保荐代表人：陈正旭、邹维刚

项目协办人：孔少锋

项目经办人：梁葳、李竹青、王巍、张建芳、于桂添、宋璇

2、律师事务所：北京市中伦律师事务所

负 责 人：张学兵

住 所：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

联系电话：0755-33256666

传 真：0755-33206888

经 办 律 师：任理峰、许志刚、谢珊

3、会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：王全洲

住 所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层（总部）

联系电话：010-82250666

传 真：010-82250851

经办会计师：谭红旭、傅映红

4、资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司

法定代表人：曹宇

住 所：北京海淀区苏州街49号

联系电话：010-62520868

传 真：010-62536723

经办评估师：赵升平、汤淑娟

5、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地 址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：0755-25938000

传 真：0755-25988122

6、收款银行：

地 址：

联 系 电 话：

传 真：

公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、预计发行上市的重要日期

1、刊登发行公告的日期： 年 月 日

2、开始询价推介的日期： 年 月 日

3、刊登定价公告日期： 年 月 日

4、申购日期和缴款日期： 年 月 日

5、股票上市日期： 年 月 日

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、保持持续创新能力的风险

本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内外领先的 32 位嵌入式 CPU 芯片供应商，在自主创新 CPU 内核、多媒体技术、SoC 芯片技术、功耗和电源管理技术、软件平台技术等 5 大领域形成了 15 项核心技术。通过持续的技术创新，公司已经在便携消费电子和便携教育电子应用领域取得了领先的市场优势。在集成电路设计行业，技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。未来如何保持持续的技术创新能力是公司面临的重大风险。

二、核心技术泄密风险

本公司处于集成电路设计行业，主营业务为 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台的研发和销售。本公司的核心技术均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

三、核心技术被替代的风险

目前，公司在 CPU 内核、功耗和电源管理技术、软件平台技术等核心领域的技术均处于国内领先水平或国际先进水平。但是，该行业正处于快速发展过程中，技术创新及终端电子产品日新月异，存在公司现有技术被其他新技术替代，从而导致公司丧失竞争优势，对本公司的生产经营造成不利影响的风险。

四、成长性风险

公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的领域。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，在便携消费电子、教育电子应用领域的市场竞争力优势明显，市场占有率稳步提高，具备高成长性。报告期内，公司业绩持续快速增长，2008年和2009年营业收入分别较上年增长了321.54%和32.71%，净利润分别较上年增长了809.13%和51.50%，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或产业政策等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

五、人力资源风险

集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。根据公司未来的战略规划，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还将进一步增加。如果公司不能建立完善的员工激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

六、募集资金投资项目的市场风险

公司本次募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家产业政策，具有良好的市场前景。但是，面向便携消费电子、便携教育电子和移动互联网终端设备应用领域的新一代嵌入式 CPU 芯片的研发和市场推广，面临着技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定性。如果公司推出的新产品其性能和价格无法满足市场需求，将可能导致募集资金投资项目的效益不能如期实现。

七、募集资金投资项目实施新增折旧、摊销及研发支出导致业绩下滑的风险

受现有资本实力限制，公司目前固定资产规模及年均研发支出相对较小。根据募集资金可行性研究报告及公司会计政策，募集资金投资项目实施当年及其后四年将分别增加固定资产折旧、摊销及研发支出合计4,295.83万元、5,570.46万元、1,958.96万元、1,958.96万元和1,958.96万元。

尽管公司充分考虑了各种内外部因素对募集资金投资项目效益的影响，并对募集资金投资项目进行了可行性研究，论证结果也显示公司本次募集资金投资项目的总体经济效益良好，足以抵销新增折旧、摊销及研发支出对公司经营业绩带来的压力。但下游电子产品市场环境变化较快，如果公司本次募集资金投资项目研发的新产品无法满足目标市场的需求，无法实现预期效益，新增折旧、摊销及研发支出将对公司未来业绩造成不利影响。

八、知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在 15 项核心技术上取得了重大突破，不仅打破了国外芯片设计企业长期以来在 CPU 核心技术方面的垄断，并成功实现了国产 CPU 的产业化。公司已形成以自主 CPU 技术为核心的完整技术体系和产业化体系，是目前国内极少数在 CPU 内核、多媒体处理、前

后端芯片设计、软硬件开发平台及整体解决方案均掌握自主核心技术的本土芯片设计企业。以上核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

九、市场风险

公司目前研发生产的 32 位嵌入式 CPU 芯片广泛运用于便携消费电子、教育电子等产品之中，公司研发的新一代 CPU 芯片将进一步运用于智能手机和平板电脑等互联网终端设备，公司未来产品线将进一步扩展。在上述便携电子产品行业之中，由于产品更新换代快、市场竞争激烈、生产厂商众多，如果公司部分下游客户因为政策管制、违规经营或经营不善等原因出现经营风险，将会对本公司芯片产品的市场需求产生不利影响。

十、管理风险

近年来，公司业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，积累了丰富的、适应快速发展的经营管理经验，完善了公司治理结构，形成了有效的内部激励和约束机制。本次发行后，公司业务、资产及人员规模都将大幅增加，需要在产品研发、资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进一步提高。如果公司管理水平不能适应发行后业务、资产及人员规模迅速扩张的需要，将对公司竞争力的持续提高产生影响。

十一、税收优惠政策变化的风险

公司位于北京市新技术产业开发试验区，2005 年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]74 号）以及国税函[2002]182 号《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函》并经北京市海淀区国家税务局核定，公司 2007 年免征企业所得税。

2008 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）的规定，公司执行 25%的企业所得税税率。

2009 年 10 月 20 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》和《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度执行 7.5%的企业所得税税率。

如果按法定企业所得税税率，即 2007 年度按 33%计算、2008 年度和 2009 年度按 25%计算，则公司 2007 年度、2008 年度和 2009 年度享有的税收优惠金额分别为 75.72 万元、0 万元和 1,499.78 万元，分别占当期利润总额的 12.94%、0.00%和 18.86%。

如果未来政府税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对公司经营业绩产生一定影响。

十二、供应商和客户较为集中的风险

2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-6 月，公司向前五大供应商采购的金额分别为 2,572.66 万元、8,575.18 万元、6,670.43 万元、3,592.19 万元，占同期采购总额的比例分别为 100.00%、95.42%、93.80%、93.55%，采购的集中度较高。公司主要供应商均为行业内具备一定实力的知名厂商，且与公司建立了长期稳定的合作关系。但仍不排除这些供应商因其自身原因而导致公司产品无法按时交货，从而对公司的经营产生不利影响。

公司采用 Fabless 模式，主要专注于集成电路设计环节。报告期内，公司主要采用直销与经销相结合的营销模式。2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-6 月，公司向前五大客户销售的金额分别为 3,269.36 万元、13,206.78 万元、16,367.46 万元、10,359.39 万元，占同期营业收入的比例分别为 95.15%、91.18%、85.15%、91.87%，呈逐年下降趋势，但占比仍然较高。如果目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生一定影响。

十三、净资产收益率下降的风险

自设立以来，公司业绩快速增长，净资产收益率较高。2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月，公司全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 4.84%、65.24%、64.15%和 31.45%。本次发行后，公司净资产规模将大幅度提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降，存在因净资产收益率下降导致的相关风险。

十四、产业政策变化的风险

集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。集成电路已作为我国优先发展的重点科技领域，而 SoC 芯片产品则是对未来整机发展有重要影响的产品。2006 年 8 月，原信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》，明确将 SoC 芯片设计技术列入集成电路领域重点发展的技术和项目。2009 年 4 月国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，明确要求“支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用，形成较为先进完整的集成电路产业链”。公司目前从事的主营业务及本次募集资金投资项目均符合国家产业政策，国家扶持政策的出台对行业及公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家相关产业政策发生重大调整，将对公司的发展产生一定的影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人改制重组及设立情况

（一）设立方式

公司前身君正有限成立于 2005 年 7 月 15 日。

2009 年 10 月 30 日，君正有限召开股东会，会议决议将君正有限整体变更、改制设立为股份有限公司。2009 年 12 月 16 日，君正有限全体股东签署《发起人协议》，决定以君正有限经审计的截至 2009 年 10 月 31 日的账面净资产折合为 6,000 万股，每股面值 1 元，其余列入资本公积，将君正有限整体变更为股份有限公司。2009 年 12 月 18 日，北京君正召开创立大会，兴华事务所出具（2009）京会兴验字第 1-23 号《验资报告》，审验确认公司注册资本已由各发起人足额缴纳。2009 年 12 月 24 日，公司取得了北京市工商局核发的注册号为 110108008639445 的营业执照。

（二）发起人

公司发起人为刘强、李杰等 12 名自然人股东和盈富泰克 1 家法人股东，发起人在公司发起设立时认购的股份数和持股比例如下：

序号	股东名称	身份证号/注册号	持股数量（股）	持股比例
1	刘强	11010819690305****	18,092,633	30.15%
2	李杰	11010719630917****	12,000,000	20.00%
3	盈富泰克	440301103127961	10,791,367	17.99%
4	张紧	11022519620703****	4,608,000	7.68%
5	洗永辉	42011119680824****	4,608,000	7.68%
6	姜君	51060219740707****	1,800,000	3.00%
7	刘飞	37061119721119****	1,500,000	2.50%
8	许志鹏	41052319731215****	1,500,000	2.50%
9	晏晓京	11010819651112****	1,500,000	2.50%
10	赵明漪	11010519420219****	1,200,000	2.00%
11	鹿良礼	31011019720807****	1,200,000	2.00%

12	张燕祥	11010819680905****	600,000	1.00%
13	张敏	13223319730525****	600,000	1.00%
合 计			60,000,000	100.00%

注：上述股东的出资方式均为净资产折股。

（三）发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

公司主要发起人为控股股东暨实际控制人刘强和李杰。公司改制设立前，刘强拥有的主要资产为君正有限30.15%的股权和深圳市君正科技有限公司（以下简称“君正科技”）26%的股权、北京君正集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港君正有限”）35.2%的股权，李杰拥有的主要资产为君正有限20%的股权、北京南山高科技有限公司（以下简称“南山高科”）70%的股权、北京西邦信息技术有限公司（以下简称“西邦信息”）50%的股权、北京庚顿数据科技有限公司（以下简称“庚顿数据”）40%的股权及君正科技25%的股权、香港君正有限11.2%的股权。除君正有限外其他公司的情况详见本节“五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人成立时承继了君正有限的全部资产、负债和业务，延续了原有生产经营体系。君正有限生产经营相关的全部资产、负债及人员进入公司，改制设立时未发生资产、负债或人员重组事项。公司成立时拥有的资产主要为货币资金、应收账款、预付款项、存货、固定资产、软件著作权等与集成电路设计开发有关的经营性资产。

公司成立时从事的主要业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。

（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人成立后，除君正科技和香港君正有限已经注销外，主要发起人刘强和

李杰所拥有的其他主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

公司改制前后业务流程未发生变化。公司业务流程的具体内容，请详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况”之“（四）发行人的生产与销售模式”。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司主要发起人刘强和李杰合计持有公司发行前50.15%的股份。有关公司与主要发起人关联交易的情况详见本招股说明书“第六节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

经兴华事务所2009年12月18日出具的（2009）京会兴验字第1-23号《验资报告》确认，公司发起人的出资均已缴足。截至本招股说明书签署之日，君正有限拥有的业务、资产与机构以及相关债权、债务均由本公司整体承继，并依法办理了资产权属变更登记手续。

（九）发起人在发行人设立过程中的税收缴纳情况

2009年12月24日，君正有限以截至2009年10月31日经审计的净资产值为基础折股、整体变更为股份有限公司。该次整体变更所涉及的个人所得税暂未缴纳。

公司自然人股东刘强、李杰、张紧、洗永辉、姜君、刘飞、许志鹏、晏晓京、鹿良礼、赵明漪、张燕祥、张敏承诺，将于公司上市之日起两年内缴纳上述公司整体变更为股份有限公司过程中其应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项；如果公司因上述事宜被追究责任或被税务机关进行处罚而产生任何支出、费用或损失，其将立即向公司进行全额补偿，保证公司不因此遭受任何损失。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：虽然发行人自然人股东未及时缴纳发行人整体变更过程中所产生的个人所得税，但其已出具承诺函，承诺全额承担当时应缴纳的个人所得税及相应的滞纳金、罚款等款项，同时承诺保证发行人不因此遭受任何损失，因此，上述情形不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

（十）发行人独立运行情况

公司改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全分开、独立运作，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产完整情况

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的研发、供应、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在违规占用公司的资金、资产和其它资源的情况。公司没有以其资产、权益或信用为关联方的债务提供过担保，也不存在资产、资金被股东占用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

2、人员独立情况

公司设有人事管理部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序选任；总经理和其他高级管理人员均由董事会聘任。公司独立发放工资，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

3、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合自身情况制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企

业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立情况

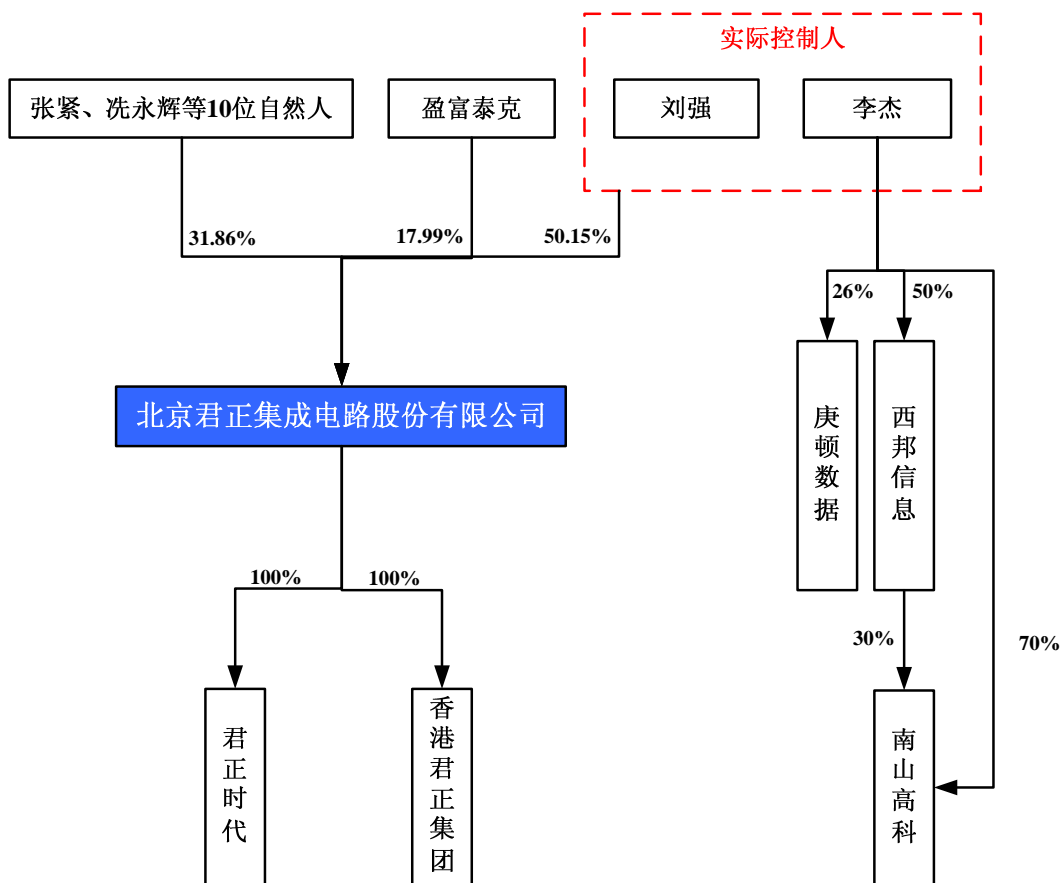
公司已形成独立完整的研发、采购、销售系统，业务独立于股东及其他关联方，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

二、发行人设立以来的重大资产重组情况

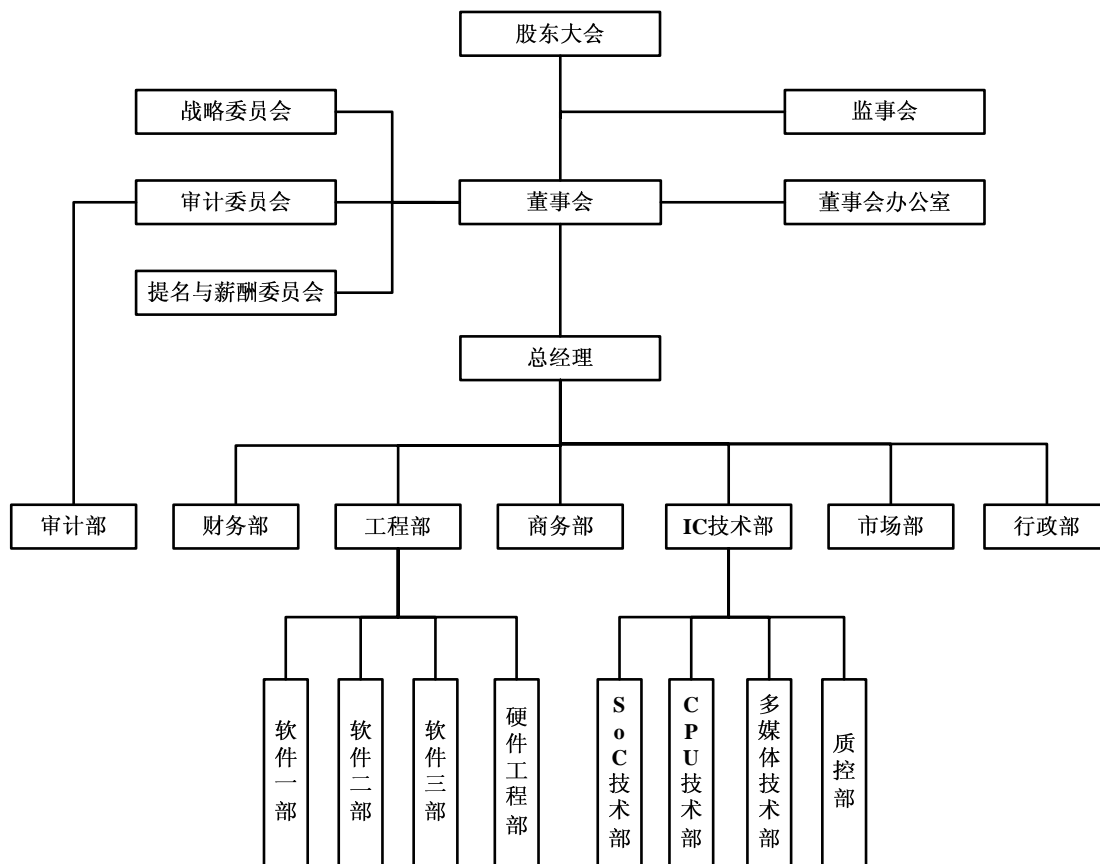
公司自设立以来，未发生重大资产重组行为。

三、发行人的组织结构

（一）发行人股权结构图



（二）发行人的组织结构图



（三）发行人的主要职能部门

公司已按照现代企业制度的要求建立了各个职能部门，各职能部门的主要职责如下：

职能部门	主要职能
董事会办公室	由董事会秘书分管，负责股东大会和董事会会议的筹备、股权管理、证券事务、信息披露、投资者关系管理、接受股东咨询以及公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作。
IC技术部	研究、设计、实现芯片产品，开发芯片生产过程中所需的测试环境；芯片产品的质量控制在。IC技术部下设SoC技术部、CPU技术部、多媒体技术部、质控部四个分部。

工程部	芯片的功能验证、测试；系统开发板、产品设计参考板的设计开发；软件平台的移植、优化和开发；整体解决方案的开发和整合；客户技术支持。工程部下设软件一部、二部、三部及硬件工程部四个分部。
商务部	负责公司原材料采购、购销合同管理、招投标文件的制作、售后保障以及其他商务工作；营销资源分配；配合市场部执行和管理市场拓展战略、销售组织设立、客户支持服务等。
市场部	负责企业发展规划的拟订；公司的宣传推广、品牌建设、市场信息的收集整理及研究；组织新产品的调研和客户意见反馈收集；确定产品功能、性能指标等市场需求；跟踪客户项目状态并配合工程部提供技术支持服务；市场活动的举办以及其他市场工作。
财务部	负责公司财务管理、会计核算等有关制度规范的实施和执行；预、决算的执行和管理，并提供经营分析支持；组织完成公司的会计核算、纳税核算及申报缴纳；参与合同的评审工作；办理日常现金收支、银行结算以及开具发票业务；统筹管理下属子公司对口业务。
行政部	负责公司日常行政事务管理，包括公司行政管理制度的制定与执行、公司资产管理与公司整体资源的协调安排等；负责制订人力资源战略规划、人事管理规章制度、人员招聘、培训、劳资福利管理以及绩效考评工作等。
审计部	在董事会审计委员会的领导下，负责对公司各部门、控股子公司的经营状况、财务收支情况以及重大工程项目的结算报告进行审计监督，独立行使审计职权，对董事会负责并报告工作，接受监事会的监督。

四、发行人控股、参股公司情况

截至本招股说明书签署之日，公司拥有两家全资子公司，分别为香港君正集团和君正时代：

（一）北京君正集成电路（香港）集团有限公司

1、香港君正集团的基本情况

成立日期：2006年8月14日

注册证号：NO.1066743

法定股本：10,000 元港币

实收股本：10,000 元港币

注册地址：香港九龙旺角花园街2道16号好景商业中心10楼1007室

股东构成：北京君正持有100%的股权

主营业务：委托加工及销售半导体集成电路芯片

2、香港君正集团的历史沿革

香港君正集团成立于2006年8月14日，以实际控制人刘强、李杰个人名义在香港注册成立，法定股本为港币1万元，刘强、李杰各认购50%股份并担任董事，该公司实收股本为港币零元。

2007年6月29日，君正有限股东会作出决议，决定收回香港君正集团。2007年12月31日，刘强、李杰与君正有限签订股权转让协议，将香港君正集团全部股权以零对价转让给君正有限。同日，香港君正集团在香港公司注册机构将董事变更为君正有限（法人董事）。

君正有限收购上述股权后，拟办理境外投资备案手续，但当时商务部门表示不受理境内公司收购境内自然人持有的境外公司股权的备案申请。为规范公司的境外投资事项，2008年9月17日，君正有限与美国籍人士刘君博（护照号码为057382***，有效期为2004年2月5日至2014年2月4日）签订了附有受托方不实际享有和承担股权及其附带的股东权利和义务、不享有投资收益、不承担投资风险、不负责经营管理、限期转回等限制控制权转移条款的《委托持股协议》，约定君正有限委托刘君博代其持有香港君正集团股权；同日，双方签订股权转让协议，君正有限将香港君正集团全部股权以零对价转让给刘君博。2008年10月17日，刘君博与君正有限签订股权转让协议，刘君博又将香港君正集团全部股权以零对价转回给君正有限。

2009年10月22日，北京市商务委下发京商务经字[2009]204号文，同意君正有限收购香港君正集团的全部股权。2009年10月26日，商务部向君正有限颁发企业境外投资证书（商境外投资证第1100200900098号），批准了君正有限

对香港君正集团的境外投资事项。

2009年12月10日，香港君正集团收到君正有限足额缴付的股本港币1万元。

2010年3月12日，刘君博出具《确认函》，确认其于2008年9月受君正有限委托，代君正有限持有香港君正集团股权，香港君正集团股权的实际持有人为北京君正；受托人已将代持股权转回给北京君正，委托关系已终止，不存在任何纠纷。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：君正有限2008年将香港君正集团股权转让给刘君博委托持股，是为了完成境外投资备案手续，股权转让后，与该股权相关的收益和风险未发生转移，君正有限对香港君正集团的控制权也未发生转移。该股权转让对君正有限持续拥有香港君正集团的控制权不构成影响。

3、香港君正集团的财务数据

香港君正集团设立以来的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2006年 12月31日
总资产	27,395,287.57	38,012,021.97	55,413,358.84	9,637,127.05	2,122,703.18
净资产	27,309,943.05	27,049,609.46	38,833,950.77	5,700,871.41	1,759,739.16
项 目	2010年 1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	2,404,852.46	46,041,863.54	132,245,134.74	23,508,448.08	2,424,015.46
净利润	260,333.59	8,699,958.69	33,133,079.36	3,917,259.12	1,749,461.76

注：2006年度数据未经审计，近三年一期数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计。

香港君正集团于2009年向公司分配了现金股利300万美元，导致该公司2009年末净资产值较2008年末出现下降。报告期内，香港君正集团已依照香港地区税务条例的规定足额缴纳税款，不存在违反香港地区税务条例规定的情形。

（二）深圳君正时代集成电路有限公司

1、君正时代的基本情况

成立时间：2009年4月14日

营业执照号：440301103949639

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：刘强

办公场所：深圳市南山区高新中二道2号深圳国际软件园4栋301-305、322-326

股东构成：北京君正持有100%的股权

经营范围：半导体集成电路芯片及计算机软硬件的技术开发、设计、销售、技术咨询及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、君正时代的历史沿革

珠三角地区是全球重要的消费电子、教育电子研发和制造基地之一，是公司未来产品重要的目标市场。2006年10月，君正有限在深圳设立了北京君正集成电路有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”），主要负责新一代多媒体播放器及便携电视产品方案的研发。

深圳分公司报告期内的经营和税收缴纳情况如下：

单位：元

项 目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
主营业务收入	-	447,981.86	166,625.96
主营业务成本	-	387,300.25	105,202.75
净利润	-77,862.11	-2,218,390.90	-751,014.50

单位：元

项 目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
增值税	-	19,303.84	5,280.42
企业所得税	78,550.05	39,839.24	-
城市维护建设税	110.08	96.20	39.55
教育费附加	330.23	288.63	118.68

2008年11月，为便于申请当地政府资助研发项目及需要法人资格开展经营

活动，君正有限股东会决议同意撤销深圳分公司，在深圳设立子公司。2009年4月9日，深圳市工商行政管理局核准深圳分公司的注销。2009年4月14日，发行人全资子公司深圳君正时代集成电路有限公司在深圳设立。

3、君正时代的定位及经营情况

君正时代成立后承继了原深圳分公司的职责和定位，继续进行新一代多媒体播放器及便携电视产品方案的研发。该公司设立以来持续进行研发，尚未取得研发成果，因此一直处于亏损状态，报告期内经兴华事务所审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产	921,736.14	912,806.71
净资产	-3,604,287.80	-1,580,392.22
项 目	2010年1-6月	2009年度
营业收入	210,256.56	59,877.95
净利润	-2,023,895.58	-2,580,392.22

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人

刘强和李杰为一致行动人，合计持有公司股份 30,092,633 股，占公司发行前总股本的 50.15%，共同拥有对公司的控制权，系公司的控股股东暨实际控制人。

1、控股股东暨实际控制人的基本情况

（1）刘强

刘强，男，出生于 1969 年，身份证号：11010819690305****，中国国籍，无境外永久居留权，目前持有公司股份 18,092,633 股，占公司股份总数的 30.15%。

（2）李杰

李杰，男，出生于 1963 年，身份证号：11010719630917****，中国国籍，

无境外永久居留权，目前持有公司股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 20.00%。

2、自公司设立以来，刘强和李杰一直为公司的控股股东暨实际控制人

发行人由刘强、李杰等两名股东共同拥有控制权，公司的实际控制人为刘强、李杰两人，最近两年来未发生变化，主要理由和依据如下：

（1）公司设立以来不存在单一绝对控股股东，股权结构相对分散。公司董事长、总经理刘强始终为公司的第一大股东，其最高时（君正有限成立时）持有公司 44% 股权，目前持有公司 30.15% 股份，并不能单独对公司形成控制。因此，并无任何股东能够单独支配公司的行为。

（2）刘强、李杰为公司的主要创办人，自公司成立以来，两人始终为公司的主要股东。刘强一直为公司持股比例最高的股东，李杰在 2006 年 5 月盈富泰克入股后持股比例低于盈富泰克，2008 年 7 月，李杰的出资比例超过盈富泰克，之后一直为公司第二大股东。上述两人具体出资情况如下：

时点	刘强	李杰	合计
2005 年 7 月 15 日	44.00%	14.00%	58.00%
2006 年 5 月 9 日	34.60%	11.00%	45.60%
2007 年 11 月 30 日	40.24%	11.20%	51.44%
2008 年 7 月 21 日	34.25%	23.35%	57.60%
2008 年 9 月 25 日	22.65%	20.00%	42.65%
2009 年 4 月 2 日	25.15%	20.00%	45.15%
2009 年 8 月 11 日	27.65%	20.00%	47.65%
2009 年 11 月 11 日以后	30.15%	20.00%	50.15%

（3）刘强、李杰自公司成立以来始终在公司担任核心职务，刘强一直担任公司董事长和总经理，李杰一直担任公司董事，两人对公司的业务发展、经营规划具有决定性的影响。

（4）刘强、李杰为同乡、清华校友，研究生期间在中国科学院师从同一导师，个人关系密切。两人作为主要创办人共同创办了公司，在经营理念和管理思路上相互认可，具有共同的利益基础。两人（作为股东或董事）在公司股东大会（或股东会）、董事会对重大事项的决策中均表达了一致意见，具体情况见下表：

序	会议时间	会议类别	重大决策事项	表决情况
---	------	------	--------	------

号				
1	2006年3月28日	股东会	同意盈富泰克对公司进行增资	一致投赞成票
2	2006年7月27日	股东会	由刘强、李杰以个人名义代公司在香港设立子公司香港君正集团	一致投赞成票
3	2007年6月29日	股东会	收购香港君正集团	一致投赞成票
4	2008年7月28日	股东会	转让股权给员工，并增加注册资本至695万元	一致投赞成票
5	2008年11月13日	股东会	撤销深圳分公司，成立深圳子公司君正时代	一致投赞成票
6	2009年10月30日	股东会	同意分配利润，同意将公司整体改制、变更设立为股份有限公司	一致投赞成票
7	2009年12月18日	创立大会暨第一次股东大会	审议《公司章程》及三会议事规则；选举董事、监事等	一致投赞成票
8	2010年2月24日	股东大会	审议《关于公司申请公开发行人民币普通股票并在创业板上市的议案》、《公司章程》（草案）等	一致投赞成票
9	2005年7月20日	董事会	讨论公司两年发展规划	一致投赞成票
10	2006年6月5日	董事会	在深圳设立分公司	一致投赞成票
11	2009年5月15日	董事会	同意对君正时代增资	一致投赞成票
12	2009年12月18日	董事会	选举第一届董事会董事长、聘任总经理等高级管理人员	一致投赞成票

（5）为进一步明确一致行动的意愿及建立明确、稳定的共同控制关系，刘强和李杰于2009年12月1日签署了《一致行动协议书》。同时，刘强、李杰分别作出承诺，在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，其本人不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前持有的股份，也不由公司回购该等股份。因此，发行人在首次公开发行股票后可预期期限内的股权结构是稳定的，两名股东共同控制公司的情况亦是稳定、有效的。

综上所述，刘强、李杰作为公司的主要创办人，始终为公司的主要股东及在公司担任核心职务，两人在2009年12月签署《一致行动协议书》之前，虽然没有通过公司章程、协议或其他方式作出明确安排，但两人已实际形成了事实上的一致行动关系和对公司的共同控制关系。2009年12月，两人共同签署了《一致行动协议书》，对今后共同实施公司控制权事宜以协议方式予以明确，并且两人

已按照有关实际控制人的要求作出了股份锁定承诺。因此，刘强、李杰为发行人的共同实际控制人，两人对于公司的共同控制关系是真实、合理和稳定的。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：公司由上述两名股东共同拥有公司控制权符合《证券期货法律适用意见第 1 号》（证监法律字[2007]15 号发布）第三条规定的条件：

①两名股东均直接持有公司股份及拥有股份的表决权；

②公司的治理结构健全、运行良好，两名股东共同拥有公司控制权的情况并未影响公司的规范运作；

③两名股东已签署《一致行动协议书》，对共同拥有公司控制权的情况进行了明确；在《一致行动协议书》签订之前，公司由两名股东共同控制的情况是稳定、有效存在的，两名股东最近两年来均为公司主要股东，没有出现重大变更；

④公司最近两年内第一大股东始终为刘强，没有发生变化。

（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

持有公司 5%以上股份的其他主要股东为盈富泰克、张紧、洗永辉。各股东的具体情况如下：

1、盈富泰克创业投资有限公司

盈富泰克目前持有公司 10,791,367 股，占公司股份总数的 17.99%。该公司基本情况如下：

成立时间：2000 年 4 月 20 日

营业执照号：440301103127961

注册资本：11,100 万元

实收资本：11,100 万元

法定代表人：刘廷儒

住所：深圳市福田区滨河路联合广场 B 座 1701 室

经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

截至本招股说明书签署之日，盈富泰克的股权结构如下：

名 称	出资额（万元）	出资比例
深圳市鑫海泰投资咨询有限公司	1,240	11.17%
中国普天信息产业股份有限公司	1,220	10.99%
云南南天电子信息产业股份有限公司	1,220	10.99%
深圳创维——RGB 电子有限公司	1,220	10.99%
广州无线电集团有限公司	1,220	10.99%
中国电子信息产业集团公司	1,220	10.99%
彩虹集团公司	1,220	10.99%
海信集团有限公司	1,080	9.73%
中国电子信息产业发展研究院	780	7.03%
熊猫电子集团有限公司	680	6.13%
合 计	11,100	100.00%

盈富泰克最近一年及一期主要财务数据如下（2009 年数据经深圳义云天会计师事务所审计，2010 年 1-6 月数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
总资产	143,074.14	100,610.21
净资产	102,615.81	74,013.57
项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度
营业收入	4,113.08	9,670.03
净利润	2,450.02	7,839.34

2、张紧

张紧，男，出生于 1962 年，身份证号：11022519620703****，中国国籍，无境外永久居留权，目前持有公司股份 4,608,000 股，占公司股份总数的 7.68%。

3、洗永辉

洗永辉，男，出生于 1968 年，身份证号：4201119680824****，中国国籍，无境外永久居留权，目前持有公司股份 4,608,000 股，占公司股份总数的 7.68%。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业

1、深圳市君正科技有限公司

成立时间：2005年4月6日

营业执照号：4403012171964

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：李杰

住 所：深圳市南山区学府路愉康花园2栋601

股东构成：刘强持有260万元出资，占注册资本的26%；李杰持有250万元出资，占注册资本的25%；刘军持有210万元出资，占注册资本的21%；张紧持有140万元出资，占注册资本的14%；洗永辉持有140万元出资，占注册资本的14%。

经营范围：计算机、IC卡、电子集成系统的技术开发及购销，技术与货物进出口业务，国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

君正科技自设立以来，一直未实际开展业务活动，与公司之间不存在资金及业务上的往来，也不存在成本、费用的转移及利益输送情形。2010年4月8日，该公司经深圳市市场监督管理局核准注销。

2007年11月，君正科技因未办理2005年度企业年检手续，被原深圳市工商行政管理局吊销营业执照。此外，该公司在办理税务注销过程中，由于设立后未进行过纳税申报、未办理换证手续，被深圳市南山区国家税务局和地方税务局合计处以3,800元的罚款。除上述处罚外，君正科技在报告期内不存在其他被行政处罚的情形或违法违规行为。

2010年9月17日，深圳市市场监督管理局南山分局出具书面说明，确认君正科技逾期未年检行为已依法结案，不再就该行为追究君正科技及李杰的责任。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：深圳市工商行政管理局在对君正科技逾期未办理年检手续行为进行处罚时，只是认定君正科技为责任人，对其处以吊销营业执照的处罚措施，深圳市工商行政管理局并未认定李杰存在违法行为和负

有个人责任，也未对其作出过处罚，并且深圳市市场监督管理局南山分局目前亦已确认不再就该事项追究李杰责任。据此，李杰对君正科技被吊销营业执照的情形并不承担个人责任，今后亦不存在被追究责任的风险，该事项对李杰担任公司董事的资格不构成法律障碍，该情形亦不属于损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

2、北京君正集成电路（香港）有限公司

成立时间：2006年7月7日

注册证号：NO.1057475

法定股本：10,000 元港币

实收股本：0 元港币

注册地址：香港九龙旺角花园街2道16号好景商业中心10楼1007室

股东构成：刘强持有 3,520 股，占注册资本的 35.2%；盈富泰克持有 2,000 股，占注册资本的 20%；李杰持有 1,120 股，占注册资本的 11.2%；刘军持有 1,120 股，占注册资本的 11.2%；洗永辉持有 1,120 股，占注册资本的 11.2%；张紧持有 1,120 股，占注册资本的 11.2%。

香港君正有限系君正有限当时的股东刘强、李杰、刘军、洗永辉、张紧、盈富泰克在香港设立的用于公司未来海外上市的壳公司，上述股东未实际出资，该公司成立后未开立银行账户，亦未开展实际业务活动，与公司及香港君正集团不存在业务或资金上往来。鉴于香港君正有限作为海外上市的平台已经没有存在的必要，该公司已于 2010 年 8 月 27 日经香港公司注册处核准撤销。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：香港君正有限成立后，其股东一直未实际出资，该公司也未开展实际业务活动，与发行人不存在业务或资金上往来，亦不存在转移成本、费用或利益输送等影响发行人独立性的情形。

3、北京西邦信息技术有限公司

成立时间：1999年7月20日

营业执照号：110108000727732

注册资本：1,918 万元

实收资本：1,918 万元

住 所：北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼 5 层 501 室

股东构成：李杰持有 959 万元出资，占全部股权的 50%；高帮贤持有 959 万元出资，占全部股权的 50%。

主营业务：技术开发、转让、咨询和服务，计算机系统集成及软硬件开发并销售

西邦信息最近一年一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	34,505,613.98	34,770,084.85
净资产	30,219,043.18	30,531,746.88
项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度
净利润	-312,703.70	-662,705.45

经核查，保荐机构、发行人律师认为：西邦信息与发行人在主营业务、主要产品及使用的技术上均不存在关联性；西邦信息的经营场所与发行人完全不同，不存在共用办公场所的情形；西邦信息与发行人不存在人员、机构交叉、兼职和代为付薪的情形；西邦信息的采购渠道和销售渠道亦均与发行人完全不同，与发行人之间不存在成本、费用的转移及利益输送情形，对发行人的财务成果没有影响。因此，西邦信息不存在影响发行人独立性和业绩真实性的情形。

4、北京南山高科技有限公司

成立时间：2001 年 8 月 6 日

营业执照号：110000003152139

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

住 所：北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼 5 层

股东构成：李杰持有 3,500 万元出资，占全部股权的 70%；西邦信息持有 1,500 万元，占全部股权的 30%。

主营业务：自动化工程，信息化工程，仿真系统的开发、销售与服务。其具体的业务为作战指挥训练仿真系统、后勤保障系统、计算机系统集成及综合电子信息系统的的设计开发、生产和服务。

南山高科最近一年一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
资产总额	65,940,791.84	70,719,149.54
净资产	28,998,288.30	33,015,009.67
项 目	2010年1-6月	2009年度
净利润	-4,184,471.37	-776,226.71

公司报告期内曾将闲置资金提供给南山高科用于其经营周转，并按照同期银行定期存款利率收取利息，报告期内已收回资金及利息，没有对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在成本、费用的转移及利益输送情形。

上述借款的具体情况详见本招股说明书“第六节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”之“（二）报告期偶发性关联交易事项”。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：南山高科与发行人在主营业务、主要产品及使用的技术上均不存在关联性；南山高科的经营场所与发行人完全不同，不存在共用办公场所的情形；南山高科与发行人不存在人员、机构交叉、兼职和代为付薪的情形；南山高科的采购渠道和销售渠道亦均与发行人完全不同，与发行人之间不存在成本、费用的转移及利益输送情形，对发行人的财务成果没有影响。因此，南山高科不存在影响发行人独立性和业绩真实性的情形。

5、北京庚顿数据科技有限公司

成立时间：2007年8月27日

营业执照号：110108010441265

注册资本：100万元

实收资本：100万元

住 所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼5层518室

股东构成：李杰持有26万元出资，占全部股权的26%；潘亚利持有34万元出资，占全部股权的34%；冯钊持有22万元出资，占全部股权的22%；孙宝元持有10万元出资，占全部股权的10%；见伟持有4万元出资，占全部股权的4%；张东华持有4万元出资，占全部股权的4%。

主营业务：实时数据的开发、销售与服务

庚顿数据最近一年一期的主要财务数据如下（2009 年数据已经北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计）：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	1,561,498.53	409,457.87
净资产	497,960.20	-416,206.09
项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度
净利润	914,166.29	-840,025.91

经核查，保荐机构、发行人律师认为：庚顿数据与发行人在主营业务、主要产品及使用的技术上均不存在关联性；庚顿数据的经营场所与发行人完全不同，不存在共用办公场所的情形；庚顿数据与发行人不存在人员、机构交叉、兼职和代为付薪的情形；庚顿数据的采购渠道和销售渠道亦均与发行人完全不同，与发行人之间不存在成本、费用的转移及利益输送情形，对发行人的财务成果没有影响。因此，庚顿数据不存在影响发行人独立性和业绩真实性的情形。

（四）发行人股份质押或其他有争议的情况

截至招股说明书签署之日，公司股东持有的公司股份均未被质押和托管，也不存在其它股份权属有争议或限制的情形。

六、发行人股本情况

（一）发行人本次发行前、后股本情况

本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟公开发行 2,000 万股，发行后总股本 8,000 万股。发行后，社会公众股占发行后总股本比例为 25%。发行前后公司的股本结构变化如下：

股东类别	发行前		发行后	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
一、有限售条件流通股	60,000,000	100.00%	60,000,000	75.00%
其中： 刘强	18,092,633	30.15%	18,092,633	22.62%

李杰	12,000,000	20.00%	12,000,000	15.00%
盈富泰克	10,791,367	17.99%	10,791,367	13.49%
张紧	4,608,000	7.68%	4,608,000	5.76%
冼永辉	4,608,000	7.68%	4,608,000	5.76%
姜君	1,800,000	3.00%	1,800,000	2.25%
刘飞	1,500,000	2.50%	1,500,000	1.88%
许志鹏	1,500,000	2.50%	1,500,000	1.88%
晏晓京	1,500,000	2.50%	1,500,000	1.88%
赵明漪	1,200,000	2.00%	1,200,000	1.50%
鹿良礼	1,200,000	2.00%	1,200,000	1.50%
张燕祥	600,000	1.00%	600,000	0.75%
张敏	600,000	1.00%	600,000	0.75%
二、社会公众股	-	-	20,000,000	25.00%
合计	60,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%

注：上表中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

盈富泰克为本公司唯一法人股东。经核查，保荐机构、发行人律师认为：盈富泰克不存在独家持股比例达到或超过 50% 的股东，其第一大股东深圳市鑫海泰投资咨询有限公司的股东为刘廷儒等 12 名自然人，该股东为民营企业，因此盈富泰克不符合根据国务院国有资产监督管理委员会《关于施行〈上市公司国有股东标识管理暂行规定〉有关问题的函》（国资厅产权[2008]80 号）规定的应确认为国有股东的情况，不需要根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》履行有关国有股转持义务。

（二）本次发行前公司前十名股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	刘强	18,092,633	30.15%
2	李杰	12,000,000	20.00%
3	盈富泰克	10,791,367	17.99%
4	张紧	4,608,000	7.68%
	冼永辉	4,608,000	7.68%

6	姜君	1,800,000	3.00%
7	刘飞	1,500,000	2.50%
	许志鹏	1,500,000	2.50%
	晏晓京	1,500,000	2.50%
10	赵明漪	1,200,000	2.00%
	鹿良礼	1,200,000	2.00%
合 计		58,800,000	98.00%

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	主要职务
1	刘强	18,092,633	30.15%	董事长、总经理
2	李杰	12,000,000	20.00%	董事
3	张紧	4,608,000	7.68%	董事、副总经理
4	冼永辉	4,608,000	7.68%	副总经理
5	姜君	1,800,000	3.00%	职工代表监事、部门经理
6	刘飞	1,500,000	2.50%	项目经理
7	许志鹏	1,500,000	2.50%	部门经理
8	晏晓京	1,500,000	2.50%	监事会主席、部门经理
9	赵明漪	1,200,000	2.00%	-
	鹿良礼	1,200,000	2.00%	-
合 计		44,808,633	80.01%	-

（四）最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况

公司最近一年无新增股东。

（五）本次发行前发行人自然人股东的身份背景、股份来源及是否存在向特定方利益输送情形

公司 12 名自然人股东的身份背景、股份来源如下：

序号	姓名	持股数(股)	身份背景	股份来源
1	刘强	18,092,633	董事长、总经理	设立时出资额 220 万元；受让刘军出资额

				31.5 万元；转让给李杰出出资额 37.45 万元；转让给姜君、韦建利、刘飞、于万洲、赵明漪、许志鹏共计 56.602 万元；受让于万洲出资额 17.375 万元；受让韦建利出资额 17.375 万元；受让张敏、张燕祥出资额各 86,875 元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 18,092,633 股。
2	李杰	12,000,000	董事	设立时出资额 70 万元；受让刘军出资额 38.5 万元；受让刘强出资额 37.45 万元；转让给许志鹏、晏晓京出资额 6.95 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 12,000,000 股。
3	张紧	4,608,000	董事、副总经理	设立时出资额 70 万元；转让给晏晓京、张燕祥、张敏出资额 16.624 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 4,608,000 股。
4	洗永辉	4,608,000	副总经理	设立时出资额 70 万元；转让给张敏、鹿良礼出资额 16.624 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 4,608,000 股。
5	姜君	1,800,000	监事、部门经理	受让刘强出资额 10.35 万元；增资 10.5 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,800,000 股。
6	刘飞	1,500,000	项目经理	受让刘强出资额 8.625 万元；增资 8.75 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,500,000 股。
7	许志鹏	1,500,000	部门经理	受让刘强出资额 6.477 万元；受让李杰 2.148 万元；增资 8.75 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,500,000 股。
8	晏晓京	1,500,000	监事会主席、部门经理	受让李杰出出资额 4.802 万元；受让张紧出资额 3.823 万元；增资 8.75 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,500,000 股。

9	赵明漪	1,200,000	中国科学院退休干部	受让刘强出资额 13.9 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,200,000 股。
10	鹿良礼	1,200,000	李杰控股的公司--南山高科的法 定代表人	受让洗永辉出资额 13.9 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 1,200,000 股。
11	张燕祥	600,000	副总经理、财务总监	受让张紧出资额 7.7625 万元；增资 7.875 万元；转让给刘强出资额 8.6875 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 600,000 股。
12	张敏	600,000	副总经理、董 事会秘书	受让张紧 5.0385 万元；受让洗永辉 2.724 万元；增资 7.875 万元；转让给刘强出资额 8.6875 万元；公司以净资产折合总股本为 6,000 万股，以折股时的持股比例计算为 600,000 股。

公司上述除 4 名创办人之外的 8 名自然人股东中，姜君、刘飞、许志鹏、晏晓京、张燕祥、张敏等 6 名股东均为公司业务骨干，该等股东在 2008 年 9 月公司实施股权激励过程中，通过增资和受让老股东股权方式（均按照注册资本作价）取得公司的股份。

股东赵明漪、鹿良礼为刘强、李杰等公司创始人的朋友，对公司早期业务发展作出过帮助。因此在 2008 年 9 月公司实施股权激励的同时，按照注册资本作价向两人各转让了 2% 股权。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：公司股权变动过程中不存在向特定方利益输送的情形。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前公司各股东中，刘强和李杰为一致行动人，刘强和刘飞为兄弟关系，其他股东之间无关联关系。刘强、李杰和刘飞分别持有公司本次发行前 30.15%、20.00% 和 2.50% 的股份。

（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人刘强之弟刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

盈富泰克创业投资有限公司、张紧、冼永辉、姜君、许志鹏、晏晓京、赵明漪、鹿良礼、张燕祥、张敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除前述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张紧、冼永辉、姜君、晏晓京、张燕祥、张敏、刘飞还承诺：在本人及本人的关联方任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

（八）工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过二百人的情况

公司成立以来，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

七、员工及其社会保障情况

（一）员工情况

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司在册职工总数为 121 人，其人员结构如下：

1、按专业结构划分

专 业	人 数	比 例
研发人员	93	76.86%
管理人员	8	6.61%
销售人员	7	5.79%
财务人员	6	4.96%
其他人员	7	5.78%
合 计	121	100.00%

2、按受教育程度划分

专 业	人 数	比 例
研究生及以上	27	22.31%
本科	67	55.37%
其他	27	22.32%
合 计	121	100.00%

3、按年龄划分

专 业	人 数	比 例
30 岁以下	86	71.07%
31-40 岁	29	23.97%
41-50 岁	6	4.96%
合 计	121	100.00%

（二）社会保障情况

公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。

1、社会保险

报告期内，公司和子公司君正时代均已按国家和当地有关规定，为员工购买了基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险和生育保险。具体情况如下：

北京君正		起始日期	缴费比例		2010年 1-6月		2009年		2008年		2007年	
			公司	员工	员工 人数	缴纳 人数	员工 人数	缴纳 人数	员工 人数	缴纳 人数	员工 人数	缴纳 人数
社 保	养老	2005年9月	20%	8%	80	77	82	72	87	75	60	39
	失业	2005年9月	1%	0.2%		77		72		57		32
	工伤	2005年9月	0.8%	0%		77		72		75		39
	医疗	2005年10月	10%	2%+3		80		76		77		41
	生育	2005年9月	0.8%	0%		31		32		43		16
君正时代		起始日期	缴费比例		2010年1-6月		2009年					
			公司	员工	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数				
社 保	养老	2009年5月	11%	8%	41		34	38				34
	失业	2009年5月	1%*40%	0%			7			6		
	工伤	2009年5月	0.25%	0%			34			34		
	医疗	2009年5月	4.5%	2%			34			34		
	生育	2009年5月	0.5%	0%			34			34		

注：1、员工人数为该区间末在职员工人数，各险种缴纳人数为该区间最后一个月份的缴纳人数；

2、北京君正2007年、2008年员工人数和缴纳人数包含深圳分公司，深圳分公司员工缴纳上述险种的比例执行的是深圳市当时的相关规定；

3、根据北京市劳动和社会保障局2008年12月31日下发的《关于调整本市部分社会保险缴费问题的通知》（京劳社保发〔2008〕237号），发行人从2009年1月1日起，单位失业保险费的缴费费率由1.5%调整为1%，个人缴纳失业保险费的缴费费率由0.5%调整为0.2%；工伤保险由1.0%缴费费率下调为0.8%。

报告期内对应月份实缴社保人数略低于当月末在职员工人数，是因为公司发展较快，员工规模持续扩张，每月都有部分新入职员工待办理相关社保缴纳手续，尤其是公司发展初期。

公司子公司香港君正集团无专门管理人员，不涉及社会保险问题。

根据北京市海淀区人力资源和社会保障局、北京市海淀区社会保险基金管理中心出具的证明，公司根据国家相关政策办理了养老、失业、工伤、生育、基本医疗保险五项社会保险的参保手续，报告期内无欠费，没有因违法受到行政处罚或行政处理的情形。根据深圳市社会保险基金管理局出具的证明，君正时代报告期内按时缴纳社会保险费，没有因违法违规而被处罚的情况。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人和子公司君正时代报告期内已按照国家和当地有关规定，为员工购买了各项社会保险，按时缴纳社会保险费，不存在需要补缴的情况。

2、住房公积金

报告期内，公司已按国家和当地有关规定，为员工缴纳了住房公积金；子公司君正时代按深圳有关规定，为深圳市户籍员工办理了住房公积金。具体情况如下：

北京君正	起始日期	缴费比例		2010年1-6月		2009年		2008年		2007年	
		公司	员工	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数
住房公积金	2005年8月	12%	12%	80	80	82	74	87	61	60	34
君正时代	起始日期	缴费比例		2010年1-6月		2009年					
		公司	员工	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数
住房公积金	2009年5月	13%	0%	41		6		38		5	

注：1、员工人数为该区间末在职员工人数，各险种缴纳人数为该区间最后一个月份的缴纳人数；

2、北京君正2007年、2008年员工人数和缴纳人数包含深圳分公司，深圳分公司员工缴纳住房公积金的比例执行的是深圳市当时的相关规定。

（1）北京君正

报告期内北京君正对应月份实缴住房公积金人数略低于当月末在职员工人数，是因为公司发展较快，员工规模持续扩张，每月都有部分新进员工待办理相关公积金缴纳手续，尤其是公司发展初期。

根据北京住房公积金管理中心中关村管理部出具的证明，公司按国家住房公积金法律、法规和规章的规定正常缴纳公积金。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人已根据北京市有关规定为其全部员工办理了缴交住房公积金手续，按时缴费，不存在需要补缴的情况。

（2）君正时代

报告期内，子公司君正时代根据深圳市有关规定为深圳市户籍的员工办理了缴交住房公积金手续，未缴纳部分为非深圳市户籍的员工。

深圳市住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128号）和《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179号）等文件建立起来的。根据深圳市上述规定，深圳市住房公积金制度仅适用于有深圳市常住户口的职工，并未要求用人单位为非深圳市常住户口职工缴存住房公积金。在实际执行中，企业亦无法为非深圳市常住户口职工设立住

房公积金账户。君正时代未为非深圳市户籍的员工办理住房公积金符合深圳市住房公积金制度规定及深圳市的实际情况。

君正时代目前未被有关部门要求补缴以前年度非深圳市户籍员工的住房公积金。经测算，君正时代 2009 年、2010 年 1-6 月应补缴的金额分别为 58,475.43 元、49,153.26 元。对于上述补缴风险，公司实际控制人刘强、李杰于 2010 年 8 月向公司出具《承诺函》，承诺如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、李杰将承担有关费用，并及时、足额将有关费用支付给君正时代。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：君正时代未为非深圳市户籍员工缴交住房公积金的做法符合深圳市住房公积金制度规定及深圳市的实际情况，其主观上没有严重过错，同时发行人的实际控制人亦已对该事项可能导致的风险作出承诺以确保公司不会因此遭受任何损失，因此，上述情形对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍，对发行人经营业绩不造成影响。

（3）香港君正集团

公司子公司香港君正集团因无专门管理人员，不涉及住房公积金问题。

八、实际控制人、股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺

（一）关于发行人上市后股份锁定的承诺

详见本节“六、发行人股本情况”之“（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

详见本招股说明书“第六节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。

（三）公司股东的其他承诺

详见本节“一、发行人改制重组及设立情况”之“（九）发起人在发行人设立过程中的税收缴纳情况”。

第五节 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）发行人主营业务及其变化情况





公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。

公司自成立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内外领先的32位嵌入式CPU芯片供应商，是掌握自主嵌入式CPU技术并成功市场化的极少数本土企业之一。

（二）发行人主要产品及其变化情况

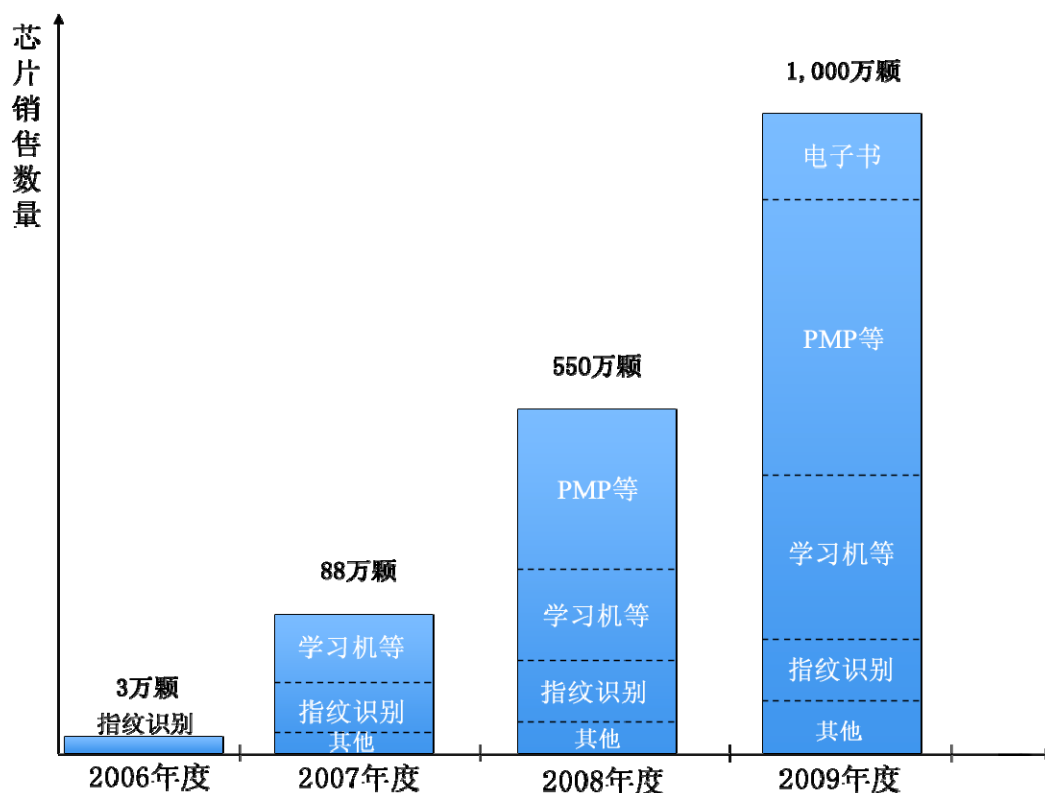
基于自主创新的XBurst CPU核心技术，公司面向便携消费电子、教育电子等领域推出了一系列具有高性价比的32位嵌入式CPU芯片产品。为了支持CPU芯片产品的应用和推广，公司提供了运行于这些芯片之上的操作系统软件平台。

目前，公司的核心技术、主要产品、服务于产品推广的系统软件平台及解决方案如下：

类别	名称及型号	描述
核心技术	XBurst CPU	公司自主研发的 32 位嵌入式 CPU 技术。
主要产品	 Ingenic JZ4740 080409S04113A-D00	CPU 主频： 360MHz 多媒体能力：标清解码 应用：主要用于学习机、电子书及其他市场
	 Ingenic JZ4750 081028S1111B01	CPU 主频： 360MHz 多媒体能力：标清解码 应用：主要用于学习机、电子书及其他市场
	 Ingenic JZ4725 080616S0619A-D05	CPU 主频： 360MHz 多媒体能力：标清解码 应用：主要用于标清 PMP 领域
	 Ingenic JZ4755 080616S0619A-D05	CPU 主频： 400MHz 多媒体能力：720P 高清解码 应用：主要用于高清 PMP 领域

软件平台	MiniOS	公司自主研发的一种实时操作系统，主要应用于PMP、教育电子等领域。
	Linux	开源社区提供的操作系统。公司对Linux内核、驱动、中间件及应用程序移植、优化并提供底层支持和维护。
	Android	Google公司提供的面向智能手机、移动互联网设备的一种操作系统。公司对Android内核、驱动、中间件及应用程序移植、优化并提供底层支持和维护。
整体解决方案	PMP方案	基于MiniOS操作系统，面向PMP领域提供的一个Turnkey整体解决方案，包括硬件的设计和所有的软件功能。
	智能手机方案	基于Android操作系统，面向智能手机提供的一个Turnkey整体解决方案，包括硬件的设计和所有的软件功能。
	平板电脑方案	基于Android操作系统，面向平板电脑提供的一个Turnkey整体解决方案，包括硬件的设计和所有的软件功能。

公司目前主要产品应用于便携消费电子及便携教育电子产品领域。公司坚持“开放平台、纵横扩展”的市场推广策略，自成立以来，不断研发新产品推向市场。



注：上图仅作示意用，不表示精确比例。

2006年，公司产品成功进入指纹识别领域；

2007年，公司年出货量突破88万颗，产品进入便携教育电子领域；

2008年，公司年出货量突破550万颗，产品进入PMP领域；

2009年，公司年出货量突破1,000万颗，产品进入电子书领域。

二、发行人所处行业的基本情况

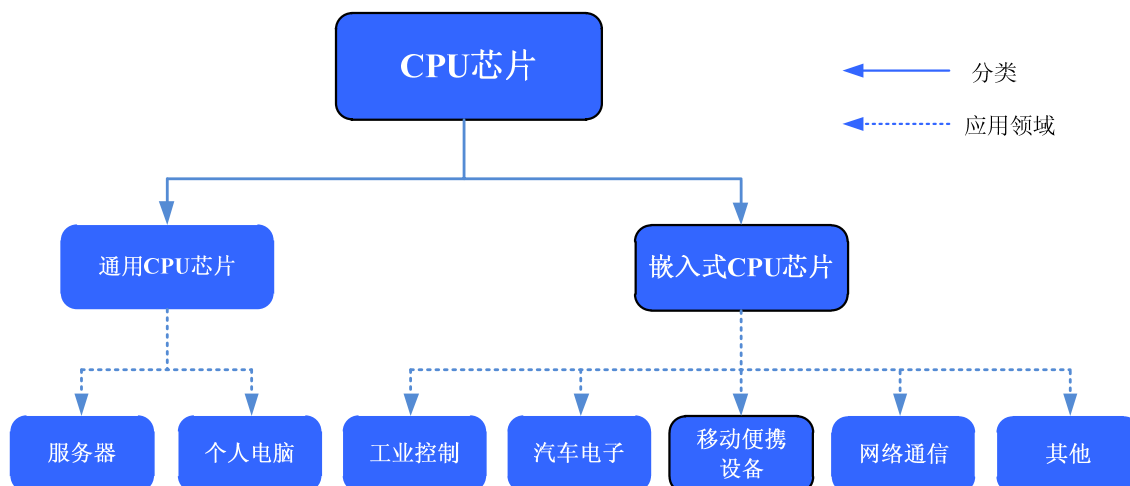
（一）行业类别及现状

集成电路行业分为设计、制造、封装和测试等子行业，公司处于集成电路设计行业，具体为嵌入式CPU芯片设计行业。

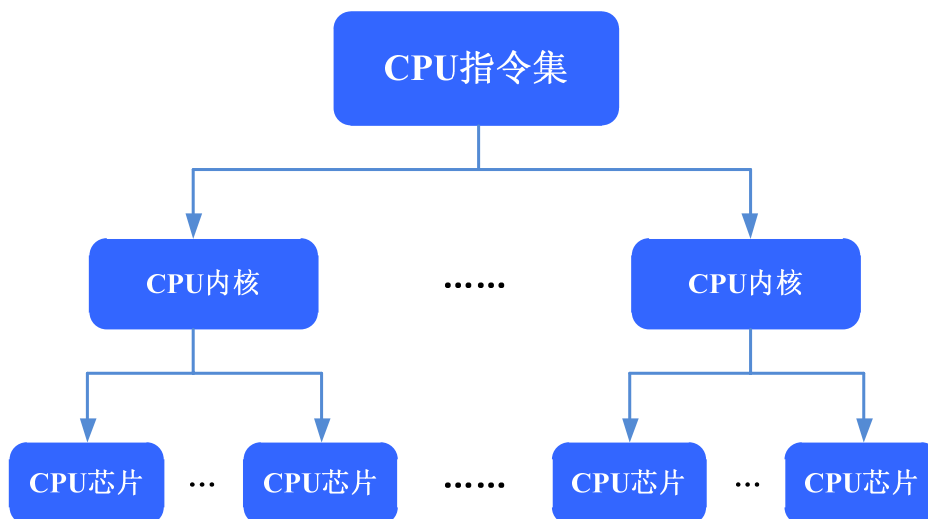
CPU，即中央处理器，简称为处理器或微处理器，是一切电子设备的核心。用于计算机、服务器的CPU通常称为通用CPU；用于其他电子设备中的CPU通常称为嵌入式CPU，这些电子设备通常不完全表现为计算机的形态。

嵌入式CPU大量应用于工业控制、汽车电子、网络设备、消费电子、移动通信、智能家电等领域中。进入21世纪后，以MP3、MP4、智能手机、平板电脑、电子书、上网本等为代表的移动便携设备领域快速兴起，对嵌入式CPU芯片的计算能力、功耗、成本、集成度提出了更高的要求，从而促进了面向移动便携设备的嵌入式CPU技术的快速提升，使嵌入式CPU行业成为集成电路行业近几年最活跃的一个分支。

CPU芯片主要分类及应用领域示意图如下：



在技术层面上，嵌入式CPU涉及到CPU指令集、CPU内核、CPU芯片三个层次，其关系如下图所示：

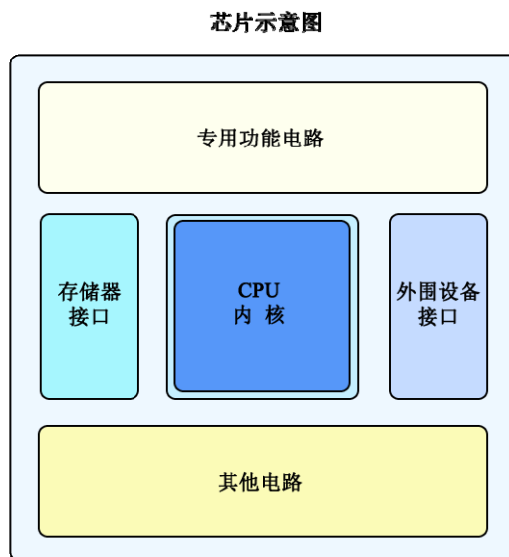


- CPU指令集是CPU所执行的指令集合。不同的CPU执行不同的指令集，形成了不同的指令集架构。通用CPU的指令集架构为X86架构，Intel、AMD等公司基于该指令集设计CPU芯片，用于计算机和服务中。嵌入式CPU领域中最著名的指令集架构是ARM架构和MIPS架构。

- CPU内核是CPU IP Core的简称，是某种指令集架构的具体电路实现。一个指令集架构可以具有不同的实现，如ARM有ARM9、ARM11等多款内核，MIPS有4K、24K等多款内核。同一架构的CPU内核执行相同的指令集，但各个内核设计不同，因此具有不同的性能、功耗等指标。CPU内核通常以知识产权授权的方

式提供给芯片设计企业使用。

● CPU芯片是产品的最终体现。一款面向某个领域的芯片产品结构通常如下图所示：



在这种芯片中，除了CPU内核外，还集成了某些专用功能电路、存储器接口电路、各种外围设备接口电路等。业界通常也把这种具有CPU内核、集成多个功能模块、面向某一领域的高集成度芯片产品称为SoC芯片，中文翻译为片上系统或系统级芯片。

早期的CPU芯片主要由若干家大企业掌握，这些企业从事从CPU指令集、CPU内核和最终芯片的设计。在随后几十年的发展过程中，产业分工、产业模式不断调整，发展到本世纪，在嵌入式CPU领域形成了专门提供CPU内核的知识产权企业。这些企业不设计芯片，而是基于某种CPU指令集，专注于CPU内核的设计，将设计好的CPU内核以知识产权的方式提供给芯片设计企业使用。而芯片设计企业则购买知识产权企业的CPU内核，并结合其他功能模块，设计最终的SoC芯片产品。英国的ARM公司和美国的MIPS公司是全球最著名的CPU内核知识产权企业，这两家企业提供的CPU内核为芯片设计企业广泛使用。

国内外大部分芯片设计企业通过购买CPU IP供应商的CPU内核进行SoC芯片设计，这种方式称为内核授权。一些国际顶级的芯片设计企业通过架构授权获取指令集的使用许可，自己设计CPU内核。例如，高通、Marvell、微软等企业获得了ARM的指令集架构授权，Broadcom、NEC、Toshiba等企业则获得了MIPS

的指令集架构授权。指令集架构授权使得芯片设计企业能够自行设计CPU内核，更好地掌控核心技术，避免内核授权而带来的产品同质化问题，使芯片产品具有更强的竞争力。

CPU芯片产业是集成电路行业中产值最大、影响力最广的产业之一，长期以来，其核心技术和产品为欧美日韩等发达国家企业所掌控。由于缺乏自主知识产权，我国企业在CPU芯片设计、制造等方面与国际领先企业存在较大差距，导致我国在CPU核心技术及其产品使用中，不仅需要支付巨额的知识产权费，更在国家信息安全等领域面临巨大风险。

自2000年以来，我国政府基于国家安全和产业布局发展的考虑，逐步加大了国产CPU芯片研发和产业化的支持力度，出台了若干扶持政策，一些高校、科研院所和企业先后参与到自主知识产权CPU的研制中，在技术和市场方面做了许多有益的尝试。

本公司在业界成熟技术的基础上进一步创新，自主设计CPU内核和芯片产品，并迅速应用于移动便携设备市场的多个产品领域，打破了国外公司在CPU领域的长期垄断，率先实现了国产CPU技术的产业化。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门与监管体制

本公司所属行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，行业自律组织为中国半导体行业协会。

工信部主要负责研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、体制和标准等，对行业的发展进行宏观调控。

中国半导体行业协会是行业内的指导、协调机构，其主要职能为参与政府产业规划、政策的制定，为政府提供决策咨询，推进集成电路设计业的技术、市场交流和研讨，维护行业合法权益与市场秩序等。

工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路设计行业的管理和自律体系，各集成电路设计企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，

面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业主要法律法规及政策

我国政府自2000年以来，大力支持发展集成电路行业，颁布了一系列的法律法规和产业政策，具体如下：

序号	政策措施	颁布时间
1	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2000年
2	《集成电路设计企业及产品认定暂行管理办法》	2000年
3	《集成电路布图设计保护条例》	2001年
4	《关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函》	2001年
5	《集成电路布图设计保护条例实施细则》	2001年
6	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》	2002年
7	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》	2005年
8	《2006-2020年国家信息化发展战略》	2006年
9	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	2006年
10	《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	2006年
11	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》	2007年
12	《信息产业“十一五”规划》	2007年
13	《集成电路产业“十一五”专项规划》	2008年
14	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》	2008年
15	《电子信息产业调整和振兴规划》	2009年

在这些政策和法规中，2006年2月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定并安排了16个国家科技重大专项。其中，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”专项中的高端通用芯片重点支持的就是国产CPU技术及其产业化。

（三）市场容量与行业发展前景

1、集成电路设计行业概况

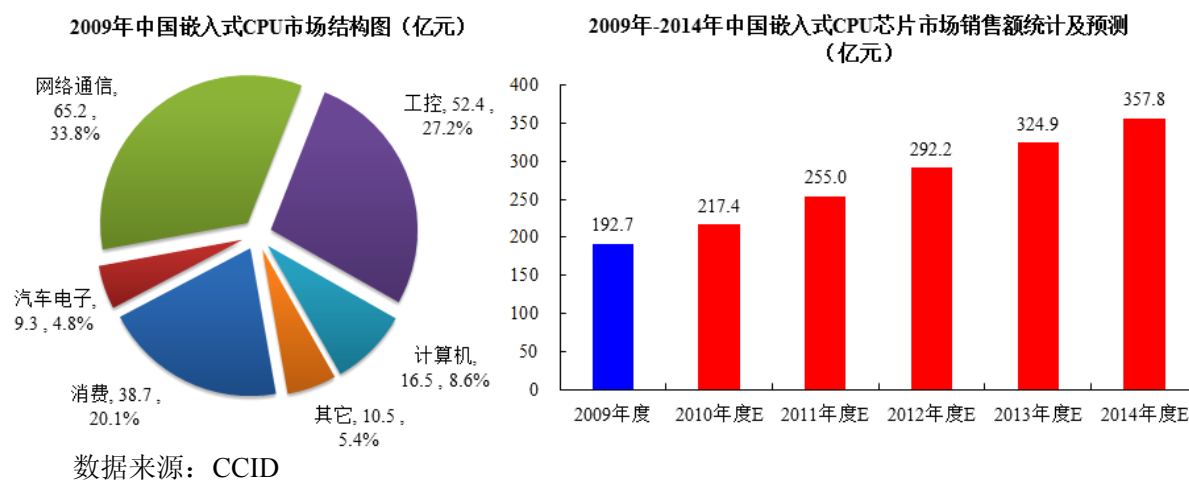
近年来，市场需求带动全球集成电路设计行业持续增长。根据赛迪顾问的研究报告，截至2009年末全球集成电路设计行业的产业规模已达到549.7亿美元，

亚洲地区特别是我国的集成电路设计行业发展迅速。

2000年以来，国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《集成电路产业“十一五”专项规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等鼓励政策的相继出台和落实，为我国集成电路设计行业创造了良好的政策环境，极大地调动了各方面的积极性，促进了集成电路设计行业规模快速增长、产业结构不断完善。国内一些优秀的集成电路设计企业逐渐崭露头角，开始与国际知名集成电路设计企业同台竞技。特别是来自工业控制、汽车电子、3G通信、移动互联网、消费电子、物联网等市场的强劲需求推动了集成电路设计行业的快速增长。2009年我国集成电路设计行业销售收入达269.92亿元，增长率为14.8%，高于国内整个集成电路产业的增幅（数据来源：CCID）。

2、32位嵌入式CPU芯片的市场容量和发展前景

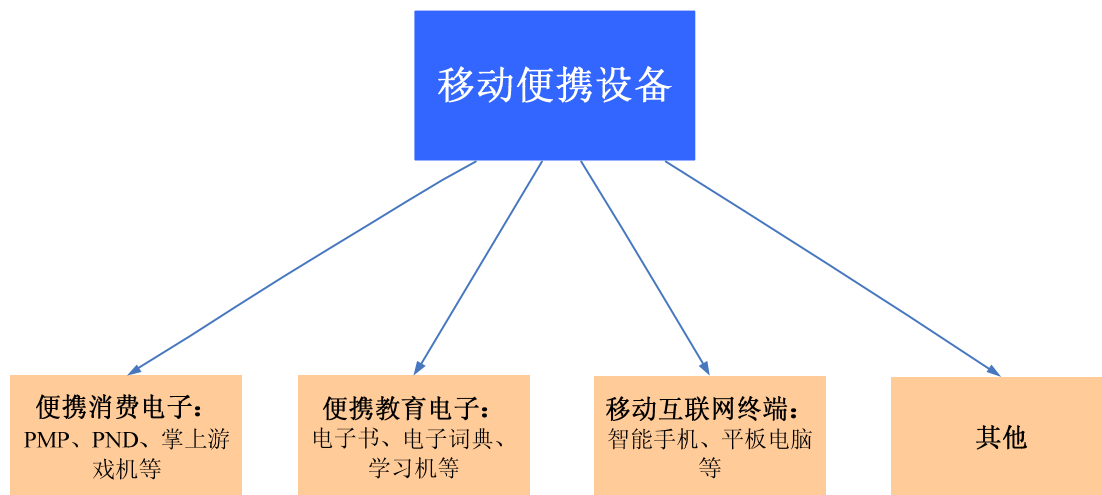
2009年，国内嵌入式CPU市场销售额达192.7亿元（含国外公司在我国的销售额）。随着我国进一步扩大内需、3C融合加速、移动互联网行业迅速崛起，嵌入式CPU芯片未来的应用领域将进一步拓展。预计到2014年，我国嵌入式CPU芯片市场规模将高达357.8亿元（数据来源：CCID）。



3、面向移动便携设备的嵌入式CPU芯片细分市场容量和发展前景

移动便携设备市场近年来发展十分迅速，是嵌入式CPU芯片的一个重要应用方向。根据用途的不同，移动便携设备主要包括便携消费电子、便携教育电子、移动互联网终端等产品类别。移动便携设备轻巧、可随身携带，是消费者贴身的信息、娱乐和教育终端，与消费者联系最为紧密。我国人口众多，消费需求旺盛，

使得该领域的市场容量巨大。随着我国不断扩大内需，移动便携设备领域还将继续高速发展，为相应的嵌入式CPU芯片提供了广阔的市场发展空间。移动便携设备分类如下：

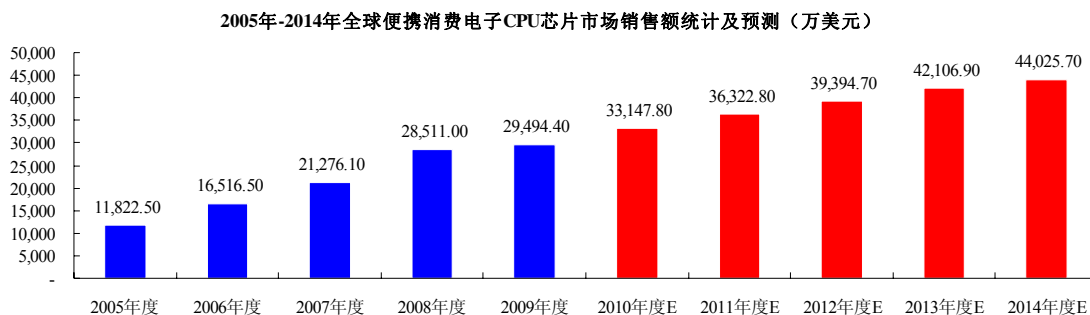


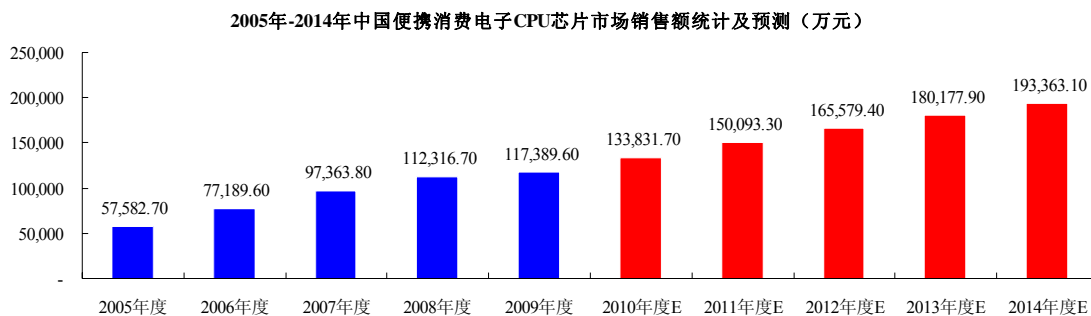
目前，公司嵌入式CPU芯片主要面向便携消费电子、便携教育电子和移动互联网终端。

（1）便携消费电子CPU芯片市场容量和发展前景

便携消费电子CPU芯片的应用对象主要包括MP3、PMP（MP4/MP5）、PND（便携式GPS导航）、掌上游戏机、数码相框等，产品种类众多。

根据赛迪顾问的统计数据，2009年，全球便携消费电子CPU芯片市场销售量为6,428.1万颗，销售额为29,494.4万美元（由于iPod、PSP和NDSL软硬件系统封闭，赛迪顾问对便携消费电子CPU芯片市场的统计数据未包括iPod、PSP和NDSL的CPU芯片销售）；国内便携消费电子CPU芯片市场销售量为3,982.8万颗，销售额为117,389.6万元。2005年—2014年国内外便携消费电子CPU芯片市场销售额统计及预测具体情况如下：





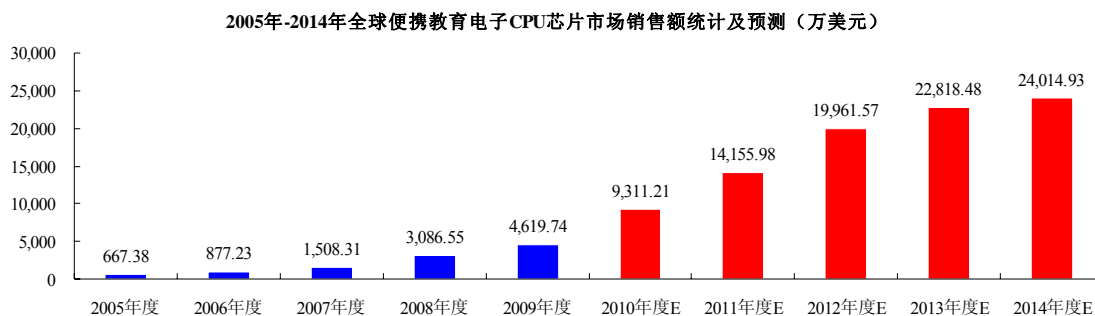
数据来源：CCID

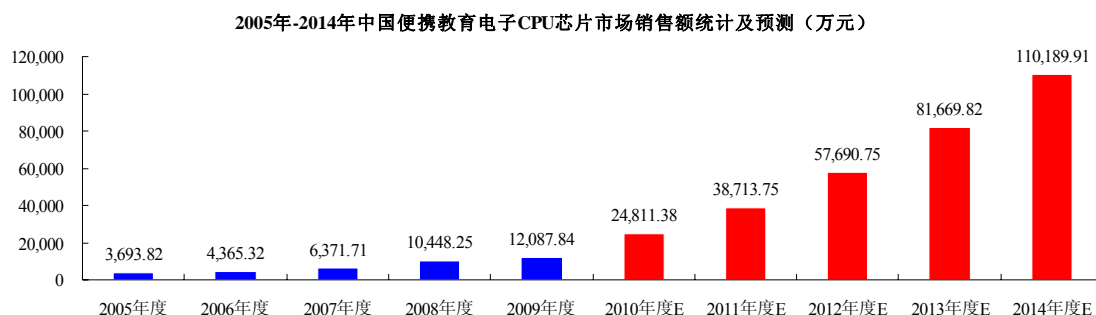
我国下游消费电子产品的升级换代、嵌入式CPU设计技术的高速发展、产业政策的大力支持以及内需的有效扩大，为未来国内便携消费电子CPU芯片市场的持续发展奠定了坚实的基础。预计到2014年，我国便携消费电子CPU芯片的销量将达到7,888.2万颗，市场规模将达到193,363.1万元（数据来源：CCID）。

（2）便携教育电子CPU芯片市场容量和发展前景

便携教育电子CPU芯片应用对象主要包括电子书、数码学习机、点读机、电子词典等。

2009年，国内外电子书市场均出现爆发式增长，带动全球便携教育电子CPU芯片市场销售量同比增长95.7%，达1,255.4万颗；销售额同比增长49.7%，达4,619.7万美元；国内便携教育电子CPU芯片市场销售量同比增长82.7%，达680.6万颗；销售额同比增长15.7%，突破12,087.8万元。2005年—2014年国内外便携教育电子CPU芯片市场销售额统计及预测具体情况如下：



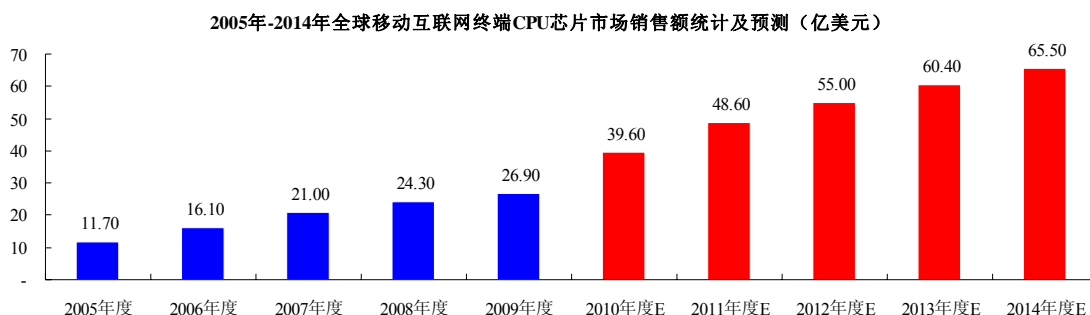


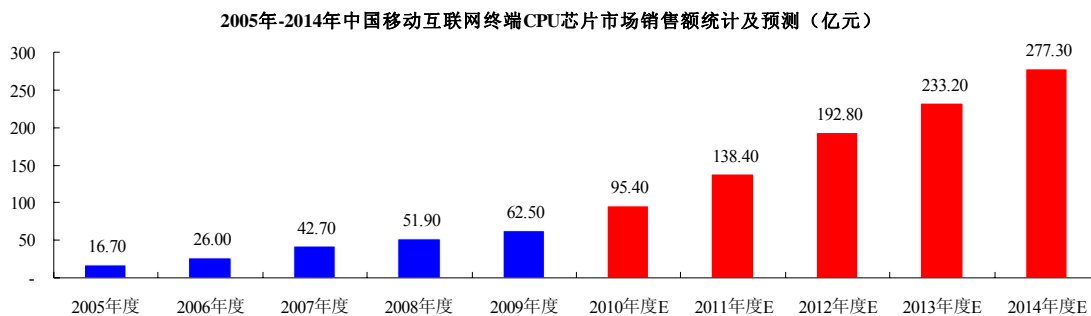
数据来源：CCID

随着国内电子书等新兴产品市场的持续高速增长，数码学习机、点读机、电子词典等产品的升级换代，便携教育电子CPU芯片市场也将面临更大的发展空间。预计到2014年，我国便携教育电子CPU芯片的销量将达3,542.7万颗，市场规模将达110,189.9万元（数据来源：CCID）。

（3）移动互联网终端CPU芯片市场容量和发展前景

互联网已经成为信息社会人们日常生活不可或缺的一部分，移动互联网结合了移动通信和互联网技术，能让用户随时、随地访问互联网，自主获取海量资讯和在线沟通，极大地满足了人们对资讯和沟通的实时需求。移动互联网终端CPU芯片应用对象主要包括智能手机、平板电脑、MID（移动互联网设备）、上网本等移动互联网终端设备。国际市场方面，随着3G技术的强势推广，全球对移动互联网终端的需求激增，极大地推动了移动互联网终端CPU芯片市场规模的迅速扩张。2009年，全球移动互联网终端CPU芯片市场销售量达到2.1亿颗，销售额达26.90亿美元。国内市场方面，我国3G网络建设、三网融合和智能手机的快速普及为我国移动互联网产业的崛起奠定了重要基础，国内移动互联网终端CPU芯片面临巨大的发展机遇。2009年，国内市场销售额达62.50亿元，销售量达7,000万颗，年均复合增长率达到54.6%，增速远高于全球平均水平。2005年—2014年国内外移动互联网终端CPU芯片市场销售额具体情况如下：





数据来源：CCID

我国人口众多，移动互联网的潜在客户群巨大。据工信部统计，截至2009年末我国已有手机用户约7.5亿户，随着3G的不断推广，越来越多的用户将把普通手机升级为智能手机，移动互联网终端产品市场将面临爆发式增长，必将相应带动国内移动互联网终端CPU芯片市场的快速增长。预计2010年—2014年，国内移动互联网终端CPU芯片市场销售额分别为95.40亿元、138.40亿元、192.80亿元、233.20亿元和277.30亿元（数据来源：CCID）。

（四）行业竞争状况

1、行业市场化程度

目前，国内外集成电路设计企业众多，行业已经高度市场化。

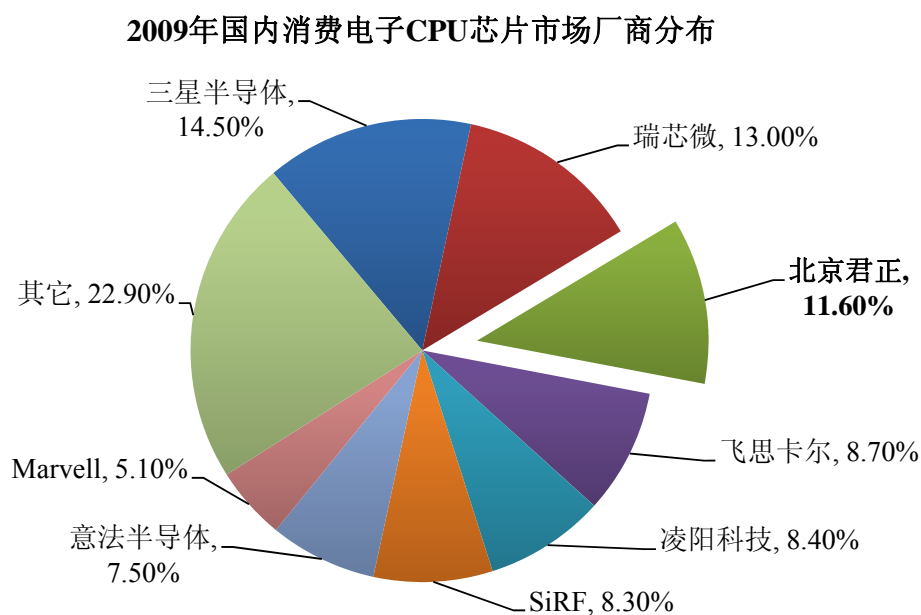
2、细分行业竞争格局

2005年以前，嵌入式CPU芯片设计行业基本为国外厂商所主导。近年来，随着ARM、MIPS等CPU IP核购买门槛的降低、SoC设计技术的广泛应用、晶圆制造企业和封装测试企业在国内的快速发展，国内集成电路设计企业开始逐步进入嵌入式CPU芯片设计领域并在一些细分市场取得成功。嵌入式CPU芯片设计行业的竞争格局正不断演变。

（1）便携消费电子CPU芯片市场竞争格局

便携消费电子领域在前几年的主要芯片供应商是欧美韩台的知名芯片设计企业，如美国的飞思卡尔、Marvell、SiRF，欧洲的意法半导体，韩国的三星半导体，台湾的凌阳科技等。近几年，国内开始涌现出优秀的芯片供应商，如瑞芯微在PMP领域有很高的市场占有率。凭借产品的高性价比、低功耗等特点，公司

近年来在便携消费电子CPU芯片市场取得了长足发展，市场份额迅速扩大。2009年国内便携消费电子CPU芯片市场厂商分布如下：

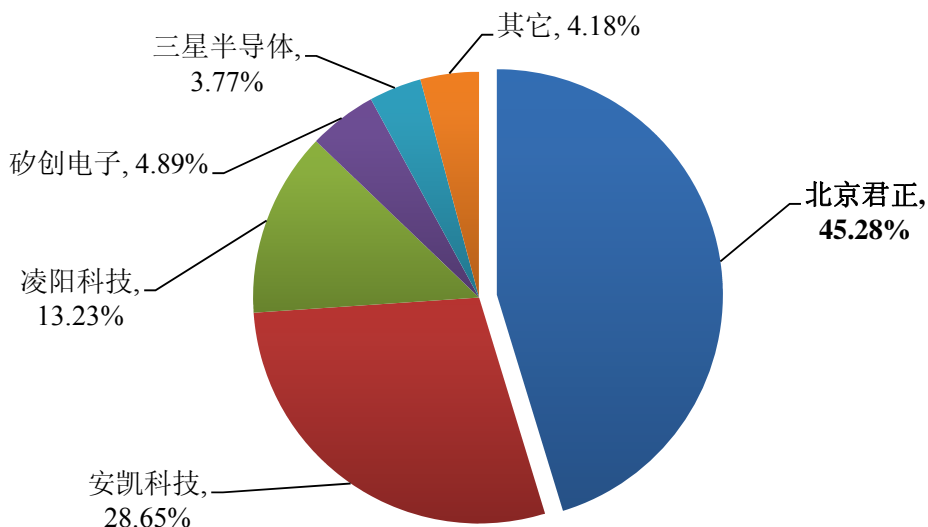


数据来源：CCID

（2）便携教育电子CPU芯片市场竞争格局

目前，国内便携教育电子CPU芯片市场正处于快速发展的起步阶段，参与竞争的集成电路设计企业不多，整体竞争格局相对简单。根据赛迪顾问的研究报告，目前公司在国内的市场占有率处于领先地位，安凯技术、台湾的凌阳科技、矽创电子以及国外的三星半导体、德州仪器和Marvell也占据了一部分市场份额。公司在国内便携教育电子CPU芯片市场销售量和销售额分别占38.61%和45.28%的市场份额，均在国内市场排名第一。2009年国内便携教育电子CPU芯片市场厂商分布如下（按销售额统计）：

2009年国内教育电子CPU芯片市场厂商分布



数据来源：CCID

3、行业进入壁垒

嵌入式CPU芯片设计行业是集成电路设计行业的核心之一，属于智力和资本密集型相结合的行业，对产业化运作有着很高的要求。因此，嵌入式CPU芯片设计行业主要在技术、资金和规模、产业化方面存在较高的进入壁垒，具体如下：

（1）技术壁垒

与面向某个特定产品领域的专用集成电路不同，基于32位嵌入式CPU芯片的应用是一个复杂的软硬件系统。嵌入式CPU芯片不但需要在硬件上连接通信模块、网络模块、人机接口模块等各种外围设备，还需要操作系统、驱动程序、中间件、应用软件等软件的配合。正是这种复杂性，导致嵌入式CPU芯片的研发周期长、产品风险大，这也是国产嵌入式CPU芯片一直很难成功的重要原因。因此，进入嵌入式CPU芯片行业，不仅需要突破CPU内核技术，还需要掌握硬件主板、操作系统、外围电路、产品设计等综合的知识技术体系，需要芯片设计公司具备强大的综合能力。

根据集成电路行业著名的摩尔定律，集成电路设计技术每18个月就更新换代一次，能否紧跟集成电路设计技术的高速发展、保持持续的核心竞争力和创新能力是进入本行业的另一大技术障碍。芯片新产品面市时的高利润会吸引大量模仿者，造成产品的同质化严重、供过于求，最终导致利润率下降。企业能否在后续

竞争中胜出或保持优势，关键是持续地进行技术创新并形成差异化的产品，这就要求企业具有自主核心技术，并具有强大的持续创新能力和产品应用设计能力。

（2）资金和规模壁垒

集成电路设计行业是一个投入高、周期长、风险大的行业。研发投入方面，以芯片研发阶段的掩膜环节为例，0.18 μm 的掩膜费用约为10万美元，0.13 μm 的掩膜费用约为15万—20万美元，65nm的掩膜费用更高达60万—80万美元左右。不同的芯片需要不同的掩膜，这要求企业在研发阶段就必须投入大量资金，以支持后期开发。企业规模方面，集成电路设计行业量产标准很高，存在高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，但芯片研发投入极大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达几十万颗甚至上百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化快、集成电路设计研发周期长及成功的不确定性较大，经常会出现产品设计尚未完成企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等尴尬局面。在集成电路设计行业发展并获取丰厚回报，需要企业投入大量的资金进行研发设计和预研究。因此，资金和规模是本行业的另一大壁垒。

（3）产业化壁垒

高素质的经营管理团队、富有技术创新理念的研发队伍和有效的营销战略是企业产品顺利实现产业化的重要保障。目前，市场热点层出不穷，企业管理层需要具备敏锐的洞察力、决策力和执行力，才能准确把握市场方向、提前布局。我国嵌入式CPU设计行业的高端技术人才相对稀缺，企业之间人才争夺激烈，只有产品的产业化，才能支撑一支稳定、具备创新能力的研发团队，以保证产品和技术研发顺利。此外，由于部分领域竞争激烈，优秀的产品需要采用有效的营销战略才能快速推广并广为市场接受。

（五）行业利润水平的变动趋势及变动原因

嵌入式CPU芯片设计行业处于电子产品产业链的最上游，与下游终端电子产品行业的景气状况密切相关。由于本行业属于智力密集型和资本密集型行业，进入壁垒较高，议价能力较强，因此本行业竞争力较强的企业能在产业链中持续获

得较高利润。此外，行业利润率水平与其创新能力也息息相关，电子产品更新换代很快，新产品通常可以获取较高的利润率。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）下游市场需求巨大

嵌入式CPU芯片用途广泛，产品应用涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费电子、移动通信、智能家电等领域。我国人口众多，随着国家进一步扩大内需，下游市场对嵌入式CPU芯片的需求量巨大。新的技术应用和推广导致新型产品出现，特别是目前便携消费电子、便携教育电子、网络和通信等相关技术的进步，极大地促进了本行业的发展，为行业带来了新的增长点。随着各种多媒体视频、音频编码和解码技术的发展，移动多媒体相关的数码产品需求大增；3G技术的应用带来通讯设备的革新，为嵌入式CPU芯片设计行业的发展提供了广阔的市场空间。

（2）国家产业政策支持

集成电路设计行业特别是CPU芯片设计行业是代表国家科技水平的标志性行业之一，对综合国力和国家安全具有重要影响。近年来，我国对集成电路行业及其子行业的发展给予了一贯的高度关注和政策支持。国家产业政策的扶持促进了行业内企业的发展，增强了企业自主研发能力，提高了国内集成电路设计企业的国际市场竞争力。

①2008年1月，原信息产业部编制并颁布的《集成电路产业“十一五”专项规划》中提出：“以应用为先导、优先发展集成电路设计业”，“形成以设计业为龙头、制造业为核心、设备制造和配套产业为基础，较为完整的集成电路产业链”，“鼓励设计业与整机之间的合作”，“培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品”，“到2010年，集成电路产业结构进一步得到优化，芯片设计业在行业中的比重提高到23%，芯片制造业、封装与测试业比重分别为29%和48%，形成基本合理的产业结构”。

②2009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中提出：“完

善集成电路设计支撑服务体系，促进产业集聚”，“引导芯片设计企业与整机制造企业加强合作，依靠整机升级扩大国内有效需求”，“支持设计企业间的兼并重组，培育具有国际竞争力的大企业。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化”。

（3）全球集成电路产业发展重心的转移带来的巨大发展机遇

随着全球集成电路产业重心明显向国内转移，国内外知名的晶圆制造企业、封装测试企业纷纷在我国建立、扩充生产线，为国内集成电路设计企业提供了充足的产能基础，我国日益成为世界集成电路制造中心。此外，我国拥有庞大的消费人口，市场容量巨大，国内集成电路设计企业也获得了更多的地域优势。随着国内集成电路设计技术的进步和人才的聚集，原来由国外企业垄断的CPU芯片设计技术也开始被国内少数企业掌握。因此，国内集成电路设计企业拥有完善的设计、生产、销售环境，有利于本行业在我国的迅速发展。

（4）工艺水平发展提升企业产品性价比

大尺寸晶圆制造技术日益成熟、封装和测试工艺水平的快速进步，也使得芯片制造、封装和测试的单位成本逐步降低、芯片产品的性价比不断提升，从而增强了国内整个行业的产品市场竞争力，促进了国内集成电路设计行业的发展。

2、不利因素

（1）基础技术薄弱

CPU是属于集成电路设计行业的最高端产品，设计出高性能的CPU需要大量的高端设计人才、CPU设计经验，投入相当多的各类资源和时间。我国在集成电路设计环境、设计工具、设计人才和设计经验等方面离世界先进水平还有较大距离，在CPU技术方面更是如此。由于基础技术薄弱，目前我国集成电路设计企业尚不完全具备向世界顶尖CPU设计企业挑战的能力。尽管如此，在嵌入式CPU领域，国内已经有少量企业研发出了能够与国外同类产品相抗衡的芯片产品。

（2）设计人才不足

集成电路设计行业为智力密集型行业，知识积累和技术创新至关重要，因此集成电路设计行业对于人才的依赖远高于其他行业。对比发达国家和地区，国内有经验的集成电路设计人才相对稀缺，这是造成国内集成电路设计整体技术基础

弱、水平低的主要原因，尽管近年来我国集成电路设计行业人员培训力度逐步加大，专业设计人员的供给量也在逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。

（七）行业技术、经营模式、周期性和区域性

1、行业技术水平和发展趋势

（1）行业技术水平

随着我国集成电路设计水平的不断进步，设计能力不断提升。根据赛迪顾问报告，我国设计工艺水平小于等于 $0.5\mu\text{m}$ 的企业比例已超过60%，其中设计工艺水平在 $0.18\mu\text{m}$ 以下的企业占较大比例，少数企业设计工艺水平已经达到65nm的先进水平，未来将向45nm迈进。

（2）行业技术发展趋势

①SoC技术是未来发展趋势

集成电路设计制造技术的快速发展，使得将嵌入式系统的大部分功能集成到一颗芯片上成为可能，即可在单个芯片上实现数据的采集、转换、存储、处理和输入输出（I/O）等多种功能，从而形成SoC芯片。

进入21世纪，由于计算机、网络通讯和消费电子等技术的加速融合，对CPU芯片的性能、功耗、集成度、开发时间、生命周期等提出了愈来愈高的要求，使得集成电路行业向超大规模集成电路发展，尤其是EDA工具技术的飞速发展以及第三方独立IP核的大量涌现，集成电路设计开始以IP核为基础进行SoC设计。IP核是一种预先设计好的甚至已经过验证的具有某种确定功能的集成电路，CPU内核就是IP核的一种。IP核本身通常经过成功验证，可供用户直接进行集成设计。基于IP核的SoC设计方法的采用，使得超大规模集成电路的设计成为可能，芯片产品的性能、集成度和复杂度等都可以大幅度提高，产品研发周期进一步缩短。SoC设计方法具有诸多优势，已受到越来越多的集成电路设计企业的青睐，是未来集成电路设计的发展方向。

②更加注重低功耗设计

当集成电路设计线宽进入90nm后，漏电流问题日益凸现，功耗管理开始成

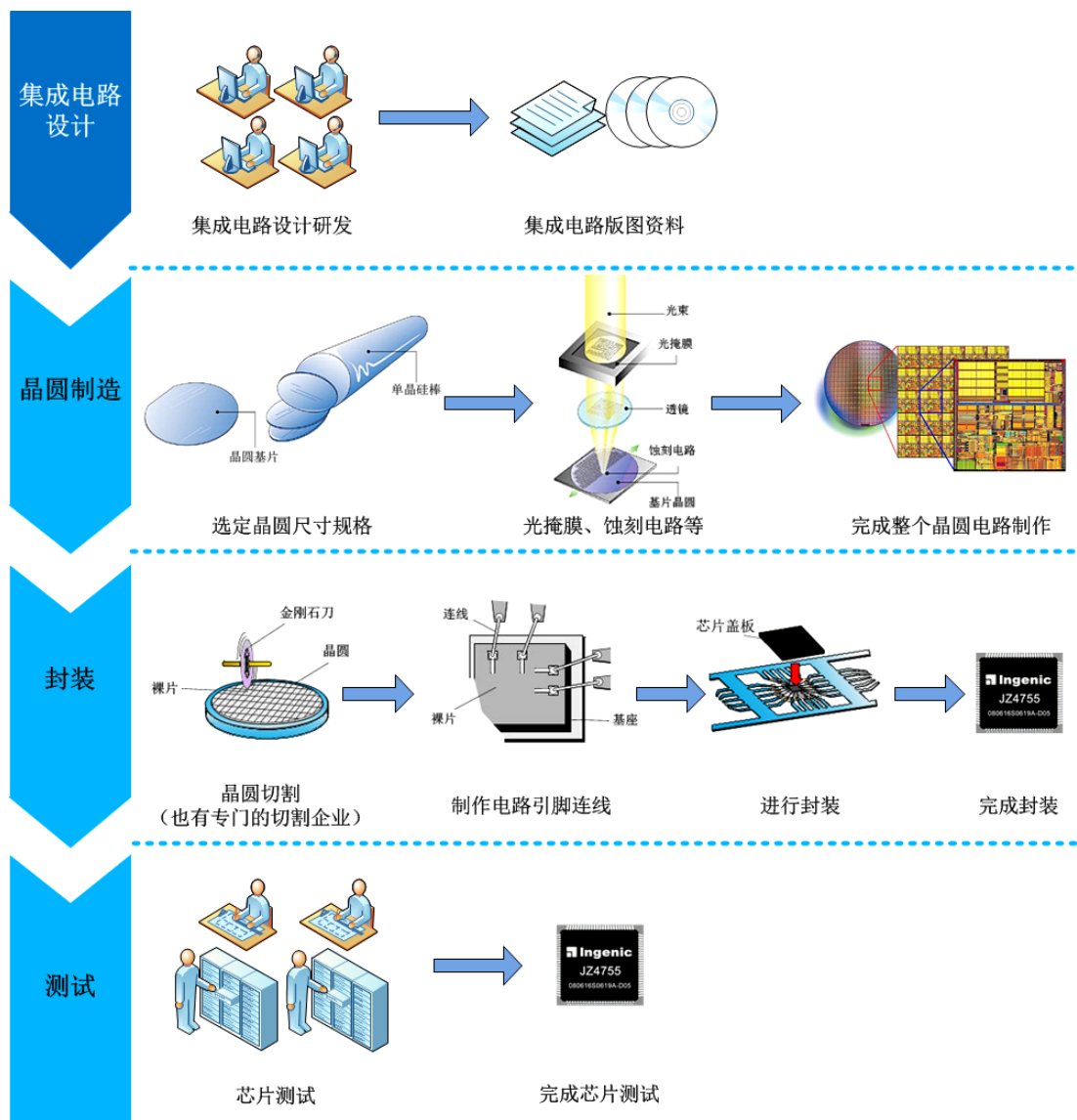
为一个重要的考虑因素，这种情况在65nm与45nm以下将更为严重。因为工艺节点的不断缩减导致栅极氧化层厚度越来越薄，栅极泄漏呈指数增长，最终出现漏电流现象。这迫使集成电路必须从设计之初就开始采用低功耗设计技术。

社会不断倡导的绿色、环保、低碳等理念，也使得低功耗技术成为集成电路设计中普遍的关注点。特别是便携式电子产品，对电池的体积和质量都有约束，随着CPU主频和集成度的提高，功耗和电池续航时间的矛盾日益突出，对降低CPU芯片功耗的要求更加凸显。降低CPU芯片能耗可有效延长电池寿命，降低用户充电或更换电池的频率，不但满足消费者对设备续航时间的要求，也符合绿色、环保、低碳理念。因此，低功耗设计将会是未来集成电路设计的主要发展方向之一。

2、行业特有的经营模式

（1）集成电路产业链情况

集成电路产业链主要由设计、制造、封装和测试等环节组成。其中设计是第一个环节，位于产业链的上游，属于智力密集型行业，是需要具有较高技术含量和创新实力的环节；制造环节为生产制造晶圆基片并将设计环节设计好的电路版图蚀刻在晶圆基片上，属资金、技术密集型行业，该环节投资巨大，通常一条晶圆生产线需要投资数亿美元；封装及测试为后段加工环节，资金及技术门槛相对较低。集成电路产业链的具体流程如下：



(2) 集成电路行业主要运营模式

从产业链角度来看，根据集成电路设计企业是否具有晶圆生产线，集成电路设计企业主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。

①IDM 模式

IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂，其业务范围涵盖集成电路的设计、制造、封装和测试等所有环节。晶圆生产、封装和测试的生产线建设均需要巨额资金投入。因此，这种模式对企业的研发力量、资金实力和市场影响力都有极高的要求。采用 IDM 模式的企业均为全球芯片行业巨头，主要代表为美国的 Intel、韩国的三星半导体等大型跨国企业。

②Fabless 模式

Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。

相比 IDM 模式，Fabless 模式下进行集成电路设计的资金、规模门槛较低，企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。因此，全球绝大部分集成电路设计企业均采用 Fabless 模式，主要代表为美国的高通、Marvell 以及我国台湾地区的联发科等。

Fabless 模式使得公司能在资金和规模有限的情况下，充分发挥公司的研发能力，集中资源进行集成电路的设计和研发，对公司的快速发展起到了至关重要的作用。

3、行业周期性、季节性和区域性

（1）周期性

嵌入式CPU芯片的应用领域十分广泛，是电子信息产业的基础。本行业主要随着国家宏观经济和社会消费的发展而发展，行业的周期性不明显。

（2）季节性

便携教育电子CPU芯片在学生寒暑假前一个月往往销量较大，但从整体来看，集成电路设计行业没有明显的季节性波动。

（3）区域性

截至2009年末，我国共有集成电路设计企业500多家，经过工信部认证的企业305家（数据来源：工信部）。目前国内集成电路设计行业主要集中在京津环渤海、长江三角洲和珠江三角洲这三大区域。这三大区域集中了全国90%以上的设计单位，2009年这三大区域集成电路设计企业销售额占到国内产业整体销售额的97.20%。2009年中国集成电路设计业销售收入区域构成如下：

区 域	销售额（亿元）	所占份额（%）
京津环渤海地区	82.13	30.40
长江三角洲地区	94.27	34.90
珠江三角洲地区	86.21	31.90

其它地区	7.31	2.80
合计	269.92	100.00

数据来源：CCID

（八）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

1、公司所处行业上下游

集成电路产业链分为上游的集成电路设计、晶圆制造、封装、测试和下游的电子产品制造。其中，集成电路设计是整个产业链的核心，为集成电路产品提供设计版图；晶圆制造、封装和测试均为集成电路设计企业提供加工服务。

集成电路设计企业设计的产品方案通过委托加工方式提供给晶圆制造企业、封装和测试企业制成成品，再由集成电路设计企业销售给下游的各种电子产品制造企业。

2、上下游行业对本行业的影响

晶圆制造企业、封装和测试企业为集成电路设计企业提供加工服务，对本行业影响体现在四个方面：①产品良率，受托加工企业的晶圆制造和芯片封装的工艺水平、集成电路测试的技术能力直接影响集成电路设计企业产品良率，从而影响单位成本；②交货周期，受托加工企业的产能直接决定集成电路设计企业产品的出货量，从而影响集成电路设计企业的交货周期；③产品成本，主要原材料晶圆价格、封装和测试费用也影响集成电路设计企业产品成本的高低和构成；④物流服务，受托加工企业配置的物流服务网络能否满足集成电路设计企业的配送要求，也将影响集成电路设计企业的市场开拓和维护。公司建立了完善的采购管理制度，从受托加工企业的选择、维护和合同管理等方面作出了明确的规定，最大程度上加强与受托加工企业的合作，避免其对公司产生不利影响。

电子产品制造企业将本行业设计的集成电路作为元器件，并配合其他软硬件系统进行电子产品的设计、研发和生产。下游企业直接面对终端消费者，并将终端消费者对产品性能升级、功能加强、价格降低等需求反馈到本行业，促使集成电路设计采用更先进工艺和更优化设计，以推出性能更强、价格更低的集成电路产品。因此，下游的需求升级和行业发展对本行业的快速发展起到了良好的促进

作用。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）公司竞争地位概述

公司是高新技术企业、中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、中关村高新技术企业、十大中国最具发展潜力IC设计公司。

1、公司是国内拥有自主创新 CPU 核心技术的极少数公司之一

公司拥有自主创新CPU核心技术——XBurst CPU技术。基于该技术的CPU内核在同样工艺下，性能、尺寸及功耗指标均明显优于国内外同类产品。相应的XBurst CPU芯片产品性价比高、功耗低，获得了业内的高度评价。2008年，公司应用该技术的CPU芯片产品JZ4740获得了“第三届（2008年度）中国半导体创新产品和技术”和“北京市自主创新产品证书”。

2、公司是国内出货量最大的自主设计嵌入式 CPU 芯片供应商

公司嵌入式CPU芯片产品获得了海内外市场和业界的高度认可。自2007年以来，公司嵌入式CPU芯片年出货量分别突破88万颗、550万颗和1,000万颗，领先于国内其他本土企业自主设计的同类产品，率先实现了国产嵌入式CPU芯片的产业化。2009年，公司产品JZ4740获得工信部软件与集成电路促进中心颁发的“2009年度‘中国芯’最佳市场表现奖”；2010年，公司产品JZ4750获得中国软件行业协会嵌入式系统分会等组织评选的“2009年度中国用户奖评集成电路‘最受用户欢迎奖’”。

3、公司是国内产品应用领域最广的自主设计 CPU 芯片供应商

依托“开放平台、纵横扩展”的市场策略，公司的嵌入式CPU产品成功进入了指纹识别、学习机、电子词典、点读机、学生电脑、PMP、电子书、POS机等多个应用领域，并在各应用领域均取得了较高的市场占有率。公司开放平台市场策略，允许用户独立地进行二次开发，使得公司产品的平台稳定性和应用领域范围均领先于本土其他自主设计的嵌入式CPU芯片。

（二）公司竞争优势

1、核心技术优势

公司拥有国际领先的自主创新 XBurst CPU 核心技术。XBurst CPU 指令集架构在工业界成熟技术的基础上进一步创新，综合了 RISC 指令和 SIMD 指令的优势，兼具计算、多媒体加速和信号处理能力；在 CPU 内核设计上引入创新因素，处理器能够在极低的功耗下高速发射指令。综合客户应用及公司测试表明，XBurst CPU 内核在相同工艺下，主频约为同类产品的 1.5 倍，面积约为同类产品的 1/2，功耗约为同类产品的 1/4。

CPU 内核设计复杂、技术含量高，大部分芯片厂商购买 CPU IP 供应商 ARM、MIPS 的 CPU IP 内核进行芯片设计，只有 Marvell、高通、Broadcom 等少数国际知名企业通过取得指令集架构授权再自主设计内核。本公司的 XBurst CPU 内核自主设计，是世界上少数成功量产的 CPU 内核之一。

CPU 是所有 SoC 芯片的基础，掌握了 CPU 技术意味着公司在核心技术上不受制于他人，避免了本行业中因为普遍采用 ARM、MIPS 内核而导致的芯片产品同质化现象。此外，掌握了 CPU 核心技术意味着占据了产业的制高点，公司能够根据市场的变化和趋势，及时推出符合市场需求的创新产品，不断拓展新的应用领域。

2、产品优势

自主创新 CPU 技术使公司芯片产品具有突出的优势，具体表现在公司产品的性价比和功耗指标远远领先于同类产品。

高性价比使公司产品在市场上具有非常强的竞争性，使得公司在短短三年之内迅速进入多个市场领域并且取得了较高的占有率。

低功耗优势使公司芯片产品在移动便携设备市场具有天然的优势。与桌面设备不同，移动便携设备采用电池供电，便携性、续航时间成为产品最重要的指标。今天，全世界的处理器厂商包括 Intel 都在为降低处理器的功耗而努力。公司产品的低功耗优势迎合了产业发展的趋势，成为市场竞争中独特的力量。

3、开放平台的市场策略优势

公司根据嵌入式 CPU 芯片及目标市场的特点，制订了“开放平台、纵横扩展”的市场推广策略。与国内大量集成电路设计企业仅提供芯片的 Turnkey 整体解决方案不同，公司一方面对市场容量大、产品功能相对专一（如 PMP、智能手机、平板电脑等）的垂直市场提供芯片 Turnkey 整体解决方案，以方便客户快速将终端产品推向市场，及时抓住市场机遇；另一方面，针对其他市场领域开放芯片技术资料、提供操作系统软件平台，以方便客户自行进行二次开发，显著扩大了公司产品的应用领域。

上述策略有效地支持了公司的市场拓展，使公司的产品既可以快速抢占 PMP 等垂直市场，也可以广泛应用于各种学习机、电子书、指纹识别等横向市场，通过点、面的有机结合，大大增强了公司的市场的竞争力，为公司进军不同的应用领域奠定了坚实的基础。

4、人才优势

集成电路设计行业是智力密集型行业，发展的最关键因素是人才。公司创始人刘强先生是国内嵌入式 CPU 行业的开拓者之一，在业内具有很高的声望。2009 年，刘强先生获得“中关村高端领军人才”称号，2010 年被新华社等媒体评为“中关村十大创新创业人才”。

公司核心技术团队成员在集成电路设计行业的从业经验均超过十年，具备计算机体系结构、编译器软件、操作系统软件、SoC 前后端设计等嵌入式 CPU 领域所需要的专业知识和领域技能。丰富的从业经验、宽广的技术视野及多年的团队合作精神形成了公司的创新基因和创新文化。

5、市场区域优势

随着全球电子信息产品的生产重心转移到国内，我国将成为全球最大的半导体消费市场。相对于海外竞争对手，本土企业更加接近、了解市场，对市场反应速度更快。在这种市场环境下，一旦本土芯片设计企业在某领域突破了技术门槛和产业化门槛，欧美公司将逐步在该领域丧失竞争力，公司在 PMP、电子书等领域的成功均证明了这点。

6、产业链上下游协同优势

公司是中芯国际、安靠科技、通富微电等著名代工厂和封装测试大厂在大陆重要的客户，并与这些企业结成了合作伙伴关系。下游客户方面，公司已与步步高、爱国者、诺亚舟、汉王科技等国内著名企业结成了合作伙伴关系，芯片产品已被大量客户所采用。

（三）公司面临的挑战

1、资本不足带来的挑战

相对于国外领先的竞争对手，公司目前的资本实力差距巨大。公司目前资金来源主要依靠自身积累。无论在技术研发、市场推广、产品升级换代速度等方面均受到资金投入不足的严重制约。

2、高级人才储备不足带来的挑战

嵌入式 CPU 芯片设计行业属于智力密集型行业。随着公司产品研发工程规模的快速扩大和业务应用领域的不断扩张，为保持公司持续创新能力和市场地位，公司需要大量高端技术、营销和管理人才。如何建立一个适合公司发展速度的人力资源体系，满足公司快速发展对大量高端人才的需求，这将是公司在未来竞争中面临的重要挑战。

3、规模扩大带来的管理挑战

现阶段，公司规模较小，管理架构和管理流程也相对简单。公司业务规模的持续快速增长，将在战略规划、研发管理、激励机制以及企业文化建设等方面对公司管理水平提出更大的挑战。

（四）主要产品市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势

1、产品市场占有率和近三年的变化

近三年，公司主要产品国内市场占有率按销售额统计情况如下：

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
便携消费电子 CPU 芯片	11.60%	9.10%	2.10%
便携教育电子 CPU 芯片	45.28%	31.03%	17.12%

数据来源：CCID

凭借产品的高性价比、低功耗优势，公司主要产品在便携消费电子、教育电子 CPU 芯片领域的市场占有率逐年上升。近三年，公司在国内便携消费电子 CPU 芯片市场占有率按销售额的排名由原来的十名以外上升至 2009 年的第三名，销售量排名则上升至第二名；便携教育电子 CPU 芯片市场占有率按销售额和销售量的排名由原来的第三名均上升至第一名。

2、未来的变化趋势

随着公司在嵌入式 CPU 芯片技术方面不断深入研究开发，公司将继续推出更加富有竞争力的产品，满足现有产品市场未来升级换代的需求，并在时机成熟的时候不断进入新的应用领域。

便携消费电子领域，指纹识别、掌上游戏机、手持电视和 PND 类产品将继续保持增长，PMP 类产品经过了爆发式增长后将逐渐进入平稳发展期。公司在继续保持现有便携消费电子 CPU 芯片细分市场份额的同时，积极拓展掌上游戏机、手持电视和 PND 细分市场产品应用领域。

便携教育电子领域，学习机、电子词典和点读机产品市场的稳步发展，电子书、学生电脑等新兴热门便携教育电子产品的涌现，将为公司便携教育电子 CPU 芯片带来更大的市场空间。

此外，公司将在巩固发展现有细分市场地位的前提下，积极向智能手机、平板电脑、互联网电视等新的产品应用领域拓展，扩大产品适用范围，丰富公司产品线。

（五）主要竞争对手简介

本公司主要竞争对手情况简介如下：

（1）三星半导体。该公司是韩国三星集团旗下的半导体产品研究机构，对电子零部件和集成电路的软件、硬件及解决方案、半导体封装技术进行研发。其

产品主要集中在存储器领域，近年来也积极开发其它产品类型，例如应用处理器，手机芯片、ASIC和其它消费类产品等。

（2）瑞芯微。该公司是我国本土的集成电路设计公司，其产品主要包括数字音视频处理芯片系列、语言复读机芯片系列、数字调谐收音机控制芯片和手机多媒体处理芯片四大类。

（3）飞思卡尔。该公司于2004年由摩托罗拉半导体部门独立而成，为汽车、消费、工业、网络和无线市场设计并制造嵌入式半导体产品，其产品主要应用于视频和音频媒体播放器、移动游戏控制台、GPS系统、智能电话、PDA、便携手持计算机和其它无线移动设备。

（4）凌阳科技。该公司于1990年成立于台湾，在台湾及伦敦交易所均挂牌上市，其主要产品有数字影音播放器单芯片、机顶盒芯片、电视芯片等。在便携消费电子领域，凌阳科技的产品主要用于PMP和掌上游戏机。

（5）安凯技术。该公司2000年成立于美国硅谷，其后公司总部迁至中国大陆，其产品主要用于MP3、MP4、学习机及以视频监控产品为主线的终端，包括手机产品芯片、数码产品芯片、开发平台及相关产品的解决方案。

（6）德州仪器。该公司是全球领先的集成电路设计制造公司，其主要产品为ARM、MIPS等架构的门类齐全的处理器及其它半导体元器件方案。在便携教育电子领域，德州仪器的芯片主要用于高端产品中。

（7）高通。该公司于1985年成立，是全球领先的无线通讯技术公司，总部设在美国，其主要为移动互联网设备提供通讯基带及应用处理器集成的产品。

（8）Marvell。该公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商。在移动互联网方面，其主要推出了手机及手持设备业务方面的系列产品，并逐步推出了通讯基带和应用处理器芯片的高集成产品。

（9）联发科。该公司成立于1997年，在台湾证券交易所挂牌上市，其主要产品用于光存储、数码电视、手机基带、消费电子、无线互联网等领域中。

四、发行人主营业务情况

（一）发行人主要产品及用途

公司主要产品详见本节之“一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”之“（二）发行人主要产品及其变化情况”。

1、芯片产品

公司的主要产品为32位嵌入式CPU芯片，具体为JZ47xx系列。针对细分市场的不同需求，这些芯片产品具有不同的主频、多媒体能力、外围电路、集成度及封装形式。目前公司芯片产品主要采用0.18 μm 和0.16 μm 工艺，对0.13 μm 工艺和65nm工艺的芯片设计技术研发也取得了重大进展。

2、操作系统软件平台

嵌入式CPU芯片必须结合操作系统平台的支持，才能应用到各种领域。基于市场需求，公司提供了各种操作系统的支持。其中，MiniOS是公司自主研发的小型实时操作系统，主要应用于PMP、教育电子等领域；Linux和Android是开放源码的操作系统，广泛应用于消费电子、教育电子、移动互联网终端等各种领域中。公司对Linux和Android的底层核心、驱动程序、中间件进行移植与优化，提供完整的测试、维护服务并向客户提供技术支持。

3、整体解决方案

公司针对产品功能相近、市场量大的垂直市场提供Turnkey整体解决方案。这些方案包括软硬件的完整设计，用户只要改动模具、按键和用户界面，就可以设计出新的产品。Turnkey整体解决方案可以加快用户产品的上市速度，利于芯片产品在某个垂直市场迅速占领市场。公司目前PMP领域的Turnkey整体解决方案已经应用于市场，智能手机解决方案和平板电脑解决方案正逐步成熟。

4、公司产品主要应用领域

公司产品主要应用于移动便携设备市场，目前主要包括便携消费电子、教育电子及其他市场。目前，在便携消费电子领域，应用产品主要包括PMP、游戏机、

移动电视和指纹识别等；在便携教育电子领域，应用产品主要包括学习机、学生词典、点读机、学生电脑、电子书等；在其他领域，产品逐步应用于POS机、互联网音频设备、互联网电视、闪联卡等。



公司产品用途示意图

（二）发行人的市场推广策略

国内外芯片企业在市场推广中，采取了不同的策略。

国外知名企业通常采取开放策略，将芯片技术资料、操作系统底层开放给客户或设计企业进行二次开发，由客户或设计企业完成产品的应用开发。开放策略要求芯片设计企业提供完整的芯片技术资料和操作系统平台的同时，还要提供硬件平台、操作系统软件平台的维护和支持，企业必须具备雄厚的技术实力才能使自己不会因资料开放而被对手使用和超越。该策略的优点是芯片产品能够应用于多个产品领域，产品生命周期长，不容易出现“一代拳王”的风险。Marvell、TI、三星半导体等企业均采用这种策略。开放策略的缺点是企业开放技术资料易于为对手所学习，需要企业有很强的底层系统软件支持能力，另外芯片产品切入

市场及市场普及的速度也较慢。

大陆和台湾地区企业通常采取封闭策略，针对某个特定市场，提供从芯片到软件的整体解决方案（通常称为Turnkey方案），直接交给客户进行生产。封闭策略在MP3、手机等领域中普遍被采用。封闭策略需要芯片企业负责所有的应用软件，对最终用户提供更多的技术支持。其优点是切入市场速度快，产品在短时间内可以迅速普及。其缺点是芯片往往只能应用于某一个专用领域，一旦为竞争对手所模仿，容易出现“一代拳王”的现象。

公司根据自身的技术储备及研发实力，将上述两种市场推广策略进行了有机结合，制订了“开放平台、纵横扩展”的策略，如下图所示：



1、在市场容量大、产品功能相对专一的垂直市场采用封闭策略，提供Turnkey整体解决方案，以便快速抢占市场。公司已于2008年成功推出PMP的Turnkey整体解决方案，迅速取得该市场的领先地位；目前，公司正着手推出智能手机的整体解决方案，平板电脑的整体解决方案也在研发之中。

2、在其他领域采用开放策略，提供与公司芯片产品配套的MiniOS、Linux、Android等多个操作系统软件平台，开放技术资料和源代码供客户进行二次开发，拓宽产品应用领域。目前，公司通过该策略成功拓展了学习机、电子书、上网本、

POS机、闪联卡等市场，市场应用领域正在进一步扩大。

公司的“开放平台”市场推广策略，是指将芯片的规格说明书、对外接口、使用方式、编程接口以及相应的操作系统平台开放给开发者进行二次开发，而最核心的芯片电路设计文档、电路描述、代码等则不会开放。仅仅通过芯片的规格说明书等资料，客户和开发者无法获取发行人的核心技术秘密。

（三）发行人的研发策略与流程

1、研发策略

（1）自主研发

通常国外芯片企业不提供整体解决方案，而是委托第三方设计企业提供；而国内企业通常采用购买知识产权供应商的CPU内核和其它关键IP核，并且将部分设计外包给设计服务企业。

本公司坚持“核心技术必须自主研发”的理念，CPU IP核及关键IP核、芯片前后端设计、软硬件开发平台、整体解决方案等全部自主研发。

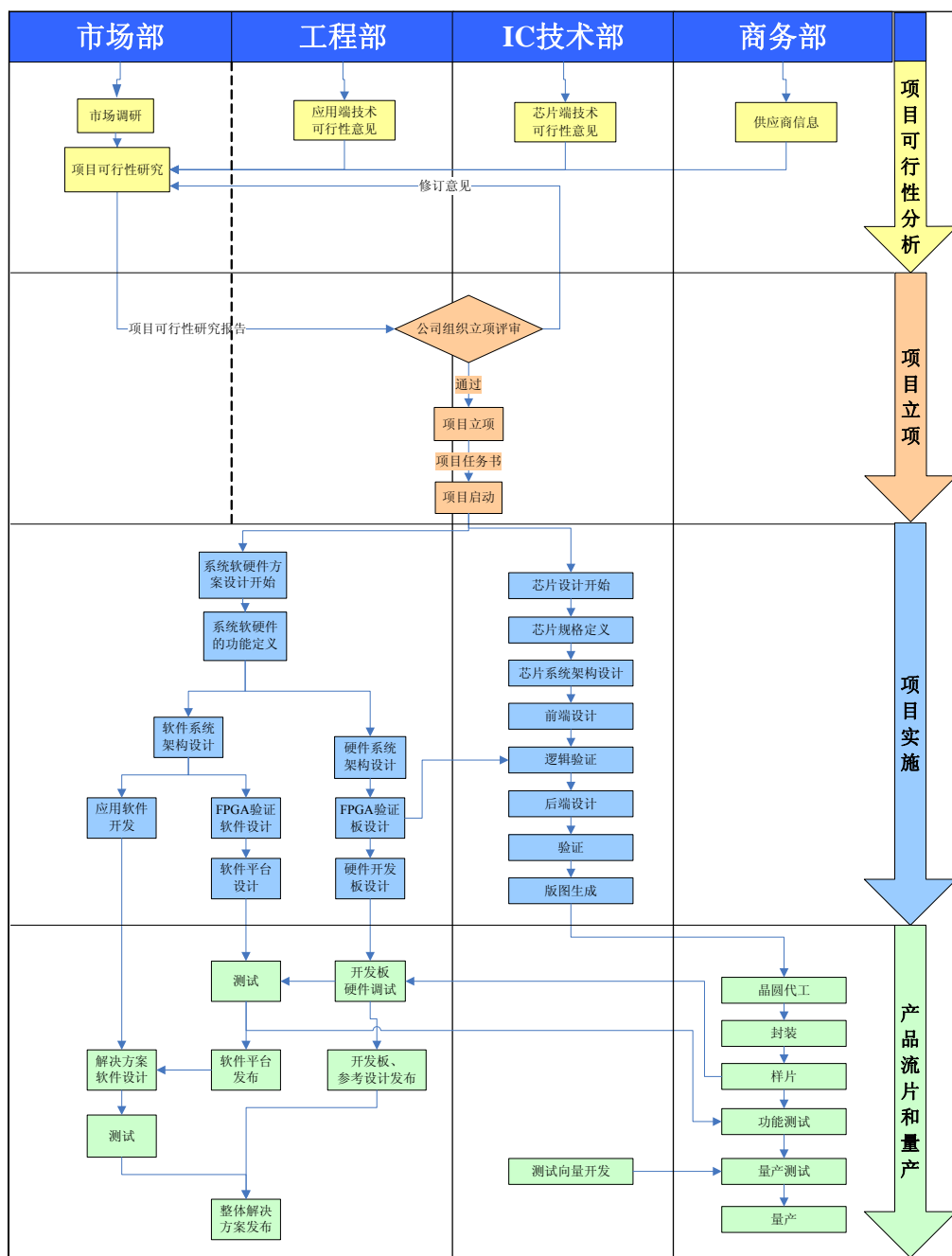
（2）市场导向

公司自成立以来一直坚持“以市场为导向”的产品研发策略，紧紧把握市场需求，时刻保持敏锐的嗅觉和快速的反应速度，专注于创造有市场价值的技术，创造性地满足不同客户和市场的需求。为此，公司在芯片研发前均进行详细的市场调研，结合自己的技术特色进行产品定位，以市场需求定产品规格，以产品规格定研发计划，实行市场导向研发模式，不断为客户提供具有国际竞争力的CPU芯片产品和解决方案。

2、研发流程

公司对产品研发实行严格的流程管理，涵盖了从研发项目可行性研究、立项、实施到产品流片和量产等重要环节，以确保产品研发的全过程得到科学有效的控制并达到预期目标。

公司的产品研发流程如下：



(1) 产品研发项目可行性研究阶段

首先，市场部进行目标市场分析和调研，再组织IC技术部、工程部和商务部等部门对调研结果进行可行性研究，以保证拟开发的产品符合市场需求、成本具有竞争力。

(2) 产品研发项目立项阶段

①组织IC技术部、工程部、市场部、商务部对项目可行性研究结果进行评审；
②根据项目要求确定详细的芯片规格、技术指标、系统软硬件方案和项目进度安排，根据人员需求计划成立跨部门项目组，并制定项目目标；③为加快项目进度，

采用软硬件协同设计方法，由跨部门项目组对芯片设计与系统软硬件同时进行开发；④确定系统架构设计、前端设计、后端设计、流片和样片生产、批量生产等阶段的任务分工及进度要求；⑤确定硬件开发板设计、软件平台研发、应用程序开发、客户试用与测试、整体解决方案完成等阶段的任务分工及进度要求。

（3）产品研发项目实施阶段

项目启动后，项目负责人带领项目组成员，根据项目目标的要求和既定的进度安排分别开展研发工作，以召开项目周会和项目协调会的方式，组织解决研发过程中遇到的问题，协调跨部门资源，保证项目研发工作的实施。与此同时，公司组织各部门负责人和内部技术专家小组定期召开项目进度会，对阶段性研发成果进行检查和评审，听取项目进度情况，分析研发过程中出现的新情况，给出评审意见及关键技术问题的改进意见。最后，IC技术部完成版图设计，准备进行产品流片；工程部完成软件及开发板设计，准备进行软硬件调试。

（4）产品流片和量产阶段

版图交与晶圆制造企业后，研发项目进入产品流片和量产阶段。商务部负责与晶圆制造、封装、测试相关企业进行商务沟通和投片安排，将集成电路产品版图交与晶圆制造企业进行样片生产，生产完成后再交与封装和测试企业进行封装测试，完成产品流片工作。随后，项目组根据样片测试情况，对版图设计做进一步修改和定型，根据样片调试软硬件开发平台，提供软硬件的修改建议。调试和修改完成后，样片送交电子产品制造商进行试用和评测。项目组在软硬件开发平台的基础上推出开放性的软件平台和整体解决方案，并负责后续的软硬件升级和系统维护工作。

产品样片试用和评测后，市场部向项目组提交试用和评测意见。通过各种测试和品质控制后，项目组提交产品量产申请，经公司审批，由商务部根据市场销量预测及芯片生产周期，向代工企业下订单进行批量生产。

（四）发行人的生产与销售模式

1、生产模式

公司采用Fabless模式运营，专注于芯片设计，芯片产品生产环节的晶圆生产、

切割和封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商进行。公司主要向晶圆制造企业采购晶圆、向封装和测试企业采购相关的服务、向IP提供商采购部分IP核。公司负责研发设计集成电路线路图，再根据市场需求，由公司或香港君正集团向供应商下订单生产。芯片产品的具体生产流程详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（七）行业技术、经营模式、周期性和区域性”之“2、行业特有的经营模式”。

（1）供应商遴选标准

公司研发人员和商务人员组成供应商评估团队，对晶圆制造企业、封装企业和测试企业进行技术评估、估算代工价格并核准合格供应商名单。公司选择供应商的标准主要包括工艺水平、产能、价格、物流及地理位置等方面。

（2）报告期内公司委托加工情况

公司芯片生产的全部环节均通过委托加工商完成。报告期内，公司委托加工的数量及金额情况如下：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
	(颗)	(万元)	(颗)	(万元)	(颗)	(万元)	(颗)	(万元)
委托加工	4,856,502	3,629.70	10,309,198	7,549.67	8,151,802	8,014.95	1,064,603	1,936.88

报告期内，公司委托加工管理金额情况如下：

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
晶圆加工	21,568,752.64	49,281,117.78	46,393,238.71	11,271,355.41
封装加工	12,928,698.86	23,792,543.03	30,561,790.66	7,252,084.26
测试加工	1,799,537.99	2,423,031.83	3,194,502.29	845,370.78

注：晶圆加工单位为中芯国际；封装加工单位包括通富微电、深圳安博、安靠公司和东莞英展；测试加工单位包括京隆科技、东莞英展、通富微电和安靠公司。

（3）公司委托加工过程中对其产品的质量控制和技术保密措施

公司高度重视产品的质量和性能，在严格考核委托加工商的基础上，对委托加工过程实施严格的管理和跟踪，以确保产品达到公司的质量和性能要求。

①质量控制措施

在晶圆生产环节，除要求对方提供符合工艺要求的晶圆生产外，在协议中明

确成品率要求，并结合后续封装和测试结果对晶圆厂进行约束；在封装环节，不仅要求封装的成品率，而且明确要求封装厂对来料进行严格的质量控制，对全部来料进行检测；在测试环节，不仅要求检测的成品率，而且要求测试厂对来料进行严格的质量控制，对来料进行抽检，检验其是否符合公司规则 and 性能要求并对检测结果负责。

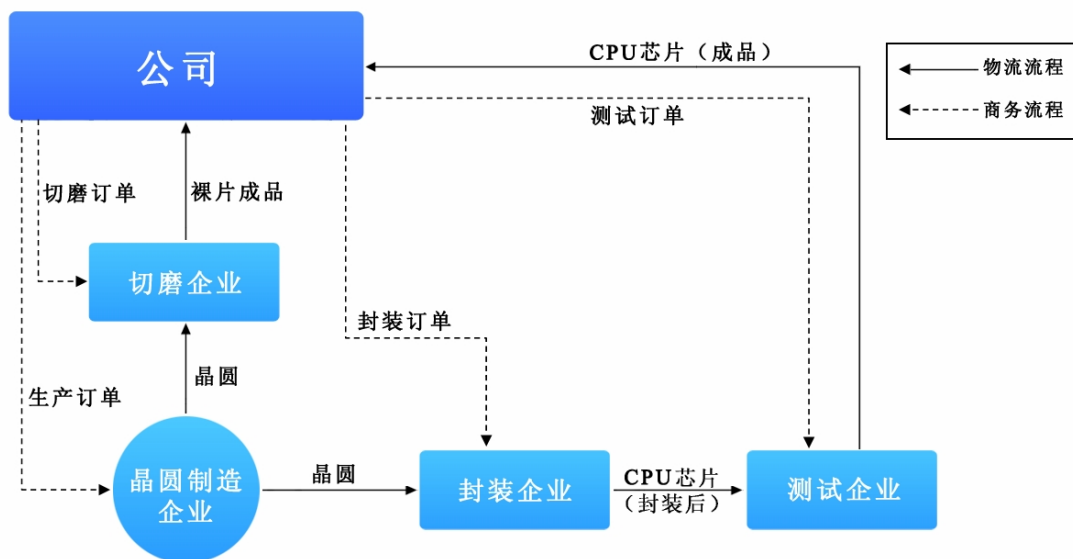
②技术保密措施

拥有核心技术是集成电路设计企业生存的关键，公司高度重视核心技术的研发和保密工作。在晶圆的生产环节，除了与委托加工厂商签订保密协议外，公司只将芯片版图提供给晶圆制造企业进行芯片的代工生产，最核心的知识产权即芯片电路的设计文档、电路描述、代码等不提供给代工企业；封装与测试环节不涉及核心技术，不会出现技术秘密被泄露的情形。

（4）采购流程

公司通常结合自身对市场的判断和客户的需求拟定采购计划，向晶圆制造企业下订单，晶圆制造企业接到订单后排期并安排生产。晶圆的生产周期通常为1.5-2个月。晶圆制造完毕后进行晶圆测试，符合公司良品率要求的晶圆，或发送到公司指定的切磨企业进行裸片加工，加工完成后直接发往公司，或发到封装企业进行封装。封装完成后，待测试的芯片发往公司指定的测试企业，完成芯片的测试，最后产成品发送至公司。

公司采购的流程如下：



经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为：报告期内，发行人不直接从事生产活动，主要专注于芯片产品的设计，最终产品需要通过委托第三方加工的方式进行生产，此种委托加工方式符合行业惯例和发行人的实际生产情况；报告期内，发行人生产委托加工商（主要包括晶圆制造、封装和测试加工商）均为知名代工企业，与发行人及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；报告期内，发行人与各委托加工商有委托加工合同或订单，并得到良好的执行，不存在纠纷，委托加工费的确定方式均采用市场化的方式由交易双方协商确定，价格公允；发行人实施的质量控制措施有效地控制了委托加工产品的质量；在晶圆的生产环节，发行人与委托加工商在协议中约定了保密义务，未出现过技术秘密被泄露的情形；封装与测试环节不涉及核心技术，不会出现技术秘密被泄露的情形。

2、以“经销为主、直销为辅”的营销模式

公司与其经销商的关系属买断式销售关系，即公司将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至经销商，无论经销商是否将商品再销售出去，对于公司来说，已实现了实际销售并可据此确认收入。

（1）“经销为主、直销为辅”的营销模式是集成电路设计行业通行的销售模式

集成电路设计属于智力密集型行业，研发和设计能力是业内企业最具核心竞争力的体现，信息产业的迅猛发展也使集成电路所涉及的行业更加细分和多样化，这决定了集成电路设计企业须将主要精力及资源集中于新产品的研发设计领域。基于该原因，目前，包括 Intel、AMD、德州仪器、联发科、三星半导体、凌阳科技等在内的绝大部分知名集成电路设计企业的产品销售均主要采用经销为主的模式。

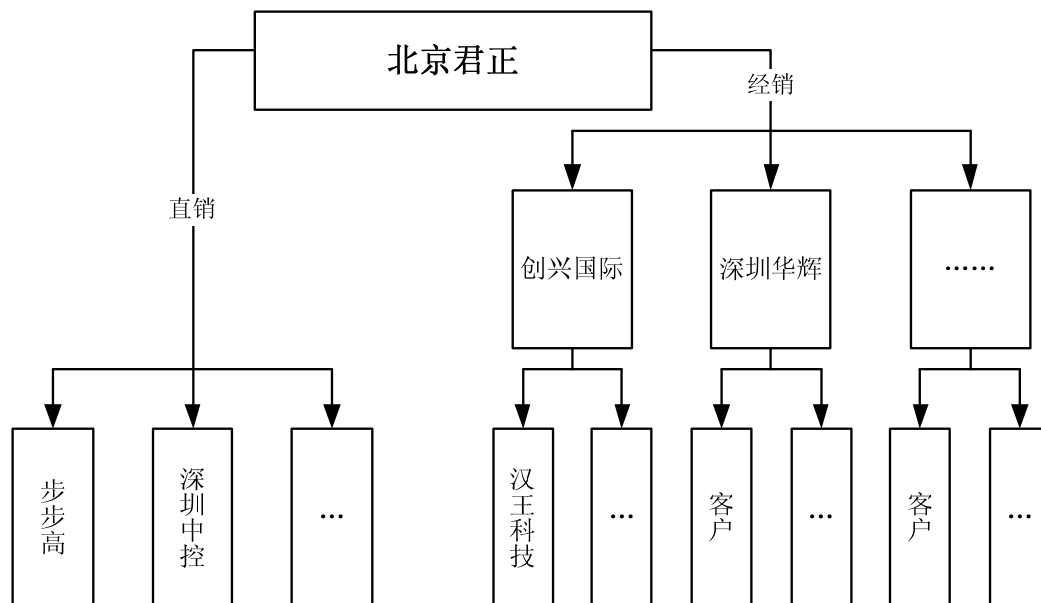
其次，嵌入式 CPU 芯片产品应用领域非常广泛，下游客户群体众多、规模不一、需求千变万化、订单零散，小规模集成电路设计企业自身拥有较大的市场营销团队并不经济。

综上，在集成电路设计行业中，企业通常会采用经销为主、直销为辅的方式进行产品销售。

（2）公司营销模式的具体运行方式

①公司的营销结构

公司成立以来，逐步形成了经销为主、直销为辅的销售模式，相关示意图如下：



②公司销售部门设置及运行

公司内部管理销售的主要部门为商务部、市场部和工程部。其中，商务部、市场部进行直接的销售管理工作，工程部负责产品应用研发以及对经销商和客户提供技术支持。各部门在销售中的具体工作为：

部门	销售管理的具体工作
商务部	负责销售组织的建立、营销资源的分配、配合市场部执行和管理市场拓展战略以及客户支持服务等。具体包括对经销商的管理和支持、对直销客户的管理和维护、经销商和客户的信用管理；制定公司价格体系、监督和管理市场秩序；如遇经销商违反市场规则，则对经销商进行处罚。

市场部	负责企业发展规划的拟订；公司的宣传推广、品牌建设、市场信息的收集整理及研究；组织新产品的调研和客户意见反馈收集；确定产品功能、性能指标等市场需求；跟踪客户项目状态并配合工程部提供技术支持服务；市场活动的举办以及其他市场工作。
工程部	负责系统开发板、产品设计参考板的设计开发；软件平台的移植、优化和开发；整体解决方案的开发和整合；提供技术支持等工作。

③直销客户与经销客户的选择

为避免资金过多的沉淀于销售环节，公司对销售回款有严格的要求，基本采取款到发货的交易形式。对具备强大资金实力、具有发展前景、采购量较大以及无需过多技术支持的客户，公司采用直销模式；其他无法达到标准的企业，公司选择采用经销模式，具体情况如下：

A、直销客户的选择标准

a、客户信用及结算条件

公司一般采用款到发货的销售形式。针对信用口碑较好、规模和资金实力足以支持其按时付款，并且结算周期在公司可接受的合理范围内的终端客户，公司可以发展成为直销客户。

b、交货条件

为避免承担过多的物流费用，针对采购频率不高、单次采购量大且位于交通发达、运输方便地区的客户，公司可以发展成为直销客户。

同时满足上述条件的客户，公司可选择直接销售。此外，对有潜力的新客户如其采购量不大且采用“款到发货”的销售形式，公司通常采用直销方式。通过与客户的前期直销，对客户的最最终产品、市场前景以及公司信用等进行综合评估，由此判断该客户未来进行大规模采购时适用的销售方式。

B、经销商客户的选择标准

公司依据不同需求，根据经销商的市场开拓能力、资金实力、公司规模、信用情况等因素选择经销商。

④经销商的管理

为及时掌握公司芯片产品的最终销售情况及使用情况，随着公司营销模式的发展和完善，公司逐步建立了经销商管理制度包括下游客户报备制度、定期拜访

制度、销售报表管理制度以及市场价格管理体系制度等，主要内容如下：

A、客户报备

公司要求经销商须定期将自己服务、供货的客户对公司报备，详细说明客户情况、联系方式、销售产品种类及型号等情况。

B、定期拜访

公司要求经销商须定期进行客户拜访，了解客户的需求变化。公司不定期地对部分终端客户进行拜访，了解客户对产品的使用情况、对经销商服务的满意度以及经销商报表的真实性进行核查。

C、销售报表管理

公司要求经销商须按照相关的格式定期提供其产品销售和库存报表，公司定期对其提供的报表真实性进行核查。

D、价格体系管理

对于特定市场，公司对客户统一定价，并根据市场情况不定期更新价格体系，经销商须严格执行和维护公司的价格体系。对于未统一定价的市场，经销商可以根据市场情况，在公司允许范围内自行定价，但需要提前报知公司。

E、押金管理

公司在选定经销商后，综合考虑经销商的采购规模及频率、信用记录、结算方式和行业经验等因素，确定是否需要该经销商支付购货押金及其金额。

对采用款到发货的经销商，公司不要求提供押金。对有信用额度的经销商，公司要求该经销商就结算周期内累计采购额超出信用额度的部分，预先支付押金；对通过综合评估但无法提供信用记录的客户或行业经验欠缺的客户，公司要求该经销商提供押金。

公司收取押金后，定期综合考虑评估与经销商的业务合作情况，可要求经销商增加或降低押金标准。

（3）“经销为主、直销为辅”的销售模式对公司的影响

通过采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，公司一方面可以通过经销商及时了解客户需求、为客户提供及时周到的服务、维护良好的市场秩序、深入拓展各个市场领域；另一方面，相对简洁的销售组织架构实现了高效的市场运作，借助经销商的作用，避免了在销售方面的过高投入和流动资金的沉淀，从而使得

公司能将主要资源集中于核心技术的研发。

总体而言，公司所采用的销售模式合理、经济，符合集成电路设计行业惯例。报告期内，公司营业收入实现了逐年快速增长，充分表明目前公司的销售模式是合理的。

（4）经销与直销的金额及比例

报告期内，公司经销与直销的金额及比例具体如下：

单位：万元

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销	8,885.26	78.80%	13,648.39	71.00%	10,359.20	71.52%	1,211.56	35.26%
直销	2,390.79	21.20%	5,574.11	29.00%	4,125.02	28.48%	2,224.47	64.74%
合计	11,276.04	100.00%	19,222.50	100.00%	14,484.22	100.00%	3,436.03	100.00%

2007年，公司处于创业发展初期，经销商体系尚在建设当中，自行发展的直销客户销售占比较大。2008年，随着公司销售体系逐渐完善，经销商数量以及经销占比大幅增长，销售结构趋于稳定。

（5）发行人经销的最终销售情况

公司经销商主要根据终端客户的实际需求向公司采购，通常不会存在产品积压情形。根据经销商报备的销售报表，2008年度、2009年度和2010年1-6月，各经销商向采购量超过20,000颗（半年采购超过10,000颗的客户）的终端客户销售情况汇总如下：

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
公司经销金额（元）	88,852,555.42	136,483,850.44	103,592,049.92
公司经销的总数量（颗）	4,454,956	7,265,792	3,873,377
统计的终端客户数量（家）	53	55	27
统计的终端经销数量（颗）	3,643,510	5,726,638	2,674,063
统计的终端经销数量占比	81.79%	78.82%	69.04%

注：2007年，公司开始尝试经销模式，经销商运营体系尚未建立，也缺乏对经销商的管理经验，未要求经销商报备终端销售报表。因此，公司无法获知各经销商2007年的终端客户情况。

经核查，保荐机构、申报会计师认为：发行人采用Fabless生产模式以及直销与经销相结合的营销模式，有助于将发行人主要资源集中于集成电路设计环

节，符合行业惯例及发行人的实际销售情况；报告期内发行人与其经销商之间不存在关联关系，与经销商之间发生的销售均实现了最终销售，销售收入的确认符合《企业会计准则》的规定，发行人报告期内的收入真实、准确。

（五）发行人报告期主要产品销售情况

1、主营业务收入分产品构成

报告期内，公司主要产品为便携消费电子CPU芯片和便携教育电子CPU芯片，主营业务收入分产品构成情况如下：

单位：万元

产 品 类 别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
便携消费电子 CPU 芯片	5,972.38	52.97	13,483.81	70.15	10,633.08	73.41	1,979.28	57.60
便携教育电子 CPU 芯片	5,205.22	46.16	5,010.93	26.07	3,131.09	21.62	1,042.37	30.34
其他	98.44	0.87	727.76	3.78	720.05	4.97	414.38	12.06
合 计	11,276.04	100.00	19,222.50	100.00	14,484.22	100.00	3,436.03	100.00

2、主要产品产销率

公司采用Fabless模式，将集成电路的生产、封装和测试环节均委托给专业的代工企业，因此公司不存在产能和产能利用率问题。报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

产品类别	2010年1-6月		
	产量（颗）	销量（颗）	产销率（%）
便携消费电子 CPU 芯片	2,713,279	3,496,226	128.86
便携教育电子 CPU 芯片	2,131,285	2,230,007	104.63
合 计	4,844,564	5,726,233	-
产品类别	2009年度		
	产量（颗）	销量（颗）	产销率（%）
便携消费电子 CPU 芯片	6,858,458	7,275,267	106.08
便携教育电子 CPU 芯片	3,076,537	2,797,103	90.92
合 计	9,934,995	10,072,370	-

产品类别	2008 年度		
	产量（颗）	销量（颗）	产销率（%）
便携消费电子 CPU 芯片	6,352,839	4,372,739	68.83
便携教育电子 CPU 芯片	1,420,079	966,585	68.07
合 计	7,772,918	5,339,324	-
产品类别	2007 年度		
	产量（颗）	销量（颗）	产销率（%）
便携消费电子 CPU 芯片	640,900	556,539	86.84
便携教育电子 CPU 芯片	317,187	314,367	99.11
合 计	958,087	870,906	-

（1）公司 2008 年度产销率较低的原因及未消化产量的处理情况

2008 年，公司产品成功进入 PMP 市场。2008 年年初，PMP 市场需求旺盛，相关电子产品层出不穷，用于 PMP 产品的便携消费电子 CPU 芯片供不应求。公司为满足市场需求，加大了便携消费电子 CPU 芯片的生产订单数量。随着全球金融危机的蔓延，国内外电子产品市场逐渐受其影响，大量下游的电子产品生产企业不得不降低产量以应付日益疲软的市场需求。公司的客户亦受此影响，纷纷控制提货速度，致使公司 2008 年库存增加，产销率下降。

2009 年及 2010 年上半年，随着各国推出的经济刺激计划逐渐生效，全球宏观经济出现了一定程度复苏，集成电路市场需求也逐步反弹。由于公司研发的芯片产品具有通用性，公司一方面积极消化上一年库存，另一方面在充分了解市场环境的情况下，结合市场需求变化，合理地向代工企业下生产订单，以控制库存风险，取得了良好的产销率。

（2）公司的库存风险和应对措施

鉴于公司生产主要以外协方式进行，公司如果一次下订单数量过多，将会出现库存风险。为此，公司主要采取以下措施：一是要求下游经销商根据自身情况定期提供需求计划，尽量做到以销定产，并据此进行生产预算；二是通过加强市场调研，提高公司的市场预测能力；三是公司芯片生产采用大量小金额订单，以减少库存积压的风险。

经核查，保荐机构认为：受金融危机影响，发行人 2008 年度产销率较低，库存商品在 2009 年已全部实现销售；发行人生产环节全部以外协方式进行，已

经建立了完善的销售订单、生产预算及订单管理制度应对库存风险。

3、主要产品平均价格变化情况

近三年一期，本公司主要产品平均价格变化情况如下：

单位：元/颗

产品类别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度
	平均价格	上升比率	平均价格	下降比率	平均价格	下降比率	平均价格
嵌入式CPU芯片	19.54	6.43%	18.36	28.78%	25.78	25.71%	34.70

报告期内，公司产品平均价格呈逐年下降趋势，主要原因为嵌入式CPU芯片的更新换代速度较快，产品成本下降明显，具体分析详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十一、盈利能力分析”之“（四）毛利率变动趋势分析”。

4、产品主要销售对象

本公司产品主要应用于便携消费电子和便携教育电子领域，广泛涉及前述领域的多种电子产品。本公司产品的销售对象主要为电子产品制造商或经销商。

5、发行人报告期内前五名客户销售情况

近三年一期，公司向前五大客户销售情况如下：

单位：元

期 间	客户名称	金额	占营业收入比例
2010年 1-6月	深圳市华辉进出口贸易有限公司	52,635,751.83	46.68%
	创兴国际贸易（上海）有限公司	29,024,138.12	25.74%
	东莞市步步高教育电子产品有限公司	8,711,562.26	7.73%
	深圳市赛凡半导体有限公司	6,917,280.30	6.13%
	深圳市中控生物识别技术有限公司	6,305,197.61	5.59%
	合 计	103,593,930.12	91.87%
2009 年度	深圳市华辉进出口贸易有限公司	103,500,865.80	53.84%
	东莞市步步高教育电子产品有限公司	26,274,699.19	13.67%
	深圳市赛凡半导体有限公司	16,447,906.77	8.56%
	深圳市中控生物识别技术有限公司	9,888,819.18	5.15%

	香港东宏电子贸易有限公司	7,562,316.69	3.93%
	合 计	163,674,607.63	85.15%
2008 年度	深圳市华芯飞科技有限公司	61,399,016.46	42.39%
	深圳市华辉进出口贸易有限公司	30,004,375.77	20.72%
	东莞市步步高教育电子产品有限公司	16,972,538.55	11.72%
	深圳市中控生物识别技术有限公司	13,113,521.05	9.05%
	深圳市唯瞻科技有限公司	10,578,353.30	7.30%
	合 计	132,067,805.13	91.18%
2007 年度	深圳市中控生物识别技术有限公司	10,096,720.71	29.39%
	深圳市华芯飞科技有限公司	9,731,398.58	28.32%
	东莞市步步高教育电子产品有限公司	8,505,308.59	24.75%
	深圳市唯瞻科技公司	2,353,720.88	6.85%
	重庆神州龙芯科技有限公司	2,006,445.05	5.84%
	合 计	32,693,593.81	95.15%

报告期内，深圳市华辉进出口贸易有限公司、创兴国际贸易（上海）有限公司、东莞市步步高教育电子产品有限公司、深圳市赛凡半导体有限公司（以下简称“深圳赛凡”）、深圳市中控生物识别技术有限公司、深圳华芯飞科技有限公司（以下简称“深圳华芯飞”）、深圳市唯瞻科技有限公司（以下简称“唯瞻科技”）以及香港东宏电子贸易有限公司分别位列公司前五大客户之一。其中，深圳中控、步步高为公司直销客户；深圳华辉、深圳华芯飞、创兴国际、唯瞻科技、深圳赛凡均为公司经销商；香港东宏既是公司终端客户，也经销公司产品。

公司与上述经销商及直销客户均通过展会等正常市场推广逐步形成业务往来。报告期内，上述经销商及直销客户除与公司存在购销关系外，与公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为：深圳华辉、深圳华芯飞、创兴国际、唯瞻科技、深圳赛凡、深圳中控、步步高、香港东宏与发行人及其实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；发行人与经销商的关系属于买断式销售关系，发行人将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至经销商，无论经销商是否将商品再销售出去，对于发行人来说，已实现了实际销售并可据此确认收入；报告期内，发行人与经销商的销售真实、公允，

并最终实现了销售；发行人与主要经销商在平等互利的基础上建立了长期稳定的合作关系，报告期内发行人的经销商保持了较高的稳定性和连续性，有利于促进发行人的业务发展；发行人对单一经销商不存在重大依赖，个别经销商的变化对公司盈利能力的连续性和稳定性不会造成重大不利影响；发行人报告期内主要客户发生变化系由于发行人对经销商进行调整引致的，发行人芯片产品的最终需求客户保持了较高的稳定性，该调整对发行人业务经营没有产生不利影响，发行人主要客户不存在重大不确定性。

（六）发行人报告期内主要原材料采购及生产成本情况

1、主要原材料及生产成本情况

公司不直接从事芯片的生产和加工环节，生产成本主要为晶圆、封装（含切割）、测试等芯片生产环节的委托加工费及其他如 IP 提成费、辅助材料等支出。报告期内，公司生产成本构成情况如下：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
晶圆	21,568,752.64	57.75	49,281,117.78	61.77	46,393,238.71	52.59	11,271,355.41	56.17
封装	12,928,698.86	34.62	23,792,543.03	29.82	30,561,790.66	34.65	7,252,084.26	36.14
测试	1,799,537.99	4.82	2,423,031.83	3.04	3,194,502.29	3.62	845,370.78	4.21
其他	1,050,143.39	2.81	4,285,891.84	5.37	8,063,107.61	9.14	698,235.10	3.48
合计	37,347,102.88	100.00	79,782,584.48	100.00	88,212,639.27	100.00	20,067,045.55	100.00

2、公司报告期内向前五名供应商采购情况

近三年一期，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：元

时间	供应商名称	全年采购额	占总采购额比例
2010年 1-6月	中芯国际集成电路制造有限公司	20,600,743.38	53.65%
	安靠封装测试（上海）有限公司	9,398,003.51	24.48%
	南通富士通微电子股份有限公司	4,609,473.50	12.00%
	东莞英展电子有限公司	868,639.09	2.26%
	京隆科技（苏州）有限公司	444,998.42	1.16%
	合计	35,921,857.90	93.55%

2009 年度	中芯国际集成电路制造有限公司	47,048,814.84	66.16%
	安靠封装测试（上海）有限公司	9,721,863.67	13.67%
	南通富士通微电子股份有限公司	5,637,764.16	7.93%
	DOLPHIN Integration SA	2,492,808.09	3.51%
	四川登巅微电子有限公司	1,803,085.56	2.54%
	合 计	66,704,336.32	93.80%
2008 年度	中芯国际集成电路制造有限公司	45,274,511.69	50.38%
	安靠封装测试（上海）有限公司	32,601,316.12	36.28%
	东莞英展电子有限公司	3,920,357.72	4.36%
	四川登巅微电子有限公司	3,383,311.70	3.76%
	DOLPHIN Integration SA	572,340.21	0.64%
	合 计	85,751,837.44	95.42%
2007 年度	中芯国际集成电路制造有限公司	16,930,917.85	65.81%
	安靠封装测试（上海）有限公司	8,097,455.04	31.48%
	四川登巅微电子有限公司	525,883.68	2.04%
	Everett Charles Technologies	172,351.42	0.67%
	合 计	25,726,607.99	100.00%

注：四川登巅微电子有限公司现已更名为四川和芯微电子股份有限公司。

近三年一期，公司向中芯国际采购金额占公司总采购额比例分别为65.81%、50.38%、66.16%和53.65%。公司向中芯国际采购占比较高的原因为：①晶圆是公司产品的主要原材料，价格高昂；②全球先进的晶圆制造企业为数不多；③在中国大陆，中芯国际拥有先进的晶圆生产线，采购价格与生产工艺满足公司的晶圆制造要求；④公司与中芯国际具有多年的合作关系。

（七）本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在上述供应商及客户中享有权益情况

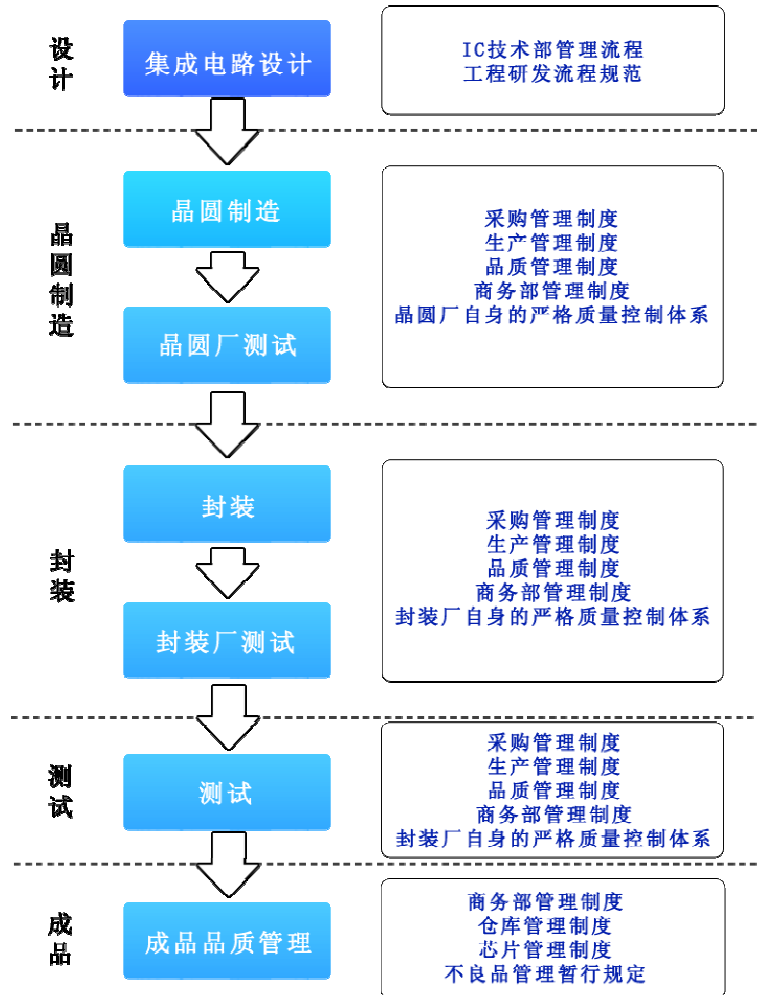
本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述供应商及客户中享有权益。

（八）产品的质量控制

为保证公司产品的质量，公司制定了相应的质量管理规定，对产品的设计、晶圆制造、封装、测试及成品等环节进行严格质量控制。根据质量技术监督部门

出具的守法证明，报告期内，公司所生产经营的产品无监督检查、行政处罚及产品投诉方面的不良记录。

公司质量控制体系见下图：



（九）公司环保达标情况

公司主要从事集成电路设计，不会产生废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染，无需按照国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）规定履行上市环保核查程序。

五、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

公司的固定资产主要包括电子及其他设备、运输设备。截至2010年6月30日，公司主要固定资产基本情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	固定资产净值	成新率
运输工具	769,966.69	547,746.25	71.14%
电子设备及其他	2,283,194.96	923,770.63	40.46%
合计	3,053,161.65	1,471,516.88	48.20%

（二）房屋建筑物及土地使用权情况

1、租赁房产

目前，公司所使用的办公场所均为租赁房产，具体情况如下：

序号	出租方	用途	租赁期限	租赁面积 (m ²)	地址
1	北京中关村软件园发展有限责任公司	研发及 办公用房	2008年12月1日— 2013年11月30日	1,171.26	中关村软件园信息中心A座106#、107#、108#
2	深圳集成电路设计产业化基地管理中心	厂房	2009年7月16日— 2011年4月30日	755.60	深圳市南山区高新中二道2号深圳国际软件园4栋301-305, 322-326

上述房产的房屋租赁合同的具体内容详见本招股说明书“第十二节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（五）房屋租赁合同”。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：公司及子公司君正时代作为专业从事集成电路设计的软件企业，对经营场所无特殊要求，普通办公用房即可满足公司日常业务需求。公司及君正时代所在地中关村软件园、深圳软件园，分别为北京市和深圳市规划的专业软件园区，公司作为集成电路设计企业在该等园区内通过租赁方式取得办公场所不存在法律障碍。租赁上述房屋以来，公司经营状况良好，业绩持续快速增长。因此，公司及子公司经营场所均为租赁取得对其日常经营不

构成不利影响。

2、土地使用权

截至本招股说明书签署之日，公司无土地使用权。

鉴于公司未来发展需要一个长期稳定的办公场所，而中关村软件园作为国家重点软件产业基地和出口基地，对公司的业务发展有一定积极影响，经公司董事会审议通过，2009年9月28日，君正有限与北京中关村软件园发展有限责任公司（以下简称“中关村软件园公司”）签订了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定由中关村软件园公司对位于中关村软件园二期（西扩）项目起步区J-2号地块进行一级开发，君正有限向中关村软件园公司承担土地开发费26,512,920.00元（不包含土地出让金），分三期支付。该地块面积5,845平方米，规划允许地上建筑面积为7,014建筑平方米，用地性质为教育科研用地。截至本招股说明书签署之日，公司已经支付前两期费用共计23,861,628.00元。

根据中关村软件园公司2010年3月16日向公司出具的《确认函》，中关村软件园公司确认在其完成上述地块一级开发后，公司可按照相关程序向土地管理部门办理用地手续。如公司最终未能取得该地块的土地使用权，软件园公司将退还公司已支付的土地开发费。

截至本招股说明书签署之日，该地块已转为建设用地。中关村软件园公司办理完成建设用地审批手续，其一级开发工作在基础设施完工后即全部完成。

公司已就在J-2地块上建设研发基地取得了北京市规划委员会出具的《规划意见函复》及北京市海淀区发展和改革委员会的《项目备案通知书》，目前正在向规划部门办理《规划意见书》手续。后续仍需办理的手续包括环保部门的环境影响评价、规划部门的《建设用地规划许可证》和方案设计审查、缴纳土地出让金、与国土部门签订《土地出让合同》、规划部门的《建设工程规划许可证》等。上述手续办理完成后即可取得《国有土地使用证》，开始建设施工。

公司上述J-2地块所处的中关村软件园二期建设项目被列为北京市海淀区2010年重点建设项目、海淀区绿色审批通道项目，政府各部门都给予了重点关注和支持，公司正在按照政府规定的流程进行相关手续的办理，取得上述土地不存在不确定性。

（三）知识产权情况

1、商标

（1）已注册商标情况

商标	注册号	注册有效期限	注册人
君正	5373860	2009年05月28日—2019年05月27日	公司
XBurst	6159093	2010年02月28日—2020年02月27日	公司

（2）已申请商标情况

序号	商标	申请号	申请日	申请状态	申请人
1		7978376	2010年1月8日	受理	公司
2		7978377	2010年1月8日	受理	公司
3		7978378	2010年1月8日	受理	公司

2、计算机软件著作权

序号	软件名称	著作权登记号	著作权人	开发完成日期	是否发表	权利取得方式	权利范围
1	USB Boot 主机端程序 1.4	2009SR013962	公司	2007年11月2日	未发表	原始取得	全部权利
2	USB Boot 设备端程序 1.4	2009SR014002	公司	2007年12月22日	未发表	原始取得	全部权利
3	Deb 软件包管理器 (pkg-manager-ingenic) 1.0.0	2009SR013960	公司	2008年1月17日	未发表	原始取得	全部权利
4	定点 WMA 解码器(WMA FIXED Decoder) 1.0.0	2009SR014008	公司	2008年6月12日	未发表	原始取得	全部权利
5	定点 mp3 编码器 (Jz_mp3_encoder) 1.2	2009SR014003	公司	2008年6月17日	未发表	原始取得	全部权利
6	网络管理软件 1.0.0	2009SR013961	公司	2008年7月18日	未发表	原始取得	全部权利
7	JDI 远程调试程序 (JDI debug server) 1.0.0	2009SR014006	公司	2008年11月10日	未发表	原始取得	全部权利
8	定点 Atrac3 解码器 (JZ_atrac3_decoder) 1.2	2009SR014007	公司	2008年11月20日	未发表	原始取得	全部权利

截至本招股说明书签署之日，公司主要资产产权变更手续已经办理完毕。

3、公司正在申请的专利

序号	名称	类型	申请日	申请号
1	一种降低 CPU 功耗的方法、装置及一种低功耗 CPU	发明	2010 年 8 月 18 日	201010256819.6
2	一种降低 CPU 功耗的方法、装置及一种低功耗 CPU	发明	2010 年 8 月 18 日	201010256830.2

（四）被授权使用的专有技术

集成电路行业分工日趋细化，由此催生出了一批专门提供不同功能模块授权的知识产权供应商（即 IP 供应商）。IP 供应商专门设计特定功能的集成电路模块，并以 IP（或称 IP Core、IP 核）授权的形式提供给集成电路设计企业使用。IP 供应商向获得授权的集成电路设计企业收取技术使用费，通常包括一次性起始费用和按芯片或晶圆数量收取的提成费用。

报告期内，公司获得的技术授权情况如下：

序号	授权方	授权技术及内容	支付方式
1	四川和芯微电子股份有限公司	针对发行人多款芯片产品 USB2.0 Device PHY 和 Audio Codec/SAR ADC/OSC 相关 IP 使用授权	起始费用+提成费用
2	Vivante Corporation	GC400 GPU Core 和 GC400 Driver Software 使用授权	起始费用+提成费用
3	RealNetworks, Inc.	Real Format Client Code 产品技术及相关格式的使用认证和授权	起始费用+提成费用
4	DOLPHIN Integration SA	Audio Codec IP 核使用授权	起始费用+提成费用
5	Synopsys International Limited	DWC USB2 nanoPHY 使用授权	一次性初始费用
6	国际绿色芯片有限公司	Analog IP set 及相关特定程序技术使用授权	一次性初始费用
7	芯原微电子（上海）有限公司	ADC、电源开关、DCAP 相关 IP 使用授权	一次性初始费用
8	昊迪移通（北京）技术有限公司	H3DAudio 三维音效软件库使用授权	一次性初始费用

公司与上述授权方签订的技术许可合同的具体情况详见本招股说明书“第

十二节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（三）技术许可合同”的相关内容。

1、四川和芯微电子股份有限公司

四川和芯微原名四川登巅微电子有限公司，是国内一家提供模拟电路 IP 核的供应商，其产品性价比高。公司主要向该供应商购买 USB PHY 和 Audio Codec IP，分别用于实现 USB 数据传输功能和音频的数模转换功能。

公司于 2006 年与四川和芯微签署协议，2010 年 4 月双方重新签署了协议，有效期限截至 2017 年 4 月 7 日。双方均按照合同约定履行了相应的义务，合同执行情况良好。报告期内，公司应用 USB PHY 技术授权的产品在营业收入中占比情况如下：

单位：万元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
应用 Audio Codec IP 产品销售收入	6,207.95	15,257.77	12,190.59	488.56
应用 USB PHY IP 产品销售收入	8,978.84	17,524.17	12,190.59	488.56
发行人营业收入	11,276.04	19,222.50	14,484.22	3,436.03
应用 Audio Codec IP 产品销售收入占比	55.05%	79.37%	84.16%	14.22%
应用 USB PHY IP 产品销售收入占比	79.63%	91.16%	84.16%	14.22%

2、Vivante Corporation

公司主要从 Vivante Corporation 购买 3D 图形 IP，该 IP 核是一款大型复杂 IP，主要功能为实现三维图形的加速。

公司于 2009 年 4 月与 Vivante Corporation 签署协议，双方均按照合同约定履行了相应的义务，合同执行情况良好。该 IP 核主要应用于公司下一代芯片产品中，由于相关芯片产品尚在研发中，报告期内，尚未形成相关销售收入。

3、RealNetworks, Inc.

Real 是一种视频编码格式，具有码率低占用网络带宽少等特点，在国内被广泛使用，国内大量网站提供的视频文件均采用 Real 格式。

公司于 2008 年进入 PMP 领域，同年与 RealNetworks, Inc. 签署了协议，公司部分产品需要使用该项授权，但比例逐年下降。报告期内，公司按相关协议支付了技术使用费。

目前，自身设计与外购 IP 核相结合是集成电路设计行业普遍采用的设计模式。大部分集成电路设计企业专注于自己擅长的部分，而其它功能模块则向 IP 供应商采购，如购买 CPU IP、多媒体 IP、USB PHY IP、Audio Codec IP 和各种标准接口 IP。通过外购 IP 核，能够使集成电路设计企业在 SoC 芯片上高效集成各种功能模块，实现芯片的多功能；加快研发进度，缩短新产品上市时间；使集成电路设计企业充分发挥自身技术特点，集中优势资源从事自己最擅长的设计部分。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

发行人在报告期内所有相关技术的使用与研发上不存在对第三方的重大依赖；发行人因研发新产品需要外购的相关技术也已经获得相关权利人的有效授权，不存在纠纷。

六、公司主要产品核心技术情况

公司一直坚持自主创新的研发策略，自 2005 年成立以来先后突破了多项核心技术。

（一）核心技术与技术来源

公司已在自主创新 CPU 内核、多媒体技术、SoC 芯片技术、功耗和电源管理技术、软件平台技术等 5 大领域形成了 15 项核心技术，具体如下：

类别	序号	核心技术名称	技术来源	创新类型
CPU 内核	1	XBurst CPU 技术	自主开发	原始创新
	2	XBurst 非对称双核 CPU 技术	自主开发	集成创新
	3	XBurst SIMD 技术	自主开发	原始创新
	4	XBurst 64 位单/双精度浮点技术	自主开发	集成创新
多媒体技术	5	XBurst 可配置多媒体处理技术	自主开发	集成创新

	6	基于 XBurst 架构的多媒体播放器技术	自主开发	集成创新
SoC 芯片技术	7	低功耗内存控制器技术	自主开发	集成创新
	8	LCD 显示控制器技术	自主开发	集成创新
	9	深亚微米后端设计技术	自主开发	集成创新
	10	深亚微米软硬件协同设计技术	自主开发	集成创新
功耗和电源管理技术	11	时钟和低功耗设计技术	自主开发	集成创新
	12	多电源域设计技术	自主开发	集成创新
软件平台技术	13	嵌入式实时多任务操作系统 MiniOS 设计	自主开发	集成创新
	14	基于 Linux 操作系统的软件平台技术	开源社区	集成创新
	15	基于 Android 操作系统的软件平台技术	开源社区	集成创新

（二）技术水平

在CPU内核、功耗和电源管理技术、软件平台技术领域，公司均具有创新的结构或者创新的设计，居国内领先、国际先进水平，部分技术达到国际领先水平。具体技术现状和技术水平如下：

序号	核心技术名称	技术现状、水平描述
1	XBurst CPU 技术	该技术为公司独创的、创新 32 位 CPU 技术，其性能、面积和功耗指标居国际领先水平。目前该技术已经大量应用于公司芯片。
2	XBurst 非对称双核 CPU 技术	该技术采用创新的自旋锁技术和高效的同步机制和结构，有效降低了双核结构带来的功耗和成本问题，居国内领先水平。目前该技术已经应用于 JZ4755 芯片。
3	XBurst SIMD 技术	该技术为公司自定义的单指令多数据指令集，能够有效地加速视频数据处理，居国内领先水平。目前该技术已经大量应用。
4	XBurst 64 位单/双精度浮点技术	该技术为公司自主研发的 64 位浮点运算单元，符合 IEEE-754 国际标准，功耗低，居国内领先水平。已开发完成，目前正在进行流片验证。
5	XBurst 可配置多媒体处理技术	该技术为公司结合 XBurst CPU 的优势推出的自主创新 XBurst 多媒体技术，该技术融合了传统“CPU+DSP”结构和 ASIC 硬核两种模式的优点，居国内领先水平。目前该技术已经大量应用于公司芯片。
6	基于 XBurst 架构的多媒体播放器技术	该技术为公司基于 XBurst 架构研制的多媒体播放器应用技术，具有创新的智能纠错解码技术，居国内领先水平。目前该技术已经大量应用于公司芯片。
7	低功耗内存控制器技术	该技术针对多媒体应用进行了专门优化，面积小，功耗低，居国内领先水平。SDRAM 内存控制器已经应用于公司芯片产

		品。支持 DDR/DDR2 的内存控制器已开发完成，并且流片验证成功。
8	LCD 显示控制器技术	该技术兼容性好，支持 CPU 和 RGB 接口，支持 OSD，支持 Bypass 模式，兼容市场上主流的 LCD 液晶屏，居国内领先水平。目前该技术已经大量应用于公司芯片。
9	深亚微米后端设计技术	在深亚微米后端设计技术上，公司先后推出了创新的自主低功耗高速度设计方法，并针对低功耗应用推出了独特的多电源域实现方法、低功耗设计方法和时钟树设计方法，居国内领先水平。该技术已经成熟。
10	深亚微米软硬件协同设计技术	公司建立了先进的软硬件协同仿真、验证环境，自主研发了国内领先的嵌入式 CPU 软硬件协同设计平台和 SoC 芯片软硬件协同设计平台，并成功应用于 XBurst CPU 技术和 JZ47xx 系列嵌入式 CPU 芯片的研制，居国内领先水平。
11	时钟和低功耗设计技术	该技术从各个功能模块、SoC 设计到系统软硬件三个层次全面进行时钟和功耗控制，基于该技术嵌入式 CPU 芯片的功耗与同类产品相比均居业内最低，居国际领先水平。
12	多电源域设计技术	该技术采用了多电源域、动态功率切换、休眠漏电管理等多项电源管理技术，既解决动态功耗问题又解决静态漏电功耗问题，居国内领先水平。已开发完成，正在进项流片验证。
13	嵌入式实时多任务操作系统 MiniOS 设计	该技术为公司自主研发的实时操作系统，已广泛应用于 MP4 方案和移动数字电视方案，具有实时性，支持多任务操作，居国内领先、国际先进水平。该技术已经成熟。
14	基于 Linux 操作系统的软件平台技术	该平台技术已广泛应用于教育电子、无线 MP4、无线数码像框等领域，是公司基于 XBurst CPU 架构和 Linux 操作系统自主研发的嵌入式软件开发平台，居国内领先、国际先进水平。
15	基于 Android 操作系统的软件平台技术	该平台技术为公司基于 XBurst CPU 架构和 Android 操作系统自主研发的软件开发平台，主要应用于移动互联网终端设备，居国内领先、国际先进水平。

（三）公司各项核心技术的研发过程

类别	序号	核心技术名称	研发时间	研发过程
CPU 内核	1	XBurst CPU 技术	2005 年 7 月 -至今	2005 年 7 月,公司开始自主研发 XBurst CPU 技术,该技术为公司最核心的技术。自公司成立开始,公司投入到该 IP 核的研发。2006 年,第一代 XBurst CPU 技术研制成功并应用到公司第一款芯片中;2007 年,公司在现有技术基础上增加了 SIMD 指令。2010 年,公司在现有基础上增加浮点指令。目前,第二代 XBurst CPU 技术正在研制中。
	2	XBurst 非对称双核 CPU 技术	2008 年 10 月 -2009 年 6 月	2008 年 10 月,公司开始研发 XBurst 非对称双核 CPU 技术。2008 年 10 月,公司认为其便携消费电子 CPU 芯片多媒体能力有待加强。通过总结分析,公司创新地引入了第二个 XBurst CPU 内核,专门用于多媒体处理。公司将对该技术持续改进、提高。
	3	XBurst SIMD 技术	2006 年 4 月 -2008 年 8 月	2006 年,公司开始研发 XBurst SIMD 技术。SIMD 指令能有效提高多媒体算法的执行效率。该技术于 2007 年研发成功;2008 年,公司又完成了第二代 SIMD 指令的设计。
	4	XBurst 64 位单/双精度浮点技术	2009 年 1 月 -2010 年 4 月	2009 年 1 月,公司开始研发 XBurst 64 位单/双精度浮点技术。原有的 XBurst CPU 支持定点指令和 SIMD 指令;2009 年 1 月份,公司定义了浮点指令;2010 年 4 月,研发成功。
多媒体技术	5	XBurst 可配置多媒体处理技术	2006 年 10 月 -至今	2006 年 10 月,公司开始研发 XBurst 可配置多媒体处理技术。2007 年 4 月,完成后处理模块的研发;2008 年 8 月,完成若干硬件加速模块的研发,处理能力达到标清能力;2009 年 4 月,基于非对称双核技术的,处理能力接近 720P 高清。公司目前正对该技术持续改进、提高。
	6	基于 XBurst 架构的多媒体播放器技术	2007 年 10 月 -至今	2007 年 10 月,公司开始研发基于 XBurst 架构的多媒体播放器技术。该技术用于在软件上实现 XBurst 可配置多媒体处理技术中的硬件能力。2008 年 8 月,该技术应用于 PMP 产品中。此后,该技术配合 XBurst 可配置多媒体处理技术持续改进,目前主要应用于 Linux 和 Android 操作系统中。

SoC 芯片技术	7	低功耗内存控制器技术	2005年7月 -至今	2005年7月, 公司开始研发低功耗内存控制器技术。存储器子系统是芯片中除CPU之外最重要的子系统。2006年3月, 公司成功研发低功耗SDRAM控制器接口, 随后持续改进其效率; 2008年, 开始研制DDR和DDR2控制器接口; 2010年4月基于0.13 μm 工艺的控制技术研制成功。公司将对该技术持续改进、提高。
	8	LCD显示控制器技术	2005年9月 -至今	2005年9月, 公司开始研发LCD显示控制器技术; 2006年, 研发成功, 随后持续改进其效率。公司将对该技术持续改进、提高。
	9	深亚微米后端设计技术	2008年7月 -至今	2008年7月, 公司开始研发深亚微米后端设计技术。该技术主要用于0.13 μm 、90nm、65nm工艺上实现电路的布局布线、物理验证等。2010年4月, 公司成功研发0.13 μm 工艺的芯片。公司将对该技术持续改进、提高。
	10	深亚微米软硬件协同设计技术	2005年7月 -2008年9月	2005年7月, 公司开始研发深亚微米软硬件协同设计技术。该技术主要用于芯片设计工程中的正确性验证。公司硬件和软件人员协同工作, 开发了芯片的验证平台, 支持了芯片的研发。2008年9月, 公司完成该技术的升级和改进。
功耗和电源管理技术	11	时钟和低功耗设计技术	2005年9月 -至今	2005年9月, 公司开始研发时钟和低功耗设计技术。该技术主要为芯片的不同功能单元提供不同的时钟、为芯片提供多种低功耗模式。低功耗设计技术是现代集成电路设计领域备受重视的技术。公司将对该技术持续改进、提高。
	12	多电源域设计技术	2009年7月 -至今	2009年7月, 公司开始研发多电源域设计技术。2009年, 公司确定用0.13 μm 工艺制程生产新芯片, 但相比以前所采用的工艺, 0.13 μm 工艺制程的漏电流很大, 无法应用到手机类产品上。为此公司开始研发多电源域技术, 有效地控制芯片的漏电流。2010年4月, 该技术研发成功。
软件平台技术	13	嵌入式实时多任务操作系统MiniOS设计	2007年7月 -2008年8月	2007年7月, 公司开始研发嵌入式实时多任务操作系统MiniOS设计。2007年下半年, 公司准备进军PMP市场。PMP产品不需要大型的操作系统, 因此公司研发嵌入式实时多任务操作系统MiniOS。MiniOS于2008年初研发成功, 广泛应用PMP、教育电子、游戏机等产品上。

	14	基于 Linux 操作系统的软件平台技术	2006 年 1 月 -至今	2006 年 1 月, 公司开始研发基于 Linux 操作系统的软件平台技术。该技术主要进行操作系统内核的移植、设备驱动程序的开发、各种中间件的开发和维护。Linux 已成为消费电子和移动设备最主流的操作系统, 公司将对该技术持续改进、提高。
	15	基于 Android 操作系统的软件平台技术	2009 年 3 月 -至今	2009 年初, 公司认识到 Android 操作系统的重要性, 开始投入力量把 Android 操作系统移植到公司的芯片上, 并作为软件平台支持智能手机和平板电脑方案的研发。2009 年 3 月, 公司开始研发基于 Android 操作系统的软件平台技术。目前, 该平台已经基本成熟, 基于该平台的智能手机和平板电脑方案正在研发。

注: 有些核心技术在研发完成后, 不再进一步研发, 对这些技术在表中标注了起始和终止时间; 有些核心技术, 在研发完成后, 有进一步的提升和改进, 对这些技术表中没有标注终止时间。

经核查, 保荐机构、发行人律师认为: 发行人的核心技术系自行研发, 具有完全的知识产权, 不存在与其他单位的职务发明、非专利技术方面的纠纷或者潜在纠纷。

（四）核心技术产品收入占营业收入的比例

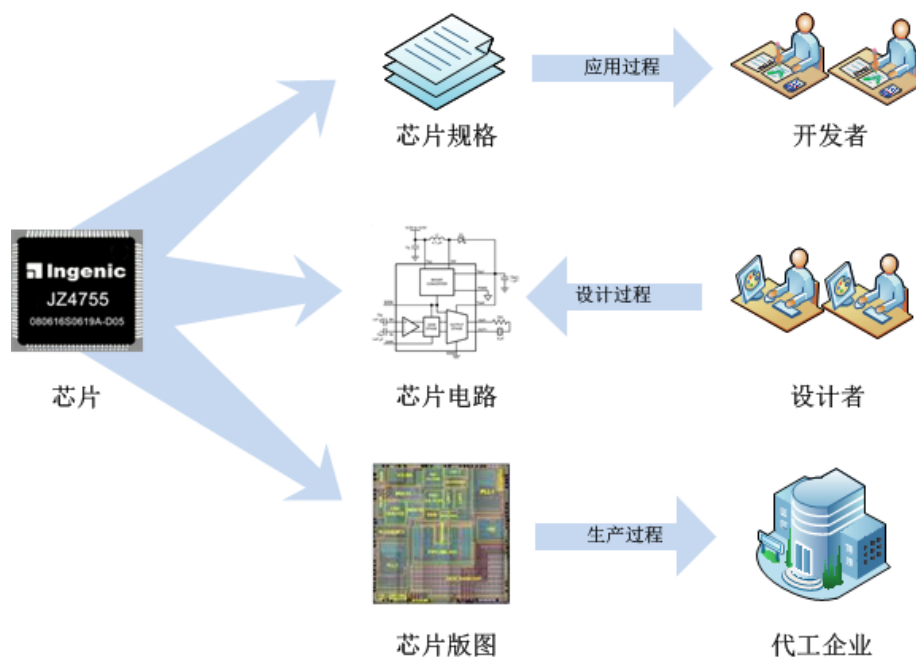
报告期内，公司的核心技术应用在不同的嵌入式CPU芯片中，核心技术产品收入占营业收入的比例如下表：

产品类别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
嵌入式CPU芯片	11,208.26	99.40	19,105.79	99.39	14,341.85	99.02	3,106.43	90.41

（五）公司核心技术的保护措施及风险分析

1、公司核心技术在产品应用、生产中采取的保护措施及其有效性

通常而言，嵌入式CPU芯片可以抽象为芯片规格、芯片电路、芯片版图三个范畴，具体如下图所示：



芯片规格：包含芯片的特性描述、编程接口、使用说明等。对CPU内核而言，芯片规格主要包含指令集信息等；对其他功能模块，芯片规格通常包含功能描述和编程接口。很多功能模块具有相似或相同的规格书，例如Intel和AMD的CPU，执行的都是X86指令集；再比如用于串行通信的控制器遵循的也是工业界公认的编程接口。

芯片电路：芯片功能的具体电路实现，电路分为处理数字信号的数字电路和处理模拟信号的模拟电路。集成电路设计公司的技术核心就是根据芯片的规格进行芯片的电路设计。

芯片版图：芯片电路的具体物理形式。在芯片电路设计完成后，需要在设计工具的辅助下，将芯片电路转换为电路的物理实现方式即芯片版图。

相应地，一款嵌入式 CPU 芯片在其生命周期中，涉及三个主要过程：

（1）芯片设计过程及保护措施

芯片规格确定后所进行的芯片电路设计是集成电路设计企业最核心的工作内容，也是集成电路设计企业最核心竞争力的体现。在相同规格条件下，因为设计者水平的不同，所设计出的电路往往也有很大差异。比如，Intel 和 AMD 的 CPU 执行基本相同的指令，但因二者的设计完全不同，最终芯片的性能、功耗等指标也有非常大的差异。芯片电路是集成电路设计公司最核心的技术秘密，其设计文档、电路描述、代码都被严格保护。

公司在设计过程中对自己的核心电路采取了一系列保护措施：

- ①设置与互联网物理隔离的专用网络存放芯片电路的数据；
- ②专用网络上的计算机不配备 USB、硬盘和光驱；
- ③只有授权人员才能拷贝专用网络上的数据且每次拷贝均做记录和备份；
- ④与所有员工签署知识产权保密协议，从而从法律上保护公司的知识产权。

上述措施有效地保护了公司的核心知识产权。自公司成立以来，从未发生过核心机密泄露的情况。

（2）芯片生产过程及保护措施

芯片电路的物理设计完成后，芯片版图被送往晶圆制造企业进行生产。在芯片生产过程中，知识产权的保护体现在以下方面：

①只有芯片版图提供给晶圆制造企业进行芯片的代工生产。集成电路设计企业最核心的知识产权即芯片电路的设计文档、电路描述、代码等并不提供给代工企业。

②现代的大规模集成电路芯片生产工艺多采用亚微米甚至纳米制程，晶体管尺寸极其微小，一个集成电路芯片的晶体管数量规模往往数以亿计，这使得从芯片版图中还原出芯片电路基本不可行。

③晶圆制造企业严格保护集成电路设计企业的芯片版图，这是晶圆制造企业存在的根本前提。公司与晶圆制造企业的协议中会有专项条款对芯片版图的知识产权进行保护。

目前，全球除了 Intel、IBM 等少数采用 IDM 模式的跨国巨头能通过自己的晶圆厂自行生产芯片外，其余集成电路设计企业基本采用 Fabless 模式，通过委托晶圆制造企业代工的方式进行芯片生产。这种专业分工、互相配合的 Fabless 模式是集成电路行业的主流模式，在该模式近二十年的应用过程中，集成电路设计企业的知识产权得到了有效保护。公司与其晶圆代工企业中芯国际长达 4 年多的合作过程中，从未发生知识产权泄露的情况。

（3）芯片推广应用过程及保护措施

发行人的“开放平台”市场推广策略，是指将芯片的规格说明书、对外接口、使用方式、编程接口以及相应的操作系统平台开放给开发者进行二次开发，而最核心的芯片电路设计文档、电路描述、代码等则不会开放。仅仅通过芯片的规格说明书等资料，客户和开发者无法获取发行人的核心技术秘密。自发行人成立以来，从未发生过因开放芯片规格说明书等资料而导致核心技术机密泄露的情况。

2、公司核心技术被抄袭的风险及防范措施

集成电路设计行业中存在部分竞争对手抄袭技术的现象。公司避免其核心技术被抄袭的措施如下：

（1）不透露 CPU 内核电路设计的任何信息。除了下游客户开发者所必需的使用说明外，公司从未在任何媒体杂志上发表关于其 XBurst CPU 设计的信息和论文。

（2）不通过专利泄露 CPU 内核电路的设计信息。专利是一把双刃剑，它既可以通过法律途径保护核心技术不被抄袭，也会因为专利信息的公布导致核心技术的泄露。CPU 核心电路在被抄袭后，举证非常困难。公司在发展初期没有足够的精力和财力从法律上保护自身的核心技术不受侵犯，公司采取了在前期不申请专利的方式。该方式使得公司的核心技术秘密不为外界所知，有效地保护了公司的知识产权不被抄袭。

通过上述措施，公司核心技术被抄袭的风险很小。

3、公司核心技术被替代风险及防范措施

任何技术一旦落后就会被其它技术所替代。公司的核心技术人员长期专注于 32 位嵌入式 CPU 内核的设计，其设计的 XBurst CPU 内核，在同样工艺制程下，性能、面积、功耗等指标均领先于业界同类产品，从而使基于 XBurst CPU 内核的芯片产品 2007 年上市以来，在多个领域迅速替代了国外的同类产品，打破了国外嵌入式 CPU 产品的长期垄断。

公司持续对自己的核心技术进行创新和改进：在 XBurst CPU 内核上，2006 年完成了基本定点指令的研发；2007 年完成了 SIMD 指令的增强；2008 年完成了第二代 SIMD2 指令的增强；2010 年完成了浮点指令的增强；目前正在进一步进行多核设计。在工艺制程上，公司成立初期开始采用 0.18 μ m 工艺，2009 年开始采用 0.16 μ m 工艺，2010 年开始以 0.13 μ m 和 65nm 工艺研发下一代产品。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：报告期内，发行人对于其核心技术采取了必要的保护措施，有效地防止了其核心技术被抄袭的风险；发行人技术上的领先优势和持续创新的传统，使得在可预见的未来，其核心技术被替代的可能性很小。

七、公司技术储备情况

为了研制性能更强、集成度更高的嵌入式 CPU 新产品，开拓以智能手机为代表的移动互联网终端等新领域和新市场，公司将不断增加研发投入，扩大研发队伍，深化应用创新，继续加强在核心技术上的技术储备。

（一）公司在研项目情况

序号	在研项目名称	研发目标	技术来源	项目进度
1	600MHz 嵌入式 CPU 芯片	采用 0.13 μ m 工艺，主频 600MHz，支持 720P 多媒体，2D 加速。	自主研发	在研阶段
2	EPD 显示控制器技术	支持 EPD 电子纸显示屏，可用于电子书屏幕的控制，应用到电子书嵌入式 CPU 芯片中将提高芯片集成度。	自主研发	在研阶段
3	XBurst2 CPU 技术预研	超标量双发射 CPU 技术。	自主研发	预研阶段
4	1GHz 嵌入式 CPU 芯片	采用 65nm 工艺，主频 1GHz，支持 1080P 多媒体，3D 图形加速。	自主研发	预研阶段

（二）研发支出投入情况

近三年一期，公司研发支出投入情况如下：

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
研究开发费用（万元）	848.24	1,410.07	802.76	355.71
流片费（万元）	87.09	363.14	410.99	645.56
研发支出合计（万元）	935.33	1,773.21	1,213.75	1,001.27
占营业收入比例（%）	8.29	9.22	8.38	29.14

八、技术创新机制

为了向客户持续不断地提供具有国际竞争力的嵌入式CPU芯片及解决方案，提高公司的核心竞争力，公司始终坚持技术创新的战略。

公司的技术创新机制主要包括：

1、有序的创新决策和管理机制

公司高度重视技术创新策略在公司内部的执行，专门成立由各技术部门负责人和技术骨干组成的技术创新领导小组，并由技术部门负责人任组长，负责技术创新项目的评估、立项、管理和考核。公司大力培育创新文化，鼓励研发人员在日常工作中提出创新性建议和想法，建立每周技术联席会议制度，对有价值的建议或思路公司会积极响应并组织技术研讨会进行论证，在人、财、物方面提供足够的支持以保障创新项目的顺利实施。项目立项后，设立专门的项目协调人，确保项目按既定进度进行。项目完成后，由技术创新领导小组进行审核。

2、市场和目标导向机制

公司坚持将技术创新服务于市场和产品，每一项技术创新均有明确的目标定位，以提高嵌入式CPU芯片产品的竞争力、巩固提高市场占有率和市场优势地位、寻找新的市场空间和机会。每项技术创新均从市场出发，通过创新转化机制将其融入公司芯片产品研发和应用方案研发中。在评估技术创新项目时，公司坚持采用市场化的绩效目标来考察和判断技术创新的成果和价值。此外，结合集成电路设计行业的发展趋势、目标市场的产业环境和公司的发展阶段，公司不仅在关键

领域如IP核和嵌入式CPU芯片设计，在应用技术方面如便携消费电子、便携教育电子（含电子书）、智能手机等重点应用方向上也坚持技术创新。

3、有效的激励机制

技术创新的主体是研发人员，除核心技术人员直接持股外，为了鼓励员工有更多的创新，除了相关管理制度外，公司还制定了有效的激励制度。激励措施包括物质奖励和精神奖励。考核技术创新成果时，公司对提交发明专利、技术创新意见被采纳的员工，实行当月奖励；另外，每年年底进行年度技术创新奖项的评选，授予年度个人和团队创新奖励。同时，公司为研发人员提供一个充分学习和成长的平台，定期组织内部和外部培训，做到人尽其能、劳有所得，每名员工在技术创新过程中都得到最大的锻炼并获得成就感和归属感。

4、风险约束机制

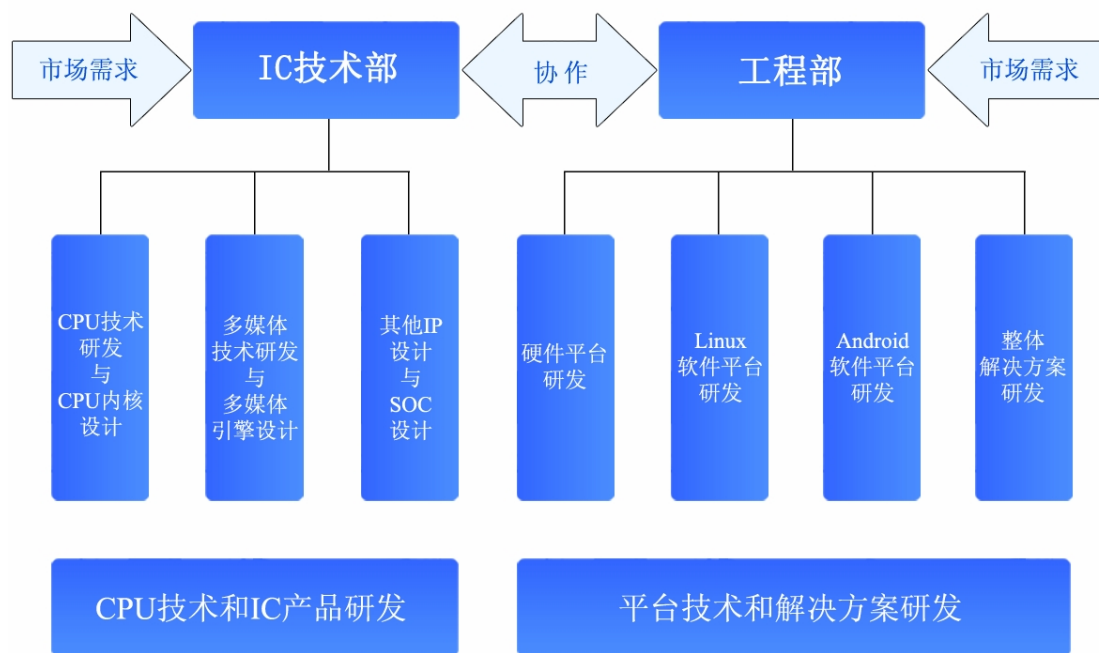
集成电路设计属于智力密集型行业，技术门槛高，技术创新项目具有一定的技术风险和知识产权风险。为了减小创新的技术风险，项目立项前须通过技术创新领导小组的项目可行性论证和先进性论证；在项目研发过程中，技术创新领导小组定期对项目的进展情况进行跟踪与指导，确实存在无法克服的困难，允许项目无条件取消或失败，以鼓励创新。在应对知识产权风险方面，公司配有专业的知识产权人员，密切关注有关技术领域的知识产权状态，一旦发现问题，及时调整项目技术方案。同时，在项目实施过程中加强自己的知识产权申请工作，积极建立自己的知识产权保护体系。

5、自主创新与联合创新相结合的机制

完整的集成电路产业链条涉及多个环节，Fabless企业一般只负责IP核设计、芯片设计、系统设计等部分环节，而晶圆制造、封装测试、整机终端、操作系统、应用软件等环节都交与上下游合作伙伴，这就要求芯片设计企业除了自主创新外还须重视联合创新。为此，公司在IP核设计、芯片设计及系统设计方面采取自主创新、在其他环节依靠联合创新的策略。例如，公司在超高工艺晶圆制造方面与中芯国际，封装测试方面与安靠公司、通富微电，整机终端方面与步步高、汉王等公司均展开密切合作，建立了战略合作关系。同时，公司积极推进产学研合作，

与国内多所大学和研究开发机构建立了长期技术合作关系，积极参与中关村产业联盟活动。

除了技术创新机制，研发体系与组织管理也是决定技术创新成败的重要因素。公司结合集成电路设计行业的特点和自身资源情况，建立了特点鲜明的两级研发体系。一是由CPU技术部、多媒体技术部、SoC技术部和质控部构成的IC技术部，主要负责集成电路设计领域的IP核设计和芯片设计；二是由3个软件部和1个硬件工程部组成工程部，面向应用和客户，主要负责嵌入式软件平台和整体解决方案的研发。由于CPU芯片类集成电路设计企业普遍采用软硬件协同设计方法，这种两级研发体系既可以让芯片和系统的研发分工更加专业和科学，又可以节省研发时间加速产品的上市时间。公司两级研发体系如下图所示：



九、核心技术人员及研发人员情况

（一）核心技术人员、研发人员占比情况

截至2010年6月30日，公司共有研发技术人员93人，占员工总人数的76.86%。其中，核心技术人员7人。

（二）最近两年核心技术人员变动情况及对发行人的影响

公司核心技术人员行业经验丰富、技术背景优秀，有力地推动了公司新产品的研究开发工作，是公司业务发展的关键力量。目前，公司核心技术人员为刘强、张紧、冼永辉、姜君、刘飞、许志鹏、晏晓京。最近两年，前述核心技术人员未发生过变动，且现均为公司股东。核心技术人员具体简历详见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

（三）公司设立以来技术研发团队的建设情况

公司自设立起即开始组建研发团队并展开关键技术的研发。随着公司业务的发展，研发团队规模也不断增大，技术覆盖范围和研发领域也不断扩展。公司的研发团队建设情况如下：

团队	创建时间	主要职责
CPU	2005年7月	研发 XBurst CPU 内核
SoC	2005年7月	基于 XBurstCPU 内核，研发一系列 SoC 芯片
软件工程	2005年7月	维护 Linux 操作系统，为客户提供技术支持
硬件工程	2005年7月	负责硬件电路板的设计
多媒体硬件	2006年10月	研发音视频编解码 IP 核
多媒体软件	2007年10月	基于公司的音视频编解码 IP 核，开发相应的软件
PMP 方案	2007年7月	基于 MiniOS 操作系统，研发 PMP 解决方案
智能手机方案	2009年7月	基于 Android 操作系统，研发智能手机解决方案
平板电脑方案	2010年1月	基于 Android 操作系统，研发平板电脑解决方案

十、公司资质、重要科研成果和获奖情况

（一）公司资质情况

序号	证书名称	证书号	发证机关	发证时间
1	高新技术企业证书	GR200911001370	北京市科学技术委员会等	2009年

2	集成电路设计企业认定证书	信认 0187-2006B	原信息产业部	2007 年
3	海淀区创新企业证书	海创字 00621 号	中关村科技园海淀园管理委员会	2010 年
4	中关村国家自主创新示范区创新型试点企业	—	北京市人民政府、科学技术部、中国科学院	2009 年
5	中关村高新技术企业	20092010062101	中关村科技园区管理委员会	2010 年

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的编号为信认 0187-2006B 号《集成电路设计企业认定证书》已通过 2009 年年审，并已向北京半导体行业协会申请名称变更，更名手续正在办理中。此外，由于北京市科学技术委员会暂停办理《高新技术企业证书》的更名手续，公司拥有的该证书尚未完成更名手续。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：《集成电路设计企业认定证书》和《高新技术企业证书》为集成电路企业和高新技术企业享受相关税收优惠前的认定，公司所从事的业务及所出售的产品不需要取得业务资质或强制性认证，其更名手续对发行人生产经营及本次发行上市申请不构成影响。

（二）产品证书及获奖情况

序号	产品证书及奖项	证书及奖励对象	发奖机关	发证时间
1	2009 年中国最具成长性集成电路设计企业	公司	中国半导体行业协会	2010 年
2	2009 年度中国用户奖评集成电路“最受用户欢迎奖”	多媒体应用处理器 JZ4750 芯片	中国软件行业协会嵌入式系统分会等	2010 年
3	2009 年度“中国芯”最佳市场表现奖	多媒体应用处理器 JZ4740	工业和信息化部软件与集成电路促进中心	2009 年
4	十大中国最具发展潜力 IC 设计公司	公司	《电子工程专辑》	2008 年
5	第三届（2008 年度）中国半导体创新产品和技术	JZ4740 系列多媒体处理器芯片	中国半导体行业协会等	2009 年
6	北京市自主创新产品证书	JZ4725 移动多媒体处理器芯片	北京市科学技术委员会等	2009 年
7	中关村高端领军人才	刘强	中关村管委会	2009 年
8	中关村十大创新创业人才	刘强	中关村、新华社等单位	2010 年

十一、香港子公司经营情况

（一）香港子公司经营基本情况

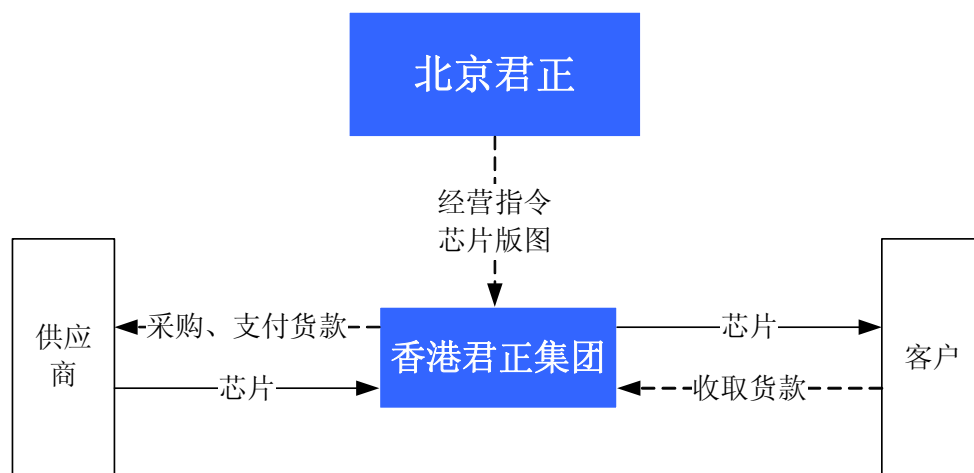
2006年8月14日，北京君正集成电路（香港）集团有限公司在香港成立，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股、参股公司情况”之“（一）北京君正集成电路（香港）集团有限公司”。

（二）香港子公司经营管理情况

报告期内，香港君正集团从事的具体业务为按照北京君正的指令，以自身名义委托加工和销售北京君正研发和设计的芯片产品。香港君正集团的业务活动均以美元结算。

香港君正集团在香港无专门管理人员和办公场所，其经营管理由发行人控制，香港君正集团的公司登记、税务等事务由发行人聘请专业中介机构（秘书公司）负责办理，其物流安排委托第三方执行。

1、香港君正集团业务流程图



2、香港君正集团的销售与生产管理

公司按月统计境外客户需求情况，根据客户后几个月的需求估算，制定生产计划，经公司商务部、总经理讨论通过后，以香港君正集团名义向供应商下订单进行CPU芯片的加工，公司商务部持续跟踪生产订单进度、物流配送情况，产品生产完成后，公司商务部负责办理CPU成品芯片的香港入库。

境外客户有采购需求时，由公司商务部办理香港君正集团与客户销售合同的签订事项，安排货物运送，跟踪客户收货情况，并办理香港君正集团与客户的对账及货款催收。

3、香港君正集团的资金管理

香港君正集团资金严格实行“收支两条线”管理。由公司按月与客户及开户银行进行香港君正集团的资金对账，香港君正集团每笔资金支出均需提交付款申请单、对应的合同或协议、相应的发票，经公司财务总监、总经理审核批准后香港君正集团方可付款。公司财务部协同公司商务部，进行香港君正集团付款和收款的账期管理。

4、香港子公司与母公司的交易

为了满足内地的市场需求以及因为部分香港君正集团的在产品需要在内地进行后续加工，母公司北京君正需要将香港君正集团的库存商品以进口方式调配至内地。公司主要委托深圳市信利康实业有限公司（现已更名为深圳市信利康供应链管理有限公司）代理办理从香港君正集团的进口事宜。2007年、2008年、2009年及2010年上半年，北京君正委托深圳信利康实业有限公司代理进口的交易金额分别为1,056,400.65元、45,150,432.40元、28,232,738.10元、7,709,197.13元。

5、香港子公司对外销售情况

报告期内，公司及香港君正集团实现对外收入情况如下：

单位：元

对外销售收入	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北京君正	110,145,311.14	97.68%	171,703,473.93	89.32%	57,745,751.35	39.87%	10,851,810.90	31.58%
香港君正集团	2,404,852.460	2.13%	20,461,607.78	10.64%	87,096,403.18	60.13%	23,508,448.08	68.42%
深圳君正	210,256.560	0.19%	59,877.95	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
合计	112,760,420.16	100.00%	192,224,959.66	100.00%	144,842,154.53	100.00%	34,360,258.98	100.00%

从上表可以看出，香港君正集团2007年、2008年实现的对外销售占比较高，分别为68.42%和60.13%。2009年以来，公司经营活动主要集中于北京君正，香港君正集团对公司合并经营成果的影响减少，其2009年、2010年1-6月实现的

对外销售占比分别降为 10.64%和 2.13%。

第六节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司主营业务是 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台的研发和销售。

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东暨实际控制人之一李杰除持有北京君正的股份外，还持有南山高科 70%的股权、西邦信息 50%的股权、庚顿数据 26%的股权。

南山高科、西邦信息、庚顿数据与本公司在主营业务、主要产品及使用的技术上均不存在关联性，不存在同业竞争。上述公司的情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

综上所述，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司从事相同或相似业务的情况。本公司此次募集资金投资项目用于主营业务，不会造成公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免今后可能产生的同业竞争，本公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

1、本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未经营与发行人现从事的集成电路的设计、开发及产业化业务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本人承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。

2、若因本人或发行人的业务发展，而导致本人经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本

人经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。

3、如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本人对因此给发行人造成的损失予以赔偿。

二、关联方及其关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，本公司的关联方和关联关系如下：

（一）本公司的控股股东、实际控制人

股东名称	对本公司的持股比例
刘强	30.15%
李杰	20.00%

（二）持有本公司 5%以上股份的其他股东

股东名称	对本公司的持股比例
盈富泰克	17.99%
张紧	7.68%
冼永辉	7.68%

（三）本公司控股子公司

子公司名称	本公司持股比例
香港君正集团	100%
君正时代	100%

（四）实际控制人控制的其他企业

关联方名称	与本公司关系	备注
君正科技	刘强、李杰控制的其他企业	已注销
香港君正有限	刘强、李杰控制的其他企业	已注销
南山高科	李杰控制的其他企业	

西邦信息	李杰控制的其他企业	
庚顿数据	李杰控制的其他企业	

（五）本公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

三、关联交易

（一）报告期经常性关联交易事项

报告期内，本公司与关联方未发生经常性关联交易事项。

（二）报告期偶发性关联交易事项

1、关联方借款

报告期内，公司曾向南山高科提供借款用于其经营资金周转，并按照同期银行定期存款利率收取利息，共收取资金占用费 263,800.00 元，全部计入财务费用。截至报告期末，所有借款均已归还完毕。上述借款的具体情况如下：

单位：元

项 目	2007 年度	2008 年度	2009 年度
期初余额	940,000.00	450,000.00	1,450,000.00
本期发生	2,050,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
本期归还	2,540,000.00	-	3,450,000.00
期末余额	450,000.00	1,450,000.00	-

目前公司已经采取修订公司章程、建立关联交易决策制度等措施来规范关联方借款。

西邦信息、南山高科和庚顿数据也已分别制定了《关联交易决策制度》，对自身未来关联交易进行规范，并分别明确未来“不与北京君正集成电路股份有限

公司发生关联交易”。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：报告期内发行人将闲置资金提供给南山高科属于偶发性关联交易行为，且已于报告期内收回资金及利息，没有对发行人财务状况和经营成果构成重大影响，不存在成本、费用的转移及利益输送情形。

2、关联方担保

报告期内，公司控股股东、实际控制人刘强于 2010 年 6 月 23 日为本公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行海淀园支行”）的流动资金贷款 1,500 万元提供连带责任保证担保（合同编号：0071597），该项借款的提款日为 2010 年 6 月 30 日之前，借款期限自首次提款日起 6 个月，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。该担保增强了本公司的偿债能力。

（三）关联方应收应付款项余额

报告期内，公司对关联方应收应付款项余额情况见下表：

科目	名称	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
		金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
其他应收款	南山 高科	-	-	-	-	1,450,000.00	70.47	450,000.00	24.60
其他应付款	刘强	-	-	1,000,000.00	64.70	-	-	-	-

公司 2009 年末对刘强的其他应付款系本公司代收的中关村科技园区管理委员会根据《中关村高端领军人才聚集工程方案》（京发[2008]28 号）开展的 2009 年第二批中关村高端领军人才评定活动支付给刘强的高端领军人才奖励款，该款项已于 2010 年全部支付。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内偶发的将闲置资金提供给南山高科，且已于报告期内收回，没有对本公司财务状况和经营成果构成重大影响。

四、规范关联交易的制度安排

为了维护全体股东利益，本公司在《公司章程》和《关联交易决策制度》中对关联交易的原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避制度作出了严格的规定，具体情况如下：

（一）关联交易原则

《关联交易决策制度》第七条规定公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用的原则；
- 2、公平、公正、公开的原则；
- 3、关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避；
- 4、与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；
- 5、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。

（二）关联交易决策权限的规定

《关联交易决策制度》规定了本公司关联交易的如下权限：

1、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在500万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、未达到前条规定标准的关联交易事项由董事会决定。

（三）关联交易的回避制度

1、《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表

决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；关联股东违反规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效；股东大会对关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东或其代理人按《公司章程》相关规定表决。

2、《关联交易决策制度》对关联人与公司签署涉及关联交易的协议做出了如下规定：

- （1）任何个人只能代表一方签署协议；
- （2）关联人不得以任何方式干预公司的决定。

3、《关联交易决策制度》规定董事会参与关联交易表决的程序

公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。

未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议形成决议须经公司全体董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、《关联交易决策制度》对于股东大会当中涉及关联交易表决的回避程序：公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

五、关联交易的执行情况及独立董事意见

本公司报告期内发生的关联交易均已履行发生当时的《公司章程》和其他关于关联交易的内控制度规定的程序，并严格遵守相关要求。对此，独立董事发表了如下意见：

“公司在报告期内与关联方发生的关联交易合法有效，关联交易价格公允，

关联交易履行的审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司其他规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

第七节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事会成员

公司现有董事 6 名，其中独立董事 2 名。本届董事会成员均于 2009 年 12 月 18 日由公司创立大会暨第一届股东大会选举产生，任期三年。

公司现任董事简历如下：

刘强先生，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居住权。刘强先生出生于 1969 年，拥有清华大学学士学位和中国科学院计算技术研究所（以下简称“中科院计算所”）工学博士学位。刘强先生先后在北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 年至 2009 年任君正有限董事长，领导研发了嵌入式 XBurst CPU，现任北京君正董事长、总经理，君正时代执行董事、总经理。

李杰先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居住权。李杰先生出生于 1963 年，拥有清华大学学士学位、中科院计算所软件工程硕士学位。李杰先生曾在中科院计算所任职，从事大型机的研制工作，现任北京君正董事、南山高科总经理、庚顿数据执行董事、西邦信息总经理、执行董事。

刘维锦先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居住权。刘维锦先生出生于 1962 年，拥有硕士学位，2000 年至今在盈富泰克任常务副总经理。刘维锦先生目前还担任上海新傲科技有限公司董事、天津巴莫科技股份有限公司董事、西安康鸿信息技术股份有限公司董事、上海硅知识产权交易中心有限公司董事、北京六合万通微电子技术有限公司董事。

张紧先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居住权。张紧先生出生于 1962 年，拥有中国科学技术大学核物理专业学士学位、中国原子能科学研究院核物理所物理专业硕士学位。张紧先生先后在中国原子能科学研究院核物理所、北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 年至 2009 年任君正有限董事、副总经理、技术总监，现任北京君正董事、副总经理。张紧

先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公司多个嵌入式 CPU 芯片研发项目。

王芹生女士，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居住权。王芹生女士出生于 1942 年，毕业于北京航空学院计算机系。王芹生女士先后在中国华大集成电路设计集团有限公司、北京华大电子设计有限责任公司任职，现任中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、北京华大信安科技有限公司董事长。王芹生女士享受政府特殊津贴，是国家“八五”、“九五”、“十五”集成电路 CAD 技术研究项目的主要负责人，主持了多项国家重点集成电路品种开发和应用项目。

傅代国先生，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居住权。傅代国先生出生于 1964 年。现任西南财经大学会计学院副院长、博士生导师、教授，中国会计学会会员，成都市会计学会副会长，成都市高级会计师评审委员会副主任委员，成都市会计电算化专家组成员、四川省会计人才培养基地负责人。除在公司担任独立董事之外，傅代国先生同时还担任四川川润股份有限公司、四川龙蟒钛业股份有限公司、山东龙力生物科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

公司现有 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本届监事会股东代表监事于 2009 年 12 月 18 日由公司创立大会暨第一届股东大会选举产生，职工代表监事于 2009 年 12 月 16 日由君正有限职工代表大会选举产生，任期均为三年。

公司现任监事简历如下：

晏晓京女士，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居住权。晏晓京女士出生于 1965 年，拥有电子科技大学学士学位，高级工程师。晏晓京女士先后在电子部第十五研究所、北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 年至 2009 年任君正有限部门经理，现任公司监事会主席、部门经理。晏晓京女士对芯片的外围接口电路有丰富的经验，主持设计了闪存接口、UART 等多个模块，同时具体负责 SoC 芯片从规格定义到量产的全过程。

葛亮先生，公司监事，中国国籍，无境外永久居住权。葛亮先生出生于 1973

年，拥有硕士学位，中级工程师。葛亮先生先后在中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司任职，现任盈富泰克总经理助理、部门经理，唯思泰瑞（北京）信息科技有限公司董事，天津巴莫科技股份有限公司、北京六合万通微电子股份有限公司、重庆博恩富克医疗设备有限公司、西安康弘新材料科技有限公司监事。

姜君先生，公司职工代表监事，中国国籍，无境外永久居住权。姜君先生出生于 1974 年，毕业于清华大学热能系动力工程专业。姜君先生曾在北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 至 2009 年任君正有限部门经理，现任公司职工代表监事、部门经理。姜君先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，主持了公司的 CPU 内核技术的研发。

（三）高级管理人员

根据《公司章程》规定，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司现任高级管理人员均由公司第一届董事会第一次会议决议聘任，任期三年。

公司现任高级管理人员简历如下：

刘强先生，公司董事长、总经理，其个人简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

张紧先生，公司副总经理、技术总监，其个人简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

洗永辉先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。洗永辉先生出生于 1968 年，拥有华中理工大学电子与信息工程系微波技术专业学士学位。洗永辉先生先后在北京首钢计算机公司、北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 年至 2009 年任君正有限董事、副总经理，现任北京君正副总经理。洗永辉先生负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司 Linux、Android 平台及 PMP 方案和智能手机方案的研发项目。

张燕祥女士，公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居住权。张

燕祥女士出生于 1968 年，管理学学士学位，在读中央财经大学研究生。张燕祥女士先后在北京荣德玩具有限公司、北京亚之捷环境工程公司、北京万方源房地产公司、秦人百年（北京）广告有限公司任职，2006 年至 2009 年任君正有限财务总监，现任公司副总经理、财务总监。

张敏女士，公司副总经理、董事会秘书、商务总监、君正时代监事，中国国籍，无境外永久居住权。张敏女士出生于 1973 年，拥有四川大学化学纤维专业硕士学位、清华大学工商管理硕士学位。张敏女士先后在深圳市金罗湖商业城有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2007 年至 2009 年任君正有限商务总监，现任公司副总经理、董事会秘书，商务总监、君正时代监事。

周生雷先生，公司副总经理、市场总监，中国国籍，无境外永久居住权。周生雷先生出生于 1975 年，拥有西安电子科技大学工学硕士学位。周生雷先生先后在 Philips 半导体设计中心、益登科技股份有限公司任职，2008 年至 2009 年任君正有限市场总监，现任公司副总经理、市场总监。

赖亚明先生，公司副总经理、君正时代常务副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。赖亚明先生出生于 1976 年，拥有清华大学硕士学位。赖亚明先生先后在北京博奥生物芯片有限公司、北京先锋博创科技发展有限公司任职，2009 年任君正时代常务副总经理，现任公司副总经理、君正时代常务副总经理。

（四）其他核心人员

公司其他核心人员的简历如下：

刘飞先生，公司项目经理，中国国籍，无境外永久居住权。刘飞先生出生于 1972 年，拥有吉林工业大学学士学位。曾任职于烟台公安局、北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司，2005 年至 2009 年任君正有限项目经理，现任公司项目经理。刘飞先生精通集成电路芯片的后端实现，主要负责公司芯片的布局布线、物理验证和流片生产。

许志鹏先生，公司部门经理，中国国籍，无境外永久居住权。许志鹏先生出生于 1973 年，拥有西南石油学院学士学位。曾任职于北京金远见电脑公司、北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司，2005 年至 2009

年任君正有限部门经理，现任公司部门经理。许志鹏先生精通 Linux 操作系统软件 and 多媒体软件，领导了公司操作系统底层的研制和多媒体播放器软件的研制。

（五）发行人董事、监事的提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2009 年 12 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。刘强提名本人和王芹生、李杰提名本人和傅代国、盈富泰克提名刘维锦、张紧提名本人为公司第一届董事会成员，其中王芹生、傅代国为独立董事。经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致同意选举刘强、李杰、刘维锦、张紧、王芹生、傅代国为公司第一届董事会成员。

2、监事提名和选聘情况

2009 年 12 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。刘强提名晏晓京、盈富泰克提名葛亮为公司第一届监事会股东代表监事。经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致同意选举晏晓京、葛亮为公司第一届监事会股东代表监事，与君正有限职工代表大会 2009 年 12 月 16 日选举的职工代表监事姜君共同组成公司第一届监事会。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	在公司任职	持股数量（股）	持股比例
1	刘强	董事长、总经理、核心技术人员	18,092,633	30.15%
2	李杰	董事	12,000,000	20.00%
3	张紧	董事、副总经理、核心技术人员	4,608,000	7.68%
4	晏晓京	监事会主席、核心技术人员	1,500,000	2.50%
5	姜君	职工监事、核心技术人员	1,800,000	3.00%

6	洗永辉	副总经理、核心技术人员	4,608,000	7.68%
7	张燕祥	副总经理	600,000	1.00%
8	张敏	副总经理	600,000	1.00%
9	刘飞	核心技术人员	1,500,000	2.50%
10	许志鹏	核心技术人员	1,500,000	2.50%
合 计			46,808,633	78.01%

（二）公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，除刘强与刘飞为兄弟关系外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属近三年所持股份的增减变动情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属近三年所持公司股份的变动情况如下表：

序号	姓名	2007 年末		2008 年末		2009 年末	
		股权 (元)	持股比例 (%)	股权 (元)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	刘强	2,515,000.00	40.24	1,574,480.00	22.65	18,092,633	30.15
2	李杰	700,000.00	11.20	1,390,000.00	20.00	12,000,000	20.00
3	张紧	700,000.00	11.20	533,760.00	7.68	4,608,000	7.68
4	晏晓京	-	-	173,750.00	2.50	1,500,000	2.50
5	姜君	-	-	208,500.00	3.00	1,800,000	3.00
6	洗永辉	700,000.00	11.20	533,760.00	7.68	4,608,000	7.68
7	张燕祥	-	-	156,375.00	2.25	600,000	1.00
8	张敏	-	-	156,375.00	2.25	600,000	1.00
9	刘飞	-	-	173,750.00	2.50	1,500,000	2.50
10	许志鹏	-	-	173,750.00	2.50	1,500,000	2.50

（四）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持股份质押和冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员

及其近亲属所持公司股份不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员发行前对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况如下：

姓名	本公司任职	投资企业	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	是否与本公司 存在利益冲突
李杰	董事	西邦信息	1,918	50	否
		南山高科	5,000	70	否
		庚顿数据	100	26	否
刘维锦	董事	深圳市鑫海泰投资咨询有限公司	200	15	否
葛亮	监事	深圳市鑫海泰投资咨询有限公司	200	7	否

上述对外投资不存在与发行人利益冲突的情形。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2009 年从公司及关联企业领取收入的情况如下：

姓名	职务	2009年在公司领取 收入（税前）	2009年在关联企业领 取收入（税前）
刘强	董事长、总经理、核心技术人员	18.00万元	-
李杰	董事	-	从南山高科领取 21.14万元
刘维锦	董事	-	从盈富泰克领取 55.56万元
张紧	董事、副总经理、核心技术人员	15.00万元	-
王芹生	独立董事	0.50万元	-
傅代国	独立董事	0.50万元	-
晏晓京	监事会主席、核心技术人员	12.00万元	-
葛亮	监事	-	从盈富泰克领取 23.55万元

姜 君	职工代表监事、核心技术人员	12.00万元	-
洗永辉	副总经理、核心技术人员	15.00万元	-
张燕祥	副总经理、财务总监	8.40万元	-
张敏	副总经理、董事会秘书	8.40万元	-
周生雷	副总经理	18.60万元	-
赖亚明	副总经理	17.20万元	-
刘飞	核心技术人员	12.00万元	-
许志鹏	核心技术人员	12.00万元	-

除此之外，上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划等。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

姓 名	兼职单位名称	职 位	兼职单位与本公司关系
刘强	君正时代	执行董事、 总经理	全资子公司
李杰	西邦信息	执行董事、 总经理	控股股东控制的其他企业
	南山高科	总经理	控股股东控制的其他企业
	庚顿数据	执行董事	控股股东控制的其他企业
赖亚明	君正时代	常务副总经理	全资子公司
张敏	君正时代	监事	全资子公司
刘维锦	盈富泰克	常务副总经理	股东单位
	上海新傲科技有限公司	董事	无关联关系
	天津巴莫科技股份有限公司	董事	无关联关系
	西安康鸿信息技术股份有限公司	董事	无关联关系
	上海硅知识产权交易中心有限公司	董事	无关联关系
	北京六合万通微电子技术有限公司	董事	无关联关系
王芹生	中国半导体行业协会集成电路设计分会	理事长	无关联关系
	北京华大信安科技有限公司	董事长	无关联关系
傅代国	西南财经大学会计学院	教授，副院长	无关联关系

	四川川润股份有限公司	独立董事	无关联关系
	四川龙蟒钛业股份有限公司	独立董事	无关联关系
	山东龙力生物科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
葛亮	盈富泰克	总经理助理、 部门经理	股东单位
	唯思泰瑞（北京）信息科技有限公司	董事	无关联关系
	天津巴莫科技股份有限公司	监事	无关联关系
	北京六合万通微电子技术股份有限公司	监事	无关联关系
	重庆博恩富克医疗设备有限公司	监事	无关联关系
	西安康弘新材料科技有限公司	监事	无关联关系

除以上人员外，截至本招股说明书签署之日，公司其他董事、监事、高级管理人员或其他核心人员不存在在外兼职的情形。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

除刘强与刘飞为兄弟关系外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议

公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的要求，与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，明确了双方之间的权利和义务，对上述人员的忠诚义务、勤勉义务、保密责任等作了相应约定。

公司未与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定任何有关借款、担保方面的协议。

截至本招股说明书签署之日，公司与上述人员签订的协议均在有效履行，未出现违约情形。

八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺

持有公司股权的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对所持有的公司股份作出自愿锁定的承诺、公司整体变更所涉及的个人所得税作出于公司上市之日起两年内缴纳的承诺，刘强和李杰还就避免与公司发生同业竞争出具《关于避免同业竞争的承诺函》，上述承诺情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、实际控制人、股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺”。

截至本招股说明书签署之日，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺。

九、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员由公司股东大会、董事会和职工代表大会依法定程序产生，不存在违反法律法规或公司章程规定的任职资格的情形。

十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因

（一）董事变动情况

最近两年董事变化情况如下：

序号	变更时间	原董事	变更后董事	变更原因
1	2008年 5月25日	刘强（董事长）、李杰、刘维锦、刘军、洗永辉	刘强（董事长）、李杰、刘维锦、张紧、洗永辉	因刘军转让全部所持股权，不再为公司股东，改选张紧担任董事
2	2009年 12月18日	刘强（董事长）、李杰、刘维锦、张紧、洗永辉	刘强（董事长）、李杰、刘维锦、张紧、王芹生（独立董事）、傅代国（独立董事）	增选独立董事

（二）监事变化情况

最近两年监事变化情况如下：

序号	变更时间	原监事	变更后监事	变更原因
1	2008年	张紧、葛亮	葛亮	经股东会同意，张紧辞去监事职务，

	5月25日			并改任公司董事
2	2009年 12月18日	葛亮	晏晓京（监事会主席）、 葛亮、姜君（职工代表 监事）	增选监事

（三）高级管理人员变化情况

最近两年，本公司高级管理人员未发生变更。

第八节 公司治理

一、发行人公司治理制度的建立健全及运行情况

依据《公司法》、《证券法》等相关法规，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规章制度，并依据该等制度规定设置了符合现行法律、法规要求的公司治理结构。公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定并修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行。

1、股东的权利和义务

按照《公司章程》规定，公司股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

《公司章程》第二十八条规定公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

《公司章程》第三十三条规定公司股东承担下列义务：（1）遵守本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得

退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

《公司章程》第三十六条规定股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（13）审议股权激励计划；（14）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

3、股东大会议事规则

《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定：

（1）会议的召开和举行

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

有下列情形之一的，公司应当事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：①董事人数不足 5 人时；②公司未弥补的亏损达到实收股本总额的 1/3 时；③单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东书面请求时；④董事会认为必要时；⑤监事会提议召开时；⑥法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第③项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。

发生前述第①、②项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照《股东大会议事规则》规定的条件和程序自行召集临时股东大会。

（2）提案的提交与表决

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

（3）股东出席的方式

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人应当向公司提交授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证和股票账户卡；委托代理人出席的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书和股票账户卡。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位机构主体资格证明、法定代表人资格证明和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位机构主体资格证明、法定代表人资格证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股票账户卡。

（4）决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；股权激励计划；法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

4、公司股东大会会议召开情况

公司自改制设立以来召开了两次股东大会：

（1）2009 年 12 月 18 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《北京君正集成电路有限公司以整体变更方式发起设立为股份有限公司的议案》、《公司章程》及三会议事规则等议案，并选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

（2）2010 年 2 月 24 日，公司召开了 2009 年度股东大会，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、2009 年度财务决算报告、2010 年度财务预算报告、《关于北京君正集成电路股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于授权北京君正集成电路股份有限公司董事会全权办理申请首次公开发行 A 股并在创业板上市事宜的议案》、《公司章程（草案）》等议案。

公司改制设立以来的历次股东大会均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定规范运作，严格履行有关法律规定的召集、召开、表决程序，决议内容合法有效。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公

公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。

1、董事会构成

公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。

2、董事会职权

根据《公司章程》的规定，公司董事会依法行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订《公司章程》的修改方案；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

3、董事会议事规则

《公司章程》、《董事会议事规则》对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。

（1）董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会定期会议每年召开二次。董事会定期会议应当在上下两个半年度各召开一次。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：①代表 1/10 以上表决权的股东提议时；②1/3 以上董事联名提议时；③监事会提议时；④董事长认为必要时；⑤1/2 以上独立董事提议时；⑥总经理提议时；⑦《公司章程》规定的其他

情形。

（2）董事会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

（3）董事会召开定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前 10 日和 3 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开董事会临时会议。

（4）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

（5）董事原则上应当亲自出席董事会会议，如因故不能出席董事会会议，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：①委托人和受托人的姓名；②委托人对每项议案的简要意见；③委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；④委托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

（6）除《董事会议事规则》另有明确规定外，董事会审议通过会议议案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该议案投赞成票。法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

（7）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数未超过全体董事的半数的，应将该事项提交股东大会审议。

4、历次董事会会议召开情况

公司自改制设立以来召开了六次董事会：

（1）2009 年 12 月 18 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，会议审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，并选举刘强担任公司董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

（2）2010 年 1 月 14 日，公司召开了第一届董事会第二次会议，会议审议

通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》及三个专门委员会的工作细则，并选举了各专门委员会的组成人员。

（3）2010年2月2日，公司召开了第一届董事会第三次会议，会议审议通过了总经理工作报告、2009年度财务决算报告、2010年度财务预算报告、公司2007-2009年度财务报告、《关于北京君正集成电路股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于授权北京君正集成电路股份有限公司董事会全权办理申请首次公开发行A股并在创业板上市事宜的议案》、《公司章程（草案）》、公司未来三年发展战略规划纲要等议案。

（4）2010年2月26日，公司召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了公司库存盘亏与报损处理方案。

（5）2010年6月18日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请1500万元借款的议案。

（6）2010年7月30日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了北京君正集成电路股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1至6月份的财务报表。

公司改制设立以来的历次董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定规范运作，严格履行有关法律规定的召集、召开、表决程序，决议内容合法有效。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。

1、监事会构成

公司设监事会，由3名监事组成。其中，2名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另1名成员由职工代表担任并由公司职工代表大会选举产生。

监事会设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

2、监事会职权

根据《公司章程》的规定，监事会依法行使以下职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

（1）监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 个工作日内召开临时会议：①任何监事提议召开时；②股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；③董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；④公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；⑤《公司章程》规定的其他情形。

（2）召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前 10 个工作日和 3 个工作日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

（3）监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会

议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给公司指定的专门负责人员。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

（4）监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

（5）监事会会议的表决实行一人一票，以举手方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。

4、历次监事会会议召开情况

公司自改制设立以来召开了三次监事会：

（1）2009年12月18日，公司召开了第一届监事会第一次会议，会议选举晏晓京担任公司监事会主席。

（2）2010年2月2日，公司召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了2009年度监事会工作报告、公司2009年度财务决算报告、公司2007-2009年度财务报告等议案。

（3）2010年7月30日，公司召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了北京君正集成电路股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月份的财务报表。

公司设立以来的历次监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序、召开、表决程序，决议内容合法有效。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事情况

公司建立了独立董事制度，聘请王芹生女士、傅代国先生担任公司独立董事，占董事会成员人数的1/3，其中王芹生女士为行业方面的专家，傅代国先生为会

计方面的专家。

公司两位独立董事均具备独立董事的任职条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（2）具有《独立董事工作制度》所要求的独立性；（3）具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（5）《公司章程》规定的其他条件；（6）兼任独立董事的公司不超过 5 家。

2、独立董事的制度安排

根据《独立董事工作制度》，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：（1）公司涉及的重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 500 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使以上特别职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施收回欠款；独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；《公司章程》规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名独立董事一致认为资料不充分或论

证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

3、独立董事履行职责的情况

公司独立董事在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面发挥了积极作用。随着公司治理的日趋完善，独立董事将在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥更重要的作用。

（五）董事会秘书的制度建设和履行职责情况

1、董事会秘书情况

公司建立了董事会秘书制度，并聘请张敏女士担任公司的董事会秘书。

张敏女士不存在法律、法规、《公司章程》及《董事会秘书工作规则》禁止担任董事会秘书的情形，具有研究生学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上，具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力，符合董事会秘书的任职条件。

2、董事会秘书工作制度

公司制定了《董事会秘书工作规则》，规定董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行如下主要职责：（1）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；（2）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法

履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（3）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（4）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（5）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（6）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；（7）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（8）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；（9）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；（10）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

3、董事会秘书履行职责情况

公司董事会秘书张敏女士自任职以来，依法筹备了历次董事会会议及股东大会会议，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理上发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

（六）董事会审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况

1、审计委员会人员构成

《公司章程》规定公司董事会下设审计委员会。公司第一届董事会第二次会议推选傅代国、王芹生、李杰为审计委员会委员，任期三年，其中傅代国为审计委员会召集人。上述委员的个人简历详见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他

核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

2、审计委员会会议事规则

公司《董事会审计委员会会议事规则》规定：

审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。

审计委员会主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审计公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度；（6）审查和评价公司重大关联交易；（7）公司董事会授予的其它事项。

审计委员会设主任委员（召集人）1名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。

审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开两次，在中期财务报告和年度财务报告公布前召开，并于会议召开前五个工作日通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后十日内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

审计委员会会议以现场召开为原则。在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采取通讯表决的方式召开。

审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席审计委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

3、审计委员会运行情况

公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会

工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了职责。2010年2月2日，公司审计委员会召开会议，讨论、审核了公司2009年度财务决算报告和2007-2009年度财务报告，并提交第一届董事会第三次会议审议通过。2010年7月30日，公司审计委员会召开会议，讨论、审核了北京君正集成电路股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月份的财务报表，并提交第一届董事会第六次会议审议通过。

二、发行人近三年违法违规行为情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

公司有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。报告期内，公司曾向控股股东、实际控制人李杰控制的南山高科提供借款，所借款项均按照同期银行定期存款利率收取利息，截至报告期末，所有向南山高科的借款均已归还完毕。为了维护全体股东利益，公司在《公司章程》和《关联交易决策制度》中对关联交易的原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避制度作出了严格的规定。公司向南山高科提供借款和规范关联交易的制度安排详见本招股说明书“第六节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”。

《公司章程》第三十七条明确规定公司不得对外提供担保，报告期内，公司未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何担保。

四、发行人内部控制情况

（一）公司管理层的自我评估意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所

所上市公司内部控制指引》等法规，结合自身的实际情况，建立了较为完备的内部控制制度，确保公司高级管理人员和“三会”的职责和制衡机制能够基本有效运作。在经营管理方面，通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司管理目标的实现；在财务管理方面，通过规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量，建立了覆盖公司各个环节的财务控制制度。

公司的内部控制制度适合本公司管理要求，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，且能够贯彻落实实施，适应公司管理和发展的需要。在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

兴华事务所对公司的内部控制制度进行了专项审核，出具了（2010）京会兴核字第 1-44 号《内部控制鉴证报告》，认为“按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及其他控制标准的规定，北京君正集成电路股份有限公司截至 2009 年 12 月 31 日和 2010 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的。”

五、发行人对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况

（一）公司对外投资、担保事项的政策及制度安排

1、公司对外投资的政策及制度安排

根据《公司章程》、《投资管理制度》的相关规定，董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：

（1）单项金额及年度累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资

产值 20%以下的投资事项，包括股权投资、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 500 万元以下，对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；

(2) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50%以下的资产抵押、质押事项；

(3) 与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率超过 60%时，单项金额人民币 3,000 万元以下的债务性融资事项（发行债券除外）；

(4) 交易金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%以下的收购、出售资产事项；

(5) 交易金额在 500 万元以下，且占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 5%以下的关联交易事项。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。

2、公司对外担保的政策及制度安排

根据《公司章程》第三十七条的规定，公司不得对外提供担保。

根据《公司章程（草案）》第四十一条的规定，公司上市后不对控股子公司以外的其他公司提供担保。公司对控股子公司提供的下列担保，须经股东大会审议通过：

(1) 公司对控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；

(2) 公司对控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 10%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 50%的控股子公司提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5%的担保；

(5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(6) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

（二）公司最近三年对外投资、担保事项的执行情况

公司最近三年未对外提供担保，最近三年的对外投资事项严格遵守法律法规和公司制度的规定，无重大违法违规事件发生。

六、发行人投资者权益保护情况

公司对投资者的合法权益的保护主要体现在公司创立大会暨第一次股东大会通过的《公司章程》、《关联交易决策制度》以及《独立董事工作制度》。

《公司章程》第二十八条规定投资者享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

《公司章程》第四十八条规定投资者依法享有提案权。公司召开股东大会，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

《关联交易决策制度》明确了公司董事会、股东大会对于关联交易的决策权限。董事会、股东大会在作出决议时，关联方应回避表决。

《独立董事工作制度》规定独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应对公司重大人事任免决策、关联交易事项发表独立意见，并对其认为可能损害中小股东权益的事项及时向董事会和股东大会发表意见。

此外，按照上市公司要求，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《信息披露事务管理制度》（草案）、《投资者关系管理制度》（草案）、《募集资金管理办法》（草案），为公司本次公开发行上市后进一步保护投资者权利做了充分的准备和制度安排。

第九节 财务会计信息与管理层分析

以下财务数据非经特别说明，均引自兴华事务所出具的（2010）京会兴审字第1-134号《审计报告》。本公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息与管理层分析外，还应关注审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
流动资产：				
货币资金	123,663,358.34	101,145,519.60	54,987,314.01	9,038,818.45
应收账款	6,273,789.69	281,397.88	1,213,983.33	117,900.00
预付账款	31,238,857.18	44,479,823.50	24,652,906.00	9,771,598.81
其他应收款	1,071,242.51	676,949.52	2,057,559.41	1,829,007.70
存货	22,704,314.25	36,533,979.53	29,068,814.18	6,882,856.72
流动资产合计	184,951,561.97	183,117,670.03	111,980,576.93	27,640,181.68
非流动资产：				
固定资产	1,471,516.88	1,443,004.85	1,462,741.88	917,394.19
递延所得税资产	106,449.24	751,961.90	642,729.94	52,700.43
非流动资产合计	1,577,966.12	2,194,966.75	2,105,471.82	970,094.62
资产总计	186,529,528.09	185,312,636.78	114,086,048.75	28,610,276.30
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
应付账款	8,789,928.83	18,457,902.75	6,569,489.51	73,067.55
预收账款	622,758.10	3,746,779.06	21,143,367.07	3,147,793.43
应付职工薪酬	349,574.06	1,344,542.82	185,268.78	57,048.22
应交税费	3,163,819.81	1,035,287.70	12,427,505.81	1,177,934.91
应付股利	-	35,000,000.00	-	-
其他应付款	561,263.36	1,545,652.04	1,431,748.15	368,544.80
流动负债合计	28,487,344.16	76,130,164.37	41,757,379.32	4,824,388.91

非流动负债：				
其他非流动负债	2,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	-
非流动负债合计	2,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	-
负债合计	30,987,344.16	79,630,164.37	43,257,379.32	4,824,388.91
股东权益：				
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	6,950,000.00	6,250,000.00
资本公积	14,156,178.85	14,156,178.85	11,552,594.02	11,551,958.77
盈余公积	941,357.62	941,357.62	1,528,971.13	64,479.19
未分配利润	80,687,552.41	30,765,468.81	50,940,040.65	6,270,906.70
外币报表折算差额	-242,904.95	-180,532.87	-142,936.37	-351,457.27
归属于母公司股东权益合计	155,542,183.93	105,682,472.41	70,828,669.43	23,785,887.39
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	155,542,183.93	105,682,472.41	70,828,669.43	23,785,887.39
负债和股东权益总计	186,529,528.09	185,312,636.78	114,086,048.75	28,610,276.30

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	112,760,420.16	192,224,959.66	144,842,154.53	34,360,258.98
减：营业成本	47,202,962.94	78,796,252.09	70,897,617.72	22,873,633.05
营业税金及附加	1,148,135.97	1,831,609.19	151,023.28	23,780.09
销售费用	3,275,761.17	10,609,695.80	3,705,176.30	1,000,641.10
管理费用	13,299,061.30	24,388,926.58	11,355,357.07	4,516,696.69
财务费用	270,523.15	-780,556.19	1,864,351.66	112,963.52
资产减值损失	15,752.33	-135,156.23	41,097.55	-12,737.68
二、营业利润	47,548,223.30	77,514,188.42	56,827,530.95	5,845,282.21
加：营业外收入	7,181,961.52	2,006,618.41	2,005.00	5,250.02
减：营业外支出	-	400.00	100,000.00	-
三、利润总额	54,730,184.82	79,520,406.83	56,729,535.95	5,850,532.23
减：所得税费用	4,808,101.22	9,629,007.35	10,595,910.06	776,032.13

四、净利润	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
其中：同一控制下企业合并的合并日以前的净利润				3,917,259.12
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.8320	1.1649	0.8317	0.1542
（二）稀释每股收益	0.8320	1.1649	0.8317	0.1542
六、其他综合收益	-62,372.08	-37,596.50	208,520.90	-351,457.27
归属于母公司所有者的其他综合收益	-62,372.08	-37,596.50	208,520.90	-351,457.27
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	49,859,711.52	69,853,802.98	46,342,146.79	4,723,042.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,859,711.52	69,853,802.98	46,342,146.79	4,723,042.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	122,252,022.33	202,866,497.88	171,380,202.20	35,879,831.98
收到的税费返还	16,920,682.67	-	-	-
收到的其他与经营经营活动有关的现金	467,621.36	17,284,371.01	9,624,605.00	7,509,361.42
现金流入小计	139,640,326.36	220,150,868.89	181,004,807.20	43,389,193.40
购买商品、接受劳务支付的现金	38,915,416.56	82,307,531.88	108,803,570.45	32,068,834.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7,547,542.21	10,491,388.51	7,329,722.66	3,459,724.73
支付的各项税费	25,373,325.43	41,160,897.33	1,600,552.65	883,858.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9,176,669.88	30,723,450.29	15,803,173.03	8,332,857.54

现金流出小计	81,012,954.08	164,683,268.01	133,537,018.79	44,745,275.53
经营活动产生的现金流量净额	58,627,372.28	55,467,600.88	47,467,788.41	-1,356,082.13
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	190.00	-	-
现金流入小计	-	190.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	621,872.33	24,258,187.55	854,364.32	66,768.24
现金流出小计	621,872.33	24,258,187.55	854,364.32	66,768.24
投资活动产生的现金流量净额	-621,872.33	-24,257,997.55	-854,364.32	-66,768.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	700,635.25	7,050,618.77
借款所收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,423,832.50	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	50,423,832.50	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-35,423,832.50	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：	-63,828.71	-51,397.74	-1,365,563.78	-216,169.47
五、现金及现金等价物净增加额：	22,517,838.74	46,158,205.59	45,948,495.56	5,411,598.93
加：期初现金及现金等价物余额	101,145,519.60	54,987,314.01	9,038,818.45	3,627,219.52
六、期末现金及现金等价物余额	123,663,358.34	101,145,519.60	54,987,314.01	9,038,818.45

（四）合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2010年1-6月								
	归属于母公司所有者权益合计							少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,156,178.85	-	941,357.62	-	30,765,468.81	-180,532.87	-	105,682,472.41
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	60,000,000.00	14,156,178.85	-	941,357.62	-	30,765,468.81	-180,532.87	-	105,682,472.41
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	49,922,083.60	-62,372.08	-	49,859,711.52
（一）净利润						49,922,083.60		-	49,922,083.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-62,372.08	-	-62,372.08
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	49,922,083.60	-62,372.08	-	49,859,711.52
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配		-	-	-					
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,156,178.85	-	941,357.62	-	80,687,552.41	-242,904.95	-	155,542,183.93

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2009 年度								
	归属于母公司所有者权益合计							少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,950,000.00	11,552,594.02		1,528,971.13	-	50,940,040.65	-142,936.37		70,828,669.43
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	6,950,000.00	11,552,594.02		1,528,971.13	-	50,940,040.65	-142,936.37		70,828,669.43
三、本年增减变动金额	53,050,000.00	2,603,584.83		-587,613.81	-	-20,174,571.84	-37,596.50		34,853,802.98
（一）净利润						69,891,399.48			69,891,399.48
（二）其他综合收益						-	-37,596.50		-37,596.50
上述（一）和（二）小计						69,891,399.48	-37,596.50		69,853,802.98
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									
（四）利润分配				8,477,744.98	-	-43,477,744.98			-35,000,000.00
1、提取盈余公积				8,477,744.98		-8,477,744.98			-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配						-35,000,000.00			-35,000,000.00
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转	53,050,000.00	2,603,584.83		-9,065,358.49	-	-46,588,226.34			-
1、资本公积转增股本									-
2、盈余公积转增股本	9,065,358.49	-		-9,065,358.49	-	-			-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他	43,984,641.51	2,603,584.83		-		-46,588,226.34			-
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,156,178.85	-	941,357.62	-	30,765,468.81	-180,532.87	-	105,682,472.41

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2008 年度								
	归属于母公司所有者权益合计							少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,250,000.00	11,551,958.77	-	64,479.19	-	6,270,906.70	-351,457.27	-	23,785,887.39
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	6,250,000.00	11,551,958.77	-	64,479.19	-	6,270,906.70	-351,457.27	-	23,785,887.39
三、本年增减变动金额	700,000.00	635.25	-	1,464,491.94	-	44,669,133.95	208,520.90	-	47,042,782.04
（一）净利润						46,133,625.89		-	46,133,625.89
（二）其他综合收益							208,520.90		208,520.90
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	46,133,625.89	208,520.90	-	46,342,146.79
（三）所有者投入和减少资本	700,000.00	635.25	-	-	-	-		-	700,635.25
1、所有者投入资本	700,000.00	635.25							700,635.25
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配				1,464,491.94	-	-1,464,491.94		-	-
1、提取盈余公积				1,464,491.94		-1,464,491.94			-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配									-
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-			-
1、资本公积转增股本		-							-
2、盈余公积转增股本	-								-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	6,950,000.00	11,552,594.02	-	1,528,971.13	-	50,940,040.65	-142,936.37	-	70,828,669.43

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2007 年度								
	归属于母公司所有者权益合计							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,500,000.00	7,251,340.00				1,260,885.79			12,012,225.79
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	3,500,000.00	7,251,340.00	-	-	-	1,260,885.79	-	-	12,012,225.79
三、本年增减变动金额	2,750,000.00	4,300,618.77	-	64,479.19	-	5,010,020.91	-351,457.27	-	11,773,661.60
（一）净利润						5,074,500.10		-	5,074,500.10
（二）其他综合收益							-351,457.27		-351,457.27
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	5,074,500.10	-351,457.27	-	4,723,042.83
（三）所有者投入和减少资本	2,750,000.00	4,300,618.77	-	-	-	-		-	7,050,618.77
1、所有者投入资本	2,750,000.00	4,300,618.77							7,050,618.77
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配				64,479.19	-	-64,479.19		-	-
1、提取盈余公积				64,479.19		-64,479.19			-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配									-
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-			-
1、资本公积转增股本		-							-
2、盈余公积转增股本	-								-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	6,250,000.00	11,551,958.77	-	64,479.19	-	6,270,906.70	-351,457.27	-	23,785,887.39

（五）母公司资产负债表

单位：元

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
流动资产：				
货币资金	112,708,455.46	82,146,611.86	24,664,685.70	8,773,184.18
应收账款	6,273,789.69	1,565,726.13	86,017.39	117,900.00
预付账款	31,238,857.18	37,659,843.63	4,555,501.84	1,304,724.03
其他应收款	5,233,141.45	2,704,984.91	2,051,407.72	1,820,554.48
存货	22,640,444.64	38,197,824.83	28,757,182.61	5,986,691.94
流动资产合计	178,094,688.42	162,274,991.36	60,114,795.26	18,003,054.63
非流动资产：				
长期股权投资	6,700,871.41	6,700,871.41	5,700,871.41	5,700,871.41
固定资产	1,112,754.92	1,074,125.49	1,462,741.88	917,394.19
递延所得税资产	123,357.82	565,999.51	94,605.66	52,700.43
非流动资产合计	7,936,984.15	8,340,996.41	7,258,218.95	6,670,966.03
资产总计	186,031,672.57	170,615,987.77	67,373,014.21	24,674,020.66
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
应付账款	8,789,928.83	16,968,835.94	15,142.60	30,515.19
预收账款	622,758.10	2,198,432.27	19,270,239.69	35,564.00
应付职工薪酬	349,574.06	1,146,842.82	185,268.78	57,048.22
应交税费	2,727,417.75	-5,589,810.45	4,208,053.05	45,003.79
应付股利	-	35,000,000.00	-	-
其他应付款	18,355,379.60	13,131,338.09	2,711,410.81	368,544.80
流动负债合计	45,845,058.34	77,855,638.67	26,390,114.93	536,676.00
非流动负债：				
其他非流动负债	2,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	-
非流动负债合计	2,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	-
负债合计	48,345,058.34	81,355,638.67	27,890,114.93	536,676.00
股东权益：				
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	6,950,000.00	6,250,000.00

资本公积	19,846,772.86	19,846,772.86	17,243,188.03	17,242,552.78
盈余公积	941,357.62	941,357.62	1,528,971.13	64,479.19
未分配利润	56,898,483.75	8,472,218.62	13,760,740.12	580,312.69
股东权益合计	137,686,614.23	89,260,349.10	39,482,899.28	24,137,344.66
负债和股东权益总计	186,031,672.57	170,615,987.77	67,373,014.21	24,674,020.66

（六）母公司利润表

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	110,242,394.65	171,763,521.79	57,745,751.35	10,851,810.90
减：营业成本	48,895,352.84	69,489,547.38	28,884,726.98	6,210,812.31
营业税金及附加	1,147,883.68	1,831,537.33	151,023.28	23,780.09
销售费用	3,123,577.43	9,275,202.74	132,267.58	98,075.44
管理费用	10,952,365.64	21,416,183.60	9,901,519.23	3,406,816.82
财务费用	265,675.62	-559,284.80	-90,716.94	-15,521.50
资产减值损失	119,874.72	-17,831.72	39,400.36	-13,174.90
加：投资收益	-	20,484,300.00	-	-
二、营业利润	45,737,664.72	90,812,467.26	18,727,530.86	1,141,022.64
加：营业外收入	7,093,585.90	2,006,428.41	2,005.00	5,250.02
减：营业外支出	-	-	100,000.00	-
三、利润总额	52,831,250.62	92,818,895.67	18,629,535.86	1,146,272.66
减：所得税费用	4,404,985.49	8,041,445.85	3,984,616.49	-10,968.32
四、净利润	48,426,265.13	84,777,449.82	14,644,919.37	1,157,240.98
五、其他综合收益	-	-	-	5,690,594.01
六、综合收益总额	48,426,265.13	84,777,449.82	14,644,919.37	6,847,834.99

（七）母公司现金流量表

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	121,006,342.23	181,732,595.27	86,482,227.82	10,991,851.04
收到的税费返还	16,920,682.67			

收到的其他与经营经营活动有关的现金	462,172.49	16,668,454.49	9,602,393.95	4,367,267.78
现金流入小计	138,389,197.39	198,401,049.76	96,084,621.77	15,359,118.82
购买商品、接受劳务支付的现金	36,978,547.08	84,593,899.14	61,057,427.74	6,988,385.13
支付给职工以及为职工支付的现金	5,852,916.44	8,785,212.52	7,329,722.66	3,459,724.73
支付的各项税费	18,978,927.46	38,330,697.48	1,600,552.65	883,858.53
支付的其他与经营活动有关的现金	10,003,432.40	19,508,121.85	10,051,688.13	4,832,410.95
现金流出小计	71,813,823.38	151,217,930.99	80,039,391.18	16,164,379.34
经营活动产生的现金流量净额	66,575,374.01	47,183,118.77	16,045,230.59	-805,260.52
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益所收到的现金	-	20,484,300.00	-	-
现金流入小计	-	20,484,300.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	585,341.33	24,185,492.61	854,364.32	66,768.24
投资支付的现金		1,000,000.00	-	-
现金流出小计	585,341.33	25,185,492.61	854,364.32	66,768.24
投资活动产生的现金流量净额	-585,341.33	-4,701,192.61	-854,364.32	-66,768.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			700,635.25	7,050,618.77
借款所收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,423,832.50		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流出小计	50,423,832.50	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-35,423,832.50	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：	-4,356.58	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：	30,561,843.60	57,481,926.16	15,891,501.52	6,178,590.01

加：期初现金及现金等价物余额	82,146,611.86	24,664,685.70	8,773,184.18	2,594,594.17
六、期末现金及现金等价物余额	112,708,455.46	82,146,611.86	24,664,685.70	8,773,184.18

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2010年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	19,846,772.86	-	941,357.62	8,472,218.62	89,260,349.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	60,000,000.00	19,846,772.86	-	941,357.62	8,472,218.62	89,260,349.10
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					48,426,265.13	48,426,265.13
(一) 净利润					48,426,265.13	48,426,265.13
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					48,426,265.13	48,426,265.13
(三) 所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配						
3、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
(六) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年年末余额	60,000,000.00	19,846,772.86		941,357.62	56,898,483.75	137,686,614.23

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2009 年度					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,950,000.00	17,243,188.03	-	1,528,971.13	13,760,740.12	39,482,899.28
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	6,950,000.00	17,243,188.03	-	1,528,971.13	13,760,740.12	39,482,899.28
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	53,050,000.00	2,603,584.83	-	-587,613.51	-5,288,521.50	49,777,449.82
(一) 净利润					84,777,449.82	84,777,449.82
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	84,777,449.82	84,777,449.82
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本		-				-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
(四) 利润分配				8,477,744.98	-43,477,744.98	-35,000,000.00
1、提取盈余公积				8,477,744.98	-8,477,744.98	-
2、对所有者(或股东)的分配					-35,000,000.00	-35,000,000.00
3、其他						-
(五) 所有者权益内部结转	53,050,000.00	2,603,584.83	-	-9,065,358.49	-46,588,226.34	-
1、资本公积转增资本(或股本)		-				-
2、盈余公积转增资本(或股本)	9,065,358.49			-9,065,358.49		-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他	43,984,641.51	2,603,584.83			-46,588,226.34	-
(六) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年年末余额	60,000,000.00	19,846,772.86	-	941,357.62	8,472,218.62	89,260,349.10

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2008 年度					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,250,000.00	17,242,552.78	-	64,479.19	580,312.69	24,137,344.66
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	6,250,000.00	17,242,552.78	-	64,479.19	580,312.69	24,137,344.66
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	700,000.00	635.25	-	1,464,491.94	13,180,427.43	15,345,554.62
（一）净利润					14,644,919.37	14,644,919.37
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小 计					14,644,919.37	14,644,919.37
（三）所有者投入和减 少资本	700,000.00	635.25				700,635.25
1、所有者投入资本	700,000.00	635.25				700,635.25
2、股份支付计入所有者 权益的金额						-
3、其他						-
（四）利润分配				1,464,491.94	-1,464,491.94	-
1、提取盈余公积				1,464,491.94	-1,464,491.94	-
2、对所有者（或股东） 的分配						-
3、其他						-
（五）所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本 （或股本）						
2、盈余公积转增资本 （或股本）						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他						-
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年年末余额	6,950,000.00	17,243,188.03	-	1,528,971.13	13,760,740.12	39,482,899.28

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2007 年度					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	3,500,000.00	7,251,340.00			-512,449.10	10,238,890.90
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	3,500,000.00	7,251,340.00		-	-512,449.10	10,238,890.90
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	2,750,000.00	9,991,212.78		64,479.19	1,092,761.79	13,898,453.76
（一）净利润					1,157,240.98	1,157,240.98
（二）直接计入所有者权益的利 得和损失	-	-		-	-	-
（二）其他综合收益		5,690,594.01				5,690,594.01
上述（一）和（二）小计	-	5,690,594.01		-	1,157,240.98	6,847,834.99
（三）所有者投入和减少资本	2,750,000.00	4,300,618.77		-	-	7,050,618.77
1、所有者投入资本	2,750,000.00	4,300,618.77				7,050,618.77
2、股份支付计入所有者权益的 金额						-
3、其他						-
（四）利润分配				64,479.19	-64,479.19	-
1、提取盈余公积				64,479.19	-64,479.19	-
2、对所有者（或股东）的分配						-
3、其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）		-				-
2、盈余公积转增资本（或股本）						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他					-	-
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年年末余额	6,250,000.00	17,242,552.78		64,479.19	580,312.69	24,137,344.66

二、 审计意见

兴华事务所对公司近三年一期财务报表进行了审计，并出具了（2010）京会兴审字第 1-134 号无保留意见的审计报告。

三、 财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 报告期内合并报表范围及其变化

报告期内合并报表范围如下：

子公司全称	注册地	合并日期	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	取得方式
北京君正集成电路（香港）集团有限公司	香港	2007 年 12 月 31 日	集成电路 开发、销售	1 万港币	100%	100%	同一控制下企业合并
深圳君正时代集成电路有限公司	深圳	2009 年 4 月 14 日	集成电路 开发、销售	100 万元	100%	100%	新设

1、 同一控制下企业合并取得的子公司

香港君正集团的历史沿革如招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、 发行人控股、参股公司情况”之“（一）北京君正集成电路（香港）集团有限公司”所述。香港君正集团股东和董事（法人董事）于 2007 年 12 月 31 日变更为君正有限，在编制本次申报报表时作为同一控制下的企业合并进行会计处理，合并日确定为 2007 年 12 月 31 日，申报报表对比期间的财务数据进行了追溯调整。

2、其他方式取得的子公司

深圳君正时代集成电路有限公司由本公司全资设立于 2009 年 4 月 14 日，自成立之日起纳入本公司合并财务报表。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入的确认原则和计量方法

1、本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
- （2）不再保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- （3）收入的金额能够可靠地计量。
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司。
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入：

（1）在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确定提供劳务交易的完工进度时选用下列方法：

- ①已完工作的测量；
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

（2）在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权：公司预计相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（二）存货的核算方法

1、存货包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

2、存货取得和发出的计价方法：存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计算主要采用品种法；低值易耗品的摊销主要采用一次摊销法。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：领用时一次摊销法。

4、存货的盘存制度：永续盘存制。

5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

本公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则本公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）长期股权投资的核算方法

1、初始投资成本确定

（1）本公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为合并而发生的各项直接相关费用之和作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为当期损益。

（2）本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

①以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款（包括直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2、后续计量及损益确认方法

（1）本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资母公司个别财务报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并财务报表范围。

（2）本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算。

（3）本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算。

（4）本公司对不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产

减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

3、确认对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于期末对长期股权投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况发生变化等原因导致长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项长期股权投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期股权投资减值准备，确认资产减值损失。除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，长期股权投资减值损失一经确认，在以后的会计期间不予转回。

（四）固定资产的核算方法

1、固定资产的确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，本公司予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。

3、固定资产的折旧方法：年限平均法。

4、各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	折旧率
房屋建筑物	25-45年	5%	2.11%~3.80%
机器设备	8-12年	5%	7.92%~11.88%
运输设备	5-10年	5%	9.50%~19.00%
电子设备	5年	5%	19.00%
其他设备	5年	5%	19.00%

5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失，将固定资产的账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

- （1）固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （3）固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被

闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响。

（4）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（5）同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低。

（6）企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额。

（7）其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不予转回。

6、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在租赁开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产折旧。

（五）无形资产的核算方法

1、无形资产的计价方法

本公司对无形资产按照成本进行初始计量，具体方法如下：

（1）购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，且实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）自行开发的无形资产的成本，按满足资本化条件的时点至达到预定用途前发生的支出总额确定，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

（3）投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定确定。

2、本公司对内部研究开发无形资产的计量原则和会计处理如下：

（1）本公司将企业内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段而发生的支出。

（2）本公司对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，不同时满足下列条件的确认为损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用

性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（3）本公司对于研究开发活动发生的支出应单独核算，如发生的研究开发人员的工资、材料费等，在公司同时从事多项研究开发活动的情况下，所发生的支出同时用于支持多项研究开发活动的，应按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配，无法明确分配的，应予费用化计入当期损益，不计入开发活动的成本。

3、本公司对无形资产使用寿命的估计情况如下：

本公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，认定其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对合同或法律没有规定使用寿命的无形资产，通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。本公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

（3）以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；

（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

（5）为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

（7）与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将其视为使用寿命不确定的无形资产。

4、本公司对使用寿命有限的无形资产自其可供使用时起至不再作为无形资产确认时止在无形资产使用寿命内采用直线法摊销。即按预计使用年限、合同规

定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司对已提减值准备的无形资产计算应摊销金额时，还需扣除该无形资产已计提的减值准备累计金额；对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销，但在每个会计期末，对该部分无形资产的使用寿命进行复核，如使用寿命仍不能确定，则对其进行减值测试。

5、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。

（1）已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

（3）已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明实际上已经发生减值的情形；

除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不予转回。

（六）金融工具

1、金融工具分为金融资产和金融负债

本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求，将金融资产在初始确认时划分为下列四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（2）其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）金融工具的确认依据

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一时，本公司对其终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融工具的计量方法

①本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量（对外销售商品或提供劳务形成的债权通常按从购买方应收的合同或协议价款进行计量）。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②除下列情况外，本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：A、持有至到期投资，按摊余成本计量；B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

除下列情况外，本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

③金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；C、外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。

④本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

⑤本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

本公司将尚未到期的持有至到期投资金融资产重分类为可供出售金融资产的依据如下：A、持有该金融资产的期限不确定；B、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；C、该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；D、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；E、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期；F、其他表明公司没有能力将尚未到期的金融资产投资持有至到期的情况。

3、金融资产转移的确认和计量

(1) 金融资产转移的确认标准：①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并

承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：A、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。B、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。C、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合同约定进行再投资的，将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

（2）金融资产转移的计量：本公司按《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移：①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

5、主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法如下：（1）存在活跃

市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；（3）初始取得或原生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据主要包括：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- （7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- （9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单独测试未发生减值的单项金额重大的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；对已单项确认减值损失的金融资产，则不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司对原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，本公司对原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

（七）应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）单独进行减值测试，在有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

（1）信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为账龄在 3 年以上的应收款项。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试和账龄分析法相结合。

3、对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后不存在减值的单项金额重大的应收款项一起，先依各应收款项的账龄分成若干组合，再按一定的比例计提各组合的坏账准备。

4、应收款项坏账损失的核算方法：备抵法。

本公司根据以往年度应收款项的实际坏账情况，并结合对主要债务单位的信用评估及其他相关信息的分析情况，确定各账龄段的应收款项组合的具体坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款	其他应收款
6个月以内	0%	5%
7至12个月	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	80%	80%
4年以上	100%	100%

此外，对具有确凿证据表明能够收回或不能收回的应收款项单独计提其坏账准备。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务的核算方法

发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折合成记账本位币记账。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因结算或采用资产负债表日即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

2、外币财务报表折算方法

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用外币交易发生时的即期汇率进行折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表的“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目中单独列报。

（九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化的开始：本公司对同时满足以下三个条件的借款费用，开始资本化：

（1）资产支出（资产支出包括为购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。

3、资本化期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

4、借款费用资本化的暂停和停止：本公司对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是使所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进

行。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

5、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，本公司对每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十）所得税、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时

性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（十一）政府补助

1、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

2、与资产相关的政府补助，分别下列情况处理：

公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。对其他与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，按照收到或应收的金额计量，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、政府补助的返还：本公司已确认的政府补助需要返还的，分别两种情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十二）合并财务报表的合并范围和编制方法

1、合并财务报表的合并范围

本公司将下列被投资单位认定为子公司，纳入合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

(1) 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权。

(2) 公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，且满足下列条件之一的：

①通过与被投资单位其他投资者之间的协议拥有被投资单位半数以上表决权；

②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。即以合并期间母公司和纳入合并范围的控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。

在编制合并财务报表时将母、子公司之间的投资、集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销，并计算少数所有者权益（损益）。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

（十三）会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

1、会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项发生。

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项发生。

3、会计差错更正

本公司报告期内无会计差错更正事项发生。

五、税项情况

1、本公司主要适用的税种和税率：

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	17%、3%
营业税	应税营业收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	0%~25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税字[2000]25号）规定：“自2000年6月24日至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”本公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，经北京市海淀区国家税务局第九税务所审核批准（档案号：0166873），本公司从2009年12月1日起，享受该即征即退的增值税税收优惠政策。

（2）企业所得税

根据国务院批准并由北京市人民政府颁发的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》以及国税函[2002]182号《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函》，对北京市新技术产业开发试验区内的新技术企业，减按15%税率征收所得税，新技术企业自开办之日起，3年

内免征所得税，经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按15%税率减半征收所得税。公司为试验区的新技术企业，2005年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，经北京市海淀区国家税务局核定，公司2007年免征企业所得税。

公司于2008年办理高新技术企业重新认定工作，但没有能在2008年度汇算清缴前完成认定手续。因此，税务机关暂停执行对发行人的税收优惠政策，当年未获得免税优惠政策。

公司于2009年10月20日经重新认定为高新技术企业，并且尚处于原《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》规定的3年按15%税率减半征收企业所得税的优惠期，根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）第二条：“原依法享受企业所得税定期减免税优惠尚未期满同时符合本通知第一条规定条件的高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》以及《科学技术部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火[2008]362号）的相关规定，在按照新标准取得认定机构颁发的高新技术企业资格证书之后，可以在2008年1月1日后，享受对尚未到期的定期减免税优惠执行到期满的过渡政策”，公司2009年度按15%税率减半征收企业所得税，执行7.5%所得税税率。该税收优惠已经北京市海淀区国家税务局第九税务所海国税201009JMS1600003号文备案。

经核查，保荐机构、申报会计师认为：公司享受上述优惠有国家税收法规作为依据，合法有效。

六、主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
流动比率（倍）	6.49	2.41	2.68	5.73
速动比率（倍）	5.70	1.93	1.99	4.30

资产负债率（%，合并）	16.61	42.97	37.92	16.86
资产负债率（%，母公司）	25.99	47.68	41.40	2.18
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.59	1.76	10.19	3.81
财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率（次）	34.36	255.50	216.98	509.80
存货周转率（次）	1.59	2.40	3.94	5.40
息税折旧摊销前利润（元）	55,416,252.19	79,949,560.24	57,069,348.38	6,146,747.40
归属于母公司股东的净利润（元）	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	48,915,336.15	67,791,648.20	46,207,122.14	1,151,990.96
利息保障倍数（倍）	130.13	不适用	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.9771	0.9245	0.7911	-0.0251
每股净现金流量（元/股）	0.3753	0.7693	0.7658	0.1003

注：上述财务指标的计算方法如下

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息费用+资本化利息支出）/（利息费用+资本化利息支出）

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/发行在外的普通股加权平均数

每股净现金流量=现金流量净额/发行在外的普通股加权平均数

归属于发行人股东的每股净资产=期末净资产/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

1、净资产收益率

报告期利润	全面摊薄净资产收益率				加权平均净资产收益率			
	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
归属于发行人普通股股东的净利润	32.10%	66.13%	65.13%	21.33%	38.21%	69.93%	98.10%	35.39%

扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润	31.45%	64.15%	65.24%	4.84%	37.44%	67.83%	98.26%	8.04%
--------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------

2、每股收益

报告期利润	基本每股收益（元/股）				稀释每股收益（元/股）			
	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.8320	1.1649	0.8317	0.1542	0.8320	1.1649	0.8317	0.1542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.8153	1.1299	0.8330	0.0350	0.8153	1.1299	0.8330	0.0350

注：上述数据计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率= $P \div E$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，E为归属于公司普通股股东的期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

七、资产评估情况

北京中科华资产评估有限公司（以下简称“北京中科华”）对君正有限整体变更为股份有限公司时所涉及的全部资产和负债进行了评估，并出具了中科华评报字[2009]第P109号资产评估报告，评估基准日为2009年10月31日。

1、评估原则、评估程序和评估方法

根据国家资产评估的有关法规及资产评估惯例，北京中科华遵循国家及行业规定的公认原则，独立性、科学性、公正性、客观性的工作原则，产权利益主体变动原则，资产持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等操作原则。

在评估过程中，北京中科华对指定评估范围内的资产和负债进行了必要的评估和产权核实，对相关的法律性文件、财务记录等相关资料进行了必要的验证审核，实施了必要的资产评估程序。

评估采用的基本方法为成本法。

2、评估结果

经评估，截至 2009 年 10 月 31 日，在持续使用前提下，君正有限所涉及的净资产经评估为 10,676.95 万元。

上述评估值仅作为整体变更为股份有限公司时参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

八、历次验资情况

（一）2005 年 7 月君正有限成立时的验资情况

公司前身君正有限设立时注册资本为 500 万元。其中，设立时以货币方式出资 50 万元，剩余出资在两期内以每期 225 万元等额缴付，一期出资的缴款期为半年，二期出资的缴款期为三年。

2005 年 7 月 15 日，刘强、洗永辉、张紧、李杰和刘军分别向君正有限开立于中国农业银行北京市分行的注册资本（金）专用帐户缴付货币出资 22 万元、7 万元、7 万元、7 万元和 7 万元，中国农业银行北京市分行向该等自然人出具了《交存入资资金凭证》。根据北京市工商局 2004 年 2 月 15 日颁布的《北京市改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第十三条规定“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”，因此君正有限设立时缴付的货币出资未进行验资。

针对该部分出资，兴华事务所于 2010 年 2 月 2 日出具了（2010）京会兴核字第 1-25 号《关于北京君正集成电路股份有限公司 2005 年 7 月设立时注册资本实收情况的专项复核报告》专项复核报告，认为截至 2005 年 7 月 15 日，君正有限已足额收到各股东认购的注册资本合计人民币 500,000.00 元。

（二）2006 年 1 月一期出资的验资情况

2006 年 1 月 25 日，北京中泽永诚会计师事务所有限公司对君正有限一期出资情况进行了审验，并出具了中泽永诚验字[2006]第 006 号《验资报告》。经验证，截至 2006 年 1 月 25 日，君正有限已收到股东刘强、李杰、刘军、张紧和洗永辉和分别出资的 99 万元、31.5 万元、31.5 万元、31.5 万元和 31.5 万元，共计 225 万元，均为货币出资。

（三）2006 年 4 月新增注册资本的验资情况

2006 年 4 月 13 日，北京中泽永诚会计师事务所有限公司对君正有限新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中泽永诚验字（2006）第 020 号《验资报告》。经验证，君正有限新增注册资本 125 万元，由股东盈富泰克分两期缴付，其中首期应于 2006 年 4 月 6 日前向君正有限缴付 75 万元。截至 2006 年 4 月 6 日，君正有限已收到盈富泰克缴纳的第一期注册资本 75 万元，出资方式为货币。

（四）2007 年 11 月二期出资的验资情况

2007 年 11 月 27 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司对君正有限二期出资情况进行了审验，并出具了京仲变验字[2007]1127J-M 号《验资报告》。经验证，截至 2007 年 11 月 27 日，君正有限已收到股东刘强、李杰、张紧、洗永辉和盈富泰克分别缴付的出资 130.5 万元、31.5 万元、31.5 万元、31.5 万元和 50 万元，共计 275 万元，完成了章程规定的二期出资。

（五）2008 年 9 月注册资本增加到 695 万元的验资情况

2008 年 9 月 17 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司对君正有限新增注册

资本的实收情况进行了审验，并出具了京仲变验字[2008]0818Z-G号《变更登记验资报告》。经验证，截至2008年9月17日，君正有限已收到新增注册资本（实收资本）70万元，其中姜君出资10.5万元、韦建利出资8.75万元、刘飞出资8.75万元、于万洲出资8.75万元、许志鹏出资8.75万元、晏晓京出资8.75万元、张燕祥出资7.875万元、张敏出资7.875万元，以上出资方式均为货币。

（六）2009年12月整体变更为股份有限公司时的验资情况

2009年12月18日，兴华事务所对公司整体变更为股份有限公司时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了（2009）京会兴验字第1-23号《验资报告》。经验证，截至2009年12月18日，北京君正已收到各发起人股东投入的资本。

九、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本招股说明书签署之日，本公司报告期内无需披露的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

十、财务状况分析

（一）资产构成分析

1、报告期内，公司资产构成情况如下：

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (元)	占总资产 比例 (%)	金额 (元)	占总资产 比例 (%)	金额 (元)	占总资产 比例 (%)	金额 (元)	占总资产 比例 (%)
货币资金	123,663,358.34	66.30	101,145,519.60	54.58	54,987,314.01	48.20	9,038,818.45	31.59
应收账款	6,273,789.69	3.36	281,397.88	0.15	1,213,983.33	1.06	117,900.00	0.40
预付款项	31,238,857.18	16.75	44,479,823.50	24.00	24,652,906.00	21.61	9,771,598.81	34.16
其他应收款	1,071,242.51	0.57	676,949.52	0.37	2,057,559.41	1.80	1,829,007.70	6.39
存货	22,704,314.25	12.17	36,533,979.53	19.71	29,068,814.18	25.48	6,882,856.72	24.06
流动资产合计	184,951,561.97	99.15	183,117,670.03	98.81	111,980,576.93	98.15	27,640,181.68	96.60
固定资产	1,471,516.88	0.79	1,443,004.85	0.78	1,462,741.88	1.28	917,394.19	3.21

递延所得税资产	106,449.24	0.06	751,961.90	0.41	642,729.94	0.57	52,700.43	0.19
非流动资产合计	1,577,966.12	0.85	2,194,966.75	1.19	2,105,471.82	1.85	970,094.62	3.40
总资产	186,529,528.09	100.00	185,312,636.78	100.00	114,086,048.75	100.00	28,610,276.30	100.00

公司资产构成情况呈现以下特征：

（1）总体结构保持稳定

报告期内，公司主要资产为流动资产。2007年末、2008年末、2009年末及2010年6月30日货币资金、预付账款及存货等三项流动资产合计余额分别占当年末资产总额的89.81%、95.29%、98.29%、95.22%，说明公司报告期内经营稳健，资产质量较高，财务状况良好。

（2）公司资本实力迅速增强

报告期内，资产总额迅速扩张。尤其是2008年末、2009年末公司资产总额分别较上年同期增长298.76%、62.43%，主要由于公司产品性价比突出、市场需求旺盛，公司盈利能力较强，因此公司资产总额快速扩张，资本实力迅速增强；2010年6月30日资产总额较上年末增长0.66%，增速放缓，主要是因为2010年上半年支付上年末应付股利，因此降低了2010年6月30日资产规模。

（3）资产流动性强

作为集成电路设计企业，公司Fabless运营模式无需生产设备及厂房的大额投入，因此流动资产占比较高。报告期内，各年末流动资产占总资产比例均保持在90%以上，2009年末达到了98.81%，2010年6月30日达到了99.15%，公司资产流动性较强。

综上所述，公司的资产构成与Fabless经营模式相适应，符合目前产销规模需要。

2、流动资产分析

（1）货币资金

报告期内，公司货币资金情况如下：

项 目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
货币资金（元）	123,663,358.34	101,145,519.60	54,987,314.01	9,038,818.44

占总资产比例（%）	66.30	54.58	48.20	31.59
-----------	-------	-------	-------	-------

2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月30日公司货币资金分别为9,038,818.44元、54,987,314.01元、101,145,519.60元和123,663,358.34元，分别占当年末资产总额的31.59%、48.20%、54.58%和66.30%。公司货币资金主要来源于经营活动，说明公司盈利能力及盈利质量较高。

报告期内，公司各年（期）末保留的货币资金占比较高，主要因为：①公司嵌入式CPU芯片产品研发周期长、风险较大以及公司销售规模扩大带来相应较大的投片和备货支出均需要较大的资金支持；②集成电路设计企业作为轻资产型企业，融资渠道有限，公司需要较大的资金储备以备临时支付。

（2）应收账款

①报告期内，公司应收账款情况如下：

项 目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应收账款（元）	6,273,789.69	281,397.88	1,213,983.33	117,900.00
占同期末总资产比例（%）	3.36	0.15	1.06	0.40
占同期营业收入比例（%）	5.56	0.15	0.84	0.34

公司CPU芯片产品销路较好，对客户信用严格管理，因此应收账款余额保持在较低水平。2007年末、2008年末、2009年末及2010年6月30日公司应收账款占当年营业收入的比例分别为0.34%、0.84%、0.15%和5.56%。

②2010年6月30日应收账款绝大部分为正常收款期内的应收账款，其中账龄在6个月以内的应收账款比例为99.92%，主要情况如下：

单位：元

项 目	账面余额	比例（%）	已计提坏账准备	账面价值
6个月以内	6,270,289.69	99.92%		6,270,289.69
7-12个月				
1-2年				
2-3年	5,000.00	0.08%	1,500.00	3,500.00
3-4年				
4年以上				
合 计	6,275,289.69	100.00%	1,500.00	6,273,789.69

③2010年6月30日应收账款前五名客户情况分析

客户名称	应收账款情况	
	余额（元）	占全部应收账款比例（%）
东莞市步步高教育电子产品有限公司	3,289,274.59	52.41%
深圳市华辉进出口贸易有限公司	1,924,560.92	30.67%
深圳市赛凡半导体有限公司	830,684.56	13.24%
深圳市汇科盛数码科技有限公司	177,486.28	2.83%
东莞艾利博电子有限公司	46,239.60	0.74%
合计	6,268,245.95	99.89%

公司应收账款质量较好，并与公司的实际情况相符，有利于公司业务的发展，现有应收账款规模不会对公司持续经营造成影响。

(3) 预付款项

①报告期内，公司预付款项情况如下：

单位：元

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
预付款项	31,238,857.18	44,479,823.50	24,652,906.00	9,771,598.81

2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月30日公司预付款项余额分别为9,771,598.81元，24,652,906.00元，44,479,823.50元和31,238,857.18元，主要为预付委托加工费和土地开发费。

2008年末预付款项余额较2007年末增加1,488.13万元，同比增长152.29%，主要原因是CPU芯片产品生产周期为2-3个月，随着生产规模的急剧扩张，为保证生产以及满足客户供货和备货的需求，公司相应增加了对委托加工供应商的预付款项。随着公司信用度的提升，公司预付账款逐年下降。

2009年末预付款项余额较2008年末增加1,982.69万元，同比增长80.42%，主要原因是公司预付了2,386.16万元土地开发费。2009年9月28日，君正有限与北京中关村软件园发展有限责任公司签订了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定由该公司对位于中关村软件园二期（西扩）项目起步区J-2号地块进行一级开发，君正有限承担土地开发费26,512,920.00元（不包含土地出让金），分三期支付，目前公司已经支付前两期费用共计23,861,628.00元。

公司 2010 年 6 月 30 日预付款项余额较上年末余额减少，主要是因为随着公司生产规模扩大以及公司过往的采购信用记录较好，公司获得的供应商信用额度增长，相应可减少预付款项。

②报告期内，公司预付账款绝大部分为一年以内的款项，账龄情况如下：

账龄	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1年以内	31,238,857.18	100.00	44,430,034.63	99.89	24,591,494.53	99.75	9,717,188.27	99.44
1至2年			225.33	0.00	61,411.47	0.25	54,410.54	0.56
2至3年			49,563.54	0.11	-	-	-	-
3年以上			-	-	-	-	-	-
合计	31,238,857.18	100.00	44,479,823.50	100.00	24,652,906.00	100.00	9,771,598.81	100.00

③2010年6月30日公司预付款项前五名客户情况分析

单位名称	与本公司关系	金额（元）	款项性质
北京中关村软件园发展有限公司	非关联方	24,089,633.28	预付土地款及房租
中芯国际集成电路制造有限公司	供应商	3,567,054.32	预付货款
安靠封装测试（上海）有限公司	供应商	2,978,227.49	预付货款
泰克科技（中国）有限公司	供应商	268,094.74	预付货款
万达杰诚国际物流（北京）有限公司	供应商	188,845.07	预付设备款
合计		31,091,854.90	

(4) 其他应收款

①报告期内，公司其他应收款情况如下：

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
其他应收款余额（元）	1,071,242.51	676,949.52	2,057,559.41	1,829,007.70
占总资产比例（%）	0.57	0.37	1.80	6.39

其他应收款主要为租赁押金、员工借款及关联方暂借款等款项。

2007年末、2008年末应收南山高科暂借款余额分别为45.00万元及145.00万元。该等款项已于2009年收回，对公司财务状况没有影响。有关内容详见本招股说明书“第六节、同业竞争和关联交易”之“三、关联交易”之“(二)报

告期偶发性关联交易事项”。

②2010年6月30日公司其他应收款主要为1年以内的款项，相关账龄情况如下表：

单位：元

账龄	2010年6月30日				
	金额	比例	计提比例	坏账准备	净额
1年以内	797,002.71	69.54%	5%	39,850.14	757,152.57
1至2年	348,507.92	30.41%	10%	34,850.79	313,657.13
2至3年	618.30	0.05%	30%	185.49	432.81
3至4年			80%		
4年以上			100%		
合计	1,146,128.93	100.00%		74,886.42	1,071,242.51

③公司2010年6月30日其他应收款前五名客户情况分析

单位名称	与本公司关系	欠款金额（元）	占其他应收款总额比例	性质或内容
广州奥熠电子科技有限公司	非关联关系	500,000.00	43.63%	保证金
北京中关村软件园发展有限公司	非关联关系	342,007.92	29.84%	押金
北京优普达科技有限公司	非关联关系	95,000.00	8.29%	订金
北京首欣物业管理有限责任公司	非关联关系	74,726.39	6.52%	保证金
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	非关联关系	68,004.00	5.93%	押金
合计	-	1,079,738.31	94.21%	-

(5) 存货

①报告期内，公司存货情况如下：

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
存货余额（元）	22,704,314.25	36,533,979.53	29,068,814.18	6,882,856.72
占总资产比例（%）	12.17	19.71	25.48	24.06

公司存货余额随着公司经营规模的扩大而相应增长，2007年末、2008年末、2009年末及2010年6月30日公司存货余额占总资产余额的比例分别为24.06%、

25.48%、19.71%及 12.17%。

2008 年末存货余额较 2007 年末余额增长 2,218.60 万元，主要是由于下游客户受全球金融危机影响，控制提货进度所致；2009 年末存货余额较 2008 年末增长 746.52 万元，主要是由于公司销售规模扩张，市场规模增长迅速，而芯片产品的生产周期一般需要 2-3 个月，为满足及时向客户供货和备货要求，公司需要保持较高的存货水平。

与最近两年末相比，公司 2010 年 6 月 30 日存货余额略有减少，主要是由于暑假为便携教育电子销售高峰，而终端客户一般提前一个月提货以备其生产，因此公司 2010 年 6 月 30 日存货规模相对下降。

②2010 年 6 月 30 日公司存货构成情况如下：

项 目		账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	金额（元）	526,282.97	-	526,282.97
	比例（%）	2.32	-	2.32
在产品	金额（元）	11,570,825.64	-	11,570,825.64
	比例（%）	50.96	-	50.96
库存商品	金额（元）	10,607,205.64		10,607,205.64
	比例（%）	46.72		46.72
合 计	金额（元）	22,704,314.25		22,704,314.25
	比例（%）	100.00		100.00

2、非流动资产分析

公司非流动资产主要为固定资产，即与公司经营活动密切相关的电子设备及运输设备。

（1）固定资产

①报告期内，公司固定资产情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
固定资产净额（元）	1,471,516.88	1,443,004.85	1,462,741.88	917,394.19
占总资产比例（%）	0.79	0.78	1.28	3.21

报告期内，公司固定资产余额在资产总额占比较低，主要是因为公司采用具有“轻资产”特点的 Fabless 运营模式，自身不直接从事 CPU 芯片产品的生产，

无需购置生产设备等固定资产。此外，公司目前主要经营场地采用租赁方式解决，节约了资本支出。

②2010年6月30日公司固定资产具体情况如下：

固定资产	原值（元）	占比（%）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
运输工具	769,966.69	25.22%	222,220.44	547,746.25	71.14%
电子设备及其他	2,283,194.96	74.78%	1,359,424.33	923,770.63	40.46%
合计	3,053,161.65	100.00	1,581,644.77	1,471,516.88	48.20%

3、资产质量分析

公司资产质量良好，报告期内公司资产减值准备主要为根据账龄分析计提的坏账准备，具体情况如下：

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应收账款坏账准备（元）	1,500.00	6,900.00	2,400.00	800.00
其他应收款坏账准备（元）	74,886.42	53,734.09	193,390.32	153,892.77
坏账准备（元）	76,386.42	60,634.09	195,790.32	154,692.77
占总资产比率（%）	0.04	0.03	0.17	0.54

报告期内，公司坏账准备余额与总资产相比比率极小，不对公司正常生产经营活动产生影响。

公司已严格按照会计政策规定的计提原则及比例进行资产减值准备的计提，计提情况与资产状况相符，不存在因资产减值准备计提不足而影响公司持续经营能力的情形。

（二）负债构成总体分析

1、报告期内，公司负债构成情况如下：

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 （元）	占负债总额 比例（%）	金额 （元）	占负债总额 比例（%）	金额 （元）	占负债总额 比例（%）	金额 （元）	占负债总额 比例（%）
短期借款	15,000,000.00	48.41	15,000,000.00	18.84	-	-	-	-
应付账款	8,789,928.83	28.37	18,457,902.75	23.18	6,569,489.51	15.19	73,067.55	1.51

预收账款	622,758.10	2.01	3,746,779.06	4.71	21,143,367.07	48.88	3,147,793.43	65.25
应付职工薪酬	349,574.06	1.13	1,344,542.82	1.69	185,268.78	0.42	57,048.22	1.18
应交税费	3,163,819.81	10.21	1,035,287.70	1.30	12,427,505.81	28.73	1,177,934.91	24.42
应付股利	-		35,000,000.00	43.94	-	-	-	
其他应付款	561,263.36	1.81	1,545,652.04	1.94	1,431,748.15	3.31	368,544.80	7.64
流动负债合计	28,487,344.16	91.93	76,130,164.37	95.60	41,757,379.32	96.53	4,824,388.91	100.00
其他非流动负债	2,500,000.00	8.07	3,500,000.00	4.40	1,500,000.00	3.47	-	-
非流动负债合计	2,500,000.00	8.07	3,500,000.00	4.40	1,500,000.00	3.47	-	-
负债总额	30,987,344.16	100.00	79,630,164.37	100.00	43,257,379.32	100.00	4,824,388.91	100.00

报告期内，公司主要负债为流动负债。其中，应付账款、预收账款及应交税费三项负债合计余额分别占 2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月 30 日负债总额的 91.18%、92.80%、29.19%及 40.59%。

2、主要负债分析

（1）短期借款

公司短期借款情况如下：

单位：元

项 目	短期借款	
	2010 年 6 月 30 日	年利率（%）
担保借款	15,000,000.00	4.86%

短期借款期限由 2010 年 6 月 23 日至 2010 年 12 月 23 日，由刘强提供无限连带责任担保。

（2）应付账款

①报告期内，公司应付账款情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
应付账款（元）	8,789,928.83	18,457,902.75	6,569,489.51	73,067.55
占负债总额比例（%）	28.37	23.18	15.19	1.51

2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月 30 日，公司应付账款余额分别为 7.31 万元、656.95 万元、1,845.79 万元和 878.99 万元。应付账款自 2007

年至 2009 年逐年上升主要是因为随着公司规模扩大及与委外加工商合作关系的深入，公司获得了较长的结算周期及较大的信用额度。2010 年 6 月 30 日应付账款余额较 2009 年 12 月 31 日下降主要是因为公司及时结算货款所致。

②2010 年 6 月 30 日，公司应付账款主要为一年以内的款项，具体情况如下：

账 龄	金额（元）	占应付账款比例（%）
1 年以内	8,789,928.83	100.00
1 年以上	-	-
合 计	8,789,928.83	100.00

（3）预收账款

①报告期内，公司预收账款余额情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
预收账款	622,758.10	3,746,779.06	21,143,367.07	3,147,793.43
占负债总额比例（%）	2.01	4.71	48.88	65.25

报告期内，公司预收账款余额基本保持稳定，主要是规模较小的无账期客户预付的采购款。

2008 年末预收账款余额较大，主要是由于客户受全球金融危机影响，未及时提货所致。

②2010 年 6 月 30 日公司预收账款均为正常预收款项，具体情况如下：

账 龄	金额（元）	占预收账款比例（%）
1 年以内	622,758.10	100.00
1 年以上	-	-
合 计	622,758.10	100.00

（4）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	349,574.06	1,344,542.82	185,268.78	57,048.22

2009 年末应付职工薪酬余额主要为预提的年终奖，2010 年 6 月 30 日应付职工薪酬余额为工会经费和职工教育经费，无属于拖欠性质的款项。

（5）应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
营业税		-	-	12,500.00
企业所得税	794,121.16	-653,610.57	12,166,296.00	1,132,931.12
增值税	2,062,950.31	1,473,939.97	191,415.10	10,634.92
城市维护建设税	154,062.57	103,154.84	13,509.14	1,549.62
个人所得税	86,657.45	67,585.25	50,212.89	19,585.45
教育费附加	66,028.32	44,218.21	6,072.68	733.80
合 计	3,163,819.81	1,035,287.70	12,427,505.81	1,177,934.91

2007 末、2008 年末、2009 年末与 2010 年 6 月 30 日，公司应交税费余额分别为 117.79 万元、1,242.75 万元、103.53 万元和 316.38 万元。

2008 年末余额较 2007 年末大幅增长的原因是公司 2007 年享受免征企业所得税税收优惠，2008 年各季度仍按免征企业所得税申报企业所得税，而年终汇算清缴时根据税务机关要求改按 25% 的税率汇算清缴，因此 2008 年末预提 398.46 万元所得税。其他余额为香港君正集团 2008 年尚未缴纳的利得税。

2009 年 10 月 20 日公司获得“高新技术企业”资格，根据北京市人民政府颁发的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》以及国家税务总局颁发的国税函[2002]182 号《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函》的规定，公司 2009 年适用 7.5% 的所得税税率，而此前公司各季度已按 25% 税率预缴企业所得税，导致 2009 年 12 月 31 日应交企业所得税余额为负。

（6）其他应付款

①报告期内，公司其他应付款情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
-----	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

其他应付款（元）	561,263.36	1,545,652.04	1,431,748.15	368,544.80
占负债总额比例（%）	1.81	1.94	3.31	7.64

其他应付款为暂收的经销押金、代收款以及代扣代缴款，占负债总额比率较小。2009年其他应付款主要是应付刘强的款项，系公司代收的中关村科技园区管理委员会根据《中关村高端领军人才聚集工程方案》（京发[2008]28号）开展的2009年第二批中关村高端领军人才评定活动支付给刘强的高端领军人才奖励款100万元，该款项已于2010年全部支付。

②2010年6月30日公司其他应付款的具体情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	性质
深圳市赛凡半导体有限公司	500,000.00	1年以内	经销押金
其他	61,263.36	1年以内	代扣代缴社保等
合计	561,263.36		

（7）其他非流动负债

①报告期内，公司其他非流动负债主要为递延收益，具体情况如下：

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额（元）	占负债总额比例（%）	金额（元）	占负债总额比例（%）	金额（元）	占负债总额比例（%）	金额（元）	占负债总额比例（%）
递延收益	2,500,000.00	8.04	3,500,000.00	4.40	1,500,000.00	3.47	-	-

递延收益主要是待转销研发项目专项资金。公司对递延收益在确认相关费用的期间计入当期损益。

②报告期内，公司待转销研发项目专项资金情况如下表：

序号	项 目	补助部门	补助总金额（元）	已结转收入（元）	递延收益（元）
1	移动数字电视 SoC 芯片研发及产业化	工业和信息化部	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2	移动数字电视 SoC 芯片研发和产业化	北京市工业促进局	500,000.00	500,000.00	-
3	高性能数字移动终端多媒体应用 CPU 芯片开发及产业化	工业和信息化部	4,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00

合 计	-	5,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00
-----	---	--------------	--------------	--------------

2008年6月26日，公司与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订《电子信息产业发展基金无偿资助项目合同书》，工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室给予公司移动数字电视 SoC 芯片研发及产业化项目 100 万元补助。

2008年，公司与北京市工业促进局和北京市财政局签订了《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，北京市工业促进局为公司移动数字电视 SoC 芯片 JZ4750 研发和产业化项目补助 50 万元。

2009年9月10日，公司与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室给予公司高性能数字移动终端多媒体应用 CPU 芯片开发及产业化项目 400 万元补助。根据上述项目合同约定的完成进度，本公司于 2009 年 12 月结转营业外收入 50 万元，2010 年 6 月结转营业外收入 100 万元。

（三）所有者权益分析

报告期内，公司所有者权益情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	60,000,000.00	60,000,000.00	6,950,000.00	6,250,000.00
资本公积	14,156,178.85	14,156,178.85	11,552,594.02	11,551,958.77
盈余公积	941,357.62	941,357.62	1,528,971.13	64,479.19
未分配利润	80,687,552.41	30,765,468.81	50,940,040.65	6,270,906.70
外币报表折算差额	-242,904.95	-180,532.87	-142,936.37	-351,457.27
合 计	155,542,183.93	105,682,472.41	70,828,669.43	23,785,887.39

1、股本变动分析

2008年实收资本增加 70.00 万元，主要系由姜君、韦建利、刘飞、于万洲、许志鹏、晏晓京、张燕祥及张敏分别以货币 10.5 万元、8.75 万元、8.75 万元、8.75 万元、8.75 万元、8.75 万元、7.875 万元及 7.875 万元合计 70.00 万元向君正有限增资。

2009年股本增加5,305.00万元，系因为君正有限于2009年12月24日整体变更为股份有限公司时以2009年10月31日经审计净资产折为公司股本6,000.00万元。

2、资本公积变动分析

报告期内，资本公积变动主要系因为君正有限整体变更为股份有限公司时以2009年10月31日经审计净资产折为公司股本6,000.00万元，超过部分计入资本公积。

3、盈余公积变动分析

报告期内，盈余公积变动如下表：

单位：元

项 目	2010年 1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
年初盈余公积	941,357.62	1,528,971.13	64,479.19	-
加：本期提取法定盈余公积金	-	8,477,744.98	1,464,491.94	64,479.19
减：净资产折股	-	9,065,358.49	-	-
年末盈余公积	941,357.62	941,357.62	1,528,971.13	64,479.19

报告期内，盈余公积增加为当年分配税后利润时，按税后利润的10%计提的法定公积金。2009年盈余公积减少系因为君正有限整体变更为股份有限公司以2009年10月31日经审计的净资产折为股本及资本公积。

4、未分配利润变动分析

单位：元

项 目	2010年 1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
年初未分配利润	30,765,468.81	50,940,040.65	6,270,906.70	1,260,885.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10
减：提取法定盈余公积金	-	8,477,744.98	1,464,491.94	64,479.19
应付普通股股利	-	35,000,000.00	-	-
以净资产折股	-	46,588,226.34	-	-
期末未分配利润	80,687,552.41	30,765,468.81	50,940,040.65	6,270,906.70

报告期内，未分配利润增加为当年所实现的净利润。

2009 年末分配利润减少主要由于：（1）君正有限整体变更为股份有限公司时以 2009 年 10 月 31 日经审计净资产折为股本及资本公积；（2）2009 年君正有限股东会决议，将君正有限未分配利润中的 3,500.00 万元按出资比例向股东进行分配。

（四）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

偿债能力指标	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	6.49	2.41	2.68	5.73
速动比率（倍）	5.70	1.93	1.99	4.30
资产负债率 （合并，%）	16.61	42.97	37.92	16.86
财务指标	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	5,541.63	7,994.96	5,706.93	614.67

从上表可以看出：

（1）报告期内，公司保持了较高的流动比率、速动比率，短期偿债能力较强。

（2）2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月 30 日公司合并资产负债率分别为 16.86%、37.92%、42.97%及 16.61%，资产负债率合理，偿债风险低。

（3）报告期内，公司息税折旧摊销前利润从 2007 年的 614.67 万元增加到 2009 年的 7,994.96 万，2010 年 1-6 月的息税折旧摊销前利润达 5,541.63 万元，呈快速增长趋势，说明公司具有较强的长期偿债能力。

（五）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率（次）	34.36	255.50	216.98	509.80
存货周转率（次）	1.59	2.40	3.94	5.40
总资产周转率（次）	0.61	1.28	2.03	1.64
扣除货币资金后总资产周转率（次）	1.53	2.68	3.68	2.34

从上表可以看出，报告期内，公司资产周转能力较强。

2010年1-6月应收账款周转率34.36次较2009年度的255.50次下降较大，一方面是因为2010年1-6月为半年数据；另一方面，每年的暑假为便携教育电子销售高峰，终端客户一般提前一个月提货以备其生产，造成应收账款余额较大，周转率次数下降，但应收账款余额均已在正常的信用期间内收回，未对公司正常的生产经营活动产生影响。

随着公司资产规模扩大，存货周转率及总资产周转率有所下降，但仍保持在较高且稳健的水平。

十一、盈利能力分析

（一）利润来源分析

报告期内，公司毛利构成情况如下：

产品类别	2010年6月30日		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
便携消费电子CPU芯片	34,440,352.23	52.53	77,898,763.14	68.68	52,365,404.17	70.82	3,654,021.19	31.81
便携教育电子CPU芯片	30,330,690.90	46.27	30,578,330.98	26.96	18,330,608.16	24.79	4,710,832.14	41.01
其他	786,414.09	1.20	4,951,613.45	4.36	3,248,524.48	4.39	3,121,772.60	27.18
毛利总额	65,557,457.22	100.00	113,428,707.57	100.00	73,944,536.81	100.00	11,486,625.93	100.00

公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，主要产品为CPU芯片，广泛应用于消费电子和教育电子产品。报告期内，公司平均毛利总额的95%来源于便携消费电子CPU芯片和便携教育电子CPU芯片的销

售。2010年1-6月，由于新型教育电子产品如电子书用CPU芯片的热销，公司便携教育电子CPU芯片毛利占比上升幅度较大。

（二）营业收入分析

1、营业收入总体变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入总体变动趋势情况如下：

产品类别	2010年1-6月	2009年度		2008年度		2007年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
便携消费电子CPU芯片	59,723,804.97	134,838,085.84	26.81	106,330,783.11	437.22	19,792,787.74
便携教育电子CPU芯片	52,052,211.28	50,109,308.33	60.04	31,310,855.29	200.38	10,423,650.17
其他	984,403.91	7,277,565.49	1.07	7,200,516.13	73.77	4,143,821.07
合计	112,760,420.16	192,224,959.66	32.71	144,842,154.53	321.54	34,360,258.98

报告期内，公司营业收入快速增长，2008年和2009年营业收入分别较上年增长了321.54%和32.71%，主要原因是公司通过自主研发与产品创新，产品性能不断完善、品牌日益提升、应用领域逐年拓展，推动了营业收入实现快速增长。

（1）便携消费电子CPU芯片营业收入变动原因分析

2008年，公司消费电子CPU芯片实现爆发式增长，营业收入较2007年增长437.22%，主要是由于公司2007年下半年进入PMP消费电子领域，当年末推出的嵌入式CPU芯片具有较强的多媒体功能，迅速赢得市场认可，在2008年获得热销，从而推动了2008年营业收入的快速上升。2009年消费电子领域实现平稳增长，仍保持在相对较高的水平。

（2）教育电子CPU芯片营业收入变动原因分析

公司客户步步高、诺亚舟从2007年部分采用公司嵌入式CPU芯片产品后，2008年更多的产品型号采用公司芯片产品，推动教育电子CPU芯片营业收入较2007年增长200.38%。2009年，步步高教育电子产品大量采用公司芯片产品以及公司芯片产品在新型教育电子设备如电子书应用上获得巨大成功，推动该类产品的营业收入在2008年高速增长的基础上仍快速增长60.04%。

2、营业收入分产品类别构成分析

产品类别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
便携消费电子CPU芯片	59,723,804.97	52.97	134,838,085.84	70.15	106,330,783.11	73.41	19,792,787.74	57.60
便携教育电子CPU芯片	52,052,211.28	46.16	50,109,308.33	26.07	31,310,855.29	21.62	10,423,650.17	30.34
其他	984,403.91	0.87	7,277,565.49	3.78	7,200,516.13	4.97	4,143,821.07	12.06
合计	112,760,420.16	100.00	192,224,959.66	100.00	144,842,154.53	100.00	34,360,258.98	100.00

报告期内，便携消费电子CPU芯片营业收入占比较高，主要是由于便携消费电子市场广阔，客户众多。随着公司推出用于高端便携教育电子产品如电子书的CPU芯片产品，便携教育电子CPU芯片销售占比有所提升。2010年1-6月，由于新型教育电子产品如电子书用CPU芯片的热销，公司便携教育电子CPU芯片收入占比上升幅度较大。

3、营业收入按销售模式分布分析

销售模式	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
经销	8,885.26	78.80	13,648.39	71.00	10,359.20	71.52	1,211.56	35.26
直销	2,390.79	21.20	5,574.11	29.00	4,125.02	28.48	2,224.47	64.74
合计	11,276.04	100.00	19,222.50	100.00	14,484.22	100.00	3,436.03	100.00

2007年，公司处于创业发展初期，经销体系尚在建设当中，自行发展的直销客户销售占比较大。2008年，随着经销体系逐渐完善，公司销售模式日趋稳定，经销商数量以及经销收入占比大幅增长，销售结构趋于稳定。

4、营业收入按交货地分布分析

产品类别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
广东地区	74,942,096.03	66.46	161,108,317.07	83.82	54,665,369.51	37.74	8,124,275.90	23.64
香港地区	6,155,411.86	5.46	20,461,607.78	10.64	87,096,403.18	60.13	23,508,448.08	68.42

其他地区	31,662,912.27	28.08	10,655,034.81	5.54	3,080,381.84	2.13	2,727,535.00	7.94
合计	112,760,420.16	100.00	192,224,959.66	100.00	144,842,154.53	100.00	34,360,258.98	100.00

珠三角地区是全球重要的消费电子、教育电子研发和制造基地之一，公司客户众多，且具有长期稳定的合作关系，是公司产品重要的目标市场。

随着全球集成电路设计及制造重心逐渐向中国大陆转移，下游厂商订单也随之转向国内，因此，公司自 2008 年开始国内销售比重迅速提升。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成及变动趋势分析

（1）报告期内，公司营业成本分产品类别构成如下：

产品类别	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
便携消费电子 CPU 芯片	25,283,452.74	53.56	56,939,322.70	72.26	53,965,378.94	76.12	16,138,766.55	70.56
便携教育电子 CPU 芯片	21,721,520.38	46.02	19,530,977.35	24.79	12,980,247.13	18.31	5,712,818.03	24.97
其他	197,989.82	0.42	2,325,952.04	2.95	3,951,991.65	5.57	1,022,048.47	4.47
合计	47,202,962.94	100.00	78,796,252.09	100.00	70,897,617.72	100.00	22,873,633.05	100.00

与公司产品销售结构相一致，便携消费电子 CPU 芯片成本比例与其销售收入比例持平。

（四）毛利率变动趋势分析

1、报告期内，公司毛利率及其变动趋势情况如下：

产品类别	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
	毛利率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)
便携消费电子 CPU 芯片	57.67	-0.17	57.77	17.30	49.25	166.79	18.46
便携教育电子 CPU 芯片	58.27	-4.51	61.02	4.24	58.54	29.54	45.19
其他	79.89	17.41	68.04	50.80	45.12	-40.11	75.34

综合毛利率	58.14	-1.47	59.01	15.59	51.05	52.71	33.43
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

报告期内，除 2007 年公司处于创业发展初期，毛利率较低外，公司毛利率均保持在 50% 以上。2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月毛利率略有变化，主要是产品销售结构发生变化所致，为正常经营波动。

2、报告期内公司 CPU 芯片产品综合售价及综合成本情况如下：

项 目	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额 (元/颗)	上涨比 率 (%)	金额 (元/颗)	下降比 率 (%)	金额 (元/颗)	下降比 率 (%)	金额 (元/颗)
综合售价	19.54	6.43	18.36	28.78	25.78	25.71	34.70
综合成本	8.21	8.17	7.59	39.47	12.54	50.02	25.09
毛利率 (%)	57.98		58.66		51.36		27.69

从上表可以看出，报告期内，公司产品综合售价、综合成本呈下降趋势；除 2007 年公司因产品推出初期生产成本较高，导致当年毛利率较低之外，公司产品毛利率比较稳定且均保持在较高的水平。

3、报告期内，发行人便携消费电子 CPU 芯片产品、便携教育电子 CPU 芯片产品平均单位售价、单位成本、单位毛利率及其变化情况如下：

项目		2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
		金额 (元/颗)	增长比 率 (%)	金额 (元/颗)	增长比 率 (%)	金额 (元/颗)	增长比 率 (%)	金额 (元/颗)
便携消 费电子	单位售价	17.08	-7.83	18.53	-23.81	24.32	-31.61	35.56
	单位成本	7.23	-7.66	7.83	-36.55	12.34	-57.45	29.00
CPU 芯 片产品	单位毛利率 (%)	57.67	-0.17	57.77	17.30	49.25	166.79	18.46
便携教 育电子	单位售价	23.34	30.32	17.91	-44.71	32.39	-2.32	33.16
	单位成本	9.74	39.54	6.98	-48.03	13.43	-26.09	18.17
CPU 芯 片产品	单位毛利率 (%)	58.27	-4.51	61.02	4.24	58.54	29.54	45.19

从上表可以看出，公司报告期内，不同领域内的芯片产品价格变动趋势略有差异。便携消费电子 CPU 芯片产品售价在 2008 年、2009 年变化较大，综合售价下降较快；便携教育电子 CPU 芯片产品售价在 2008 年基本稳定，在 2009 年

综合售价下降较快，2010年1-6月出现大幅回升。

（1）产品综合售价变动的原因

报告期内，公司便携消费电子CPU芯片产品、便携教育电子CPU芯片产品综合售价呈下降趋势，主要原因是该领域内销售结构变化和单价下降引起。公司CPU芯片产品根据封装形式大体可分为三大类产品，第一类为采用PBGA工艺封装的产品，采用该等工艺封装的产品，一般为高端产品，用户对产品的性能要求较高，由于封装成本较高，售价也较高；第二类为采用QFP工艺封装的产品，采用该等工艺封装的产品，为中端产品，用户对产品的性能要求不太高，由于封装成本较低，价格也较前一类产品低；第三类为未经封装的裸片产品，这一类产品由于未经封装，性能一般，生产成本较低，售价也相应较低。

①产品销售结构变化

从上表可以看出，在便携消费电子CPU芯片产品领域，公司各年度的产品综合售价分别为35.56、24.32、18.53、17.08元/颗，呈下降趋势。主要是由于公司为满足多元化的市场需求及扩大产品线，陆续推出售价较低的QFP工艺封装的产品以及未封装的裸片产品。其中，售价较高的采用BGA工艺封装的产品销售占比从2007年度的100%下降到2010年1-6月的18.67%。

与便携消费电子CPU芯片产品相类似，公司便携教育电子CPU芯片产品各年度的产品综合售价亦呈下降趋势，分别为33.16、32.39、17.91、23.34元/颗。

②同一产品销售单价下降原因分析

A、行业惯例及公司定价策略

公司所处的CPU芯片行业，产品性能更新较快，市场竞争激烈，因此，公司推出的新产品在面市早期定价较高，争取超额毛利，在一段时间后，彻底退出市场之前，通常会通过下调产品销售单价等措施来延长其生命周期，但产品价格下降接近行业平均生产成本时，将趋于稳定。通常而言，芯片供应商为了获取稳定的毛利率，会通过不断推出售价较高的新产品，获取较高的毛利率来弥补旧产品毛利率下降的空间，因此，从长期来看，CPU芯片行业内的新旧产品的平均售价及企业综合毛利率比较稳定。

公司根据产品生命周期内价格变化的趋势，采用与行业惯例一致的定价策略，即新产品售价较高，维持一段时间之后，再根据市场竞争或者其他策略性原

因降低产品售价。

B、便携消费电子 CPU 芯片领域

便携消费电子 CPU 芯片近三年一期的销售价格总体呈缓慢下降。主要原因是，消费电子领域尤其是 PMP 市场，终端生产准入门槛较低，厂商众多，CPU 芯片供应商较多，竞争激烈，导致单一产品的价格下降较快，但由于新产品推出的速度也较快，使得新旧产品价格平均之后下降趋势变得较为平缓。

C、便携教育电子 CPU 芯片领域

与便携消费电子 CPU 芯片领域不同，便携教育电子 CPU 芯片产品进入门槛较高，竞争格局及市场相对较稳定，单一产品的价格较为平稳，新产品推出的速度较为缓慢。因此，总体来看单一产品的价格及综合售价较为稳定。

（2）单位生产成本下降

单位成本下降的原因主要是芯片生产过程委外加工费单价逐年呈快速下降趋势。

①单位晶圆成本下降

报告期内，公司单颗芯片的晶圆成本下降的主要原因是公司委托加工所使用的晶圆尺寸规格变化以及晶圆委托加工费下降所致，具体情况如下：

A、公司在 2008 年之前委托加工所使用的晶圆主要是直径为 8 英寸的晶圆，自 2008 年开始，部分新产品委托加工使用 12 英寸晶圆。在同等工艺条件下，12 英寸晶圆可用面积为 8 英寸晶圆的 2.25-2.5 倍左右，而采购价格低于 8 英寸晶圆基片采购价格的 2.25 倍。因此，采用 12 寸晶圆进行生产，芯片的晶圆成本更低。

B、报告期内，委托加工的晶圆价格也不断降低，直接带动了芯片单位成本逐年降低。

②封装成本下降

报告期内，公司产品平均单位封装成本呈下降趋势，主要是由于销售结构发生变化。不同芯片产品，需要的封装工艺不同。公司 2008 年采用封装单价较低的 QFP 工艺，且形成较大销售量，带动 2008 年单位封装成本的下降；2009 年，QFP 封装的芯片产品销售比例进一步提高，无须封装的裸片产品也开始形成较大规模的销量，同时，公司开始引入单价较低的新封装加工商，致使公司封装成本较 2008 年进一步下降。

③测试成本下降

2008 年测试成本较 2007 年下降主要是委托加工商提供的测试单价持续下降，2009 年测试成本的下降则主要由于当年裸片销量数量较大。

3、与同行业上市公司毛利率比较分析

(1) 报告期内，公司毛利率与同行业上市公司对比情况如下：

公 司	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
士兰微	34.77%	28.13%	24.02%	20.33%
复旦微电子	42.84%	42.00%	38.43%	29.60%
国民技术	47.65%	43.95%	38.68%	28.90%
行业平均水平	41.75%	38.03%	33.71%	26.28%
北京君正	58.14%	59.01%	51.05%	33.43%

报告期内，较之我国大陆地区其他集成电路设计公司，公司综合毛利率水平较高，主要原因是：

①产品类别不同

嵌入式 CPU 芯片产品生产工艺复杂，售价较高，因此嵌入式 CPU 芯片产品毛利率通常较其他芯片产品高。报告期内，公司与全球范围内其他主要嵌入式 CPU 设计企业如高通、Marvell、联发科（MTK）毛利率相当，具体情况如下：

公 司	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
高通	50.15%	50.80%	52.30%	53.50%
Marvell	59.44%	56.30%	51.65%	48.26%
联发科（MTK）	55.91%	58.71%	53.74%	56.19%
平 均	55.17%	55.27%	52.56%	52.65%
北京君正	58.14%	59.01%	51.05%	33.43%

②公司自主掌握嵌入式 CPU 设计核心技术

CPU 芯片设计技术含量高，是集成电路设计行业的最高端，嵌入式 CPU 设计需要多门类、跨学科的专业知识。公司是全球为数不多的自主掌握嵌入式 CPU 设计核心技术的企业之一。掌握最具竞争力的核心技术，意味着公司 IP 支出较低，营业成本较低。

③公司产品应用领域广，不断进入新领域

公司采用“开放平台、纵横扩展”的市场推广策略，专注于芯片产品的设计和研发，同时开放系统软件平台，便于下游终端客户进行二次开发，设计个性化新产品，公司芯片产品不断提前进入新领域、新市场，因此一直保持较高的毛利率。

综上所述，公司自主掌握了嵌入式 CPU 设计的核心技术，成功采用了“开放平台、纵横扩展”的市场策略，取得高于国内同行业公司毛利率水平，符合公司经营实际情况。

（五）主要产品销售价格及主要原材料价格变动的敏感性分析

公司主要成本为晶圆支出，主要产品销售价格及主要成本价格变动对公司毛利率的影响如下：

变动率		单位售价变动比率/变动后毛利率						
		-20%	-10%	-5%	0%	5%	10%	20%
单位 成本 变动/ 变动 后毛 利率	-20%	57.98%	60.46%	62.65%	64.62%	66.39%	67.99%	69.44%
	-10%	55.36%	57.98%	60.32%	62.41%	64.29%	65.99%	67.53%
	-5%	52.73%	55.51%	57.98%	60.20%	62.19%	63.99%	65.62%
	0%	50.11%	53.04%	55.65%	57.98%	60.08%	61.99%	63.71%
	5%	47.48%	50.57%	53.32%	55.77%	57.98%	59.98%	61.80%
	10%	44.85%	48.10%	50.98%	53.56%	55.88%	57.98%	59.89%
	20%	42.23%	45.63%	48.65%	51.35%	53.78%	55.98%	57.98%

从上表可以看出，公司产品毛利率较高，具有较高的安全边际，单位售价与单位成本的变动对公司毛利率影响不大。

（六）期间费用分析

1、报告期内，期间费用及其变动趋势分析：

项 目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	占营业 收入比 (%)	金额 (元)	占营业 收入比 (%)	金额 (元)	占营业 收入比 (%)	金额 (元)	占营业 收入比 (%)

销售费用	3,275,761.17	2.91	10,609,695.80	5.52	3,705,176.30	2.56	1,000,641.10	2.91
管理费用	13,299,061.30	11.79	24,388,926.58	12.69	11,355,357.07	7.84	4,516,696.69	13.15
财务费用	270,523.15	0.24	-780,556.19	-0.41	1,864,351.66	1.29	112,963.52	0.33
合计	16,845,345.62	14.94	34,218,066.19	17.80	16,924,885.03	11.69	5,630,301.31	16.39

报告期，随着公司规模扩大，期间费用增加较快，但占营业收入比重一直保持较低的水平，说明公司费用管理控制严格，资金使用效率较高。

(1) 报告期内，销售费用明细项目如下：

项 目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	金额 (元)	占营业收入比例 (%)
市场推广费	1,735,333.80	1.54	3,902,728.55	2.03	2,836,074.40	1.96	788,652.69	2.30
物流费	183,869.45	0.16	821,432.22	0.43	742,265.36	0.51	119,395.78	0.35
技术使用费	954,605.47	0.85	5,717,519.21	2.97	-	-	-	-
其他	401,952.45	0.36	168,015.82	0.09	126,836.54	0.09	92,592.63	0.26
合计	3,275,761.17	2.91	10,609,695.80	5.52	3,705,176.30	2.56	1,000,641.10	2.91

报告期内，市场推广费占销售收入的比重保持在比较稳定的水平，随着公司销售规模的增大而增长。

技术使用费的变动主要是由于公司 2007 年、2008 年在 PMP 领域的销售由深圳市华芯飞科技有限公司自行提供解决方案和技术支持并承担该等支出，深圳市华芯飞科技有限公司退出后由公司自行提供解决方案和技术支持，因此 2009 年支出较大。随着公司 2010 年 1-6 月销往 PMP 应用领域的芯片产品减少，技术使用费相应减少。

其他费用主要是业务招待费和差旅费等费用支出。

(2) 报告期内，公司管理费用构成如下：

项 目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
研究开发费用	8,482,395.05	63.78	14,100,674.98	57.82	8,027,568.80	70.69	3,557,125.42	78.76
流动资产损益	-	-	2,749,154.13	11.27	-	-	-	-
水电房租费	817,723.91	6.15	2,167,434.41	8.89	1,074,462.05	9.46	331,279.56	7.33

职工薪酬	1,300,469.38	9.78	1,795,757.79	7.36	1,379,053.65	12.14	191,788.15	4.25
专业服务费	1,967,355.51	14.79	1,043,351.84	4.28	47,105.48	0.41	10,500.00	0.23
其他	731,117.45	5.50	2,532,553.43	10.38	827,167.09	7.30	426,003.56	9.43
总计	13,299,061.30	100.00	24,388,926.58	100.00	11,355,357.07	100.00	4,516,696.69	100.00

管理费用主要是研发支出、工资费用、水电、房租及物业管理费用，体现了公司高科技企业以及 Fabless 模式的特征。

报告期内，公司持续增加研发投入，具体情况如下：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发费用（元）	8,482,395.05	14,100,674.98	8,027,568.80	3,557,125.42
增长率（%）		75.65	125.68	1,550.89
占管理费用比例（%）	63.78	57.82	70.69	78.76
占营业收入比例（%）	7.52	7.34	5.54	10.35

从上表可以看出，报告期内，公司研发支出占比较大，且上升明显。2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月研发支出占管理费用比重分别为 78.76%、70.69%、57.82%及 63.78%，体现了公司作为持续创新型企业的特点。

2007 年、2008 年、2009 年投入增长率分别为 1,550.89%、125.68%、75.65%。作为集成电路设计企业，公司研发费用投入逐步增加，除加大对基础 IP 核和处理器芯片研发的投入外，还着重加强技术的创新和应用，保持并增强在便携消费电子、便携教育电子（包括电子书）、智能手机、平板电脑等重点应用方向的技术优势和持续创新能力。

研发费用的构成情况如下：

项 目	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额（元）	所占比例（%）	金额（元）	所占比例（%）	金额（元）	所占比例（%）	金额（元）	所占比例（%）
职工薪酬	5,342,922.33	62.99	9,836,342.91	69.76	5,347,942.29	66.62	619,601.64	17.42
技术支持费	2,691,173.43	31.73	3,005,170.83	21.31	1,626,673.16	20.26	2,049,584.05	57.62
其他	448,299.29	5.28	1,259,161.24	8.93	1,052,953.35	13.12	887,939.73	24.96
合计	8,482,395.05	100.00	14,100,674.98	100.00	8,027,568.80	100.00	3,557,125.42	100.00

（七）营业外收入分析

报告期内，公司的营业外收入主要是政府补助，具体情况如下：

项 目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (元)	占利润总 额比例	金额 (元)	占利润总 额比例	金额 (元)	占利润总 额比例	金额 (元)	占利润总 额比例
固定资产清理	-		190.00	0.0002%	-	-	-	-
政府补助-增值税返还	6,093,585.90	11.13%						
政府补助-研发项目专项资金	1,000,000.00	1.83%	2,000,000.00	2.52%	-	-	5,250.00	0.09%
其他	88,375.62	0.16%	6,428.41	0.01%	2,005.00	0.0035%	0.02	0.00%
合 计	7,181,961.52	13.12%	2,006,618.41	2.53%	2,005.00	0.0035%	5,250.02	0.09%

公司2010年1-6月确认补贴收入100万元，内容请详见本节“十、财务状况分析”之“（二）负债构成总体分析”之“2、主要负债分析”。

（八）与上市公司相关指标的比较

公司主要产品为32位嵌入式CPU芯片，目前已上市公司中无从事32位嵌入式CPU芯片生产与销售的企业。已上市公司中的集成电路设计企业有凌阳科技、国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”）、上海复旦微电子股份公司（以下简称“复旦微电子”）及珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”）。其中凌阳科技在台湾交易所上市、复旦微电子在香港联合交易所上市。

主要 指标	年度	对比公司						北京 君正
		凌阳科技	国民技术	士兰微	复旦微电子	欧比特	平均	
毛利率	2010年 1-6月	37.96%	47.65%	34.77%	42.84%	34.57%	39.56%	58.14%
	2009年度	33.13%	43.95%	28.13%	42.00%	36.38%	36.72%	59.01%
	2008年度	38.70%	38.68%	24.02%	38.43%	32.98%	34.56%	51.05%
	2007年度	42.46%	28.90%	20.33%	29.60%	47.38%	33.73%	33.43%
应收账款 及票据周	2010年 1-6月	3.36	3.94	1.89	2.68	1.43	2.66	34.36
	2009年度	7.42	6.85	3.42	5.03	5.87	5.72	255.50

转率(次)	2008 年度	6.12	5.31	3.65	5.03	7.09	5.44	216.98
	2007 年度	6.17	5.75	4.40	5.75	4.27	5.27	509.80
存货周转率(次)	2010 年 1-6 月	3.48	2.12	1.42	1.78	2.07	2.17	1.59
	2009 年度	5.89	4.06	2.11	2.81	4.42	3.86	2.40
	2008 年度	3.69	3.35	2.16	2.6	4.48	3.26	3.94
	2007 年度	4.05	3.30	2.66	3.66	3.78	3.49	5.40
总资产周转率(次)	2010 年 1-6 月	0.39	0.25	0.42	0.47	0.20	0.35	0.39
	2009 年度	0.45	1.86	0.60	0.72	0.84	0.89	1.28
	2008 年度	0.47	1.61	0.48	0.71	0.93	0.84	2.03
	2007 年度	0.59	1.59	0.52	0.90	0.76	0.87	1.72

从上述财务指标可以看出

（1）公司产品盈利能力强

报告期内，公司综合毛利率较行业平均水平高。主要是因为公司具有自主研发的 CPU 内核，较一般的集成电路设计企业节约了外购 CPU 内核的成本。

此外，公司产品性能优越、具有较强的议价能力。因此公司产品具有较高的盈利能力。

（2）公司资产使用效率高

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率均高于同行业上市公司平均水平，公司资产使用效率较高。

综上所述，公司盈利能力、资产管理能力现状符合公司快速成长期的特点。公司制定了全面的研发、技术创新、产品生产及销售策略以及相关的财务管理控制制度，对研发、销售、存货、应收账款及固定资产等严格管理，能够有效、合理控制经营风险。

（九）非经常性损益对公司盈利能力的影响分析

兴华事务所对公司报告期内的非经常性损益情况进行了核验，并出具了（2010）京会兴核字第 1-47 号《关于北京君正集成电路股份有限公司非经常性损益明细表的专项审核报告》。报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	-	190.00	-	-
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	2,000,000.00	-	5,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	263,800.00	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	3,917,259.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,375.62	6,028.41	-97,995.00	0.02
非经常性损益合计	1,088,375.62	2,270,018.41	-97,995.00	3,922,509.14
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	81,628.17	170,267.13	-24,498.75	-
扣除所得税及少数股东损益影响额后非经常性损益合计	1,006,747.45	2,099,751.28	-73,496.25	3,922,509.14

2007年、2008年、2009年和2010年1-6月非经常性损益分别占同期净利润的比例分别为77.30%、-0.16%、3.00%和2.02%。除2007年非经常性损益对当期净利润影响较大外，其他期间非经常性损益对公司经营成果影响极小。

（十）所得税费用与会计利润的关系

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
利润总额	54,730,184.82	79,520,406.83	56,729,535.95	5,850,532.23
本期应交所得税费用	4,162,588.56	9,738,239.31	11,185,939.57	787,000.45
减：递延所得税资产增加额	-645,512.66	109,231.96	590,029.51	10,968.32
所得税费用	4,808,101.22	9,629,007.35	10,595,910.06	776,032.13

（十一）主要税收缴纳情况

报告期内，公司主要税种的缴纳情况如下表：

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
企业所得税	2,817,803.21	22,550,328.84	79,678.48	-
增值税	4,664,554.58	16,883,126.16	1,339,971.36	99,464.60
营业税	65,478.15	13,190.00	12,507.50	429.09
合 计	7,547,835.94	39,446,645.00	1,432,157.34	99,893.69

企业所得税、增值税缴纳金额 2009 年较 2008 年大，主要原因如下：

（1）缴纳企业所得税的增加，主要是由于发行人利润总额的大幅增加。此外，发行人在 2008 年进行企业所得税季度申报时，按 2007 年免征企业所得税的税收优惠进行了申报，因此 2008 年各季度未预缴企业所得税，而在 2009 年办理 2008 年企业所得税汇算清缴时，根据税务机关要求按 25% 的企业所得税税率计算并缴纳了 2008 年的企业所得税；2009 年，发行人按 25% 的企业所得税税率按季进行企业所得税申报和预缴。因此，发行人 2009 年缴纳的所得税较 2008 年出现大幅增长。

（2）缴纳增值税增加主要是因为 2007 年、2008 年发行人注册于香港的子公司—香港君正集团销售金额较大且无增值税纳税义务；2009 年发行人销售金额大幅增长，由于境内销售货物需要缴纳增值税，因此发行人 2009 年增值税缴纳金额较 2008 年大幅增加。

兴华事务所对公司报告期主要税种的纳税情况进行了审核，并出具了（2010）京会兴核字第 1-46 号《关于北京君正集成电路股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月主要税项纳税情况审核报告》，认为公司编制的《关于北京君正集成电路股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月主要税项纳税情况审核报告》如实反映了公司主要税种的纳税情况。

十二、现金流量分析

1、报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	58,627,372.28	55,467,600.88	47,467,788.41	-1,356,082.13

投资活动产生的现金流量净额	-621,872.33	-24,257,997.55	-854,364.32	-66,768.24
筹资活动产生的现金流量净额	-35,423,832.50	15,000,000.00	700,635.25	7,050,618.77
汇率变动对现金的影响额	-63,828.71	-51,397.74	-1,365,563.78	-216,169.47
现金及现金等价物净增加额	22,517,838.74	46,158,205.59	45,948,495.56	5,411,598.93

经营活动产生的现金净流入金额较大，筹资活动中公司股东持续增资及借款使得现金流量净额为正。

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量金额除 2007 年因备货预付委托加工商的款项支出较大导致当年为净流出外，其他年度均为较大金额的净流入，说明公司盈利质量较高。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是因为公司规模持续扩大，相应进行资本投资，符合企业快速成长的特征。2009 年投资活动现金流出金额较大的原因是预付中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-2 号地块的土地开发费 2,386 万元。

(3) 2007 年-2009 年筹资活动产生的现金流量净额均为正数，主要是因为 2007 年-2008 年公司持续获得资本投入，2009 年取得短期借款 1,500.00 万元，2010 年 1-6 月的现金流量金额为负数，主要是因为支付 2009 年应付股利 3,500 万元。

2、净利润与经营活动现金净流量分析

报告期内，公司各年度净利润与经营活动现金净流量对比情况见下：

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度	合 计
净利润	49,922,083.60	69,891,399.48	46,133,625.89	5,074,500.10	171,021,609.07
经营活动产生的现金流量净额	58,627,372.28	55,467,600.88	47,467,788.41	-1,356,082.13	160,206,679.44
比例（%）	117.44	79.36	102.89	-26.72	93.68

从上表可以看出，经营活动产生的现金流量金额占当年净利润的比重较高，说明公司盈利质量较高，保持了良好的竞争力。

2007 年经营活动产生的现金流量净额为-135.61 万元，主要是为保证持续快

速增长，公司当年末预付委托加工费等经营支出较大，造成 2007 年经营活动产生的现金流量净额为负数。

报告期内，其他与经营活动有关的现金流量主要是经销商押金、项目合作保证金、政府补助、关联方资金往来等款项收支，具体情况如下：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

报告期内，发行人收到的其他与经营活动有关的现金流入具体情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
收到经销商押金及合作保证金	-	2,550,696.11	2,000,000.00	3,074,428.70
收到政府补助	-	4,500,000.00	1,000,000.00	5,250.02
收到借款	-	-	1,900,000.00	-
收回借款	-	8,713,800.00	3,000,000.00	3,040,000.00
代收刘强中关村奖励款	-	1,000,000.00	-	-
职工交还差旅费余款	260,987.00	23,450.00	848,910.00	1,136,086.70
收到银行存款利息	174,238.40	353,200.43	110,916.37	17,493.91
其他杂项	32,395.96	143,224.47	764,778.63	236,102.09
合 计	467,621.36	17,284,371.01	9,624,605.00	7,509,361.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金流出主要是支付管理费用和销售费用、支付关联方款项、员工借款以及返还经销商押金、项目合作保证金等支出，具体情况如下：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
付现的销售费用	1,143,835.69	10,609,429.85	3,085,108.44	902,565.66
付现的管理费用	6,042,098.30	10,154,556.29	4,717,411.24	2,563,287.04
支付、返还押金及保证金	500,000.00	1,850,531.26	-	2,455,644.44
借出款项	-	7,000,000.00	4,000,000.00	1,600,000.00
偿还职工借款	-	-	1,900,000.00	-
差旅借款	-	220,000.00	386,497.43	165,000.00
支付租赁押金	228,005.28	-	342,007.92	234,906.00
支付代收刘强的奖励款	1,000,000.00	-	-	-
银行手续费及利息支出	16,572.47	98,759.00	168,070.67	33,084.79
其他	370,096.35	790,173.89	1,204,077.33	378,369.61

合 计	9,300,608.09	30,723,450.29	15,803,173.03	8,332,857.54
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为：发行人“收到的其他与经营活动有关的现金”及“支付的其他与经营活动有关的现金”的编制符合企业会计准则的相关规定；报告期内，发行人曾存在对部分单位的资金拆出不规范行为，没有造成严重后果，不属于重大违法违规行为，对本次发行不构成实质性的法律障碍；辅导期间发行人已建立健全了企业规范运作的制度，有效杜绝了不规范行为的发生。

十三、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

2009年9月28日，君正有限与中关村软件园公司签订了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定由中关村软件园公司对位于中关村软件园二期（西扩）项目起步区J-2号地块进行一级开发，君正有限向中关村软件园公司承担土地开发费26,512,920.00元（不包含土地出让金），分三期支付。该地块面积5,845平方米，规划允许地上建筑面积为7,014建筑平方米，用地性质为教育科研用地。目前公司已经支付前两期费用共计23,861,628.00元。

（二）未来可预计的重大资本性支出

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金拟投资项目外，本公司暂无其他可预见的重大资本性支出。本次发行募集资金拟投资项目的详细情况详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

十四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司资产质量良好，资产管理能力较强，但总体资产规模偏小。随着盈利能力的不断增强，公司资产规模将持续增长，2007年末、2008年末、2009年末的资产总额较上年末增长率分别达到113.19%、298.76%、62.43%。如果本次募集资金项目成功实施，公司资金实力将明显增强，资产规模将快速增长，为公司的

持续创新和跨越发展奠定坚实的基础。

公司长期以来专注于 32 位嵌入式 CPU 芯片设计和开发，并在该领域具有明显的技术优势，成功开发了多款在国内技术领先、符合市场需求的 32 位嵌入式 CPU 芯片产品，并在便携消费电子产品、便携教育电子产品等领域占有较高的市场份额，为公司提供了稳定的利润来源。

未来公司将继续立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用、商业模式的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大，营造充分的发展空间。如果募集资金项目成功实施，便携消费电子 CPU 芯片、便携教育电子 CPU 芯片、智能手机和移动互联网终端 CPU 芯片将实现产业化及大规模应用，公司的收入来源将更加广泛，持续盈利能力将进一步增强。

十五、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

1、公司成立前的股利分配政策

君正有限股利分配政策依据《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行，分配顺序为：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取 10% 的法定公积金；
- （3）向出资者分配利润。

2、公司成立后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

（二）发行人报告期内的股利分配情况

公司系由君正有限于 2009 年 12 月 24 日整体变更设立的股份有限公司。本公司及前身报告期内股利分配情况如下：

1、2007 年股利分配情况

君正有限 2007 年未进行利润分配。

2、2008 年股利分配情况

君正有限 2008 年未进行利润分配。

3、2009 年股利分配情况

2009 年 10 月 30 日，君正有限股东会审议通过将君正有限未分配利润中的 3,500.00 万元按出资比例向各股东进行分配。2010 年 1 月 15 日和 1 月 18 日，公司分别向各自然人股东和法人股东支付了上述股利，并代扣代缴了自然人股东的个人所得税。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司保持了良好的财务状况，并于 2010 年 1-6 月取得良好的经营成果及现金流入，该次股利支付未对公司日常生产经营活动产生重大影响。

（三）发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配政策除保持与《公司法》有关条款的一致性外，根据公司 2009 年度股东大会决议通过的《公司章程》（草案），本次发行后的股利分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 5%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（四）发行前滚存利润共享安排

根据公司 2009 年度股东大会决议，若公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请分别取得中国证监会和深圳证券交易所的核准，则本次公开发行之日前的滚存利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

第十节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）募集资金数额

经公司2009年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行2,000万股，占发行后总股本的25%。本次发行募集资金总额为[]万元，扣除发行费用后，募集资金净额为[]万元。募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。

（二）募集资金投资计划

按项目轻重缓急程度排列，本次募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	投资时间计划		项目备案文件编号
			第一年	第二年	
1	便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	8,721	5,093	3,628	京海淀发改(备)[2010]22号
2	便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	8,165	4,675	3,490	京海淀发改(备)[2010]23号
3	移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	12,387	8,168	4,219	京海淀发改(备)[2010]24号
4	研发中心建设项目	3,388	3,388	-	京海淀发改(备)[2010]25号
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-

注：上表处理器芯片即指本公司的32位嵌入式CPU芯片

上述募集资金投资项目拟在北京市海淀区中关村软件园区内租赁办公场所实施。为实施上述项目，公司已于2010年2月1日与中关村软件园公司签订了《房屋租赁意向书》，约定公司向中关村软件园公司租赁北京市海淀区中关村软件园内面积约6,000建筑平方米的房屋作为研发和办公用房；房屋租金为3.4元/建筑平方米/日，月租金总额620,500.00元，年租金总额7,446,000.00元。续租期间，因市场变化中关村软件园公司调整租金每年涨幅不超过上述租金标准的

10%，租金按季支付；租赁期限为3年，自双方签订正式的《房屋租赁协议》之日起算，租赁期满发行人提前提出要求可续租；在确定承租后，双方签订正式的《房屋租赁协议》，意向书有效期至2011年6月30日。

上述房屋已由中关村软件园公司取得京海国有（2005出）第3335号《国有土地使用证》和京房权证海其字第012810号《房屋所有权证》，可用于租赁，发行人与出租方签订的《房屋租赁意向书》合法有效。

基于上述，保荐机构、发行人律师认为：本次募集资金投资项目拟新增租赁房产的取得不存在重大障碍，对本次发行上市不构成实质性影响。

若实际募集资金净额与项目总投资之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。

为及时把握市场机遇，募集资金到位之前，公司可先自筹适当资金投入上述项目，待募集资金到位后以募集资金置换先期自筹投入的资金。

（三）募集资金专户存储安排

根据公司《募集资金管理办法》，公司募集资金实行专户存储制度，募集资金存放于公司董事会指定的专项账户集中管理。公司已于[]银行[]支行开设了账号为[]的募集资金专项账户，用于本次募集资金的专项存储。

（四）本次募集资金投资项目具有重大战略意义

当前，信息已成为与材料、能源共同支撑世界发展的三大资源之一，也是支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心资源。以网络通信、移动便携设备（智能手机、PMP、平板电脑、MID、学习机、电子书等）、计算机、集成电路和软件为代表的信息技术应用改变了人类的生产、生活和思维方式，极大地促进了人类社会由工业化社会向信息化社会的转变，推动全球及我国经济的持续增长。

CPU芯片是一切电子信息产品的“大脑”，大至超级计算机，小至手机或电子玩具，都包含一个或多个CPU芯片。然而，CPU芯片研发的技术门槛和资金需求都很高，目前基本上被少数跨国企业所垄断。按照国家自主创新战略的要求：

“我国在关系国民经济命脉和国家安全的关键领域，真正的核心技术和关键技术只能依靠我们自己，只能依靠自主创新”。为了保障国家信息安全和自主发展信息产业，我国必须拥有自主知识产权的CPU，这也是推动我国电子信息产业从大到强的战略选择。

公司本次募集资金投资项目主要通过加大在嵌入式CPU芯片及其配套软件平台等方面的研发投入，攻克一批关键技术，推动持续自主创新，升级现有芯片的同时研发公司新一代XBurst2 CPU技术及CPU内核，推出在性能、价格、功耗等方面具备国际竞争力及良好产业化前景的新一代面向便携消费电子、便携教育电子和移动互联网终端的嵌入式CPU芯片，它不仅将产生可观的经济效益，更有助于实现我国在自主CPU技术领域的光荣和梦想。

（五）大规模投资的合理性

嵌入式CPU芯片设计涉及多项基础技术和多门类跨学科知识，需要有长期的资本投入、大量的高端人才进行坚持不懈地研发，才有可能实现CPU芯片核心技术的突破。长期以来，本土集成电路设计企业受制于资金实力，只能针对一些细分市场研发一些相对低端的CPU芯片，发展缓慢。公司过去采用“四两拨千斤”的发展策略，将有限的人力和资金集中于最关键的技术研发，在国内便携消费电子、便携教育电子嵌入式CPU芯片市场取得了较为领先的市场地位。但为进一步拓宽发展空间、保持现有市场竞争优势、抓住移动互联网终端市场快速增长的机遇，公司需要从根本上解决公司发展中的资本不足问题，增强实力与跨国企业在上述目标市场进行竞争，发展和壮大民族CPU芯片产业。

本次发行募集资金投资项目全部围绕公司主营业务展开，是对公司现有业务的延伸、拓展和提升：公司CPU设计工艺全面从0.18 μm 升级到0.13 μm /65nm/55nm，CPU主频大幅提升；技术改造后的便携消费电子CPU芯片将集成GPS基带IP核并增强多媒体功能，便携教育电子CPU芯片将集成公司自主研发的EPD显示控制器IP核；此外，公司还将研发面向智能手机、MID、上网本、平板电脑等产品领域的XBurst2 CPU芯片及配套软件平台等。根据公司的发展规划，本次募集资金投入使用后，公司的研发实力、自主创新能力和发展空间将实

现质的飞跃。

二、募集资金项目概述

（一）便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目

1、项目概要

本项目主要针对便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片的市场需求和技术发展趋势，在公司已推出的便携消费电子CPU芯片基础上进行技术升级与改造，拟采用0.13 μm /65nm技术工艺，集成GPS基带IP核，研究开发多媒体性能更强、适用于便携消费电子产品的嵌入式CPU芯片，并配套高清PMP解决方案、GPS解决方案和基于MiniOS/Linux的软件平台，实现新一代便携消费电子CPU芯片的产业化。

2、项目可行性分析

（1）市场前景广阔

2009年，我国便携消费电子CPU芯片的销售量达到3,982.8万颗，销售额为117,389.6万元。预计未来五年，国内便携消费电子CPU芯片的销售额年均复合增长率为10.5%，到2014年，国内市场的销量将达7,888.2万颗，销售额接近20亿元，内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）市场容量与行业发展前景”。

在快速发展的便携消费电子CPU芯片市场中，一方面主流PMP产品将从目前标清视频播放升级到高清视频播放，逐步融合摄像、GPS导航、移动电视、无线连接等功能。市场需求的变化要求CPU芯片进行升级换代向多格式高清、更高集成度和更高工艺的方向发展，从而创造新的市场空间。另一方面，随着我国汽车GPS安装率的提高以及手机GPS导航市场的兴起，未来五年，我国PND芯片市场将保持更快的发展速度，销售额年均复合增长率将达13.7%，销售量将从2010年的2,360.6万颗增长至2014年的4,471.7万颗（数据来源：CCID）。

（2）公司市场竞争优势明显

国内便携消费电子CPU芯片市场的主要参与者有公司、三星半导体、瑞芯微、

凌阳科技、飞思卡尔、SiRF、Marvell等企业。关于主要竞争对手的内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（五）主要竞争对手简介”。基于自主创新的嵌入式CPU技术，公司自主研发了高性能、超低功耗的CPU内核与多媒体引擎，在成本与低功耗上具备明显的竞争优势。凭借产品较高的性价比，公司现已成为国内便携消费电子CPU芯片市场的领先者之一。根据CCID的统计，2009年按销售量计算，公司以14.1%的市场份额排名第二，按销售额计算，公司以11.6%的市场份额排名第三。随着新一代便携消费电子CPU芯片的推出，凭借公司较好的产业化经验和客户基础，本项目有助于巩固公司在便携消费电子CPU芯片市场的市场竞争优势，并进一步扩大市场份额。

（3）公司技术储备和保障

本项目是技术改造项目，公司在原有芯片基础上进行升级改造，公司已积累了丰富的嵌入式CPU芯片设计经验，且已基本实现了PMP、移动电视、GPS整体解决方案和支持多操作系统的软件平台。目前，公司在便携消费电子CPU芯片及解决方案的研发技术储备较为充分。结合已有的技术储备以及后期的研发投入，本项目实施的技术风险小，技术可行性高。

3、项目建设内容

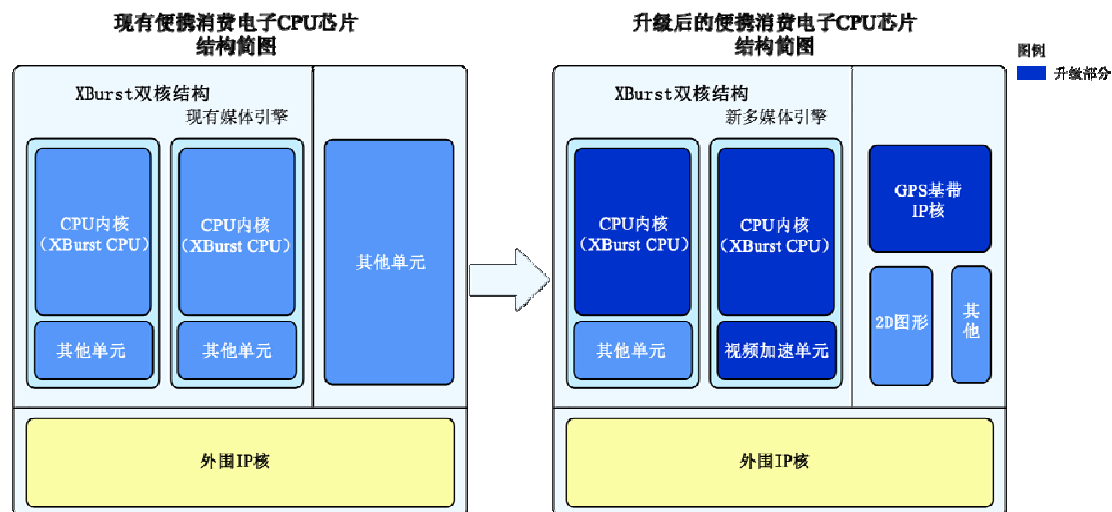
公司拟组建多个专项项目组，在已推出的JZ4755芯片基础上进行技术升级与改造，将工艺技术由0.18 μm 提升至0.13 μm /65nm、将双核CPU主频由400MHz提高到600MHz~1GHz、支持多媒体指令集XBurst SIMD2、支持720P高清解码，在工艺、性能提升的同时降低功耗；集成GPS基带功能；提供包括面向高清PMP与GPS导航的整体解决方案、基于MiniOS/Linux的嵌入式软件平台，与新的便携消费电子CPU芯片相配套。

本项目拟研发的升级产品与现有产品的比较如下：

项 目	升级产品	现有产品 JZ4755
CPU 主频	600MHz~1GHz	400MHz
视频解码能力	多格式 720P	MPEG4 720P
GPS 基带 IP 核	有	无
工艺技术	0.13 μm /65nm	0.18 μm

GPS 解决方案	无需 GPS 基带芯片	外围需 GPS 基带芯片
----------	-------------	--------------

公司便携消费电子CPU芯片升级前后结构简图如下：



4、项目投资概算

本项目总投资8,721万元，具体投资构成如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	占比
1.工程费用	390	4.47%
1.1 设备购置	390	4.47%
2.工程建设其他费用	5,944	68.15%
2.1 办公场地租赁费	386	4.43%
2.2 办公场地装修费	166	1.90%
2.3 办公家具购置费	8	0.09%
2.4 软件购置费	539	6.18%
2.5 开发费用	4,815	55.21%
2.6 可行性研究费用	30	0.34%
3.预备费	633	7.26%
4.铺底流动资金	1,754	20.12%
投资总额	8,721	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括工作终端及显示器、服务器、笔记本电脑、开发用PC机、打印机、路由器、FPGA开发测试板、全制式数字电视卡、普通示波器、高速示波器、频谱分析仪、多系统GPS信号模拟器、HDMI协议分析仪等。

本项目自用软件包括电路设计软件、仿真工具、综合工具、后端布局布线工

具、Windows XP操作系统、办公软件、服务器OS等。

5、项目的建设时间和产业化措施

（1）建设时间

本项目建设期2年。

（2）产业化措施

①与晶圆制造企业和封装测试企业建立长期合作伙伴关系

本项目将采用先进的0.13 μm /65nm技术工艺。公司已与中芯国际、安靠公司、通富微电等著名晶圆制造企业和封装测试企业建立了长期合作伙伴关系。上述专业代工企业可在产能、交货时间及价格等方面满足公司经营要求。

②加强销售与技术支持网络

公司已在北京和深圳分别建立销售与技术支持团队，就近市场提供销售与技术支持服务。随着高清PMP、移动电视市场的快速增长及在游戏机、GPS市场份额的扩大，公司将在上述两地着重加强对便携消费电子市场的支持力度。

6、项目实施管理、劳动定员及人员培训

（1）项目实施管理

本项目实施采取建立专项项目组的方式进行管理，将成立多个项目小组，专门从事该项目的技术升级改造工作，采用ISO9001规范进行开发过程管理和产品测试。公司将提供良好的开发环境和开发条件并确保项目开发所必须的人力、物力和资金投入。按照管理目标责任制和科学规范的管理程序，确保项目平稳推进，顺利实施。

（2）人力资源配置

本项目需要新增项目人员共计54人。建设期第一年项目需要新增38人，第二年需要新增16人。

（3）人员培训

人员培训由公司行政部负责，新员工必须接受上岗培训。培训内容主要包括ISO9001过程、项目管理、SoC设计、前后端EDA工具使用、视音频编解码技术、XBurst CPU技术及CPU芯片架构、Linux操作系统与驱动程序、版本管理工具的使用（SVN）、测试规范与Test Link的使用、相关开发工具使用、相关开发语言、

开发规范等。

7、环保问题及采取的措施

本项目不会产生废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。本项目业经北京市海淀区环境保护局审查批准，并出具了《关于对北京君正集成电路股份有限公司便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0211号）。

8、投资项目的选址

本项目规划拟在北京市海淀区中关村软件园区内租赁办公场所实施。项目新增场地面积约1,380平方米，其中项目办公场地1,080平方米，实验场所300平方米。

9、项目的经济效益分析

序号	指标	数据	备注
1	年均增量销售收入（万元）	8,330.68	按项目实施后的前5年平均
2	利润总额（万元）	2,215.23	按项目实施后的前5年平均
3	年均净利润（万元）	1,642.55	按项目实施后的前5年平均
4	税后内部收益率（%）	32.02	-
5	税后静态投资回收期（年）	3.77	-
6	投资利润率（%）	22.38	-

（二）便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目

1、项目概要

本项目主要针对便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片的市场需求和技术发展趋势，在公司已推出的便携教育电子CPU芯片JZ4750基础上进行技术改造，拟采用0.13 μ m/65nm技术工艺研发，提升CPU性能、集成自主研发的EPD显示控制器IP核，并配套电子书整体解决方案和基于Linux的嵌入式软件平台，实现新一代便携教育电子CPU芯片的产业化。

2、项目可行性分析

（1）市场前景广阔

近年来，中国已成为全球便携教育电子产品最大的生产国与消费国，国内便携教育电子市场的快速增长带动了相关嵌入式CPU芯片市场的高速增长。随着具有环保、节能、友好用户界面的新型教育电子产品的不断推出，教育电子产品将继续保持快速增长的态势，特别是电子书市场，销量呈井喷式增长。根据CCID的数据，2009年我国面向便携教育电子市场的嵌入式CPU芯片销售量已达到680.6万颗，销售额为12,087.8万元。预计未来五年，该市场的销售量年均复合增长率为39.1%；到2014年，该市场的销售额将达110,189.9万元，销售量将达3,542.7万颗，其中，电子书CPU芯片销售额将达94,382.2万元，具体详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）市场容量与行业发展前景”。

为了满足上述日益增长的市场需求和发展趋势，公司启动本项目拟采用更加先进的技术工艺对原有嵌入式CPU芯片进行技术改造。公司新的教育电子产品CPU芯片将从单核升级到双核CPU架构，主频更高，并集成EPD显示控制器IP核，既面向电子书市场，也面向学习机、点读机等其他教育电子市场，不仅CPU处理能力得到大幅增强，同时为用户节省了一颗昂贵的EPD显示控制芯片，降低了终端电子产品的整机成本。

（2）公司市场竞争优势明显

在国内，便携教育电子CPU芯片市场的主要竞争者是公司、安凯技术、凌阳科技、三星半导体、飞思卡尔、Marvell等企业。关于主要竞争对手的内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（五）主要竞争对手简介”。目前，不论是在传统的数码学习机、点读机、电子词典领域，还是新兴的电子书领域，市场均被本土芯片企业主导。

公司从2007年开始进入便携教育电子CPU芯片市场，凭借着较高的产品性价比，公司产品迅速获得客户的认可。按销售额计算，根据CCID的统计，2009年公司在国内学习机CPU芯片、点读机CPU芯片、电子词典CPU芯片的市场份额分别为51.6%、44.3%、6.2%，分别排名国内市场第一、第一、第三。对于新兴的电子书CPU芯片市场，2009年公司市场份额以80.5%的绝对优势排名国内市场第一，领先于飞思卡尔、三星半导体等国际企业。

（3）公司技术储备和保障

本项目研发的芯片产品需要设计一个EPD显示控制器IP，CPU内核将在成熟的双核CPU IP核的基础上进行升级，采用先进的0.13 μm /65nm技术工艺进行设计。

在先进工艺设计上，公司已积累了丰富的物理实现经验，同时，公司已为本项目做了相关技术储备，并基于JZ4750芯片实现了支持多操作系统的软件平台。

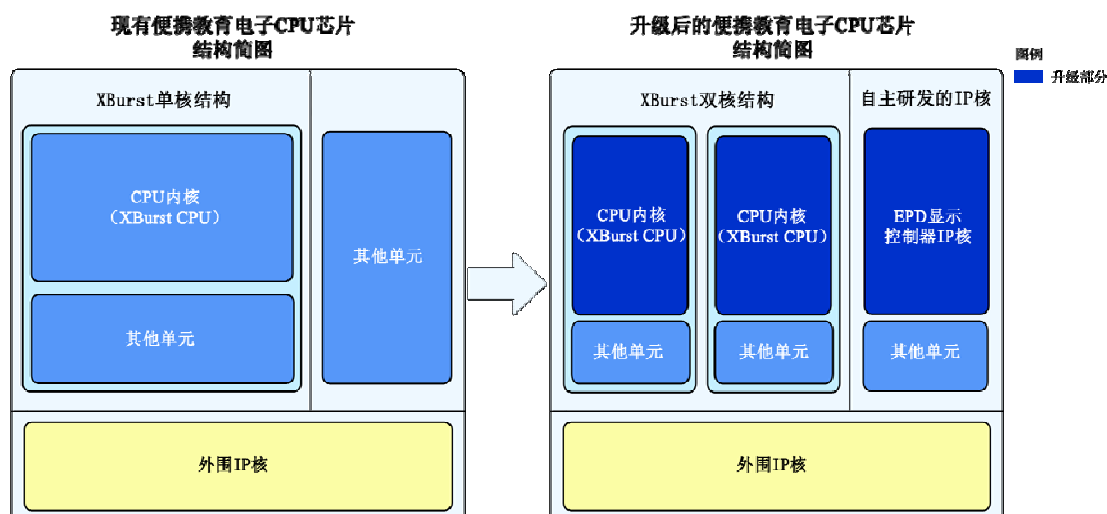
3、项目建设内容

公司拟在已推出的JZ4750芯片的基础上进行技术升级与改造，将工艺技术由0.18 μm 提升至0.13 μm /65nm、将CPU架构由单核升级为双核、将每个CPU主频由400MHz提高到600MHz~1GHz，在工艺、性能提升的同时降低功耗；将EPD显示控制器IP核集成到CPU芯片内，直接驱动EPD显示屏；提供包括面向电子书阅读器的整体解决方案和针对所有便携教育电子产品的嵌入式软件平台在内的平台式解决方案，实现产业化。

本项目拟研发的升级产品在性能和解决方案方面和现有产品的比较如下：

对比项目	升级产品	现有产品 JZ4750
CPU 主频	600MHz~1GHz	400MHz
CPU 架构	XBurst, 双核	XBurst, 单核
EPD 显示控制器 IP 核	有	无
工艺技术	0.13 μm /65nm	0.18 μm

公司便携教育电子CPU芯片升级前后结构简图如下：



4、项目投资概算

项目总投资8,165万元，具体投资构成如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	占比
1.工程费用	251	3.08%
1.1 设备购置	251	3.08%
2.工程建设其他费用	5,768	70.64%
2.1 办公场地租赁费	353	4.32%
2.2 办公场地装修费	151	1.85%
2.3 办公家具购置费	7	0.09%
2.4 软件购置费	536	6.56%
2.5 开发费用	4,690	57.45%
2.6 可行性研究费用	30	0.37%
3.预备费	602	7.37%
4 铺底流动资金	1,544	18.91%
投资总额	8,165	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括工作终端主机、工作终端显示器、服务器、笔记本电脑、开发PC机、打印机、路由器、FPGA开发测试板、高速示波器、逻辑分析仪和DDR/DDR2协议分析仪等。

本项目自用软件包括电路设计软件、仿真工具、综合工具、后端布局布线工具、Windows XP操作系统、办公软件、服务器OS等。

5、项目的建设时间和产业化措施

（1）项目建设期

本项目建设期2年。

（2）产业化措施

相关的详细内容请详见本节“二、募集资金项目概述”之“（一）便携式消费电子电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”之“5、项目的建设时间和产业化措施”。

6、项目实施管理、劳动定员及人员培训

本项目需要新增项目人员共计48人。建设期第一年需要人员投入36人，第二

年需要投入12人。在项目的实施管理与人员培训方面与便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目一致。

7、环保问题及采取的措施

本项目不会产生废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。本项目业经北京市海淀区环境保护局审查批准，并出具了《关于对北京君正集成电路股份有限公司便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0212号）。

8、投资项目的选址

本项目规划拟在北京市海淀区中关村软件园区内租赁办公场所实施。项目场地面积约1,260平方米，其中项目办公场地960平方米，实验室300平方米。

9、项目的经济效益分析

序号	指标	数据	备注
1	年均增量销售收入（万元）	7,642.12	按项目实施后的前5年平均
2	利润总额（万元）	2,015.93	按项目实施后的前5年平均
3	年均净利润（万元）	1,494.15	按项目实施后的前5年平均
4	税后内部收益率（%）	31.38	-
5	税后静态投资回收期（年）	3.81	-
6	投资利润率（%）	21.69	-

（三）移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目

1、项目概要

本项目拟基于自主研发的第二代XBurst CPU技术——XBurst2 CPU技术，开发具备多核CPU、强大多媒体引擎、3D图形引擎和丰富外围接口的CPU芯片，应用于Android操作系统的智能手机、平板电脑、MID等移动互联网终端设备。

本项目拟开发的用于移动互联网终端设备的CPU芯片，主要技术指标和核心技术如下：

项目	技术指标/核心技术
XBurst2 CPU 内核	①主频：1GHz ②微体系结构：8级流水线 ③缓存：具备二级缓存 ④具备浮点运算单元
多媒体处理能力与音视频接口	①1080P 高清解码 ②支持多种主流视频文件封装格式 ③支持多种主流音频格式 ④内置摄像头输入接口，支持 1,600 万像素摄像头输入 ⑤内置 LCD Controller，支持 1024×768 分辨率液晶屏的输出接口 ⑥内置高精度音频 Codec 和音频 ADC/DAC
3D 图形处理器（GPU）性能	①支持 OpenGL 和 OpenVG ②支持每秒 2 千万个三角形的处理能力
内存子系统	①支持 16/32 位 SDRAM、Mobile SDRAM、DDR2 SDRAM ②支持 SLC/MLC Nand Flash，支持 24 位 ECC 校验
外围可扩展能力	①含有 USB、SPI、SDIO、UART 等多种片上接口 ②支持 Ethernet、Wi-Fi/WAPI 等网络连接 ③支持多种数字电视或广播标准 ④支持多种 2G/3G/LTE 移动通信标准及其演进技术

2、项目可行性分析

（1）项目背景

①市场容量与增长率

2009年，我国移动互联网CPU芯片市场规模达到7,000万颗，销售额达到62.5亿元，年均复合增长率达到39.1%。根据CCID的预测，未来五年内，随着智能手机、MID、平板电脑等产品的爆发式增长，我国移动互联网CPU芯片市场销售额仍将保持快速增长态势，年均复合增长率将保持在35.4%。到2014年，市场规模将达到35,000万颗，销售额达到277.3亿元，内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）市场容量与行业发展前景”。

②技术发展趋势

智能手机及其它移动互联网CPU芯片技术呈现以下发展趋势：

A、提高芯片集成度。随着智能手机及其他移动互联网终端产品功能的不断提高，CPU、多媒体、3D图形、GPS、移动电视、多种高速接口等皆要集成到单

颗芯片，以简化终端设计并减少整机成本。

B、低功耗。由于移动设备电池容量有限，在增强性能和功能的同时为保证终端产品的续航时间，要求处理器芯片必须在低功耗技术方面有新的进展。

C、多操作系统平台支持。国内应用于智能手机的操作系统主要有Symbian、Windows Mobile、Linux、Android和中国移动的OMS。Android作为新兴的开源系统，已得到全球越来越多终端厂家的支持。

③国内芯片厂商介入该市场的条件已经成熟

面对迅速增长的智能手机和MID市场，国内众多手机方案提供商、手机生产企业、PMP生产企业已经进入或准备进入这个领域，对这些企业而言，直接采用市场上主流的智能终端方案都会面临开发费用高、设计难度大的难题，迫切需要国内CPU芯片企业提供能减小研发成本和风险的移动互联网终端解决方案。此外，国内3G网络正在加速建设，且TD-SCDMA终端基本由国内生产企业主导，为国内CPU芯片企业也提供了极好的发展契机。目前公司进入移动互联网CPU芯片市场的技术条件和产业化基础已经具备。

（2）市场竞争分析

①主要竞争者及优劣势

目前，移动互联网终端CPU芯片已成为全球半导体产业的热点和新的业务增长点。市场主要的参与者包括Intel、三星半导体、德州仪器、Marvell、意法半导体、高通等欧美日韩大公司，以及联发科、海思等国内企业。关于主要竞争对手的内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（五）主要竞争对手简介”。

欧美日韩企业进入移动互联网终端CPU芯片领域早，凭借多年的产品开发经验，在技术先进性和产品性能上有较强的竞争力，在诺基亚、三星、索尼爱立信等国际终端生产企业中占据统治地位。而以联发科、海思为代表的国内芯片企业则在成本和服务上有明显的优势，可以帮助国内终端企业大大降低整机研发和软件设计的门槛，更容易在国内市场获得客户的认可。

②公司实施本项目的优势

在国内智能手机市场，公司的主要竞争对手将是三星半导体、MTK及其他注重性价比和本土服务的国内企业。作为移动互联网终端CPU芯片市场的后来

者，公司在品牌、影响力方面与先入者有一定差距，但在技术产品、市场策略等方面拥有独到的优势。

在技术方面，公司拥有自主创新的XBurst CPU技术，在低功耗和低成本方面达到国际领先水平，而主要国内竞争对手均需从ARM直接购买CPU内核，部分还从第三方购买DSP核和多媒体硬核。

在产品方面，公司在核心技术方面的突破使公司产品拥有明显的性价比优势和低功耗优势，并且避免了都使用ARM CPU内核造成的产品同质化问题。

在市场推广方面，公司凭借丰富的软件平台开发经验，将为本项目提供支持Linux、Android多种操作系统的软件平台。

（3）技术保障

本项目的主要开发工作是将XBurst CPU内核升级为XBurst2 CPU内核，并增强部分多媒体处理能力和3D图形处理能力。公司目前已开始XBurst2 CPU技术及其相关配套技术的预研工作。结合已有的技术储备，本项目实施过程中技术风险较小，技术可行性较高。

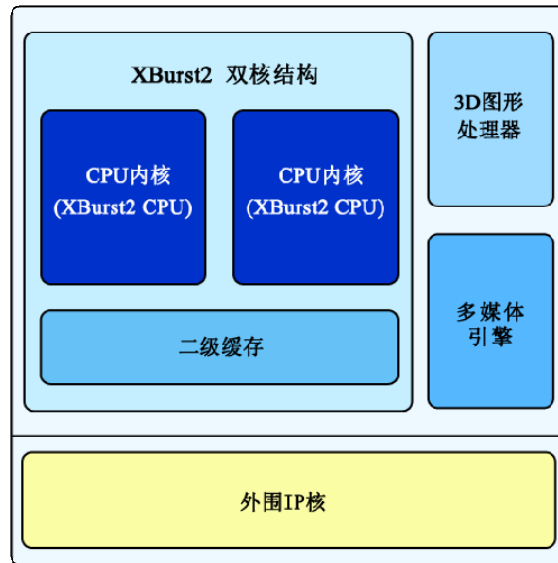
3、项目建设内容及技术创新点

本项目将研发应用于移动互联网终端的嵌入式CPU芯片和Android智能手机/MID平台，并实现产业化。项目创新点主要包括：

（1）XBurst2 CPU内核的实现

本项目的移动互联网CPU芯片将采用公司自主研发的32位XBurst2多核CPU微体系架构，使用超标量技术，具有二级高速缓存和浮点运算单元，芯片主频高达1GHz。本项目实现的XBurst2 CPU内核，具有双发射流水线，有效提高CPU的性能和多媒体性能。本项目设计的XBurst2 CPU内核将具备业内领先的低功耗优势和低成本优势，基于该CPU内核的移动互联网终端CPU芯片结构简图如下：

移动互联网终端CPU芯片
结构简图



（2）高性能3D图形处理器的实现

本项目在加强多媒体性能的同时，将3D图形处理器IP核应用到移动互联网终端CPU芯片中，该图形处理器具有高性能、低功耗、低成本的特点，支持OpenVG和OpenGL ES 2.0/1.1图形标准，支持每秒2千万个三角形的处理能力。该图形处理器采用创新的体系结构，使得芯片面积比同类芯片节省30~45%的面积。由于采用超低功耗的微体系结构和频率变换技术，该图形处理器具有超低的功耗水平。

（3）65nm/55nm超高工艺芯片设计技术

本项目采用65nm/55nm超高工艺进行芯片设计，相比于公司目前采用的0.13 μm 工艺，采用65nm/55nm工艺将大幅降低功耗并减小硅片面积，并且可以使XBurst2 CPU的主频从600MHz提升至1GHz。此外，本项目将利用多电压电源预管理技术和Power Switch技术，尽量减少由于工艺的提升带来静态漏电加大、信号完整性等的负作用。

（4）基于Android操作系统的智能手机平台

本项目设计的CPU芯片具有灵活的可配置架构和丰富的外部设备接口，将集成多个USB、SPI、UART、SDIO及TS接口以便轻松连接外部各种系统和设备。

硬件方面，本项目将针对智能手机和MID应用研制一个硬件平台，支持TD-SCDMA、WCDMA、CDMA等2G/3G/LTE基带通信模块，并灵活外接

Wi-Fi/WAPI、GPS、FM收音机以及手机电视等功能。

软件方面，本项目将把Android软件平台移植到本处理器芯片，主要的研究内容包括Android操作系统内核、系统基本库及外部设备驱动的移植开发，有关多媒体应用程序的优化和网络浏览器、JAVA虚拟机、电子邮件客户端、文字处理应用、多媒体播放等多种智能手机应用程序的移植和优化。

4、市场开发策略

（1）发展新的经销商

公司仍将秉承以往的市场策略，针对市场需求，结合国内移动互联网终端产业的特点，发展专注于移动互联网终端、具有丰富行业经验的新经销商，并建立长期合作伙伴关系，协助公司在新领域的市场开拓。

（2）加强销售与技术支持网络

公司已在北京与深圳分别建立销售与技术支持团队。随着智能手机市场和MID市场的开拓，公司除在北京、深圳增加面向智能手机/MID市场的工程师和市场人员外，将在上海设立一个分支机构，以就近支持长江三角洲的手机厂商和手机方案设计公司。

（3）提供市场上性价比最佳的智能手机/MID平台

近年来，在国内便携消费电子、便携教育电子领域，公司从市场追随者迅速成为市场领导者，其关键因素在于坚持向市场提供性价比最佳的平台化解决方案。在移动互联网终端领域，公司将继续贯彻此策略。

其他内容详见本节“二、募集资金项目概述”之“（一）便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”之“5、项目的建设时间和产业化措施”。

5、项目投资概算

项目总投资12,387万元，具体投资构成如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	占比
1.工程费用	619	5.00%
1.1 设备购置	619	5.00%
2.工程建设其他费用	7,990	64.50%
2.1 办公场地租赁费	448	3.62%

2.2 办公场地装修费	192	1.55%
2.3 办公家具购置费	10	0.08%
2.4 软件购置费	754	6.09%
2.5 开发费用	6,556	52.93%
2.6 可行性研究费用	30	0.24%
3. 预备费	861	6.95%
4 铺底流动资金	2,918	23.55%
投资总额	12,387	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括工作终端主机、工作终端显示器、服务器、笔记本电脑、开发PC机、打印机、路由器、FPGA开发测试板、EMC测试设备、高速示波器、手机综测仪、手机测试电源、手机信号模拟器、手机测试屏蔽盒和信号分析仪等。

本项目自用软件包括电路设计软件、仿真工具、综合工具、后端布局布线工具、Windows XP操作系统、办公软件、服务器OS等。

6、项目的建设时间

本项目建设期2年。

7、项目实施管理、劳动定员及人员培训

本项目新增开发人员共计65人。建设期第一年新增开发人员45人，第二年新增20人。在项目实施管理方面与消费电子用多媒体处理器技术改造项目相同，在人员培训方面增加Android操作系统与驱动程序的培训。

8、环保问题及采取的措施

本项目不会产生废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。本项目业经北京市海淀区环境保护局审查批准，并出具了《关于对北京君正集成电路股份有限公司移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0213号）。

9、投资项目的选址

本项目规划拟在北京市海淀区中关村软件园区内租赁办公场所实施。项目新增场地面积约1,600平方米，其中项目办公场地1,300平方米，实验室300平方米。

10、项目的经济效益分析

序号	指标	数据	备注
1	年均增量销售收入（万元）	12,263.19	按项目实施后的前5年平均
2	利润总额（万元）	3,856.05	按项目实施后的前5年平均
3	年均净利润（万元）	2,800.12	按项目实施后的前5年平均
4	税后内部收益率（%）	31.47	-
5	税后静态投资回收期（年）	3.81	-
6	投资利润率（%）	28.00	-

（四）研发中心建设项目

1、项目概要

为了跟踪研发集成电路设计行业基础性、前沿性技术及应用技术，公司将建设研究中心。

（1）进一步突破关键技术

嵌入式CPU技术：公司将在XBurst/XBurst2的基础上，继续研究微体系结构、多发射、多核、低功耗等下一代高性能CPU涉及的核心技术，配合45nm、32nm等更先进工艺不断提升CPU性能，为公司各种CPU芯片提供业内领先的CPU内核，提升公司的核心竞争力。

多媒体处理技术：公司研发中心将继续沿着XBurst多媒体处理技术软硬结合的思路提升多媒体处理能力，支持多格式1080P编解码，为公司各种CPU芯片提供高性能创新的多媒体引擎IP核。

（2）扩展研究领域及应用领域

本项目公司研发中心重点研究自主的嵌入式CPU技术、多媒体处理技术与图形处理技术。随着研发中心规模的扩大与相关人才的积累，公司将逐渐把混合信号处理技术纳入进来，为公司各种芯片提供更多的关键IP核并提高未来芯片的集成度。

随着公司产品线的扩张和多媒体能力的提升以及基于新一代嵌入式CPU技术的处理器的面世，公司产品还将进入更加广泛的应用领域。

本项目建成后，能够满足公司在未来3年内保持具有市场领先优势的CPU核

心技术的要求。

2、项目建设内容

本项目拟建设研发中心，包括IC研究部和平台开发部。IC研究部下设CPU研究室、多媒体研究室、图形处理研究室、环境适应性实验室、信号完整性实验室、测试验证实验室等，主要负责新技术的跟踪研究和核心IP的系统设计。平台开发部下设Android平台部、Linux平台部等，主要负责针对XBurst架构的系统软件移植/优化和软件开发工具的研制。

研发中心的主要研发内容包括：

- （1）在第一代XBurst CPU技术基础上，研发XBurst2 CPU技术，并基于XBurst2 CPU技术进行高性能、低功耗CPU内核的系统结构设计和前端逻辑设计；
- （2）研发XBurst多媒体技术，并进行自主创新多媒体处理器的系统结构设计和前端逻辑设计；
- （3）研发65nm/55nm工艺技术下高性能CPU和SoC芯片测试与验证方法；
- （4）研发基于XBurst2架构的Android/Linux软件平台；
- （5）研发基于XBurst2架构的集成开发环境。

3、关键技术

本项目涉及的关键技术如下：

- （1）基于XBurst2 CPU技术的CPU内核

XBurst CPU内核已经应用于公司JZ47xx系列CPU芯片中，获得市场广泛认可。在本项目中，研发中心拟在XBurst CPU内核的基础上，进一步研发XBurst2 CPU内核。XBurst CPU内核与XBurst2 CPU内核的区别如下：

比较项目	XBurst CPU 内核	XBurst2 CPU 内核
指令集架构	RISC+SIMD	RISC+SIMD+浮点
微体系结构	单发射，顺序执行	双发射，乱序执行
高速缓存	一级缓存	二级缓存
多核技术	单核、双核	双核、三核、四核……

XBurst2 CPU内核的主要特点为：

- ① 微体系结构方面：采用超标量技术，实现双发射流水线和乱序执行，有

效地提高指令执行的并行性；

- ② 支持二级缓存；
- ③ 支持多核处理。

（2）先进的XBurst多媒体技术

目前业界常用的多媒体解码技术，主要为“CPU+DSP”的软解码模式和ASIC硬解码模式。前者构架总体成本较高、功耗较大、在多媒体能力扩展方面的开发相对困难、编程复杂且开发周期长；后者不支持多种制式的媒体处理，灵活性较差，无法满足互联网应用对多媒体格式兼容性的要求。

公司面向移动互联网设备与多媒体领域，结合XBurst CPU的优势，推出了自主创新的XBurst多媒体技术。XBurst多媒体技术包括以下几方面的内容：

- ① 一套面向多媒体加速的SIMD指令集，有效地对视频编解码算法进行加速；
- ② 可配置的视频codec加速器：DCT/IDCT、Motion Composition、Motion Estimation、Deblock、CSC & Resize等，针对所有格式的编解码；
- ③ 专门的Codec硬件加速器。

公司现有研发部门基于XBurst多媒体技术完成了多媒体引擎的设计，并应用于JZ47xx系列CPU芯片中，获得市场广泛认可。本项目将在原有多媒体引擎的基础上继续优化系统结构与电路，进一步提升多媒体编解码能力，增强多媒体引擎对高清分辨率、多格式、高码率等方面的支持。

（3）Android/Linux软件平台

综合市场因素与技术因素，公司先后选择了Linux和Android操作系统作为开放平台的软件基础。Linux平台主要是面向教育电子、消费电子、POS机、安防、医疗电子等嵌入式领域，Android平台主要是面向移动互联网终端和消费电子产品。

经过近年的系统软件研发，公司现有研发部门已将Android、Linux等操作系统、驱动程序、底层软件及部分应用程序成功移植到XBurst CPU架构。在本项目中，研发中心将在此基础上将Android、Linux系统平台移植到XBurst2 CPU架构上，并定时根据操作系统版本进行系统维护和系统升级。公司现有软件平台技术和待开发的软件平台技术比较如下：

比较项目	已有的软件平台技术	将开发的软件平台技术
CPU 架构	XBurst, 单核/双核	XBurst2, 多核
Android 操作系统版本	1.5	2.0、2.1……
Linux 操作系统版本	2.6.24	2.6.30……

本项目拟重点解决的问题包括Android操作系统内核、系统基本库及外部设备驱动等的移置开发和网络浏览器、JAVA虚拟机、电子邮件客户端、文字处理应用等多种应用程序的移植、优化和开发。由于Android多媒体应用程序功能较弱，公司还将重点移植、优化在Android平台的多媒体播放等应用程序。凭借在移动多媒体领域的积累，公司将把经PMP验证过的多格式多媒体、移动电视、电子书等功能移植到Android平台。

4、项目投资概算

项目总投资3,388万元，具体投资构成如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	占比
1.工程费用	617	18.21%
1.1 设备购置	617	18.21%
2.工程建设其他费用	2,404	70.94%
2.1 办公场地租赁费	246	7.27%
2.2 办公场地装修费	211	6.23%
2.3 办公家具购置费	11	0.32%
2.4 软件购置费	746	22.02%
2.5 提前进场准备费	1,124	33.17%
2.6 可行性研究费用	30	0.89%
2.7 研讨及咨询费	20	0.59%
2.8 知识产权登记费用	15	0.44%
3.预备费	302	8.91%
4 铺底流动资金	66	1.94%
投资总额	3,388	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括工作终端主机、工作终端显示器、服务器、笔记本电脑、开发PC机、打印机、路由器、复印机、FPGA开发测试板、网络分析仪、普通示波器、高速示波器、逻辑分析仪、音频分析仪和视频分析仪等。

本项目自用软件包括电路设计软件、仿真工具、综合工具、Windows XP操

作系统、办公软件、服务器OS等。

5、项目的建设时间

本项目建设期1年。

6、项目实施管理、劳动定员及人员培训

本项目需要新增人员共计73人，其中研发中心负责人1名，IC研究部39人，平台开发部33人。项目实施管理与消费电子用多媒体处理器技术改造项目一致，在人员培训方面，增加对XBurst CPU及处理器芯片架构培训、版本管理工具的使用（SVN）、测试规范与Test Link的使用等方面的培训。

7、环保问题及采取的措施

本项目不会产生废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。本项目业经北京市海淀区环境保护局审查批准，并出具了《关于对北京君正集成电路股份有限公司研发中心建设项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0214号）。

8、投资项目的选址

本项目规划拟在北京市海淀区中关村软件园区内租赁办公场所实施。项目新增场地面积约1,760平方米，其中项目办公场地1,460平方米，实验室300平方米。

9、项目的经济效益分析

本项目为其他项目提供基础技术支撑，经济效益体现在具体产品研发项目中，本项目并不直接产生经济效益。

（五）其他与主营业务相关的营运资金

1、营运资金的必要性

（1）充足的营运资金为公司主营业务进一步开展提供强大支持

为巩固和保持在嵌入式CPU芯片及配套软件平台的技术领先优势及市场地位，公司拟在未来三年大力研发XBurst2超标量多核CPU技术，研制面向不同应用的多种低功耗、高性能嵌入式CPU芯片及其平台式解决方案，改善和优化研发

体系、销售体系和管理流程，同时积极开拓国际市场，把国产自主创新CPU技术推广到更多的国家和领域。在业务发展过程中，公司需要保证充足的运营资金支持上述发展计划。此外，公司在市场培育、开发过程中，通常采用技术引导、产品引导等多种方式，在巩固与长期合作客户的战略伙伴关系基础上，不断拓展产品的应用领域，开发新客户，该过程也需要公司维持充足的运营资金。

另一方面，随着客户需求及经济状况的不断变化，在为公司提供新的发展机会的同时，也可能带来业务占用资金等不利影响，因此，公司拥有充足的营运资金不仅可以避免因资金短缺而失去发展机会，同时也可以防范因资金短缺而出现的经营困难，为公司主营业务的可持续发展提供支持。

（2）充足的营运资金是公司应对市场竞争和变化的保障

目前，中国正逐渐成为全球集成电路产业最重要的市场之一，在此过程中，该市场的竞争将愈加激烈。公司在巩固现有领域的市场份额的同时，将不断向市场空间更大、竞争对手更强的移动互联网终端应用领域和其他高端领域拓展，因此公司除了继续保持在产品技术、贴近市场、生产成本、客户服务等方面的优势外，必须拥有充足的营运资金应对市场竞争。

2、对投入的与主营业务相关的营运资金管理安排

公司将严格按照募集资金专项管理制度等规定对营运资金进行管理。具体使用过程中，将根据公司业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，保障和不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

三、固定资产投资和研发支出的必要性

（一）固定资产投资必要性分析

本公司四个募集资金项目中的固定资产投资分别为1,226.61万元、1,041.47万元、1,711.54万元和1,171.27万元，总计为5,150.89万元，资本性支出额较大。募集资金项目的固定资产投资较大的主要原因有：

1、研发实验室建设需要大量固定资产投入

对现有产品进行技术升级改造、开发新一代CPU内核技术、应用更高级别工艺的设计CPU芯片产品必须更新配备更完善的芯片设计工具环境，需要建设高等级的CPU研究室、多媒体研究室、图形处理研究室以及环境适应性实验室、信号完整性实验室、测试验证实验室和多种支持平台。构造上述设计环境和支持平台需要进行大量前期考察论证、配置大量的系统设备，要求公司必须进行较大的资本性投入。

2、新的研发内容和人员配置要求增加先进的研发设备

集成电路设计行业发展迅速，新开发的芯片技术层出不穷。设计技术与工艺的提高，要求相应的设计工具、研发设备必须相应地不断升级，才能满足集成电路设计行业的要求。长期以来，国内集成电路设计行业的整体技术水平远低于国际知名厂商，除起步晚之外，更重要的是没有强大的研发工具和实验条件。公司本次募集资金投资项目将涉及多核CPU技术、GPS基带接收技术、EPD显示控制技术、1080P高清解码处理技术、3D图形处理技术等多个领域，并将采用0.13 μm /65nm/55nm等先进工艺，一方面需要公司添置更先进的研发设备，另一方面也需要增加研发人员数量，势必要求公司在新产品研发过程中使用更多、更先进的开发设计软件工具、开发调试平台工具、测试设备等。

3、办公场所扩大需要固定资产投入

由于目前公司的经营场所于2008年租赁，经过一年多的发展，公司经营场所已经难以满足业务发展需要。随着业务规模的迅速发展、研发项目的增加、员工数量的快速增长，公司亟需扩大经营场所，改善实验条件和办公环境。

（二）研究开发支出的必要性

本公司四个募集资金项目中的研发支出分别为4,815.20万元、4,690.40万元，6,556.00万元和1,123.80万元，总计为17,185.40万元，研发支出金额较大。募集资金投向项目的研发支出较大的主要原因为：

1、产品持续更新换代要求公司加大产品研发支出

下游日益增长的市场需求推动着集成电路设计技术的快速发展。下游市场和终端用户对电子产品性能、功能、功耗的要求越来越高，促使集成电路设计企业不断加强研发、推动芯片产品持续升级换代，以满足下游市场的需求。公司现有产品主要应用于便携消费电子和便携教育电子，来自这两个领域的应用需求不断增长，要求公司对现有产品进行持续改进和投入，使产品系列更加完善、性价比更高。同时，公司将研发移动互联网终端CPU芯片，以拓展新的产品市场。由于市场竞争加剧，为巩固公司的市场竞争力，本次公司产品的更新换代必然会大幅增加产品研发支出。

2、技术发展要求公司加大技术研发支出

集成电路设计行业发展日新月异，新的技术和应用不断涌现。为保持在行业内的技术领先地位、提升核心竞争力，公司坚决重视研发力量建设、加大技术研发支出。本次募集资金投资项目中，公司拟实施的研发中心建设项目将研发新一代的XBurst2 CPU技术，以及多种软件平台；技术改造项目和新产品开发项目将大幅提升主频、增强多媒体引擎、加大集成度，并涉及到多核CPU技术、1080P高清视频处理技术、3D图形处理技术、低功耗和电源管理技术等多项新技术的应用。大量的技术研发、平台研发和技术应用需要公司投入大量的技术研发资金保障前期论证、配置研发人员、芯片流片和试制等工作顺利开展。

3、技术工艺的提升要求更多的研发投入

集成电路行业特点以及国外规模化集成电路设计企业发展事实表明，芯片技术工艺每提升一代，其研发投入将成倍增长。本次募集资金投资项目将采用更高级别的芯片技术工艺，由原来的0.18 μm 提升至0.13 μm /65nm/55nm，所需的研发投入大幅增加。

四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响

（一）募集资金运用对公司经营成果和财务状况的综合影响

公司本次募集资金拟投资四个项目，将有部分资金用于固定资产、其他资产及研发支出。募集资金投资项目实施后，公司相应折旧、摊销费用及研发支出也

将会上升，可能会给公司经营业绩带来一定的影响。

根据项目实施进度及公司会计政策，本次募集资金投资项目年新增折旧、摊销及研发支出情况如下：

单位：万元

项 目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
研发支出	4,749.18	5,817.68	2,206.18	2,206.18	2,206.18
固定资产折旧	804.92	1,011.05	1,011.05	1,011.05	1,011.05
其他资产摊销	514.94	514.94	514.94	514.94	514.94
增量费用合计	6,069.04	7,343.67	3,732.17	3,732.17	3,732.17
减：2009 年度研发投入	1,773.21	1,773.21	1,773.21	1,773.21	1,773.21
净增量费用	4,295.83	5,570.46	1,958.96	1,958.96	1,958.96
最近两年平均毛利率	55.86%	55.86%	55.86%	55.86%	55.86%
净增量费用盈利平衡点销售收入	7,690.35	9,972.18	3,506.91	3,506.91	3,506.91
其中：拟投资项目预计新增收入	2,591.34	13,676.50	39,407.22	52,516.40	32,988.50

从上表可以看出，项目实施第一年、第二年新增折旧、摊销及研发支出金额较大，实现盈亏平衡的新增销售收入分别为7,690.35万元、9,972.18万元。报告期内，本公司效益持续快速增长，2008年和2009年营业收入分别较上年增长了321.54%和32.71%，净利润分别较上年增长了809.13%和51.50%。根据募集资金投资项目可行性研究报告，项目实施后第一年新产品销售收入为2,591.34万元，按公司最近两年毛利率简单算术平均数55.86%计算，公司现有产品销售收入仅需新增5,099.01万元，较2009年增长26.53%即可消化第一年新增费用对公司损益的影响，确保公司营业利润不会因实施募集资金投资项目而下降；项目实施第二年起新产品将分别新增销售收入13,676.50万元、39,407.22万元、52,516.40万元和32,988.50万元，综合税后投资利润率均高于20%（企业所得税率按25%计算），足以抵销新增固定资产折旧及研发支出等成本费用。综上，本次募集资金投资项目年新增折旧、摊销及研发支出不会对公司经营业绩带来不利影响。

（二）净资产大幅增加将改善公司的财务状况

1、对净资产总额和每股净资产的影响

截至2010年6月30日，公司净资产为15,554.22万元，每股净资产为2.5924

元。募集资金到位后，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产大幅度增长，公司账面价值将显著上升。

2、对公司资产结构的影响

截至2010年6月30日，公司的资产负债率为16.61%。募集资金到位后，在公司负债总额不变的情况下，公司的资产负债率将明显下降，公司的资产结构得以优化，公司抗风险能力进一步提高。

（三）优化公司现有产品，保持公司盈利能力

公司目前的利润的主要来源为便携消费电子CPU芯片和便携教育电子CPU芯片。在集成电路设计行业，芯片技术日新月异，公司必须紧跟市场热点，及时在芯片产品中集成新的功能、提升产品性能。如果公司募投项目能成功实施，实现对公司的现有产品的升级换代，将对公司盈利能力产生积极影响。

（四）培育公司利润增长点，降低公司经营风险

本次募集资金的成功运用，将为公司拓展移动互联网应用领域创造积极的条件，移动互联网终端CPU芯片的产业化将形成公司新的利润增长点，丰富公司产品链，降低公司经营风险，增强公司的可持续发展能力。

（五）净资产大幅增长，净资产收益短期内下降

本次发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，短期无法产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内下降。待产品研发完成并推向市场，新产品的带来的利润将提升公司的净资产收益率。

第十一节 未来发展与规划

一、公司发行当年和未来三年的发展规划及发展目标

（一）公司发展战略

公司坚持“创新技术、自主研发”的技术战略和“开放平台、纵横扩展”的市场战略。在技术上，公司将进一步加大投入和持续进行技术创新，采用更加先进的工艺，研制国际领先的面向移动便携设备的新一代CPU技术。在市场上，充分发挥自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，巩固并加强公司产品在便携消费电子市场和便携教育电子市场的领先地位，抓住未来10年移动互联网的新兴产业机会，重点开拓移动互联网终端CPU芯片市场，逐步将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

（二）公司发展目标

1、整体发展目标

通过募集资金投资项目的顺利实施，公司将以全球领先、自主研发的XBurst CPU技术为基础，大力研发XBurst2超标量多核CPU技术，不断推进国产CPU在核心技术领域的突破；开发面向不同应用领域的多种低功耗、高性能CPU芯片及其平台式解决方案，进一步扩大公司产品在性价比和功耗方面的领先优势，巩固并加强公司产品在国内便携消费电子领域和便携教育电子领域的市场领导地位；充分利用公司通用开发平台的开放性，重点开拓以智能手机和平板电脑为代表的具有高成长性的移动互联网应用领域。通过不断完善和优化研发体系、销售体系和管理流程，积极开拓国际市场，将国产创新CPU技术推广到更多的国家和领域。

2、具体发展目标



公司市场路线图

在不同的市场领域，公司未来三年具体业务目标如下：

（1）便携消费电子CPU芯片领域：公司将在现有消费电子CPU芯片基础上进行技术改造，推出主频更高、多媒体性能更强、集成GPS基带功能的新一代芯片，在保持市场领先地位的同时，扩大在游戏机和GPS导航设备等领域的市场份额，并逐渐进入互联网电视这一新兴产业，进一步加强在国内便携消费电子领域的技术优势和市场领导地位。

（2）便携教育电子CPU芯片领域：公司将在现有便携教育电子CPU芯片基础上进行技术改造，推出主频更高、功耗更低、集成EPD显示控制器的新一代芯片，进一步扩大性价比和低功耗优势，保持在全球学习机和点读机领域市场第一的地位；扩大在全球电子书应用领域的市场占有率；进入学生电脑这一新兴的教育电子产品，丰富产品线，全面提升竞争力，将公司打造成全球领先的便携教育电子CPU芯片供应商。

（3）移动互联网终端CPU芯片领域：公司将基于XBurst2 CPU技术，研制用于移动互联网终端的、主频至少为1GHz的高性能多核CPU芯片，大力拓展智能手机和平板电脑市场，将公司打造为国内外领先的移动互联网终端CPU芯片供应商，并打破国外主流竞争对手在国际市场上对该领域的垄断。

(4) 其他细分市场：随着新型电子产品的不断研制和开发，32位嵌入式CPU前景广阔，公司将继续秉承“开放平台，纵横扩展”的市场推广策略，充分发挥公司在技术和产业化方面的优势，适时涉足新的应用领域，开辟新的利润增长点。

（三）实现发展目标的计划与措施

围绕公司的发展战略和发展目标，公司拟通过以下具体计划和措施来增强公司的成长性、自主创新能力和核心竞争优势。

1、研发中心建设计划

该计划旨在跟踪国内外嵌入式CPU基础性前沿技术及其发展趋势，研究XBurst2 CPU技术和可配置多媒体处理技术，为公司各种CPU芯片提供业界领先的核心IP的逻辑设计，并研制基于Android、Linux等多种操作系统的软件平台和开发环境。公司计划1年内建成包含IC研究部、平台开发部及多个实验室的研发中心，提升在核心技术和关键IP核技术的自主创新能力，巩固公司在这些核心技术上的领先优势，加强公司在行业内的领先地位。

2、技术研发计划

根据全球嵌入式CPU芯片最新的技术发展趋势、公司的产品定位和市场策略，公司在CPU、多媒体、图形、工艺等关键技术的未来发展路线如下：

(1) CPU技术：采用先进的多发射超标量技术、多核CPU技术和高速缓存技术研制第二代高性能XBurst2 CPU技术。XBurst2 CPU内核性能将与ARM最新的Cortex-A9持平，但功耗更低，面积更小，居世界领先水平。

(2) 多媒体处理技术：采用“SIMD指令集+可配置视频加速器+专门硬件加速器”这种创新的软硬件相结合的方式，继续升级公司自主研发的XBurst多媒体技术，保持公司产品在视频性能方面的领先地位。

(3) 3D图形处理技术：图形处理技术从2D升级到3D，完全符合OpenVG和OpenGL ES 2.0/1.1 图形标准，支持每秒2千万个三角形的处理能力，满足用户对3D图形用户界面、Flash、游戏等不断提高的兴趣和需求。

(4) 超高工艺后端物理实现技术：未来三年内公司芯片设计将从0.13 μm 工

艺逐步升级到65nm工艺和40nm工艺，公司将自主完成全部芯片的后端物理实现工作，在后端物理实现技术方面保持国内领先水平。

（5）软件平台：公司将在Linux、MiniOS系统平台基础上，推出基于XBurst CPU架构的Android软件平台，随着CPU架构的持续升级，不断地把Linux、Android软件平台升级到新的CPU架构和新的芯片。

3、产品开发计划

为了巩固和加强已有优势市场，开拓新的应用领域，公司在未来三年将面向便携消费电子、便携教育电子、移动互联网终端等领域开发性能更高、集成度更高的CPU芯片。

2010年到2012年，在现有便携消费电子CPU芯片基础上进行技术升级与改造，采用0.13 μ m/65nm工艺技术研发集成GPS基带IP核的新一代便携消费电子CPU芯片；在现有便携教育电子CPU芯片基础上进行技术升级与改造，采用0.13 μ m/65nm工艺技术研制集成EPD显示控制器IP核的新一代便携教育电子CPU芯片；基于公司自主创新的XBurst2多核CPU架构，采用65nm/55nm工艺技术研制用于移动互联网终端的CPU芯片。

4、人才发展计划

公司将持续实施人才战略，实行人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，完善激励机制，保持公司强大的核心竞争力。

（1）强化内部培训。通过建立和完善内部培训体系，采用多种培训方式，加快培养出一批素质高、专业能力强的芯片设计运营专才；与国内外知名集成电路设计企业开展技术交流，聘请行业专家来公司授课。通过培训，使现有员工队伍进一步适应公司快速发展步伐。

（2）不断引进外部人才。随着公司经营规模的不断扩大，管理的复杂程度日益加深，公司将面向知名院校和社会引进大批优秀的专业技术人才和管理人才，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求。

（3）进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发员工的创新能力，形成优秀的企业文化。

5、营销计划

（1）实施差异化的产品开发策略。公司坚持以客户需求为导向，以技术创新为支撑，通过提供在全球范围内具有性价比和低功耗优势的产品以及开放平台解决方案，逐渐丰富产品线的深度与宽度，形成高、中、低端系列化的产品布局，不断满足不同客户差异化的需求。

（2）实施重点客户销售策略。公司将集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供符合重点客户要求 and 市场发展需求的产品，帮助其提升技术创新水平，加快发展步伐，以期建立双赢的战略合作关系，增强自身抵御经营风险的能力。

（3）加强产业链合作伙伴关系。公司将进一步加强与产业链上下游核心合作伙伴的合作，巩固和提升业已建立的战略合作伙伴关系，不断整合和优化产业链的资源配置，为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件。

（4）扩大技术支持与销售服务网络，积极开拓海外市场。公司为客户提供更快、更有效的技术支持，并扩大销售服务网络，为客户创造更多的价值。同时，积极开拓海外市场，重点布局亚太区，让国产CPU技术传播到更多的国家和领域。

6、筹资计划

本次募集资金到位后，公司将加强研发流程管理和项目管理，力争早日产生效益。随着公司的进一步发展，公司将以股东利益最大化为原则，根据经营状况和项目规划，在保持合理负债结构的前提下，运用债务融资和自身积累相结合的方式筹措资金，保证公司稳健、持续、快速发展。截至目前，公司尚无特定的再融资计划。

7、收购兼并与对外扩充计划

本次发行后，公司不排除通过收购兼并的方法整合业内其它公司的资源，巩固和提升公司的市场竞争力和市场地位。公司目前还没有明确具体的收购对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。

二、本次募集资金运用对发行人未来发展以及增强成长性和自主创新的影响

本次募集资金的运用，是公司以现有主营业务为基础，结合未来市场需要而进行的产品技术升级、优化产品系列、实现产业化的重大战略，对公司的未来发展以及增强成长性和自主创新具有重要意义。

（一）有利于优化产品结构，增强公司核心竞争力

通过本次募集资金投资项目的实施，公司将大幅提升技术研发和技术支持能力，提高公司在中高端产品的国际竞争力，巩固和加强在便携消费电子、教育电子CPU芯片领域的市场领导地位，扩大在智能手机、平板电脑等CPU芯片市场规模，逐步形成高、中、低端系列化的产品布局，丰富产品线组合，优化产品结构，增强核心竞争力。

（二）有利于提升公司的市场占有率

本次募集资金投资项目中“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”和“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”是在业已成熟的市场领域进行，公司目前已经处于市场领导地位，具备较快的成长基础。

“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的实施将为公司拓展移动互联网应用领域创造积极的条件，移动互联网终端CPU芯片的产业化将形成公司新的利润增长点，扩大公司在该领域的市场份额，增强抗风险能力和可持续发展能力。

（三）有利于改善公司的财务结构

集成电路设计行业属于资金密集型行业，公司为了保持自己的领先优势，需要进行大规模、持续的技术开发投入。募集资金到位后，公司资产结构得以优化，为未来发展目标的实现提供充足的资金保障，公司抗风险能力进一步提高。

（四）有利于吸引和培养优秀人才

本次发行后，公司将可以通过建立市场化的股权激励制度持续对公司管理层、核心技术人员和业务骨干实施股权激励，将其个人利益与公司长远利益紧密结合，增强团队的凝聚力和稳定性，提高公司的自主创新能力，实现公司的可持续发展。

（五）有利于提升公司的整体实力

如果本次股票发行并成功上市，公司的法人治理结构、品牌、知名度、市场影响力、资源整合能力等将得到全面改善和提升，为公司的业务发展提供强有力的支持。

三、发展规划和目标的假设条件与面临的主要困难

（一）拟订发展规划和目标所依据的假设条件

1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且没有对公司发展将会产生重大不利影响的不可抗力情况发生；

2、国家对集成电路设计行业、高新技术产业和软件产业现有各项扶持政策支持没有重大不利变化，各项扶持政策得到贯彻执行；

3、本次发行能如期完成，募集资金能够及时足额到位；募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期效益；

4、发行人所在行业和领域的市场处于正常的发展状态下，没有出现重大的市场突变情形；

5、公司无重大经营决策失误以致严重影响公司正常运转，公司管理层及核心技术人员不发生重大变动；

6、公司与主要客户之间的合作关系继续保持稳定。

（二）规划实施和目标实现面临的主要困难

1、高级人才需求迫切

公司所处的集成电路设计行业，属于智力密集型行业，未来产品开发和业务拓展对集成电路设计专业技术人才和管理人才具有较大的需求。

2、资金投入不足

公司未来发展计划的实现，需要大量的资金投入作保障。经过近几年的高速发展，公司目前已经实现了一定的资本积累，但集成电路设计行业是个智力密集型和资本密集型的行业，公司为了保持技术领先，需要不断进行技术创新，这就必须有雄厚的资金实力作保障。现阶段，公司可抵押物较少，很难从银行获得足够的贷款支持；如果仅依靠自有资金，难以进行大规模、持续的技术开发投入。因此，能否借助资本市场，通过公开发行股票迅速筹集资金，成为本公司能否顺利实施发展计划的关键所在。

3、规模扩大对管理水平的挑战

现阶段，公司资产规模较小，管理架构也相对简单。随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、机制调整、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

（三）确保规划实施和目标实现拟采用的措施

1、充分发挥募集资金的作用

如果本次公开发行股票募集资金成功，将为公司实现上述业务发展目标提供资金支持。公司将认真组织募集资金投资项目的实施，持续技术创新，增强公司在集成电路设计行业的影响力。

2、加强技术人才和管理人才队伍建设

公司将加强技术人才和管理人才队伍建设，同时通过行之有效的人才激励制度，面向全球吸引高端人才，培育积极、包容的企业文化，打造国际一流的团队，

确保公司业务发展目标实现。

3、进一步完善公司内部运营管理机制

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

公司将根据集成电路设计行业特点，更加细化对产品研发、市场开拓、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，严格执行管理规定，全面提升运营效率。

四、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系

（一）现有业务为实现发展规划和目标提供了坚实的基础

公司目前的核心技术、产品知名度、产业化经验、市场影响力、各项管理制度是在现有业务的发展过程中逐渐积累起来的，既是公司最重要的无形资产，也为实现未来的业务发展目标打下了坚实基础。公司将坚持“创新技术，开放平台”的发展理念，专注于领先的国产创新CPU技术的自主研发及产业化，追求现有市场业务的持续发展并结合自身核心竞争力在新领域进行适当拓展。

（二）业务发展规划和目标是现有业务的延伸和发展

公司业务发展规划和目标一方面增加了产品种类、丰富了业务结构、扩展了业务领域，另一方面，大大提高了现有产品的技术水平和技术创新，能够巩固公司的技术优势和行业地位，并建立持续稳定的盈利模式。

五、公司关于公告规划实施和目标实现情况的声明

本公司声明：本次发行上市完成后，公司将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

第十二节 其他重要事项

一、重大合同

本节重大合同指公司目前正在履行的、交易金额超过 200 万元的合同，或者交易金额虽未超过 200 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至本招股说明书签署之日，公司（包括香港君正集团、君正时代）已签署、正在履行的重大合同如下：

（一）销售合同

公司对外销售分为直销和经销两种方式，其中经销方式通常是与经销商签订框架协议，协议项下的具体交易事项采用订单的形式进行。截至本招股说明书签署之日，公司正在履行的重大销售合同及框架协议情况如下：

1、2010 年 4 月 15 日，公司与深圳华辉订立《代理协议》，指定深圳华辉作为授权区域内的非独家代理商，按协议约定条件代理公司的产品销售及售后服务；自公司产品发出并经深圳华辉确认之日起，深圳华辉自行承担销售和库存风险，并在账期内尽早向公司支付货款；协议有效期两年。

2、2010 年 4 月 1 日，公司与创兴国际订立《代理协议》，指定创兴国际作为授权区域内的非独家代理商，按协议约定条件代理公司的产品销售及售后服务；付款条件为款到发货，自公司产品发出并经创兴国际确认之日起；创兴国际自行承担销售和库存风险，并在账期内尽早向公司支付货款；协议有效期两年。

3、2010 年 7 月 9 日，公司与步步高订立《订货合同》，约定公司向步步高提供总价款为 4,060,684.60 元的芯片，质量要求按双方技术协议或双方签板认可之样品，付款方式为月结 0 天。

（二）委托加工合同

公司与主要晶圆制造、切割、封装和测试企业签订了框架协议，建立了长期合作关系，双方对框架协议项下的具体交易事项采用订单的形式进行。截至本招股说明书签署之日，公司正在履行的重要委托加工框架协议情况如下：

1、2005年9月，君正有限与中芯国际签订《集成电路芯片代工协议》，约定中芯国际为君正有限代工集成电路芯片（晶圆），具体代工产品的要求由君正有限在具体的订单中指定、并经中芯国际的书面同意，代工产品的具体价格由双方协商并体现在君正有限发给中芯国际的订单中。该协议自签订之日起生效。

2、2009年12月25日，公司与深圳安博电子有限公司（以下简称“安博”）签订《加工合同》，约定由公司提供8英寸圆片、IC和加工要求，安博负责减薄、切割。该合同有效期一年，到期双方如无异议顺延一年。

3、2009年12月25日，公司与安博签订《加工合同》，约定由公司提供12英寸圆片、IC和加工要求，安博负责减薄、切割。该合同有效期一年，到期双方如无异议顺延一年。

4、2009年12月25日，公司与安靠公司签订《集成电路封装测试委托服务合约》，委托安靠公司为公司制造的晶圆或集成电路进行封装和典型测试。该合约有效期一年，到期自动展延。

5、2009年12月25日，公司与东莞英展电子有限公司签订《委托测试合约书》，约定由公司提供封装IC与测试所必需的电路板模块及软件，由东莞英展代为测试，并依公司制定标准分类、检验与包装。该合约有效期至2011年12月31日。

6、2009年12月25日，公司与东莞英展签订《委托加工合约书》，约定由公司提供集成电路硅晶圆，由东莞英展代为加工、装配成为各类型式之塑料立体型集成电路。该合约有效期至2011年12月31日。

（三）技术许可合同

截至本招股说明书签署之日，公司正在履行的全部技术许可合同情况如下

表：

序号	授权方	授权技术及内容	支付方式	签订日期	有效期限
1	四川和芯微电子股份有限公司	USB2.0 Device PHY/Audio Codec/SAR ADC/OSC IP 设计技术	起始费用 + 提成费用	2010年 4月8日	2017年 4月7日
2	四川和芯微电子股份有限公司	USB2.0 Device PHY/SAR ADC/RTC IP 设计技术	起始费用 + 提成费用	2010年 4月8日	2017年 4月7日
3	四川和芯微电子股份有限公司	针对 SMIC 0.18 μ m 工艺的 USB2.0 Device PHY/SAR ADC/RTC 设计技术	起始费用 + 提成费用	2010年 4月8日	2017年 4月7日
4	四川和芯微电子股份有限公司	针对 SMIC 0.18 μ m 工艺的 USB2.0 Device PHY/SAR ADC/RTC 设计技术	起始费用 + 提成费用	2010年 4月8日	2017年 4月7日
5	Vivante Corporation	GC400 GPU Core 和 GC400 Driver Software 使用授权	起始费用 + 提成费用	2009年 4月1日	无期限
6	RealNetworks, Inc.	Real Format Client Code 产品技术及相关格式的使用认证和授权	起始费用 + 提成费用	2008年 7月7日	2011年 7月6日
7	DOLPHIN Integration SA	hiCODlv-9001 2G	起始费用 + 提成费用	2008年 1月14日	无期限
8	DOLPHIN Integration SA	hiCODlv-9001 2G	起始费用 + 提成费用	2008年 12月24日	无期限
9	DOLPHIN Integration SA	shCOD95.BT01-Helium shCOD95-SP03-Helium2-2V5	起始费用 + 提成费用	2009年 7月24日	无期限
10	Synopsys International Limited	DWC USB2 nanoPHY	一次性初始费用	2009年 5月20日	无期限
11	国际绿色芯片有限公司	Analog IP set 及相关特定程序技术	一次性初始费用	2010年 3月24日	24个月
12	芯原微电子（上海）有限公司	S13V33_ADC_08C_8C12B1M	一次性初始费用	2009年 8月14日	无期限
13	芯原微电子（上海）有限公司	Power Switch cell DCAP cell	一次性初始费用	2009年 10月26日	无期限
14	昊迪移通（北京）技术有限公司	H3DAudio 三维音效软件库	一次性初始费用	2010年 1月6日	2010年 12月31日

（四）借款合同

2010年6月23日，公司与北京银行海淀园支行签订《借款合同》（合同编号：0071597），向北京银行海淀园支行借款1,500万元，提款日为2010年6月30日之前，贷款利率即提款日同期基准利率，借款期限自首次提款日起6个月，贷款用途为补充流动资金。

（五）房屋租赁合同

1、2008年11月25日，君正有限与中关村软件园公司签订《房屋租赁合同》，

承租中关村软件园信息中心 A 座 106#、107#、108# 三间办公用房。租赁房屋用途为研发及办公用房；房屋建筑面积为 1,171.26 平方米；租赁期限自 2008 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日；房屋租金及支付方式为：2010 年 11 月 30 日前租金为 3.2 元/平方米/日，年租金 1,368,031.68 元，2010 年 12 月 1 日起租金为 3.4 元/平方米/日，年租金 1,453,533.66 元，租金按季度缴付。

2、2009 年 6 月 22 日，君正时代与深圳集成电路设计产业化基地管理中心签订《房屋租赁合同》，承租位于深圳市南山区高新中二道 2 号深圳国际软件园 4 栋 301-305、322-326 房。租赁房屋用途为厂房；租赁房屋建筑面积为 755.6 平方米；租赁期限自 2009 年 7 月 16 日至 2010 年 4 月 30 日；房屋租金为 40 元/平方米/月，月租金总额 30,224.00 元。2010 年 3 月 23 日，君正时代与深圳集成电路设计产业化基地管理中心签订《续租约定》，约定将上述房屋的租期延长至 2011 年 4 月 30 日，其他条款按原合同不变。

（六）其他重大合同

1、2009 年 9 月 28 日，君正有限与中关村软件园公司签订了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定由中关村软件园公司对位于中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-2 号地块进行一级开发（具体包括地上物拆除、市政建设、基础设施建设、城市绿化隔离带和公共绿地景观建设等），君正有限向中关村软件园公司承担土地开发费 26,512,920.00 元（不包含土地出让金），分三期支付。该地块面积 5,845 平方米，规划允许地上建筑面积为 7,014 建筑平方米，用地性质为教育科研用地。目前公司已经支付前两期费用共计 23,861,628.00 元。

由于中关村软件园公司未按上述协议约定在 2009 年 11 月 15 日前完成“三通一平”工作，公司亦未向中关村软件园公司支付最后一期土地开发费。2010 年 8 月 4 日，公司与中关村软件园公司签署《补充协议》，双方约定中关村软件园公司不追究公司未在原协议签订之日起 180 日内支付最后一期土地开发费的违约责任，公司亦不追究中关村软件园公司未在 2009 年 11 月 15 日完成“三通一平”工作的违约责任，在中关村软件园公司完成上述土地“三通一平”并书面

通知公司的 10 个工作日内，公司应向中关村软件园公司支付最后一期土地开发费。

2、2010 年 3 月 22 日，公司与齐鲁证券签订《北京君正集成电路股份有限公司与齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股之承销暨保荐协议》，聘请齐鲁证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商。

二、对外担保事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在任何对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

1、公司的重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，公司未涉及任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等有重大影响的诉讼及仲裁事项，未面临任何有重大影响的诉讼事项。

2、公司主要关联人的重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

3、控股股东、实际控制人最近三年内的重大违法行为

公司控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为。

4、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

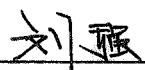
截至本招股说明书签署之日，公司没有董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事起诉的情况。

第十三节 有关声明

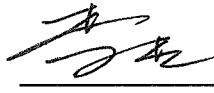
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

北京君正集成电路股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）



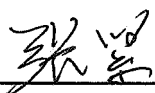
刘 强



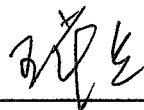
李 杰



刘维锦



张 紧

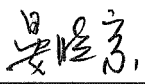


王芹生

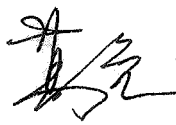


傅代国

全体监事（签名）



晏晓京

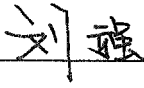


葛 亮

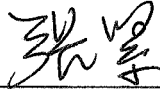


姜 君

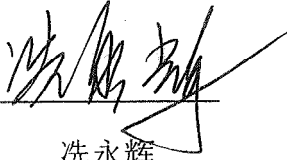
高级管理人员(签名)



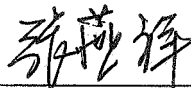
刘 强



张 紧



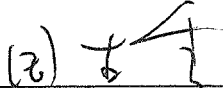
洗永辉




张燕祥



张 敏



周生雷



赖亚明

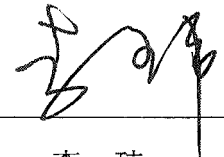


北京君正集成电路股份有限公司

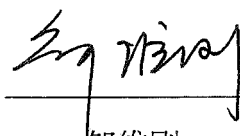
2010年 11月 8日

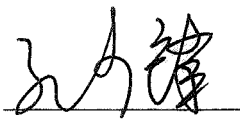
二、保荐机构（主承销商）声明

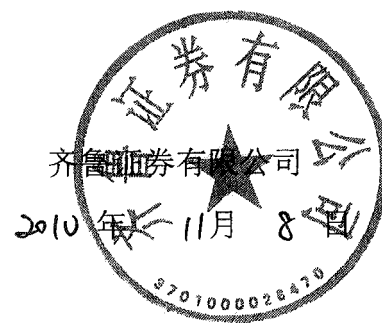
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
李 玮

保荐代表人： 
陈正旭


郇维刚

项目协办人： 
孔少锋



三、发行人律师声明

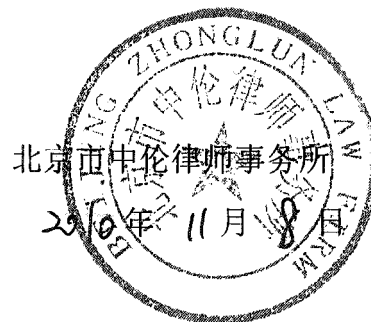
本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人: 张学兵
张学兵

经办律师: 任理峰
任理峰


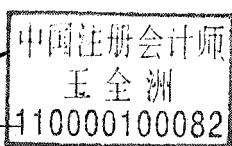
许志刚
许志刚



谢珊
谢珊

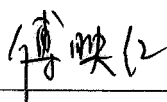
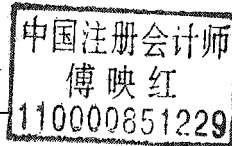


四、 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  
 王全洲

签字注册会计师：  
 谭红旭

 
 傅映红

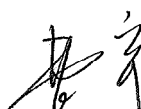
北京兴华会计师事务所有限责任公司
 2010年11月8日




五、资产评估机构声明


本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:


曹宇

签字注册资产评估师:


赵 Junping

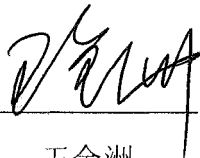

汤淑娟

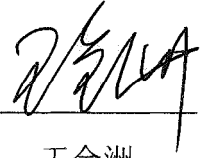
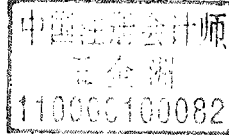
北京中科华资产评估有限公司

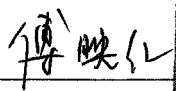

2010年11月8日

六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人：  
王全洲

签字注册会计师：  
王全洲

 
傅映红

北京兴华会计师事务所有限责任公司

2010年11月8日

第十四节 附 件

一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在公司和保荐机构（主承销商）办公场所查阅，该等文件也已在中国证监会指定网站披露。

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查地点、时间

（一）备查地点

发 行 人：北京君正集成电路股份有限公司

地 址：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A 座 108 室

电 话：010-82825005

传 真：010-82825845

联 系 人：张敏

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

地 址：山东省济南市经十路 20518 号

电 话：0755-82792736

传 真：0755-82792736

联 系 人：胡伟

（二）备查时间

周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00

三、信息披露网址

深圳证券交易所指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn

北京君正集成电路股份有限公司

二〇一〇年十一月八日

